

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

重庆物奇微电子股份有限公司

(Chongqing Wuqi Microelectronics Co., Ltd.)

(重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼)



首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 (申报稿)

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



(上海市静安区新闻路 1508 号)

联席主承销商



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



重庆市江北区金沙门路 32 号

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

一、发行人上市的目的

（一）把握发展机遇，助力新质生产力培育，服务国家重大战略

发行人是国内较早全面采用 RISC-V 架构并实现商业化量产落地的芯片设计企业。自设立以来，公司始终专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发与销售，主要产品应用于网络通信与端侧智能两大领域，同时为客户提供 SoC 芯片定制服务。

当前，以发行人为代表的国产芯片设计企业在关键技术与高端应用市场方面已取得重要突破，但在综合研发实力、核心技术深度及优质客户资源积累等方面，与国际行业巨头仍存在一定差距。RISC-V 架构的开放性与灵活性为我国芯片产业提供了重要发展机遇，公司作为该架构在国内的先行者之一，具备显著先发优势和成熟的产业化能力。

借助本次上市契机，发行人将进一步聚焦并拓展以 RISC-V 异构多核 SoC 架构为核心的技术体系，深化“连接中枢+端侧入口”双轮驱动模式，持续攻坚高端 Wi-Fi 芯片自主化与端侧多模态智能感知技术。公司将主动把握国家加快建设网络强国、完善信息通信网络、实施人工智能战略等重大部署带来的发展机遇，助力新质生产力的培育与发展，不断缩小与世界先进水平的差距。

（二）持续强化研发能力，加速新产品迭代升级，保持技术与核心竞争力优势

公司采用 Fabless 经营模式，所处行业为技术与人才密集型，研发实力和人才储备是核心竞争力的根本。经过多年积累，公司已在 RISC-V 架构芯片设计、Wi-Fi 通信、端侧智能感知等领域形成扎实的技术基础，并实现了规模化应用。

本次上市后，公司将借助资本市场资源整合优势，通过多元化激励政策吸引更多行业优秀人才及技术专家加盟，着力扩充核心研发团队，构建结构更优化、专业更全面的高素质研发队伍，加速产品迭代升级与技术成果转化。在长期由境外厂商主导的高端 Wi-Fi AP 芯片领域，公司将以已实现量产突破的 Wi-Fi 6 AP 芯片为基石，加速推进 Wi-Fi 7 AP 芯片的研发；同时，依托端侧智能芯

片领域积累的规模化应用基础，持续迭代先进制程产品，并前瞻布局端侧多模态智能感知与轻量化 AI 计算能力。通过强化自主创新与完善知识产权体系，公司稳步突破行业壁垒，在激烈的市场竞争中巩固技术优势，持续提升核心竞争力。

（三）优化治理结构，提升经营水平，与投资者共同分享公司成长价值

借助本次上市规范运作契机，发行人将进一步完善法人治理结构，主动吸纳投资者（尤其是中小投资者）的合理意见建议，严格按照资本市场高标准规范公司运作流程，重点提升财务信息透明度、优化科学决策机制、强化风险管理能力，进而全面提升企业运营效能、专业化经营水平与抗风险能力。依托行业发展红利及自身核心技术优势，发行人将持续全面提升品牌影响力、扩大市场份额、增强经营韧性，在实现自身高质量发展的同时，切实保障投资者合法权益，实现长期稳健发展，与全体投资者共同分享公司成长带来的价值回报，积极回应投资者的合理投资诉求。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

发行人建立健全了完善的现代企业制度，已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次募集资金将投向新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目、端侧智能芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目并补充公司流动资金。本次募集资金使用将紧密围绕公司网络通信芯片与端侧智能芯片的研发、设计与销售等主营业务展开，紧跟行业技术演进趋势，聚焦主营产品在代际更迭与工艺制程上的迭代升级、前沿技术的研发布局与核心技术储备，全面提升公司核心竞争力与市场地位。本次募集资金投资项目的实施，将有效助力公司强化人才队伍建设以支持产品研发与技术深耕，加速核心技术成果转化，为公司持续高质量发展奠定坚实基础，更好服务国家半导体产业战略需求。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

报告期内，依托在短距通信领域积淀的深厚技术基础，发行人持续加大研发投入力度、推进核心技术创新，已系统掌握 RISC-V 架构、蓝牙、Wi-Fi、NPU、MIPI 设备及软件生态等全流程核心技术，形成了一系列自主知识产权成果，相关技术可高效复用至公司各产品线开发及定制化业务中，为产品迭代升级与业务规模拓展提供了坚实的技术支撑。

依托上述核心技术体系，发行人产品涵盖 Wi-Fi AP 芯片、Wi-Fi STA 芯片、智能音频主控芯片等。在网络通信芯片领域，一方面，发行人自主研发的基于 RISC-V 架构的 Wi-Fi 6 AP 芯片，在多项关键性能指标上达到国际领先水平，是截至目前极少数具备量产能力的中国大陆企业，该产品已于 2025 年第四季度正式启动客户小批量交付，为我国信息基础设施建设筑牢自主独立的“连接底座”；另一方面，发行人自主研发的 Wi-Fi STA 芯片已覆盖 Wi-Fi 4 至 Wi-Fi 6 全系列，应用于电视、安防等领域，服务创维集团、客户 A、客户 B 等终端客户。在端侧智能芯片领域，发行人自主研发的智能音频主控芯片已在智能耳机、智能眼镜领域实现大规模批量出货，并持续加大研发投入，进一步提升产品竞争力与场景适配能力，获得了客户与市场的广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。

受益于科技创新能力持续转化、主要产品品质稳定、客户认可度不断提升，发行人报告期内营业收入稳步增长，持续经营能力不断增强。

未来，公司将顺应行业发展趋势，紧密围绕国家产业政策导向、行业技术迭代方向及下游市场核心需求，以现有产品为根基，充分发挥各产品间的协同效应，持续完善现有产品布局。一方面，公司将持续投入 Wi-Fi 芯片的研发工作，提升技术水平与产品性能，为数字经济发展提供可靠的网络基础设施支持；另一方面，公司将积极把握人工智能产业发展机遇，深度融合高性能网络连接能力与人工智能端侧入口能力，依托自身在芯片设计领域技术积累与研发优势，稳步拓展各产品线边界，为客户提供高性能、多样化、定制化的系统级解决方案。公司将通过持续拓展产品应用领域、扩大客户覆盖范围，为人工智能的泛在赋能提供坚实支撑，进而提升公司核心竞争力与市场地位，实现可持续发展。

董事长：


郑建生（Jason ZHENG）



重庆物奇微电子股份有限公司

2026年6月26日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行股数不超 87,335,000 股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。如本次发行及上市采用超额配售选择权的，则因行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行及上市的一部分，本次发行及上市股票数量的上限应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行及上市股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终发行数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门的核准为准
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 34,920.00 万股
保荐人、主承销商	光大证券股份有限公司
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目录

重要声明	1
致投资者声明	2
一、发行人上市的目的.....	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....	3
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	3
四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....	4
本次发行概况	6
目录.....	7
第一节 释义	12
一、普通术语.....	12
二、专业术语.....	14
第二节 概览	18
一、重大事项提示.....	18
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	20
三、本次发行概况.....	21
四、发行人主营业务情况.....	22
五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.....	25
六、发行人主要财务数据及财务指标.....	26
七、财务报告审计截止日后主要经营情况.....	26
八、发行人选择的具体上市标准.....	26
九、发行人公司治理特殊安排.....	27
十、募集资金用途.....	27
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	28
第三节 风险因素	29
一、与发行人相关的风险.....	29
二、与行业相关的风险.....	34
三、其他风险.....	35
第四节 发行人基本情况	37

一、发行人基本信息.....	37
二、发行人改制设立情况.....	37
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.....	60
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况	60
五、发行人的股权结构.....	60
六、发行人控股子公司、参股公司简要情况.....	61
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	66
八、发行人公司治理特殊安排.....	73
九、发行人有关股本情况.....	73
十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.....	100
十一、公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.....	100
十二、董事（含董事会审计委员会）、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.....	113
十三、董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况	122
十四、董事、高级管理人员及核心技术人员近二年的变动情况.....	123
十五、董事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.....	125
十六、董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.....	126
十七、发行人员工及社会保障情况.....	128
第五节 业务与技术	134
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况.....	134
二、发行人所处行业的基本情况.....	146
三、发行人销售情况和主要客户	177
四、发行人采购情况和主要供应商.....	180
五、发行人对主要业务有重大影响的主要固定资产和无形资产	182
六、发行人核心技术和研发情况.....	185
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.....	204
八、境外生产经营情况.....	205

第六节 财务会计信息与管理层分析	206
一、财务报表	206
二、注册会计师审计意见类型	211
三、关键审计事项及重要性水平	211
四、财务报表编制基础	212
五、合并报表范围及变化	213
六、主要会计政策和会计估计	213
七、税项	222
八、非经常性损益情况	225
九、发行人主要财务指标	226
十、经营成果分析	227
十一、资产质量分析	259
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	276
十三、报告期内重大资产重组、重大资本性支出事项	290
十四、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项	290
十五、发行人盈利预测	291
十六、未来实现盈利的前瞻性信息	291
第七节 募集资金运用与未来发展规划	297
一、募集资金使用管理制度及对发行人主营业务贡献	297
二、募集资金投资项目概况	299
三、募集资金具体运用情况	303
四、公司发展战略和业务发展目标	311
第八节 公司治理与独立性	316
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况	316
二、发行人内部控制情况	316
三、发行人最近三年违法违规行为及受到处罚性	316
四、发行人资金占用和对外担保情况	317
五、面向市场独立持续经营的能力情况	317
六、同业竞争	318
七、关联方及关联关系	319

八、关联交易.....	322
第九节 投资者保护	325
一、本次发行前滚存利润的股利分配政策和已履行的决策程序.....	325
二、发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红政策.....	325
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.....	327
四、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况及投资者保护措施.....	327
第十节 其他重要事项	328
一、重要合同.....	328
二、对外担保情况.....	331
三、重大诉讼或仲裁事项.....	331
第十一节 声明	333
一、发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明.....	333
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	335
三、保荐人（主承销商）声明.....	336
四、保荐人（主承销商）总裁声明.....	337
五、保荐人（主承销商）董事长声明.....	338
联席主承销商声明.....	339
联席主承销商声明.....	340
六、发行人律师声明.....	341
七、会计师事务所声明.....	342
八、验资机构声明.....	343
九、资产评估机构声明.....	344
第十二节 附件	345
一、备查文件.....	345
二、查阅时间.....	345
三、查阅地点.....	345
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票 机制建立情况.....	346
五、与投资者保护相关的重要承诺.....	351

六、股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明.....	389
七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....	391
八、发行人主要无形资产情况.....	392
九、发行人曾经的关联方.....	408

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、普通术语

名词		释义
物奇微、发行人、公司、本公司	指	重庆物奇微电子股份有限公司
物奇微有限	指	重庆物奇微电子有限公司，系发行人前身
物奇科技	指	重庆物奇科技有限公司，系发行人全资子公司
上海物骐微	指	上海物骐微电子有限公司，系发行人全资子公司
香港物奇	指	WuQi Micro (HongKong) Limited，系发行人全资子公司
长沙物奇微	指	长沙物奇微电子有限公司，系发行人全资子公司
杭州物奇微	指	杭州物奇微电子有限公司，系发行人全资子公司
北京物奇	指	北京物奇科技有限公司，系发行人全资子公司
新加坡物奇	指	WUQI MICRO (SINGAPORE) PTE. LTD.，系香港物奇全资子公司
智联讯科	指	重庆智联讯科科技有限公司，系发行人曾经的全资子公司，已于 2023 年 12 月 15 日注销
上海物麒	指	上海物麒科技有限公司，系发行人曾经的全资孙公司，已于 2024 年 2 月 23 日注销
航中天启	指	航中天启（重庆）微电子股份有限公司，曾用名航天中电科技（重庆）微电子有限公司、航天中电科技（重庆）有限公司，曾经系物奇科技控股子公司
NATIVE	指	NATIVE EXPLORER LIMITED，系发行人机构股东
中移股权基金	指	中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
哈勃投资	指	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
鼎精投资	指	景宁鼎精企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人机构股东，曾用名上海鼎精投资中心（有限合伙）、上海鼎精企业管理咨询中心（有限合伙）
南方工业基金	指	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
惠友投资	指	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
ASTREND	指	Astrend Opportunity IV (HongKong) Alpha Limited，系发行人机构股东
智城二号	指	深圳市智城数智二号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
临空远翔	指	重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾经系发行人机构股东
清研华业	指	重庆清研华业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机

名词		释义
		构股东
佳禾电声	指	江西佳禾电声科技有限公司，系发行人机构股东
聚源创投	指	聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东，曾用名中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
ANKER	指	Anker Innovations Limited，系发行人机构股东
君丰桐芯	指	嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
北碚西证	指	重庆北碚西证私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
大河融科	指	北京大河融科创业投资有限公司，系发行人机构股东
商功投资	指	杭州商功股权投资有限公司，系发行人机构股东
合顺盈二号	指	共青城合顺盈稳创二号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
长沙华业	指	长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
承远壹号	指	深圳市承远壹号投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
泰科源	指	深圳泰科源电子器件科技有限公司，系发行人机构股东
荣泽投资	指	北京荣泽投资管理有限公司，系发行人机构股东
盈趣科技	指	厦门盈趣科技股份有限公司，系发行人机构股东
重泰资本	指	深圳重泰资本投资企业（有限合伙），系发行人机构股东
科兴科创	指	重庆科兴科创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
信见成	指	重庆信见成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
利和丰投资	指	厦门利和丰股权投资有限公司，系发行人机构股东
睿鲸云锦	指	共青城睿鲸云锦二号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
合泰昇通	指	天津合泰昇通国际贸易合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
渝富益华	指	重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
豫富君冻	指	嘉兴豫富君冻壹号投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
重庆战新	指	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
洪泰嘉晟	指	重庆渝北洪泰嘉晟创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
远致星火	指	深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东
物奇壹	指	重庆物奇壹企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
物奇贰	指	重庆物奇贰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台

名词		释义
物奇叁	指	重庆物奇叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
物奇肆	指	重庆物奇肆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
物奇伍	指	重庆物奇伍企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
物奇陆	指	重庆物奇陆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
物奇捌	指	上海物奇捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
华奇恒	指	重庆华奇恒企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人曾经的员工持股平台
临空开发	指	重庆临空开发投资集团有限公司，系发行人原股东
光大富尊	指	光大富尊投资有限公司，系发行人原股东
靖烨投资	指	靖烨投资集团有限公司，系发行人原股东
华润创投	指	汕头市华润创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人原股东
润科投资	指	润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人原股东
本次发行	指	本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
招股说明书/本招股说明书	指	重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
发行人会计师、天健会计师、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒律师	指	北京德恒律师事务所
《公司章程》	指	《重庆物奇微电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年	指	2023年度、2024年度及2025年度
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

二、专业术语

名词		释义
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆

名词		释义
		片，经切割、封装等工艺后可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit 的简称，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
封装	指	将芯片转配为最终产品的过程，即把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试及成品测试
模拟芯片	指	用来处理模拟信号的集成电路
模拟信号	指	用连续变化的物理量表示的信号，信号的特性在一段时间内连续变化，如声音、光、压力等
SoC	指	System on Chip 的简称，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
IP	指	Intellectual Property 的简称，即知识产权，IP 核即知识产权模块
PLC	指	Power Line Carrier 的简称，即电力线载波通信，以输电线路为载波信号传输媒介的电力系统通信技术
HPLC	指	High-speed Power Line Carrier 的简称，即高速电力线载波，一种以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信，利用配电网作为传输媒介，实现数据传递和信息交换
蓝牙、BT	指	Bluetooth 的简称，一种支持设备短距离通信的无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的简称，指低功耗蓝牙技术，是短距离、低成本、可操作性的无线技术
Wi-Fi	指	Wireless-Fidelity 的简称，即无线上网，是一个创建于 IEEE802.11 标准的无线局域网技术
Wi-Fi 4	指	是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准（802.11n），支持 2.4GHz 和 5GHz 频段
Wi-Fi 5	指	是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准（802.11ac），支持 5GHz 频段，向下兼容 802.11a/b/g/n
Wi-Fi 6	指	是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准（802.11ax），支持 2.4GHz 和 5GHz 频段
Wi-Fi 7	指	是一项由 IEEE 标准协会制定无线局域网标准（802.11be），支持 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 频段
AI	指	Artificial Intelligence 的简称，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output 的简称，指多进多出，是为极大地提高信道容量，在发送端和接收端都使用多根天线，在收发之间构成多个信道的天线系统
QAM	指	Quadrature Amplitude Modulation 的简称，指正交幅度调制，系一种通过同时调制载波的幅度和相位来传输数字信号的调制方式。该技术将两路相互正交的载波信号分别进行幅度调制后叠加输

名词		释义
		出，可在相同带宽内提高数据传输效率
STA	指	Station 的简称，即客户端
AP	指	Access Point 的简称，即移动计算机用户进入有线网络的接入点
IoT	指	Internet of Things 的简称，即物联网，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
AIoT	指	人工智能物联网，融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化
DBDC	指	Dual Band Dual Concurrent（双频并发）的简称，是无线网络技术中的一种功能，可以同时两个频段上（通常是 2.4GHz 和 5GHz）进行数据传输。这种技术可以提高无线网络的容量和效率，因为它可以让设备同时连接到两个频段，从而更好地分配网络负载和避免干扰
MLO	指	Multi-Link Operation（多链路操作）的简称，一种通过聚合多个频段的无线信道以提升网络吞吐量和可靠性的技术方案
MCS	指	Modulation and Coding Scheme（调制编码方案）的缩写，一种通过索引值配置无线传输速率与可靠性平衡的技术参数组合
1×1	指	1×1 天线的简称，指的是一种天线系统，包括一个天线元件和一个无源单元（如放大器或变频器）。这种天线系统只有一个输入和一个输出，通常用于低成本、低功耗的应用，如 IoT 设备、智能家居设备、低功耗蓝牙设备等
2×2	指	2×2 天线的简称，指的是一种天线系统，包括两个天线元件和一个无源单元（如放大器或变频器）。这种天线系统有两个输入和两个输出，通常用于需要高速数据传输和更可靠的连接的应用，如高速无线网络、高清视频传输等
AR	指	Augmented Reality 的简称，即增强现实，是将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术
VR	指	Virtual Reality 的简称，即虚拟现实，是一种可创建和体验虚拟世界的技术
TWS	指	True Wireless Stereo 的英文缩写，即真正无线立体声，其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展，工作原理为手机通过连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用
OWS	指	Open Wearable Stereo（开放式可穿戴立体声系统）的缩写，是一种全新的全开放不入耳的声音解决方案，通常采用气传导方式，通过外耳膜、鼓膜、鼓室等传统气导传递介质，将电信号转化的声波振动信号直接通过颞骨传至听觉神经
SDK	指	Software Development Kit（软件开发工具包）的缩写，是为特定软件包、硬件平台或操作系统创建应用时的开发工具集合
Fabless	指	无工厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的研发设计、应用和销售，晶圆制造和封装测试环节通过委外加工完成
IDM	指	Integrated Device Manufacturing 的简称，即垂直整合制造模式，是涵盖集成电路设计、晶圆制造和封装测试等全产业链环节的一

名词		释义
		体化运作模式
PA	指	Power Amplifier 的简称，即功率放大器
LNA	指	Local Area Network 的简称，即局域网
AFE	指	Analog Front End 的简称，模拟前端。用于处理信号源过来的模拟信号，并将处理完的信号转换成数字信号送往后续数字电路进行处理。应用领域的不同，包含的功能模块也不同，一般包含模拟信号放大，信号调理和模数转换电路等
ADC	指	Analog-to-Digital Converter 的简称，将模拟信号转换成数字信号的设备
DAC	指	Digital-to-Analog Converter 的简称，把数字输入信号转换成模拟信号的电路或器件
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体）的缩写，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术
EVM	指	Error Vector Magnitude（误差向量幅度）的缩写，衡量数字调制信号质量的一种指标
DPD	指	Digital Pre-Distortion（数字预失真）的缩写，指一种用于无线通信系统中补偿功率放大器非线性失真、提高信号质量和效率的技术
MAC	指	Medium Access Control 的简称，即介质访问控制层，主要包括信道访问控制技术、算法、协议等
RISC-V	指	基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计
CPU	指	Central Processing Unit 的简称，即中央处理器，是信息处理、程序运行的最终执行单元
NPU	指	Neural-network Processing Unit 的简称，即神经网络处理器，采用“数据驱动并行计算”的架构，特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据
DSP	指	Digital Signal Processing 的简称，即数字信号处理，专注于对音频、图像、传感器等连续物理信号进行实时、高速的数字处理
ISP	指	Image Signal Processor 的简称，即图像信号处理，主要对前端图像传感器输出的信号进行后期处理，以优化图像质量
ANC	指	Active Noise Cancellation，主动降噪简称，一种用于耳机降噪的方法。通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音抵消，从而实现降噪的效果
ENC	指	Environmental Noise Cancellation，通话环境降噪技术的简称，采用单麦、双麦或多麦克风阵列，精准计算语音者说话的位置，在保护主方向目标语音的同时，消除环境中的干扰噪音，为用户提供高品质的语音通话效果
FTTR	指	Fiber to The Room（光纤到房间）的缩写，一种通过光纤实现全屋千兆级覆盖的组网技术

招股说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。

（一）特别风险因素

1、报告期内尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-30,042.97 万元、-23,850.84 万元和-21,343.52 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-30,751.75 万元、-24,402.79 万元和-22,086.71 万元；截至 2025 年末，累计未分配利润为-85,465.36 万元。发行人报告期内尚未盈利，且最近一期末存在累计未弥补亏损。

上述情况主要系公司为保持核心技术与产品的先进性，在报告期内持续进行大额研发投入所致。目前公司仍处于快速发展阶段，若未来未能按计划实现销售规模扩张，或产品总体市场需求出现大幅下滑，则公司营业收入可能无法达到预期水平，未来一定期间内仍存在无法盈利的风险。上述情形可能导致公司现金流紧张，进而对业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入及市场开发等方面造成不利影响。

2、新产品推广不及预期风险

发行人产品主要应用于网络通信及端侧智能领域。

在网络通信领域，尤其是 Wi-Fi 芯片市场，长期以来由博通、高通、联发科及瑞昱等巨头主导，行业集中度较高。国内厂商需要持续投入技术研发、优化产品性能、拓展市场渠道并完成客户验证，方能逐步突破现有市场格局。其中，Wi-Fi AP 芯片作为路由器、网关、FTTR 等网络通信基础设施的核心器件，下游品牌客户对性能、稳定性及安全性要求极高，导致新产品准入难度大、验证周期长。因此，公司未来 Wi-Fi 6 AP 芯片的销售规模化放量进程有赖

于在关键客户处的验证通过及批量供货节奏；Wi-Fi STA 芯片的持续放量则取决于在电视、安防领域客户处的应用拓展及客户采购规模。

在端侧智能领域，由于市场需求及产品更新相对迅速，这要求公司持续提升研发效率，能够紧跟下游客户的产品迭代节奏，精准匹配多样化应用场景，产品具备快速响应与灵活适配能力，否则难以实现规模化推广。

若公司在上述重点客户的导入过程中出现验证周期延长、产品认证未通过或客户采购不及预期等情形，相关产品的收入增长将无法达到预期，可能对公司未来业绩增长及整体经营状况产生不利影响。

3、研发结果未达到预期或无法产业化风险

公司所在的集成电路设计行业为技术密集型行业，前沿技术的研发、新产品的开发及现有产品的迭代升级均需要持续且高强度的资源投入。为保持技术领先优势与市场竞争力，公司需紧密跟踪技术演进趋势及下游市场需求，在网络通信芯片及端侧智能芯片领域不断进行研发深耕。报告期各期，公司研发投入金额分别为 28,972.20 万元、25,107.80 万元和 23,472.59 万元，占主营业务收入的比重分别为 98.10%、48.85%和 41.55%，研发投入规模较大且占比较高。

集成电路芯片的研发过程涉及前端设计、后端验证、流片试产、系统测试等多个复杂环节，研发周期长、技术难度高、不确定性较大。若公司研发项目未能顺利实现产业化，或公司新开发的产品在性能、功耗、成本、集成度等方面不及竞争对手，公司将面临研发成果无法实现预期经济效益的风险，前期投入的大量研发资源将难以在短期内转化为收入，可能对公司的财务状况及盈利能力造成不利影响。

（二）发行人对未来的预测性信息

本招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提请投资者注意，本招股说明书的预测性陈述仍存在不确定性，公司存在无法在 2028 年实现扭亏为盈的风险。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股说明书所载明的任何预测性及前瞻性陈述，不应被视为本公司的承诺与声明。

（三）本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者阅读本公司、股东、董事、审计委员会委员、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况等事项。详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的重要承诺”。

（四）本次发行后公司的利润分配政策

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、（二）发行后的股利分配政策、决策程序”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	重庆物奇微电子股份有限公司	成立日期	2018年7月3日
注册资本	26,186.50 万元	法定代表人	郑建生
注册地址	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼	主要生产经营地址	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼
控股股东	无	实际控制人	郑建生
行业分类	I6520 集成电路设计	在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况	无

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人	光大证券股份有限公司	主承销商	光大证券股份有限公司
发行人律师	北京德恒律师事务所	其他承销机构	国泰海通证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	坤元资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股说明书签署之日，保荐机构控股股东中国光大集团股份有限公司所投资的主体是发行人股东穿透过程中出现的间接出资人，穿透层级较远且穿透后持股比例极低，合计间接持有发行人的股份不足 0.005%。该间接投资行为系相关投资主体所作出的独立投资决策，并非保荐机构相关主体主动针对发行人股份进行投资。 发行人股东北碚西证执行事务合伙人之一西证股权投资有限公司系为本次发行联席主承销商之一西南证券股份有限公司的全资子公司。	

	除上述情况外，发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。
--	---

（三）本次发行的其他有关机构

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	中国民生银行上海分行 陆家嘴支行
其他与本次发行有关的机构	无		

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	87,335,000 股	占发行后总股本比例	25.01%
其中：发行新股数量	87,335,000 股	占发行后总股本比例	25.01%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	349,200,000 股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采取网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式或证券监管机构认可的其他方式		
发行对象	符合相关资格规定的询价对象和在上交所开立股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（国家法律或法规禁止购买者除外）		

承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目
	端侧智能芯片研发及产业化项目
	研发中心建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

（二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期	【】年【】月【】日
缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

发行工作具体日期，请投资者关注发行人及保荐机构（主承销商）光大证券在相关媒体披露的公告。

四、发行人主营业务情况

（一）发行人主要业务

发行人是国内较早全系采用 RISC-V 架构，并实现商业化落地与量产的芯片设计企业。自设立以来，专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发和销售，并为客户提供 SoC 芯片定制服务。发行人致力于短距通信与端侧智能的深度融合，现已构建由高带宽低时延通信技术、端侧多模态 AI 算法及超低功耗数模混合芯片设计组成的三大核心能力，并以此为基础搭建了完善的自主研发平

台，形成了“连接中枢+端侧入口”双轮驱动的业务方向。截至目前，发行人产品主要应用于网络通信与端侧智能两大领域。

在网络通信芯片领域，发行人先后推出 Wi-Fi STA 芯片与 Wi-Fi AP 芯片，全面布局从连接到中枢的核心环节。历经多年持续攻关，发行人在 Wi-Fi AP 芯片的射频前端架构设计、基带信号处理及 SoC 系统集成等关键技术领域实现重大突破，成功研发基于 RISC-V 架构、性能比肩国际主流的 Wi-Fi 6 AP 芯片，是截至目前极少数掌握自主知识产权并具备量产能力的中国大陆企业，成为打破国际巨头在高端路由器芯片领域的长期垄断格局的重要力量。在 Wi-Fi 终端连接方面，公司 Wi-Fi STA 芯片已覆盖 Wi-Fi 4 至 Wi-Fi 6 全系列，广泛应用于电视、安防等领域，服务的终端客户包括创维集团、客户 A、客户 B 等知名企业，真正实现从终端到中枢的“智联万物”。

在端侧智能芯片领域，发行人推出的智能音频主控芯片，广泛适用于智能耳机、智能眼镜等终端设备。

截至报告期末，发行人已获得授权专利 141 项，其中境内专利 121 项（含发明专利 109 项）、境外专利 20 项，专利布局紧密围绕核心产品及相应核心技术，形成了完善的知识产权保护体系。此外，公司还获评国家级专精特新“小巨人”企业，连续三年获得中国 IC 设计成就奖、成功入选中国 IC 设计 Fabless100 排行榜之 Top10 无线连接芯片公司；发行人研发的 Wi-Fi 6 AP 芯片荣膺 2025 中国创新 IC-强芯领航奖；2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片凭借稳定的传输性能和国际领先的低功耗表现，获得“中国芯”优秀技术创新产品奖。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、芯片产品	56,369.28	99.77%	51,120.54	99.46%	28,409.42	96.19%
端侧智能芯片	45,470.45	80.48%	44,167.03	85.93%	17,486.90	59.21%
网络通信芯片	10,898.84	19.29%	6,953.52	13.53%	10,922.52	36.98%
二、定制开发及技术服务	84.20	0.15%	240.32	0.47%	1,038.02	3.51%
三、其他	43.35	0.08%	36.68	0.07%	87.25	0.30%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

（二）发行人主要经营模式

自成立以来，发行人始终采用 Fabless 经营模式，即无晶圆厂模式。在该模式下发行人专注于从事芯片的研发设计与销售的工作，将晶圆制造、封装、测试等生产环节分别委托给第三方晶圆制造和封装测试企业完成，在集中力量提高研发效率的同时不必投入大量资金建设晶圆制造、封装测试的工厂和产线。

发行人具体经营模式详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、（四）发行人主要经营模式”。

（三）发行人主要原材料及重要供应商

公司专注于集成电路的设计业务，主要采购晶圆、封测服务及存储芯片等。报告期内，公司重要供应商具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”。

（四）发行人主要客户

结合集成电路行业惯例及公司自身经营特点，报告期内，公司采用经销和直销两种模式进行产品销售。公司重要客户详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”。

（五）竞争地位

公司聚焦两大核心产品线，分别为网络通信芯片、端侧智能芯片。在市场竞争格局中，高通、博通、联发科及瑞昱等境内外知名集成电路设计企业，与发行人上述两条产品线均形成竞争关系。此外，发行人亦面临部分在各细分领域具备优势、专注于特定场景布局的芯片设计公司的竞争。

Wi-Fi 与蓝牙作为无线短距通信领域的两大核心技术，在系统架构、基带算法等底层技术层面存在显著的协同效应。发行人依托在无线短距通信领域与端侧智能领域深厚的技术积淀，同步布局 Wi-Fi 芯片与端侧智能芯片，与高通、博通、联发科及瑞昱等知名企业保持一致。

公司与同行业公司对比情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、（四）行业竞争格局及行业内主要企业”。

五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明

公司符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》规定的科创属性相关指标要求，具体情况如下：

（一）公司符合行业领域要求

公司所属科技创新行业领域见下表：

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	公司专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发和销售，主要产品应用于网络通信领域与端侧智能领域，并为客户提供 SoC 芯片定制服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”行业（代码：I6520）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“1.3.4 新型信息技术服务”对应的“集成电路设计”行业；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所处行业为“1.3.1 集成电路”。因此，公司属于科创板重点支持的“新一代信息技术产业”，符合科创板行业领域要求
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

（二）公司符合科创属性要求

公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第六条相关规定，科创属性同时符合下列 4 项指标要求：

科创属性评价标准	是否符合	指标情况
最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例≥5%，或最近3年累计研发投入金额≥8,000万元	☒ 是 ☐ 否	公司最近三年累计研发投入为7.76亿元，占最近三年累计营业收入的比例为56.43%，同时满足上述条件
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	☒ 是 ☐ 否	截至2025年末，公司研发人员人数为229人，占公司当期期末员工总数的比例为69.60%，满足条件
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7项	☒ 是 ☐ 否	截至2025年末，公司拥有境内发明专利109项，其中92项应用于公司主营业务中，满足条件
最近三年营业收入复合增长率	☒ 是 ☐ 否	公司2025年营业收入为5.65亿元，最近三

科创属性评价标准	是否符合	指标情况
≥25%，或最近一年营业收入金额≥3亿元		年营业收入复合增长率为38.31%，同时满足条件

六、发行人主要财务数据及财务指标

根据天健会计师出具的“天健审（2026）14545 号”标准无保留意见《审计报告》，报告期内公司合并财务报表主要财务数据及财务指标如下所示：

项目	2025/12/31 2025 年度	2024/12/31 2024 年度	2023/12/31 2023 年度
资产总额（万元）	76,641.70	62,124.25	73,528.06
归属于母公司所有者权益（万元）	47,739.18	42,359.86	62,375.88
资产负债率（母公司）	0.09%	3.32%	0.26%
营业收入（万元）	56,496.83	51,397.55	29,534.69
净利润（万元）	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-22,086.71	-24,402.79	-30,751.75
基本每股收益（元）	-0.84	-0.96	-1.21
稀释每股收益（元）	-0.84	-0.96	-1.21
加权平均净资产收益率	-47.38%	-45.54%	-43.97%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,619.58	-33,097.34	-23,136.90
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	41.55%	48.85%	98.10%

七、财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日后，公司经营状况较为稳定，未发生重大变化；发行人经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售及销售价格、主要客户及供应商的构成，重大合同及实际执行情况，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项，无对生产经营活动有重大影响需要披露的重大或有事项。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章

2.1.2 中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。

最近一年，公司营业收入为 56,496.83 万元；结合发行人 2025 年 6 月最新一次外部股权融资投后估值 44.17 亿，基于对发行人市值的预先评估，预计发行后总市值不低于人民币 30 亿元，符合上述标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署之日，发行人在公司治理方面不存在特殊安排。

十、募集资金用途

根据公司股东会决议通过，公司拟公开发行不超过 87,335,000 股人民币普通股，发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	备案号	项目总投资	募集资金投入额	实施主体
1	新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目	2606-500157-04-03-529995	43,902.08	43,902.08	物奇科技
2	端侧智能芯片研发及产业化项目	2605-310115-04-03-726447	43,541.20	43,541.20	上海物骐微
3	研发中心建设项目	2606-500157-04-03-139266	44,469.18	44,469.18	物奇科技
4	补充流动资金	-	30,000.00	30,000.00	发行人
合计		-	161,912.46	161,912.46	-

注：补充流动资金不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，不适用于主管部门关于固定资产投资的管理规定，无需履行相应的审批、核准或备案程序；同时不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际情况，通过自有资金或银行贷款支付上述部分项目投资，待募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。

若本次股票发行后，公司实际募集资金数额（扣除发行费用）大于上述投资项目所需资金，超过部分公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后，公司实际募集资金数额小于上述投资项目所需资金，公司将使用自有资金补足资金缺口。公司将合理安排募投项目的建设进度，保障公司经营发展的需要。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至招股说明书签署之日，除已在本招股说明书“第十节 其他重要事项”披露的情形外，发行人及其控股子公司不存在其他纠纷、调查、处罚等对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人经营状况、财务状况和持续盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、供应商集中度较高的风险

报告期各期，公司向前五名供应商合计采购的金额分别为 17,169.32 万元、51,957.59 万元及 41,194.45 万元，占当期采购总额的比例分别为 84.93%、91.09%和 89.05%，供应商集中度较高。

未来，若原有供应商因业务经营变化、产能受限或不可抗力等因素无法稳定供应产品或服务，或因国际贸易争端、地缘政治等外部环境变化导致合作关系受阻，而公司短期内难以完成新供应商的认证与切换，将对公司的生产经营造成重大不利影响。此外，若主要供应商基于自身产能紧张、原材料价格上涨或市场供需变化等原因上调晶圆制造、封装测试等服务价格，而公司无法及时将成本压力有效传导至下游客户，可能导致公司产品毛利率下降，进而对盈利能力造成不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期各期，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 70.32%、85.39%和 75.09%，集中度较高。公司与主要客户均已建立长期稳定的合作关系，但如果主要客户因生产经营或资信状况发生重大不利变化、经营或采购策略发生变化等原因减少或终止从公司的采购，且公司在新产品开发、新客户和新市场开拓等方面未能及时取得成效，则公司经营业绩将面临下滑风险。

3、新产品推广不及预期风险

发行人产品主要应用于网络通信及端侧智能领域。

在网络通信领域，尤其是 Wi-Fi 芯片市场，长期以来由博通、高通、联发科及瑞昱等巨头主导，行业集中度较高。国内厂商需要持续投入技术研发、优化产品性能、拓展市场渠道并完成客户验证，方能逐步突破现有市场格局。其中，Wi-Fi AP 芯片作为路由器、网关、FTTR 等网络通信基础设施的核心器件，下游品牌客户对性能、稳定性及安全性要求极高，导致新产品准入难度大、验证周期长。因此，公司未来 Wi-Fi 6 AP 芯片的销售规模化放量进程有赖于在关键客户处的验证通过及批量供货节奏；Wi-Fi STA 芯片的持续放量则取决于在电视、安防领域客户处的应用拓展及客户采购规模。

在端侧智能领域，由于市场需求及产品更新相对迅速，这要求公司持续提升研发效率，能够紧跟下游客户的产品迭代节奏，精准匹配多样化应用场景，产品具备快速响应与灵活适配能力，否则难以实现规模化推广。

若公司在上述重点客户的导入过程中出现验证周期延长、产品认证未通过或客户采购不及预期等情形，相关产品的收入增长将无法达到预期，可能对公司未来业绩增长及整体经营状况产生不利影响。

4、定制研发服务交付不及预期的风险

报告期内，公司除销售标准自研芯片产品外，还根据客户需求提供 SoC 芯片定制研发服务及定制芯片产品。该类业务对公司的技术理解深度、研发交付能力及项目管理水平提出了更高要求。若在定制研发过程中，公司未能准确理解或充分实现客户技术需求，或交付成果未达到约定的性能指标及验证标准，可能导致项目进度延误，触发合同中的延期交付违约条款，公司将面临支付违约金、退还已收款项甚至承担损失赔偿等风险。上述情形一旦发生，不仅会造成直接经济损失，还可能引发客户信任危机，影响公司与现有客户的持续合作，并对公司在行业内的技术服务口碑造成负面冲击，进而对公司未来业务拓展及持续经营能力产生不利影响。

（二）技术风险

1、研发结果未达到预期或无法产业化风险

公司所在的集成电路设计行业为技术密集型行业，前沿技术的研发、新产品的开发及现有产品的迭代升级均需要持续且高强度的资源投入。为保持技术

领先优势与市场竞争力，公司需紧密跟踪技术演进趋势及下游市场需求，在网络通信芯片及端侧智能芯片领域不断进行研发深耕。报告期各期，公司研发投入金额分别为 28,972.20 万元、25,107.80 万元和 23,472.59 万元，占主营业务收入的比重分别为 98.10%、48.85%和 41.55%，研发投入规模较大且占比较高。

集成电路芯片的研发过程涉及前端设计、后端验证、流片试产、系统测试等多个复杂环节，研发周期长、技术难度高、不确定性较大。若公司研发项目未能顺利实现产业化，或公司新开发的产品在性能、功耗、成本、集成度等方面不及竞争对手，公司将面临研发成果无法实现预期经济效益的风险，前期投入的大量研发资源将难以在短期内转化为收入，可能对公司的财务状况及盈利能力造成不利影响。

2、技术迭代及产品升级滞后于市场的风险

集成电路设计行业技术更新迅速，新产品、新工艺不断涌现，同时下游终端应用场景日益丰富，客户对芯片性能、功耗、集成度及定制化程度的要求持续提升。

为维持市场竞争力，公司需要准确把握行业技术发展趋势和下游市场需求变化，及时进行现有产品的迭代升级及新技术的研发布局。若公司未能前瞻性判断行业技术演进方向，或募集资金投资项目及新产品规划偏离市场需求，导致研发效果未达预期、产品迭代节奏落后于竞争对手；若公司技术迭代进度未达预期，无法及时、有效匹配市场需求；或是出现颠覆性、革新性新技术导致公司现有产品被替代，公司将面临产品升级迭代不及预期的风险，进而导致技术优势被削弱、行业地位及市场份额下滑。上述情形一旦发生，将对公司的盈利能力和长期持续发展造成重大不利影响。

3、核心技术泄密及知识产权保护风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，对专利、集成电路布图设计、软件著作权及非专利技术为核心资产的依赖程度极高。公司自设立以来，坚持自主创新，通过持续的技术创新、新产品研发和各项 IP 的积累，建立起具有完全自主知识产权的核心技术体系。

公司重视自身知识产权的申报和保护，也重视从第三方获取知识产权许可

的合法合规，避免侵犯他人知识产权。尽管公司已采取了积极的知识产权管理和保护措施，但仍然无法完全保证公司的知识产权不受侵犯，不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。另一方面，公司存在与第三方共有部分知识产权的情形，如出现相关协议约定不完善或其他因素，可能导致该等共有专利权属事项产生纠纷，公司将面临知识产权纠纷的风险，进而可能对公司生产经营造成不利影响。

同时，由于集成电路设计业务的国际化程度较高，不同国别、不同法律体系对知识产权权利范围的解释和认定存在差异，若公司未能准确理解该等法律法规，可能会引发争议甚至诉讼，从而影响公司业务开展。

4、技术人员流失风险

集成电路行业兼具技术密集型与人才密集型双重特征。依托持续的技术研发与经验积淀，公司已形成多项核心技术，组建了全建制研发团队——这些人才是公司实现持续创新、维持核心竞争力的核心基础。同时，公司通过人才培养、股权激励等多元化方式，有效激励研发技术人员，进一步保障了团队的稳定性。

近年来，随着我国对集成电路行业的大力扶持，行业整体呈现快速发展态势，但同时也面临着较大的人才缺口，人才争夺愈发激烈。若公司的薪酬体系、激励机制等未能有效吸引适配的专业人才，或因未能对核心研发技术人员实施有效的约束与激励，导致出现大规模人才流失，将可能使公司在行业竞争中陷入不利境地，进而对公司的持续发展及经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、报告期内尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-30,042.97 万元、-23,850.84 万元和-21,343.52 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-30,751.75 万元、-24,402.79 万元和-22,086.71 万元；截至2025 年末，累计未分配利润为-85,465.36 万元。发行人报告期内尚未盈利，且最近一期末存在累计未弥补亏损。

上述情况主要系公司为保持核心技术与产品的先进性，在报告期内持续进

行大额研发投入所致。目前公司仍处于快速发展阶段，若未来未能按计划实现销售规模扩张，或产品总体市场需求出现大幅下滑，则公司营业收入可能无法达到预期水平，未来一定期间内仍存在无法盈利的风险。上述情形可能导致公司现金流紧张，进而对业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入及市场开发等方面造成不利影响。

2、经营性现金流量净额持续为负值的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-23,136.90 万元、-33,097.34 万元和-1,619.58 万元，报告期内持续为负。主要原因在于公司为巩固市场地位，持续加大研发创新投入、推进市场拓展，并积极引进优秀人才充实团队。未来随着业务规模的进一步扩大，上述投入仍将持续。若公司现金回收水平未能伴随业务增长而同步提升，经营活动产生的现金流量净额可能继续为负，并对公司未来的盈利质量产生一定的不利影响。

3、毛利率相关风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 26.58%、21.80%和 19.61%，公司主营业务产品毛利率呈现一定波动且低于同行业可比公司平均毛利率水平。公司主营业务毛利率主要受产品售价、市场竞争、行业周期波动以及上游供应链成本变动等多重因素综合影响。

此外，如果未来出现行业竞争加剧，或因下游市场需求放缓导致公司议价能力削弱，而成本端压力无法同步传导，公司毛利率将面临持续承压的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 11,616.72 万元、25,757.88 万元和 26,560.94 万元，占流动资产的比例分别为 17.44%、45.80%和 36.69%。未来，若行业需求、市场竞争发生不利变化导致存货市场价格进一步下跌，或公司存货管理不当、市场拓展不力导致存货积压、产品滞销，公司将面临存货跌价准备增加的风险，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

5、应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 10,800.09 万元、13,591.08 万元和 11,928.31 万元，占当期营业收入比例分别为 36.57%、26.44%和 21.11%。

虽然公司主要客户目前发生坏账的可能性较小，但未来宏观形势、行业景气度等因素若发生不利变化，影响下游客户的经营情况和回款能力，公司将面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险，对公司的资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争风险

在网络通信芯片领域，Wi-Fi AP/STA 芯片市场长期由博通、高通、联发科、瑞昱等巨头主导。与这些头部厂商相比，公司在销售规模、品牌影响力及客户基础等方面仍存在较大差距。在 Wi-Fi 6 AP 芯片领域，除发行人外，境内已有海思半导体实现批量供货，同时其他本土芯片设计企业亦在持续布局，未来市场竞争将更趋激烈；在 Wi-Fi STA 芯片领域，境内已涌现少量竞争对手，其在部分产品线或细分客户群体上已形成局部领先优势。公司在该领域面临来自国际巨头与境内同业的多元竞争压力。

在端侧智能芯片领域，市场竞争呈现显著的分层化特征：国际芯片厂商在高端市场仍占据重要地位；国内方面，以恒玄科技为代表的头部设计企业与公司共同服务于荣耀、OPPO 等中高端品牌客户，在技术性能、功耗控制及算法适配等方面展开直接竞争；同时，以中科蓝讯等为代表的企业主要面向白牌市场，凭借成本优势在价格敏感型市场快速扩张。此外，随着端侧 AI 向智能眼镜、智能家居等新兴场景渗透，部分头部终端品牌亦通过自研芯片方式向上游延伸，进一步加剧了中高端市场的竞争复杂度。

若未来国内外先进企业采取更为强势的市场竞争策略，通过价格战、技术封锁或客户捆绑等方式挤压公司生存空间，则可能导致公司市场份额被侵蚀、产品价格持续承压、毛利率水平下滑，进而对经营业绩造成不利影响。

（二）下游市场需求波动的风险

公司产品主要应用于网络通信及端侧智能两大领域，市场需求受到下游产业演进节奏、技术迭代速度及终端应用场景拓展进程等多重因素影响。

在网络通信领域，Wi-Fi 芯片的市场需求与通信技术的代际更迭进程密切相关。若 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 向 Wi-Fi 6 及更高代际的升级节奏慢于预期，或新一代通信技术在路由器、网关、FTTR 等设备的渗透率提升不及预期，可能导致下游客户对公司 Wi-Fi 芯片的采购需求延迟释放。同时，网络通信基础设施的建设和更新受国家新型基础设施建设规划、电信运营商资本开支及行业数字化转型进程等因素影响，若相关投入放缓或周期性波动，亦将对公司网络通信芯片业务的增长空间形成制约。

在端侧智能领域，公司产品广泛应用于智能耳机、智能眼镜等终端设备，其市场规模与人工智能技术在端侧的渗透进程高度相关。若人工智能在消费电子领域的应用场景拓展不及预期，或端侧 AI 的技术成熟度、用户体验未能持续提升，导致智能终端产品的市场需求增长放缓，将直接影响公司端侧智能芯片的销售规模。

上述下游市场需求的波动及产业演进节奏的不确定性，可能对公司产品销量、营业收入及未来增长空间造成不利影响。

（三）国际贸易争端和地缘政治风险

近年来，地缘政治不确定性持续加剧，全球半导体供应链不稳定性显著上升，集成电路行业逐步成为全球技术竞争的核心焦点。美国通过多次修订《出口管理条例》以及出台《芯片与科学法案》等贸易限制政策，不断扩大半导体相关技术与产品的管制范围，持续加码对中国半导体产业的限制，意图遏制其发展。发行人主要从事网络通信芯片及端侧智能芯片的研发与设计业务，存在向 CEVA、Cadence、Synopsys 等境外企业采购 IP、EDA 工具等专有技术授权的情形。若未来美国等发达国家出于贸易保护或地缘政治等战略考量，可能导致上述境外 IP 授权中断、EDA 工具使用受限及技术支持终止。在此情况下，将导致公司研发进程停滞、产品迭代延迟、研发成本显著增加，进而造成客户订单无法及时履约、市场份额面临下滑压力，对公司的经营业绩、市场竞争力及未来发展产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目紧密围绕发行人主营业务，紧跟行业技术演进趋势，聚焦主营产品在代际更迭与工艺制程上的迭代升级、前沿技术的研发布局与核心技术储备，涉及下一代网络通信及端侧智能芯片的研发及产业化、前沿技术布局及高端研发人才引进。若出现项目建设进度滞后、未来市场需求发生变化、技术路线革新、产业政策调整，以及新产品开发进度不及预期、产品性能指标未达预期或公司市场开拓不力等情况，公司将面临募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，可能对公司经营业绩产生不利影响。

本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，但由于建设项目和产生效益需要一定时间，因此，公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

（二）发行失败风险

根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的规定，在科创板首次公开发行股票，若网下投资者申购数量不足导致网下初始发行比例低于法定要求，或发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，应当中止发行。

公司本次发行将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，可能存在网下初始发行比例不足或预计发行后总市值不满足上市条件而导致发行失败的风险。

（三）前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提请投资者注意，本招股说明书的预测性陈述仍存在不确定性，公司存在无法在 2028 年实现扭亏为盈的风险。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股说明书所载明的任何预测性及前瞻性陈述，不应被视为本公司的承诺与声明。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

发行人	重庆物奇微电子股份有限公司	
英文名称	Chongqing Wuqi Microelectronics Co.,Ltd.	
注册资本	26,186.50 万元	
法定代表人	郑建生	
有限公司成立日期	2018 年 7 月 3 日	
股份公司设立日期	2023 年 3 月 20 日	
公司住所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼	
邮政编码	401122	
联系电话	021-50806308	
互联网网址	http://www.wuqi-tech.com	
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话号码	负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
	负责人	毛向荣
	电话号码	021-50806308

二、发行人改制设立情况

（一）有限公司设立情况

1、物奇微有限的设立

2018 年 6 月 13 日，任泽生、华奇恒、林豪、熊飞、鼎精投资及荣泽投资共同签署股东会决议，约定共同出资设立重庆物奇微电子有限公司，并通过了公司章程。

2018 年 7 月 3 日，物奇微有限办理了工商初始设立登记，并取得重庆市工商行政管理局渝北区分局核发的统一社会信用代码为“91500112MA60043P2T”的《营业执照》。

物奇微有限设立时的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	任泽生	2,242.00	62.28%
2	华奇恒	672.00	18.67%

序号	股东名称	注册资本	出资比例
3	林豪	250.00	6.94%
4	熊飞	250.00	6.94%
5	鼎精投资	150.00	4.17%
6	荣泽投资	36.00	1.00%
合计		3,600.00	100.00%

2、创始股东股权结构形成

2018年7月8日，物奇微有限召开股东会，通过决议同意下表所述股权转让事宜，公司类型变更为“有限责任公司（中外合资）”，并修改公司章程。具体转让情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让比例	转让价款
1	任泽生	NATIVE	1,080.00	30.00%	0.0001
2		鼎精投资	303.60	8.43%	-
3		华奇恒	228.72	6.35%	-
4		林豪	68.24	1.90%	-
5		熊飞	68.24	1.90%	-
6	荣泽投资	鼎精投资	3.96	0.11%	-

注 1：物奇微有限设立后，尚未实际经营，且各股东均未实缴。根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的编号为“重康评报字（2018）第 206 号”《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 7 月 8 日，经采用资产基础法评估结果作为最终结论的股东全部权益价值的评估结果为 0.00 万元。NATIVE 受让任泽生持有的物奇微有限 30% 股权对价为 1 元，符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》第十四条规定；

注 2：除 NATIVE 以外，本次股权转让其他对价均为 0 元。

同日，上述交易相关方分别签署对应的《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2018 年 7 月 30 日，上述事项完成工商变更登记，重庆市工商行政管理局渝北区分局向物奇微有限核发了新的营业执照。

2018 年 8 月 15 日，重庆市商务委员会向物奇微有限核发了编号为“渝商务资备 201800609”的《外商投资企业设立备案回执》。

本次股权转让完成后，物奇微有限的股权结构情况变更为：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	NATIVE	1,080.00	30.00%
2	华奇恒	900.72	25.02%
3	任泽生	493.20	13.70%
4	鼎精投资	457.56	12.71%
5	林豪	318.24	8.84%
6	熊飞	318.24	8.84%
7	荣泽投资	32.04	0.89%
合计		3,600.00	100.00%

（二）股份公司设立情况

1、股份公司设立

发行人系由物奇微有限以经审计的净资产值折股整体变更设立。

2023 年 2 月 10 日，天健会计师出具了编号为“天健审〔2023〕125 号”《审计报告》。根据该审计报告，截至 2022 年 8 月 31 日，物奇微有限净资产账面价值为 70,105.89 万元。

同日，坤元资产评估有限公司出具了编号为“坤元评报〔2023〕70 号”《重庆物奇微电子股份有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 8 月 31 日，经资产基础法评估，物奇微有限净资产评估值为 72,418.67 万元，评估增值 2,312.77 万元，增值率 3.30%。

2023 年 2 月 12 日，物奇微有限召开股东会会议，全体股东一致同意物奇微有限整体变更之折股方案，并同意公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司。

2023 年 2 月 25 日，全体发起人共同签署了《重庆物奇微电子股份有限公司发起人协议书》，物奇微的股份总额依据物奇微有限经审计的净资产值为基础，按照 11.871507:1 的比例折算成 5,905.3910 万股，每股面值为人民币 1 元，折股后余额部分计入资本公积。

2023 年 2 月 27 日，全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。2023 年 3 月 20 日，发行人取得重庆市市场监督管理局核发的统一社会信

用代码为“91500112MA60043P2T”的《营业执照》。

2023年5月16日，天健会计师对重庆物奇微电子股份有限公司实际到位的注册资本进行了验证并出具了编号为“天健验〔2023〕207号”的《验资报告》，验证上述出资已全部到位。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	NATIVE	10,800,000	18.29%
2	任泽生	4,932,000	8.35%
3	哈勃投资	4,066,310	6.89%
4	林豪	3,194,211	5.41%
5	鼎精投资	2,848,231	4.82%
6	南方工业基金	2,337,661	3.96%
7	物奇伍	2,239,300	3.79%
8	物奇贰	1,964,200	3.33%
9	惠友投资	1,848,323	3.13%
10	ASTREND	1,848,323	3.13%
11	物奇壹	1,637,900	2.77%
12	物奇捌	1,582,400	2.68%
13	物奇叁	1,508,700	2.55%
14	润科投资	1,412,126	2.39%
15	智城二号	1,386,242	2.35%
16	物奇肆	1,305,200	2.21%
17	临空远翔	1,285,700	2.18%
18	孙凤龙	1,202,993	2.04%
19	清研华业	1,168,830	1.98%
20	熊飞	1,063,987	1.80%
21	佳禾电声	1,035,060	1.75%
22	聚源创投	924,161	1.56%
23	ANKER	739,329	1.25%
24	君丰桐芯	583,681	0.99%
25	大河融科	514,300	0.87%
26	利和丰投资	404,941	0.69%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
27	睿鲸云锦	393,693	0.67%
28	吴君宇	385,700	0.65%
29	商功投资	385,700	0.65%
30	长沙华业	369,665	0.63%
31	承远壹号	369,664	0.63%
32	贾自强	358,866	0.61%
33	物奇陆	351,900	0.60%
34	荣泽投资	320,400	0.54%
35	姜永林	302,841	0.51%
36	杨心茹	295,269	0.50%
37	顾成标	287,699	0.49%
38	盈趣科技	240,282	0.41%
39	合泰昇通	227,130	0.38%
40	渝富益华	227,130	0.38%
41	重泰资本	194,560	0.33%
42	豫富君沅	181,704	0.31%
43	曹义勇	153,800	0.26%
44	科兴科创	129,382	0.22%
45	信见成	44,416	0.08%
合计		59,053,910	100.00%

2、股改基准日未分配利润为负的原因

截至股改基准日，发行人累计未分配利润金额为-50,223.77 万元，存在未弥补亏损情形，主要是由于公司快速发展，为产品研发投入较大研发费用而形成的经营性亏损。

3、该情形是否已消除、变化情况和的发展趋势

截至报告期末，公司未分配利润为负的情形尚未消除。报告期内，公司营业收入保持较快增长，但由于新产品研发投入较大且产品尚处于推广阶段，销售收入尚不足以覆盖公司整体的成本、费用及以前年度累计亏损。

从变化情况看，报告期内公司主营业务突出，所处行业市场需求较大，政策环境良好，符合国家产业政策发展方向。报告期各期，公司营业收入分别为

29,534.69 万元、51,397.55 万元和 56,496.83 万元，近三年复合增长率达 38.31%，收入规模呈现高速增长趋势。公司财务状况持续优化，资产流动性良好，不存在债务违约、无法继续履行重大合同、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情形。

从发展趋势看，未来公司将采取进一步措施提升盈利能力，但实现盈利需要一定的假设条件并落实相应措施，相关假设条件的成立或拟采取措施的落实均存在不确定性。具体详见招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、未来实现盈利的前瞻性信息”。公司未来几年持续投入新产品、新技术研发，若后续不能有效扩大经营规模，则仍存在持续亏损的风险。

4、对未来盈利能力的影响分析

报告期内，公司通过股权融资方式获得较为充裕的现金流，为生产经营活动的有序开展及研发投入的持续推进提供了较强的资金支持。同时，公司积极拓展营销渠道、深化产业链上下游协同，依托在网络通信及端侧智能领域积累的核心技术优势，在中高端智能终端市场构建了稳固的品牌客户基础和较强的核心竞争力；在技术创新层面，公司持续加大研发资源投入，稳步推动 Wi-Fi、端侧智能技术的迭代升级，产品竞争力与市场份额持续提升；此外，公司依托丰富的自主 IP 储备与 SoC 芯片设计能力，逐步拓展定制芯片服务，不断拓展业务边界，为扩大经营规模奠定了坚实基础。综上，尽管公司目前尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损的情形，但结合公司充裕的现金流、突出的技术优势、稳步提升的市场竞争力及良好的发展基础，该情形对公司业务开拓、人才引进、团队稳定、研发投入、资金链安全、生产经营可持续性等方面均不存在重大不利影响。

但公司未来盈利能力仍受到宏观经济、产业政策、供应链、下游市场需求等多方因素影响，短期内，公司仍存在累计亏损及持续亏损并将面临一系列潜在风险，详见本招股说明书“第三节 风险因素”的相关内容。

5、整体变更具体方案及相应的会计处理

发行人以截至 2022 年 8 月 31 日经审计净资产 70,105.89 万元折为整体变更后股份有限公司实收资本 5,905.39 万元，其余计入资本公积 64,200.50 万元。相

应的会计处理如下：

单位：万元

项目	金额
借：实收资本	5,905.39
资本公积-资本溢价	114,424.27
未分配利润	-50,223.77
贷：股本	5,905.39
资本公积-股本溢价	64,200.50

6、整体变更相关事项及程序是否合法合规

公司以整体变更方式发起设立股份有限公司的相关事项已经股东会表决通过，相关程序合法合规。过程中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存在纠纷；公司各发起人签署的《发起人协议书》系各发起人真实意思表示，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；公司股东会、创立大会的召开程序及所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行了工商、税务、外商投资变更等程序；发行人设立程序、条件、方式及发起人资格等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

（三）报告期初至今，发行人的股本和股东变化情况

1、2023 年期初，物奇微有限的股权情况

截至 2023 年 1 月 1 日，物奇微有限的股权结构具体如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	NATIVE	1,080.0000	18.2884%
2	任泽生	493.2000	8.3517%
3	哈勃投资	406.6310	6.8858%
4	林豪	319.4211	5.4090%
5	鼎精投资	284.8231	4.8231%
6	润科投资	280.5193	4.7502%
7	熊飞	264.6387	4.4813%
8	南方工业基金	233.7661	3.9585%

序号	股东名称	注册资本	出资比例
9	物奇伍	223.9300	3.7920%
10	物奇贰	196.4200	3.3261%
11	惠友投资	184.8323	3.1299%
12	ASTREND	184.8323	3.1299%
13	物奇壹	163.7900	2.7736%
14	物奇叁	150.8700	2.5548%
15	智城二号	138.6242	2.3474%
16	物奇肆	130.5200	2.2102%
17	临空远翔	128.5700	2.1772%
18	清研华业	116.8830	1.9793%
19	佳禾电声	103.5060	1.7527%
20	华润创投	93.5064	1.5834%
21	聚源创投	92.4161	1.5649%
22	孙凤龙	90.0000	1.5240%
23	ANKER	73.9329	1.2520%
24	君丰桐芯	58.3681	0.9884%
25	大河融科	51.4300	0.8709%
26	吴君宇	38.5700	0.6531%
27	商功投资	38.5700	0.6531%
28	长沙华业	36.9665	0.6260%
29	承远壹号	36.9664	0.6260%
30	贾自强	35.8866	0.6077%
31	物奇陆	35.1900	0.5959%
32	荣泽投资	32.0400	0.5426%
33	杨心茹	29.5269	0.5000%
34	盈趣科技	24.0282	0.4069%
35	重泰资本	19.4560	0.3295%
36	曹义勇	15.3800	0.2604%
37	科兴科创	12.9382	0.2191%
38	信见成	4.4416	0.0752%
合计		5,905.3910	100.00%

2、2023年2月，有限公司第七次股权转让

2023 年 1 月 19 日，物奇微有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意公司股东根据自身投资及发展规划进行股权转让。

2023 年 1 月 20 日，熊飞与物奇捌签署《股权转让协议》，约定熊飞将所持物奇微有限 2.68%股权（对应注册资本金额 158.24 万元）转让给物奇捌。

2023 年 2 月 10 日，华润创投与利和丰投资、孙凤龙、渝富益华分别签订了《股权转让协议》，约定华润创投将所持物奇微有限 1.58%股权（对应注册资本金额 93.5064 万元）分别转让给利和丰投资、孙凤龙、渝富益华。同日，润科投资与睿鲸云锦、姜永林、顾成标、合泰昇通、豫富君烁，分别签订了《股权转让协议》，约定润科投资将所持物奇微有限 2.36%股权（对应注册资本金额 139.3067 万元）分别转让给睿鲸云锦、姜永林、顾成标、合泰昇通、豫富君烁。

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让注册资本	转让价款	转让价格 (元/注册资本)
1	熊飞	物奇捌	158.2400	2,679.59	16.93
2	华润创投	利和丰投资	40.4941	2,400.00	59.27
3		孙凤龙	30.2993	1,795.77	59.27
4		渝富益华	22.7130	1,500.00	66.04
5	润科投资	睿鲸云锦	39.3693	2,600.00	66.04
6		姜永林	30.2841	2,000.00	66.04
7		顾成标	28.7699	1,900.00	66.04
8		合泰昇通	22.7130	1,500.00	66.04
9		豫富君烁	18.1704	1,200.00	66.04

注 1：熊飞本次转让的发行人 2.68%股权（对应注册资本金额 158.24 万元），系郑建生授予熊飞的附服务条件激励。2022 年四季度，熊飞计划自发行人处离职，经协商后，于 2023 年初将其持有的该部分股权以 16.93 元/注册资本的价格（对应发行人估值 10 亿元）转让给物奇捌，用于发行人部分高级管理人员、关键技术人员的激励；

注 2：利和丰投资作为重要有限合伙人出资的厦门伟航君裕股权投资合伙企业（有限合伙）系华润创投的重要出资人，因此利和丰投资在较早时期即与华润创投有接触，双方初步达成关于转让物奇微有限股权的意向。利和丰投资与华润创投本次股权转让价格 59.27 元/注册资本（对应发行人估值 35 亿元），介于本轮其他股东交易价格（对应发行人估值 39 亿元）及上轮其他股东交易价格（对应发行人估值 31.95 亿元）之间；

注 3：孙凤龙作为物奇微有限的股东，以与利和丰投资同等价格的条件行使了优先购买权，公司其它股东均放弃行使相应的优先购买权。

2023 年 2 月 23 日，上述股权转让事宜在重庆市渝北区市场监督管理局进

行了工商变更登记。

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	NATIVE	1,080.0000	18.2884%
2	任泽生	493.2000	8.3517%
3	哈勃投资	406.6310	6.8858%
4	林豪	319.4211	5.4090%
5	鼎精投资	284.8231	4.8231%
6	南方工业基金	233.7661	3.9585%
7	物奇伍	223.9300	3.7920%
8	物奇贰	196.4200	3.3261%
9	惠友投资	184.8323	3.1299%
10	ASTREND	184.8323	3.1299%
11	物奇壹	163.7900	2.7736%
12	物奇捌	158.2400	2.6796%
13	物奇叁	150.8700	2.5548%
14	润科投资	141.2126	2.3912%
15	智城二号	138.6242	2.3474%
16	物奇肆	130.5200	2.2102%
17	临空远翔	128.5700	2.1772%
18	孙凤龙	120.2993	2.0371%
19	清研华业	116.8830	1.9793%
20	熊飞	106.3987	1.8017%
21	佳禾电声	103.5060	1.7527%
22	聚源创投	92.4161	1.5649%
23	ANKER	73.9329	1.2520%
24	君丰桐芯	58.3681	0.9884%
25	大河融科	51.4300	0.8709%
26	利和丰投资	40.4941	0.6857%
27	睿鲸云锦	39.3693	0.6667%
28	吴君宇	38.5700	0.6531%
29	商功投资	38.5700	0.6531%
30	长沙华业	36.9665	0.6260%

序号	股东名称	注册资本	出资比例
31	承远壹号	36.9664	0.6260%
32	贾自强	35.8866	0.6077%
33	物奇陆	35.1900	0.5959%
34	荣泽投资	32.0400	0.5426%
35	姜永林	30.2841	0.5128%
36	杨心茹	29.5269	0.5000%
37	顾成标	28.7699	0.4872%
38	盈趣科技	24.0282	0.4069%
39	合泰昇通	22.7130	0.3846%
40	渝富益华	22.7130	0.3846%
41	重泰资本	19.4560	0.3295%
42	豫富君砾	18.1704	0.3077%
43	曹义勇	15.3800	0.2604%
44	科兴科创	12.9382	0.2191%
45	信见成	4.4416	0.0752%
合计		5,905.3910	100.00%

3、2023 年 3 月，公司整体变更为股份有限公司

物奇微有限 2023 年 3 月整体变更为股份有限公司，详见招股说明书本节之“二、（二）股份公司设立情况”。

4、2023 年 3 月，股份公司第一次增资

2023 年 3 月 21 日，物奇微召开 2023 年第二次临时股东大会，通过决议同意公司股本增加至 6,359.6518 万元，中移股权基金以货币资金 30,000.00 万元认购新增股本 454.2608 万元，折合发行价格 66.04 元/股，占增资后股本的 7.14%。

根据天健会计师出具的“天健验〔2023〕208 号”《验资报告》，截至 2023 年 3 月 24 日止，物奇微已收到中移股权基金缴纳的出资 30,000.00 万元，全部为货币出资，其中新增实收资本 454.2608 万元，增加资本公积 29,545.7392 万元。

2023 年 3 月 23 日，本次增资事宜在重庆市渝北区市场监督管理局进行了

工商变更登记。

本次增资完成后，物奇微股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	NATIVE	10,800,000	16.98%
2	任泽生	4,932,000	7.76%
3	中移股权基金	4,542,608	7.14%
4	哈勃投资	4,066,310	6.39%
5	林豪	3,194,211	5.02%
6	鼎精投资	2,848,231	4.48%
7	南方工业基金	2,337,661	3.68%
8	物奇伍	2,239,300	3.52%
9	物奇贰	1,964,200	3.09%
10	惠友投资	1,848,323	2.91%
11	ASTREND	1,848,323	2.91%
12	物奇壹	1,637,900	2.58%
13	物奇捌	1,582,400	2.49%
14	物奇叁	1,508,700	2.37%
15	润科投资	1,412,126	2.22%
16	智城二号	1,386,242	2.18%
17	物奇肆	1,305,200	2.05%
18	临空远翔	1,285,700	2.02%
19	孙凤龙	1,202,993	1.89%
20	清研华业	1,168,830	1.84%
21	熊飞	1,063,987	1.67%
22	佳禾电声	1,035,060	1.63%
23	聚源创投	924,161	1.45%
24	ANKER	739,329	1.16%
25	君丰桐芯	583,681	0.92%
26	大河融科	514,300	0.81%
27	利和丰投资	404,941	0.64%
28	睿鲸云锦	393,693	0.62%
29	吴君宇	385,700	0.61%
30	商功投资	385,700	0.61%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
31	长沙华业	369,665	0.58%
32	承远壹号	369,664	0.58%
33	贾自强	358,866	0.56%
34	物奇陆	351,900	0.55%
35	荣泽投资	320,400	0.50%
36	姜永林	302,841	0.48%
37	杨心茹	295,269	0.46%
38	顾成标	287,699	0.45%
39	盈趣科技	240,282	0.38%
40	合泰昇通	227,130	0.36%
41	渝富益华	227,130	0.36%
42	重泰资本	194,560	0.31%
43	豫富君砾	181,704	0.29%
44	曹义勇	153,800	0.24%
45	科兴科创	129,382	0.20%
46	信见成	44,416	0.07%
合计		63,596,518	100.00%

5、2023年3月，股份公司资本公积转增股本

2023年3月25日，物奇微召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于重庆物奇微电子股份有限公司资本公积转增股本的议案》。全体股东一致同意公司以总股本6,359.6518万股为基数，按各股东持股比例，以18,540.3482万元资本公积转增股本18,540.3482万股，转增后公司总股本增加至24,900.0000万股，注册资本增加至人民币24,900.0000万元，公司各股东持股比例不变。

根据天健会计师事务所出具的“天健验〔2023〕209号”《验资报告》，截至2023年3月25日止，物奇微已将资本公积18,540.3482万元转增实收资本18,540.3482万元。

2023年3月27日，本次增资事宜在重庆市市场监督管理局进行了工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后，物奇微股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.98%
2	任泽生	19,310,303	7.76%
3	中移股权基金	17,785,713	7.14%
4	哈勃投资	15,920,859	6.39%
5	林豪	12,506,322	5.02%
6	鼎精投资	11,151,704	4.48%
7	南方工业基金	9,152,664	3.68%
8	物奇伍	8,767,551	3.52%
9	物奇贰	7,690,452	3.09%
10	惠友投资	7,236,755	2.91%
11	ASTREND	7,236,755	2.91%
12	物奇壹	6,412,884	2.58%
13	物奇捌	6,195,584	2.49%
14	物奇叁	5,907,026	2.37%
15	润科投资	5,528,909	2.22%
16	智城二号	5,427,565	2.18%
17	物奇肆	5,110,261	2.05%
18	临空远翔	5,033,912	2.02%
19	孙凤龙	4,710,089	1.89%
20	清研华业	4,576,330	1.84%
21	熊飞	4,165,838	1.67%
22	佳禾电声	4,052,579	1.63%
23	聚源创投	3,618,376	1.45%
24	ANKER	2,894,701	1.16%
25	君丰桐芯	2,285,291	0.92%
26	大河融科	2,013,643	0.81%
27	利和丰投资	1,585,469	0.64%
28	睿鲸云锦	1,541,430	0.62%
29	吴君宇	1,510,135	0.61%
30	商功投资	1,510,135	0.61%
31	长沙华业	1,447,353	0.58%
32	承远壹号	1,447,349	0.58%
33	贾自强	1,405,071	0.56%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
34	物奇陆	1,377,797	0.55%
35	荣泽投资	1,254,465	0.50%
36	姜永林	1,185,716	0.48%
37	杨心茹	1,156,069	0.46%
38	顾成标	1,126,430	0.45%
39	盈趣科技	940,778	0.38%
40	合泰昇通	889,284	0.36%
41	渝富益华	889,284	0.36%
42	重泰资本	761,762	0.31%
43	豫富君沅	711,427	0.29%
44	曹义勇	602,174	0.24%
45	科兴科创	506,570	0.20%
46	信见成	173,902	0.07%
合计		249,000,000	100.00%

6、2025 年 6 月，股份公司第二次增资暨第一次股权转让

2025 年 6 月 19 日，物奇微召开 2024 年年度股东大会，通过决议同意公司股本增加至不超过 26,900.00 万元，新增股本由新股东重庆战新、洪泰嘉晟以货币资金认购。

2025 年 6 月 27 日，重庆战新、洪泰嘉晟与物奇微及公司其他股东签署了《增资协议》，重庆战新以 14,000.00 万元货币资金认购公司新增股本 830.00 万元，洪泰嘉晟以 7,700 万元货币认购公司新增股本 456.50 万元，折合发行价格 16.87 元/股，占增资后股本的 4.91%。

同日，润科投资与北碚西证、合顺盈二号、泰科源、王飞分别签署了《股权转让协议》，约定润科投资将其所持有的发行人 552.8909 万股股份分别转让给北碚西证、合顺盈二号、泰科源和王飞，本次交易交割完成后，润科投资不再持有发行人股份。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股份数量 （股）	转让价款	转让价格 （元/股）
----	-----	-----	---------------	------	---------------

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价款	转让价格 (元/股)
1	润科投资	北碚西证	2,017,359	3,000.00	14.87
2		合顺盈二号	1,494,191	2,222.00	14.87
3		泰科源	1,344,906	2,000.00	14.87
4		王飞	672,453	1,000.00	14.87

2025 年 6 月 30 日，上述事宜在重庆市渝北区市场监督管理局进行了工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，物奇微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.15%
2	任泽生	19,310,303	7.37%
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%
4	哈勃投资	15,920,859	6.08%
5	林豪	12,506,322	4.78%
6	鼎精投资	11,151,704	4.26%
7	南方工业基金	9,152,664	3.50%
8	物奇伍	8,767,551	3.35%
9	重庆战新	8,300,000	3.17%
10	物奇贰	7,690,452	2.94%
11	惠友投资	7,236,755	2.76%
12	ASTREND	7,236,755	2.76%
13	物奇壹	6,412,884	2.45%
14	物奇捌	6,195,584	2.37%
15	物奇叁	5,907,026	2.26%
16	智城二号	5,427,565	2.07%
17	物奇肆	5,110,261	1.95%
18	临空远翔	5,033,912	1.92%
19	孙凤龙	4,710,089	1.80%
20	清研华业	4,576,330	1.75%
21	洪泰嘉晟	4,565,000	1.74%
22	熊飞	4,165,838	1.59%
23	佳禾电声	4,052,579	1.55%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
24	聚源创投	3,618,376	1.38%
25	ANKER	2,894,701	1.11%
26	君丰桐芯	2,285,291	0.87%
27	北碚西证	2,017,359	0.77%
28	大河融科	2,013,643	0.77%
29	利和丰投资	1,585,469	0.61%
30	睿鲸云锦	1,541,430	0.59%
31	吴君宇	1,510,135	0.58%
32	商功投资	1,510,135	0.58%
33	合顺盈二号	1,494,191	0.57%
34	长沙华业	1,447,353	0.55%
35	承远壹号	1,447,349	0.55%
36	贾自强	1,405,071	0.54%
37	物奇陆	1,377,797	0.53%
38	泰科源	1,344,906	0.51%
39	荣泽投资	1,254,465	0.48%
40	姜永林	1,185,716	0.45%
41	杨心茹	1,156,069	0.44%
42	顾成标	1,126,430	0.43%
43	盈趣科技	940,778	0.36%
44	合泰昇通	889,284	0.34%
45	渝富益华	889,284	0.34%
46	重泰资本	761,762	0.29%
47	豫富君沅	711,427	0.27%
48	王飞	672,453	0.26%
49	曹义勇	602,174	0.23%
50	科兴科创	506,570	0.19%
51	信见成	173,902	0.07%
合计		261,865,000	100.00%

7、2025 年 11 月，股份公司第二次股权转让

2025 年 11 月 20 日，临空远翔与洪泰嘉晟签署《产权交易合同》，约定临空远翔将其所持有公司 503.3912 万股股份以 6,274.3142 万元的价格转让给洪泰

嘉晟。本次交易交割完成后，临空远翔不再持有发行人股份。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价款	转让价格(元/股)
1	临空远翔	洪泰嘉晟	5,033,912	6,274.3142	12.46

本次股权转让完成后，物奇微股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.15%
2	任泽生	19,310,303	7.37%
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%
4	哈勃投资	15,920,859	6.08%
5	林豪	12,506,322	4.78%
6	鼎精投资	11,151,704	4.26%
7	洪泰嘉晟	9,598,912	3.67%
8	南方工业基金	9,152,664	3.50%
9	物奇伍	8,767,551	3.35%
10	重庆战新	8,300,000	3.17%
11	物奇贰	7,690,452	2.94%
12	惠友投资	7,236,755	2.76%
13	ASTREND	7,236,755	2.76%
14	物奇壹	6,412,884	2.45%
15	物奇捌	6,195,584	2.37%
16	物奇叁	5,907,026	2.26%
17	智城二号	5,427,565	2.07%
18	物奇肆	5,110,261	1.95%
19	孙凤龙	4,710,089	1.80%
20	清研华业	4,576,330	1.75%
21	熊飞	4,165,838	1.59%
22	佳禾电声	4,052,579	1.55%
23	聚源创投	3,618,376	1.38%
24	ANKER	2,894,701	1.11%
25	君丰桐芯	2,285,291	0.87%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
26	北碚西证	2,017,359	0.77%
27	大河融科	2,013,643	0.77%
28	利和丰投资	1,585,469	0.61%
29	睿鲸云锦	1,541,430	0.59%
30	吴君宇	1,510,135	0.58%
31	商功投资	1,510,135	0.58%
32	合顺盈二号	1,494,191	0.57%
33	长沙华业	1,447,353	0.55%
34	承远壹号	1,447,349	0.55%
35	贾自强	1,405,071	0.54%
36	物奇陆	1,377,797	0.53%
37	泰科源	1,344,906	0.51%
38	荣泽投资	1,254,465	0.48%
39	姜永林	1,185,716	0.45%
40	杨心茹	1,156,069	0.44%
41	顾成标	1,126,430	0.43%
42	盈趣科技	940,778	0.36%
43	合泰昇通	889,284	0.34%
44	渝富益华	889,284	0.34%
45	重泰资本	761,762	0.29%
46	豫富君沅	711,427	0.27%
47	王飞	672,453	0.26%
48	曹义勇	602,174	0.23%
49	科兴科创	506,570	0.19%
50	信见成	173,902	0.07%
合计		261,865,000	100.00%

8、2026 年 6 月，股份公司第三次股权转让

2026 年 4 月，鼎精投资与刘辉签署《重庆物奇微电子股份有限公司股份转让协议》，约定鼎精投资将其所持有公司 632.4912 万股股份以 9,419.80 万元的价格转让给刘辉。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价款	转让价格(元/股)
1	鼎精投资	刘辉	6,324,912	9,419.80	14.89

2026年6月，前述股权转让完成交割，物奇微股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.15%
2	任泽生	19,310,303	7.37%
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%
4	哈勃投资	15,920,859	6.08%
5	林豪	12,506,322	4.78%
6	洪泰嘉晟	9,598,912	3.67%
7	南方工业基金	9,152,664	3.50%
8	物奇伍	8,767,551	3.35%
9	重庆战新	8,300,000	3.17%
10	物奇贰	7,690,452	2.94%
11	惠友投资	7,236,755	2.76%
12	ASTREND	7,236,755	2.76%
13	物奇壹	6,412,884	2.45%
14	刘辉	6,324,912	2.42%
15	物奇捌	6,195,584	2.37%
16	物奇叁	5,907,026	2.26%
17	智城二号	5,427,565	2.07%
18	物奇肆	5,110,261	1.95%
19	鼎精投资	4,826,792	1.84%
20	孙凤龙	4,710,089	1.80%
21	清研华业	4,576,330	1.75%
22	熊飞	4,165,838	1.59%
23	佳禾电声	4,052,579	1.55%
24	聚源创投	3,618,376	1.38%
25	ANKER	2,894,701	1.11%
26	君丰桐芯	2,285,291	0.87%
27	北碚西证	2,017,359	0.77%
28	大河融科	2,013,643	0.77%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
29	利和丰投资	1,585,469	0.61%
30	睿鲸云锦	1,541,430	0.59%
31	吴君宇	1,510,135	0.58%
32	商功投资	1,510,135	0.58%
33	合顺盈二号	1,494,191	0.57%
34	长沙华业	1,447,353	0.55%
35	承远壹号	1,447,349	0.55%
36	贾自强	1,405,071	0.54%
37	物奇陆	1,377,797	0.53%
38	泰科源	1,344,906	0.51%
39	荣泽投资	1,254,465	0.48%
40	姜永林	1,185,716	0.45%
41	杨心茹	1,156,069	0.44%
42	顾成标	1,126,430	0.43%
43	盈趣科技	940,778	0.36%
44	合泰昇通	889,284	0.34%
45	渝富益华	889,284	0.34%
46	重泰资本	761,762	0.29%
47	豫富君砾	711,427	0.27%
48	王飞	672,453	0.26%
49	曹义勇	602,174	0.23%
50	科兴科创	506,570	0.19%
51	信见成	173,902	0.07%
合计		261,865,000	100.00%

9、2026 年 6 月，股份公司第四次股权转让

2026 年 6 月，哈勃投资与远致星火签署《股份转让协议》，约定哈勃投资将其所持有公司 327.3313 万股股份以 4,875.00 万元的价格转让给远致星火。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股份数量（股）	转让价款	转让价格（元/股）
1	哈勃投资	远致星火	3,273,313	4,875.00	14.89

本次股权转让完成后，物奇微股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.15%
2	任泽生	19,310,303	7.37%
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%
4	哈勃投资	12,647,546	4.83%
5	林豪	12,506,322	4.78%
6	洪泰嘉晟	9,598,912	3.67%
7	南方工业基金	9,152,664	3.50%
8	物奇伍	8,767,551	3.35%
9	重庆战新	8,300,000	3.17%
10	物奇贰	7,690,452	2.94%
11	惠友投资	7,236,755	2.76%
12	ASTREND	7,236,755	2.76%
13	物奇壹	6,412,884	2.45%
14	刘辉	6,324,912	2.42%
15	物奇捌	6,195,584	2.37%
16	物奇叁	5,907,026	2.26%
17	智城二号	5,427,565	2.07%
18	物奇肆	5,110,261	1.95%
19	鼎精投资	4,826,792	1.84%
20	孙凤龙	4,710,089	1.80%
21	清研华业	4,576,330	1.75%
22	熊飞	4,165,838	1.59%
23	佳禾电声	4,052,579	1.55%
24	聚源创投	3,618,376	1.38%
25	远致星火	3,273,313	1.25%
26	ANKER	2,894,701	1.11%
27	君丰桐芯	2,285,291	0.87%
28	北碚西证	2,017,359	0.77%
29	大河融科	2,013,643	0.77%
30	利和丰投资	1,585,469	0.61%
31	睿鲸云锦	1,541,430	0.59%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
32	吴君宇	1,510,135	0.58%
33	商功投资	1,510,135	0.58%
34	合顺盈二号	1,494,191	0.57%
35	长沙华业	1,447,353	0.55%
36	承远壹号	1,447,349	0.55%
37	贾自强	1,405,071	0.54%
38	物奇陆	1,377,797	0.53%
39	泰科源	1,344,906	0.51%
40	荣泽投资	1,254,465	0.48%
41	姜永林	1,185,716	0.45%
42	杨心茹	1,156,069	0.44%
43	顾成标	1,126,430	0.43%
44	盈趣科技	940,778	0.36%
45	合泰昇通	889,284	0.34%
46	渝富益华	889,284	0.34%
47	重泰资本	761,762	0.29%
48	豫富君冻	711,427	0.27%
49	王飞	672,453	0.26%
50	曹义勇	602,174	0.23%
51	科兴科创	506,570	0.19%
52	信见成	173,902	0.07%
合计		261,865,000	100.00%

（四）历次增资及股权转让决策及核准程序

发行人历次增资及股权转让均已按照当时有效的《公司章程》的规定履行了公司内部决策程序，并已取得主管工商部门等有权机关的必要批复或备案文件。

发行人历次股权转让均系转让方及受让方的真实意思表示，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。

（五）历史沿革中非货币出资情况

发行人历次出资中除整体变更为股份公司外，不涉及非货币出资。发行人

非货币出资资产均已履行了评估程序，符合公司法的相关规定；发行人非货币出资不涉及国有资产，不适用于国有资产管理相关规定。

三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）

2016 年末，发行人创始股东选择在重庆创业设立物奇科技，随着物奇科技经营规模逐渐扩大，市场拓展、产业链协同、集成电路专业人才等需求随之提升，创始股东对公司未来架构进行综合考虑，计划：1）参考物奇科技股权结构新设物奇微有限作为未来管理主体，物奇微有限设立后收购物奇科技 100%股权；2）上海张江作为集成电路产业聚集区符合公司持续发展的要求，且主要核心骨干集中在上海办公及生活，后续物奇微有限在上海张江设立子公司，未来业务拓展新衍生的产品线由新子公司运营，不同子公司按产品线区分定位。

根据前述公司管理需要，发行人设立后，于 2018 年 9 月按注册资本作价购买物奇科技 100%股权，变更后物奇科技成为发行人全资子公司。

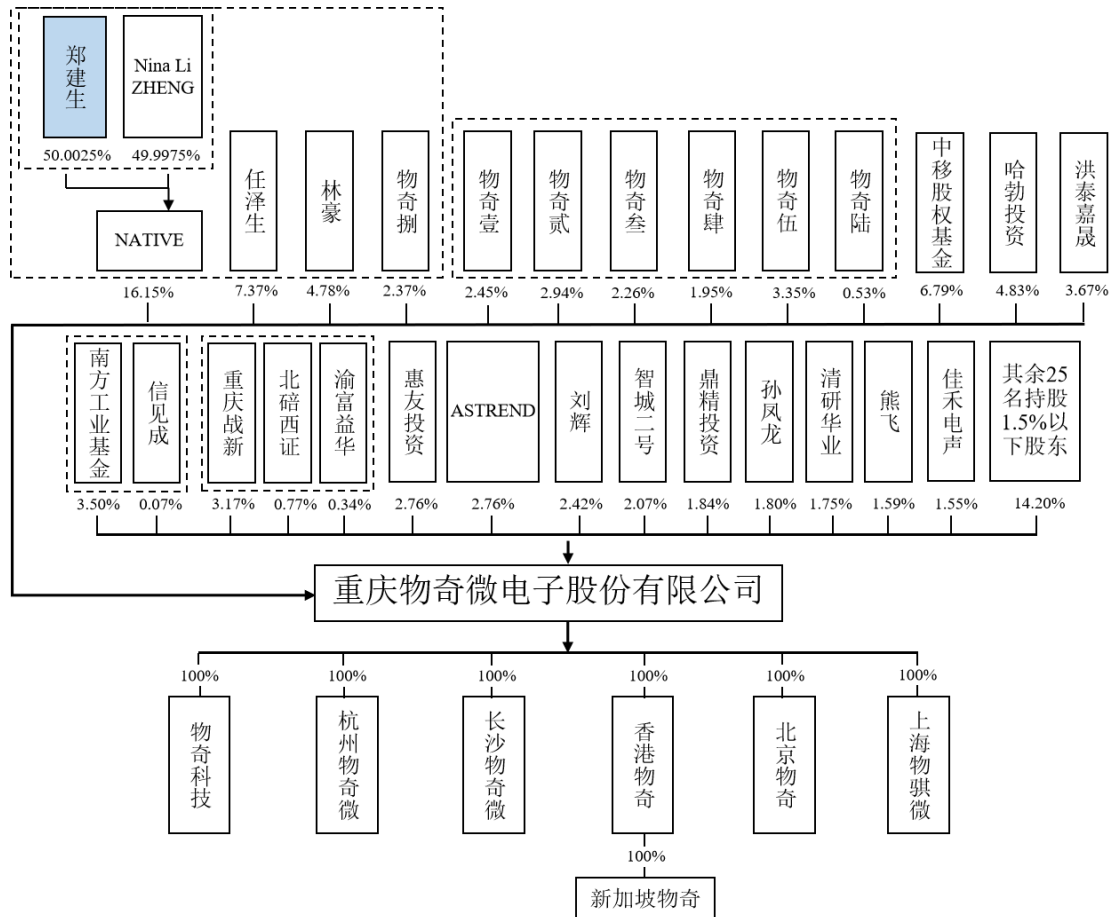
除上述事项，自成立以来，发行人不存在对管理层、控制权、业务发展及经营业绩有影响的重要事件，报告期内不存在重大资产重组情况。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他证券市场上市/挂牌的情况。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构及控制关系如下所示：



六、发行人控股子公司、参股公司简要情况

（一）发行人及子公司业务定位关系

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 6 家一级全资子公司，1 家二级子公司，不存在参股公司的情形。

该等公司均围绕发行人主营业务开展经营，是发行人主营业务的重要组成部分或为主营业务提供支持等，公司与各子公司之间的业务定位明确、分工合理，有利于资源整合，优势互补。

发行人各子公司之间的业务关系、发展定位，各公司与发行人主营业务的对应关系具体如下：

序号	公司名称	经营和发展定位	是否属于重要子公司
1	物奇科技	是发行人主营业务的重要组成部分，主要从事 PLC 芯片、端侧智能芯片及部分 Wi-Fi 芯片研发、设计和销售	是
2	上海物骐微	是发行人主营业务的重要组成部分，主要从事端侧	是

序号	公司名称	经营和发展定位	是否属于重要子公司
		智能芯片及 Wi-Fi 芯片研发、设计和销售	
3	香港物奇	海外销售主体、境外研发成本中心	是
4	新加坡物奇	暂未实际开展业务，拟作为海外销售主体、境外研发成本中心	否
5	长沙物奇微	研发和客户支持中心	否
6	杭州物奇微	研发和客户支持中心	否
7	北京物奇	研发和客户支持中心	否

注：公司在确定子公司是否重要时，一般考虑将最近一期经审计的资产总额、收入总额或利润总额占发行人合并报表相应科目比例超过 15%的子公司、或虽未达到上述比例，但作为发行人主要研发基地的子公司或发行人主要募投项目所在的子公司确定为重要子公司。

1、物奇科技

公司名称	重庆物奇科技有限公司
成立时间	2016 年 11 月 29 日
法定代表人	郑建生
注册资本	10,000.00 万元
实收资本	10,000.00 万元
注册地址	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 层
主要生产经营地	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 层
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	PLC 芯片、端侧智能芯片及部分 Wi-Fi 芯片研发、设计和销售

物奇科技最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	25,637.48
净资产	9,703.72
营业收入	21,070.84
净利润	2,777.97

注：以上数据经天健会计师审计。

2、上海物骐微

公司名称	上海物骐微电子有限公司
成立时间	2020 年 5 月 22 日
法定代表人	郑建生

注册资本	60,000.00 万元
实收资本	60,000.00 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 2 第 17 层 1701 室
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 2 第 17 层 1701 室
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	端侧智能芯片及 Wi-Fi 芯片研发、设计和销售

上海物骐微最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	48,047.39
净资产	5,804.85
营业收入	48,548.29
净利润	-24,597.64

注：以上数据经天健会计师审计。

3、香港物奇

公司名称	WuQi Micro (Hong Kong) Limited
成立时间	2019 年 1 月 22 日
董事	郑建生
股本总额	5,000,000 美元
已发行股份数量	5,000,000 股
注册地及主要生产经营地	Unit 43, Flat 2, G/F, Fo Tan Industrial Centre, 26-28 Au Pui Wan St., Fo Tan, Shatin
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	海外销售主体、境外研发成本中心

香港物奇最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	7,589.16
净资产	-2,925.49
营业收入	23,693.29
净利润	1,998.99

注：以上数据经天健会计师审计。

4、新加坡物奇

公司名称	Wuqi Micro（Singapore）Pte. Ltd.
成立时间	2022 年 7 月 27 日
董事	葛翔
股本总额	1 美元
已发行股份数量	1 股
注册地及主要生产 经营地	81 AYER RAJAH CRESCENT, #01-42, SINGAPORE 139967
股东持股情况	香港物奇持股 100%
主营业务	暂未实际开展业务，拟作为海外销售主体、境外研发成本中心

截至 2025 年末，新加坡物奇暂未实际开展业务，无财务数据。

5、长沙物奇微

公司名称	长沙物奇微电子有限公司
成立时间	2019 年 4 月 16 日
法定代表人	江正忠
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
注册地及主要生 产经营地	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段 77 号 C6 栋三一众创 23 楼 2333 号
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	研发和客户支持中心

长沙物奇微最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	2,911.23
净资产	-861.73
营业收入	904.26
净利润	-81.85

注：以上数据经天健会计师审计。

6、杭州物奇微

公司名称	杭州物奇微电子有限公司
成立时间	2024 年 8 月 28 日

法定代表人	毛向荣
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
注册地及主要生产经营地	浙江省杭州市西湖区敏迪智谷大厦 1 号楼九层 941 室
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	研发和客户支持中心

杭州物奇微最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	340.91
净资产	-9.82
营业收入	214.40
净利润	-118.47

注：以上数据经天健会计师审计。

7、北京物奇

公司名称	北京物奇科技有限公司
成立时间	2025 年 3 月 11 日
法定代表人	毛向荣
注册资本	1,000 万元
实收资本	800 万元
注册地及主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 6 层 606-3A 室
股东持股情况	发行人持股 100%
主营业务	研发和客户支持中心

北京物奇最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	191.88
净资产	191.66
营业收入	26.02
净利润	-608.34

注：以上数据经天健会计师审计。

（二）报告期内注销的子公司

公司名称	股权结构	注册资本 (万元)	注销时间	注销原因	资产、业务、人员处置
智联讯科	发行人持股 100%	500.00	2023/12/15	未实际开展业务，后续亦无经营计划，予以注销	注销前无资产、业务、人员
上海物麒	物奇科技持股 100%	500.00	2024/2/23	定位与上海物骐微重合，为提高管理和运作效率，调整公司架构，将其名下无形资产及人员转移至上海物骐微后不再实际经营，予以注销	注销前无资产、业务、人员

（三）报告期内转让的子公司

报告期内，发行人不存在转让子公司的情形。

（四）发行人及其子公司生产经营及违法违规情况

报告期内，发行人子公司按照其业务定位正常生产经营，不存在经营异常的情况。

报告期内，发行人子公司不存在重大违法违规行为，不存在影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格的情形。

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东，实际控制人为郑建生。

1、控股股东

根据《公司法》第二百六十五条的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

截至本招股说明书签署日，公司第一大股东为 NATIVE，持有发行人 42,285,334 股股份，占股份总数的 16.15%。报告期内，NATIVE 持股比例始终未超过公司股本总额的 30%，其单独所持有的公司股份所享有的表决权不足以决定发行人股东会普通决议事项和特别决议事项，无法通过其持有的股份所享

有的表决权决定公司的重大事项。因此，截至本招股说明书签署日，公司无控股股东。

2、实际控制人

根据《公司法》第二百六十五条的规定，实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人为郑建生，具体理由如下：

（1）郑建生合计控制公司 32.25%股份的表决权，能够对发行人股东会的决议产生重大影响

郑建生（Jason ZHENG）系 NATIVE 的控股股东，持有 NATIVE 50.0025% 的股份，郑建生女儿 Nina Li ZHENG 持有 NATIVE 49.9975% 的股份。两人于 2019 年 12 月 6 日签署《委托代理书》，Nina Li ZHENG 将其所持有的 NATIVE 股权所对应的全部股东投票、提名或委派董事权等股东权利委托给郑建生行使，直至物奇微首次公开发行股票并在交易所上市交易之日起三年（三十六个月）。综合考虑郑建生与 Nina Li ZHENG 的父女关系、双方签署的《委托代理书》，且 Nina Li ZHENG 从未实际参与过 NATIVE 的经营管理，因此郑建生可以实质控制 NATIVE。截至本招股说明书签署之日，NATIVE 持有发行人 42,285,334 股，持股比例为 16.15%，郑建生通过 NATIVE 控制发行人 16.15% 股份。

根据郑建生、NATIVE 与任泽生、林豪、熊飞于 2019 年 12 月 6 日签署的《一致行动人协议》（代称“一致行动人协议 1”），各方约定保证就有关公司经营发展的重大事项充分保持一致意见，以巩固郑建生在公司的实际控制地位，如各方进行反复沟通协商后，不能形成一致行动意见，各方应以郑建生意见为准。2025 年 6 月 26 日，前述各方签署《一致行动人协议之终止协议》，并由郑建生、NATIVE 与任泽生、林豪重新签署《一致行动人协议》（代称“一致行动人协议 2”），协议内容与一致行动人协议 1 相同，期限至公司首次公开发行股票并在交易所上市交易之日起三年。截至本招股说明书签署之日，任泽生、林豪分别持有发行人 19,310,303 股、12,506,322 股，对应持股比例分别为 7.37%、4.78%。郑建生通过自己及 NATIVE 与任泽生、林豪之间的一

致行动关系，控制发行人 12.15%股份。

根据郑建生、熊飞于 2025 年 6 月 26 日签署的《表决权委托协议》，熊飞不可撤销地全权委托郑建生代表其行使熊飞作为物奇微的股东，依据现行有效适用的法律法规及目标公司届时有效的章程、股东协议等文件（包括不时修改或替换该等文件的文件，以下统称“公司治理文件”）所享有的下列权利（以下统称“委托权利”）：（1）作为熊飞的代理人，根据目标公司的公司治理文件提议召开和出席目标公司的股东会会议；（2）代表熊飞对所有需要目标公司股东会讨论、决议的事项行使表决权；和（3）其他目标公司的公司治理文件项下的股东表决权及其他股东权利。截至本招股说明书签署之日，熊飞持有发行人 4,165,838 股，对应持股比例为 1.59%。郑建生通过与熊飞的《表决权委托协议》，控制发行人 1.59%股份。

物奇捌持有发行人 6,195,584 股股份，持股比例为 2.37%，郑建生作为物奇捌的执行事务合伙人控制发行人 2.37%股份。

综上，截至本招股说明书签署日，郑建生通过前述途径合计控制发行人 84,463,381 股股份表决权，占发行人本次发行上市前股份总数的 32.25%，其控制的股份所享有的表决权已足以对发行人股东会的决议产生重大影响；报告期内郑建生控制的发行人表决权比例从未低于 30%且始终为发行人第一大股东，同时其他股东的持股比例较为分散，不存在其他股东单独或同一控制下合计持股比例超过 10%的情形，与郑建生合计控制的股份比例存在较大差距。

（2）郑建生能够对董事会及公司实际经营管理施加重大影响

发行人董事会由 7 名非独立董事和 4 名独立董事组成，7 名非独立董事中的 4 名董事由郑建生通过 NATIVE 提名，且郑建生担任董事长。报告期内，发行人董事会决议事项，除郑建生回避表决的情形外，其余董事未出现与郑建生相反表决意见的情形。

同时，郑建生作为发行人的创始人、董事长，能够明确公司战略定位，把握公司发展的方向及未来的战略布局，推动公司实现战略目标；郑建生担任发行人总经理，能够主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司的基本管

理制度，制定公司的具体规章等。

综上所述，郑建生为发行人实际控制人，且最近两年未发生变化。

实际控制人基本情况如下：

郑建生先生，1955 年出生，美国国籍，中国永久居留权，其所持中华人民共和国外国人永久居留身份证号：USA310055*****。

报告期内，发行人实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

3、控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押或争议情况

截至本招股说明书签署之日，实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在委托持股、信托持股或者其他利益安排，亦不存在质押或其他有争议的情况。

4、控股股东、实际控制人控制或施加重大影响其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除物奇微及其下属公司外，实际控制人控制或施加重大影响的其他企业为 NATIVE 以及物奇捌：

序号	公司名称	与发行人关系	主营业务
1	NATIVE	发行人股东	股权投资
2	物奇捌	发行人股东	股权投资

（1）NATIVE

截至报告期末，NATIVE 持有发行人 42,285,334 股股份，占发行人总股本的 16.15%，系发行人第一大股东，其基本情况和股东结构如下：

公司名称	Native Explorer Limited
成立时间	2018 年 3 月 15 日
公司编号	1973077
注册资本	4.00 万美元
实收资本	4.00 万美元

注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
主营业务与发行人 主营业务的关系	股权投资

截至报告期末，NATIVE 出资构成和出资比例如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	郑建生	2.0001	50.0025
2	Nina Li ZHENG	1.9999	49.9975
合计		4.0000	100.0000

NATIVE 最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年年度
总资产	1,089.46
净资产	1,079.11
营业收入	-
净利润	-0.21

注：以上数据经上海轩和会计师事务所（普通合伙）审计。

（2）物奇捌

截至报告期末，物奇捌持有发行人 6,195,584 股股份，占发行人总股本的 2.37%，其基本情况和出资结构如下：

企业名称	上海物奇捌企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MAC5H2EB03
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	郑建生
成立时间	2023 年 1 月 11 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼
经营范围/主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务与发行人 主营业务的关系	发行人员工持股平台

截至报告期末，物奇捌的合伙人及出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	郑建生	董事长、总经理	0.2168	0.01%
2	有限合伙人	庞功会	董事、副总经理	801.0192	29.89%
3	有限合伙人	古强	副总工程师	758.7462	28.31%
4	有限合伙人	韦韧	副总工程师	758.7462	28.31%
5	有限合伙人	毛向荣	董事会秘书	361.2716	13.48%
合计			-	2,680.0000	100.00%

物奇捌的普通合伙人为郑建生，其基本情况请参见招股说明书本节之“七、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

物奇捌最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年年度
总资产	2,679.95
净资产	2,679.95
营业收入	-
净利润	-0.03

注：以上数据未经审计。

（二）其他持股 5%以上主要股东基本情况

截至本招股说明书签署之日，其他持有发行人 5%以上股份的股东分别为任泽生、中移股权基金。其基本情况分别如下：

1、任泽生

截至报告期末，任泽生持有发行人 19,310,303 股股份，占发行人总股本的 7.37%，其基本情况如下：

姓名	任泽生
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
身份证号码	510202194909*****

2、中移股权基金

截至报告期末，中移股权基金持有发行人 17,785,713 股股份，占发行人总股本的 6.79%，其基本情况和合伙人结构如下：

（1）基本情况

企业名称	中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）
企业类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2019年12月27日
合伙期限	2019年12月27日至无固定期限
出资额	687,600.00 万元
主要经营场所	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 F 栋 1 层 108 单元
执行事务合伙人	中移股权基金管理有限公司
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	股权投资

（2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，中移股权基金的合伙人及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资比例
1	普通合伙人	中移股权基金管理有限公司	7,600.00	1.11%
2	有限合伙人	中移资本控股有限责任公司	300,000.00	43.63%
3	有限合伙人	中国民航信息网络股份有限公司	100,000.00	14.54%
4	有限合伙人	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	100,000.00	14.54%
5	有限合伙人	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	100,000.00	14.54%
6	有限合伙人	国家制造业转型升级基金股份有限公司	80,000.00	11.63%
合计			687,600.00	100.00%

中移股权基金的执行事务合伙人为中移股权基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称	中移股权基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 F 栋 1 层 107 单元
法定代表人	聂宇田
经营范围	受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019年9月6日

营业期限	2019年9月6日至无固定期限
------	-----------------

中移股权基金管理有限公司的实际控制人为国务院国资委。

八、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，亦不存在协议控制架构等治理方面的特殊安排。

九、发行人有关股本情况

（一）本次发行前后股本情况

本次发行前，公司股份总数为 261,865,000 股。如实际发行按照本次发行上限 87,335,000 股计算（最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准），本次向社会公众发行的股份占发行后总股本 349,200,000 股的比例为 25.01%。

本次发行前后股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	NATIVE	42,285,334	16.15%	42,285,334	12.11%
2	任泽生	19,310,303	7.37%	19,310,303	5.53%
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%	17,785,713	5.09%
4	哈勃投资	12,647,546	4.83%	12,647,546	3.62%
5	林豪	12,506,322	4.78%	12,506,322	3.58%
6	洪泰嘉晟	9,598,912	3.67%	9,598,912	2.75%
7	南方工业基金	9,152,664	3.50%	9,152,664	2.62%
8	物奇伍	8,767,551	3.35%	8,767,551	2.51%
9	重庆战新	8,300,000	3.17%	8,300,000	2.38%
10	物奇贰	7,690,452	2.94%	7,690,452	2.20%
11	惠友投资	7,236,755	2.76%	7,236,755	2.07%
12	ASTREND	7,236,755	2.76%	7,236,755	2.07%
13	物奇壹	6,412,884	2.45%	6,412,884	1.84%
14	刘辉	6,324,912	2.42%	6,324,912	1.81%
15	物奇捌	6,195,584	2.37%	6,195,584	1.77%
16	物奇叁	5,907,026	2.26%	5,907,026	1.69%

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
17	智城二号	5,427,565	2.07%	5,427,565	1.55%
18	物奇肆	5,110,261	1.95%	5,110,261	1.46%
19	鼎精投资	4,826,792	1.84%	4,826,792	1.38%
20	孙凤龙	4,710,089	1.80%	4,710,089	1.35%
21	清研华业	4,576,330	1.75%	4,576,330	1.31%
22	熊飞	4,165,838	1.59%	4,165,838	1.19%
23	佳禾电声	4,052,579	1.55%	4,052,579	1.16%
24	聚源创投	3,618,376	1.38%	3,618,376	1.04%
25	远致星火	3,273,313	1.25%	3,273,313	0.94%
26	ANKER	2,894,701	1.11%	2,894,701	0.83%
27	君丰桐芯	2,285,291	0.87%	2,285,291	0.65%
28	北碚西证	2,017,359	0.77%	2,017,359	0.58%
29	大河融科	2,013,643	0.77%	2,013,643	0.58%
30	利和丰投资	1,585,469	0.61%	1,585,469	0.45%
31	睿鲸云锦	1,541,430	0.59%	1,541,430	0.44%
32	吴君宇	1,510,135	0.58%	1,510,135	0.43%
33	商功投资	1,510,135	0.58%	1,510,135	0.43%
34	合顺盈二号	1,494,191	0.57%	1,494,191	0.43%
35	长沙华业	1,447,353	0.55%	1,447,353	0.41%
36	承远壹号	1,447,349	0.55%	1,447,349	0.41%
37	贾自强	1,405,071	0.54%	1,405,071	0.40%
38	物奇陆	1,377,797	0.53%	1,377,797	0.39%
39	泰科源	1,344,906	0.51%	1,344,906	0.39%
40	荣泽投资	1,254,465	0.48%	1,254,465	0.36%
41	姜永林	1,185,716	0.45%	1,185,716	0.34%
42	杨心茹	1,156,069	0.44%	1,156,069	0.33%
43	顾成标	1,126,430	0.43%	1,126,430	0.32%
44	盈趣科技	940,778	0.36%	940,778	0.27%
45	合泰昇通	889,284	0.34%	889,284	0.25%
46	渝富益华	889,284	0.34%	889,284	0.25%
47	重泰资本	761,762	0.29%	761,762	0.22%

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
48	豫富君沅	711,427	0.27%	711,427	0.20%
49	王飞	672,453	0.26%	672,453	0.19%
50	曹义勇	602,174	0.23%	602,174	0.17%
51	科兴科创	506,570	0.19%	506,570	0.15%
52	信见成	173,902	0.07%	173,902	0.05%
53	本次发行新股	-	-	87,335,000	25.01%
合计		261,865,000	100.00%	349,200,000	100.00%

（二）本次发行前后公司前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例	股份性质
1	NATIVE	42,285,334	16.15%	非自然人股
2	任泽生	19,310,303	7.37%	自然人股
3	中移股权基金	17,785,713	6.79%	非自然人股
4	哈勃投资	12,647,546	4.83%	非自然人股
5	林豪	12,506,322	4.78%	自然人股
6	洪泰嘉晟	9,598,912	3.67%	非自然人股
7	南方工业基金	9,152,664	3.50%	非自然人股
8	物奇伍	8,767,551	3.35%	非自然人股
9	重庆战新	8,300,000	3.17%	非自然人股
10	物奇贰	7,690,452	2.94%	非自然人股
合计		148,044,797	56.53%	-

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，公司共有 12 名自然人股东。公司前十名自然人股东以及在发行人处担任职务的具体情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号	住所	在发行人处任职情况
1	任泽生	男	中国	否	510202194909*****	重庆市渝中区*****	-
2	林豪	男	中国	否	350403197606*****	上海市浦东新区*****	董事、副总经理

序号	姓名	性别	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号	住所	在发行人处任职情况
3	刘辉	男	中国	否	362401197308*****	上海市浦东新区 *****	-
4	孙凤龙	男	中国	否	220211197305*****	吉林省吉林市船营区 *****	-
5	熊飞	男	中国	否	511202197912*****	上海市浦东新区 *****	-
6	吴君宇	男	中国	否	142433197710*****	山西省晋中市榆次区 *****	-
7	贾自强	男	中国	否	132324197012*****	广东省广州市天河区 *****	-
8	姜永林	男	中国	否	320223197012*****	广东省深圳市南山区 *****	-
9	杨心茹	女	中国	否	431227199906*****	湖南省新晃侗族自治县 *****	-
10	顾成标	男	中国	否	310101196508*****	上海市徐汇区 *****	-

（四）发行人国有股份与外资股份的情况

1、发行人国有股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在国有股份情况。

2、发行人外资股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人有 3 个外资股东，分别为 NATIVE、ASTREND 及 ANKER。各外资股东直接持股的基本情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	注册地
1	NATIVE	42,285,334	16.15%	英属维尔京群岛（BVI）
2	ASTREND	7,236,755	2.76%	中国香港
3	ANKER	2,894,701	1.11%	中国香港
合计		52,416,790	20.02%	-

（五）申报前十二个月发行人新增股东的情况

截至本招股说明书签署之日前十二个月，发行人新增股东包括重庆战新、洪泰嘉晟、北碚西证、合顺盈二号、泰科源、王飞、刘辉、远致星火。上述股东均系发行人为经营所需进行市场化融资引入财务投资人，因看好公司发展前景，通过增资或股权受让的方式入股发行人。具体情况如下表所示：

时间	股东姓名/名称	增资/受让数量（股）	入股原因	入股价格（元/股）	定价依据
2025.6	重庆战新	8,300,000	看好发行人未来发展	16.87	协商确定
	洪泰嘉晟	4,565,000			
	北碚西证	2,017,359	看好发行人未来发展	14.87	协商确定
	合顺盈二号	1,494,191			协商确定
	泰科源	1,344,906			协商确定
	王飞	672,453			协商确定
2025.11	洪泰嘉晟	5,033,912	看好发行人未来发展	12.46	协商确定
2026.6	刘辉	6,324,912	看好发行人未来发展	14.89	协商确定
2026.6	远致星火	3,273,313	看好发行人未来发展	14.89	协商确定

注：2025 年 11 月，洪泰嘉晟基于渝北区国资委统一安排，通过重庆联合产权交易所受让临空远翔持有的公司 5,033,912 股股份，截至招股说明书签署之日，洪泰嘉晟持有公司 9,598,912 股股份。

1、重庆战新

截至本招股说明书签署之日，重庆战新持有发行人 8,300,000 股股份，占总股本的 3.17%。

（1）基本情况

企业名称	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 5 月 13 日
出资额	3,460,255.00 万元
主要经营场所	重庆市两江新区仙桃街道景融街 66 号渝富创新中心 A 栋 15、16 楼
执行事务合伙人	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司
经营范围	一般项目：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

（2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，重庆战新的合伙人及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资比例
1	普通合伙人	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司	255.00	0.01%
2	有限合伙人	重庆渝资光电产业投资有限公司	2,000,000.00	57.80%
3	有限合伙人	重庆渝富控股集团有限公司	500,000.00	14.45%
4	有限合伙人	重庆两江新区产业发展集团有限公司	320,000.00	9.25%
5	有限合伙人	重庆市渝北国有资本投资有限公司	200,000.00	5.78%
6	有限合伙人	重庆科学城产业发展有限公司	150,000.00	4.33%
7	有限合伙人	重庆江北国投华信资产管理有限公司	150,000.00	4.33%
8	有限合伙人	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	50,000.00	1.45%
9	有限合伙人	重庆两山产业投资有限公司	50,000.00	1.45%
10	有限合伙人	重庆新梁产城置业发展有限公司	30,000.00	0.87%
11	有限合伙人	重庆两江战新科创产业有限公司	5,000.00	0.14%
12	有限合伙人	重庆两江新区产城融合发展有限公司	5,000.00	0.14%
合计			3,460,255.00	100.00%

重庆战新的执行事务合伙人为重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人	马宝
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2014 年 5 月 9 日
营业期限	2014 年 5 月 9 日至无固定期限

重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2、洪泰嘉晟

截至本招股说明书签署之日，洪泰嘉晟持有发行人 9,598,912 股股份，占总股本的 3.67%。

（1）基本情况

企业名称	重庆渝北洪泰嘉晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024 年 9 月 13 日
出资额	300,000.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101-113 号中渝香奈公馆 6-12 幢裙楼负 2-商业 11
执行事务合伙人	重庆洪泰共晟企业管理咨询有限公司
经营范围	许可项目：创业投资（限投资未上市企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务）
主营业务	股权投资

（2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，洪泰嘉晟的合伙人及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资比例
1	普通合伙人	重庆洪泰共晟企业管理咨询有限公司	3,000.00	1.00%
2	有限合伙人	重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	120,000.00	40.00%
3	有限合伙人	重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	90,000.00	30.00%
4	有限合伙人	重庆空港经济开发建设有限公司	60,000.00	20.00%
5	有限合伙人	青岛翊立企业管理合伙企业（有限合伙）	27,000.00	9.00%
合计			300,000.00	100.00%

洪泰嘉晟的执行事务合伙人为重庆洪泰共晟企业管理咨询有限公司，其基本情况如下：

企业名称	重庆洪泰共晟企业管理咨询有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101-113 号中渝香奈公馆 6-12 幢裙楼负 2-商业 11
法定代表人	刘立群
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2023 年 9 月 19 日
营业期限	2023 年 9 月 19 日至无固定期限

重庆洪泰共晟企业管理咨询有限公司的实际控制人为盛希泰。

3、北碚西证

截至本招股说明书签署之日，北碚西证持有发行人 2,017,359 股股份，占总股本的 0.77%。

（1）基本情况

企业名称	重庆北碚西证私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024 年 9 月 12 日
出资额	50,000.00 万元
主要经营场所	重庆市北碚区歇马镇歇马街 688 号（重庆高新区歇马拓展园）
执行事务合伙人	重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司、西证股权投资投资有限公司
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	股权投资

（2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，北碚西证的合伙人及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资比例
1	普通合伙人	重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司	100.00	0.20%
2	普通合伙人	西证股权投资投资有限公司	15,000.00	30.00%
3	有限合伙人	重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	14,900.00	29.80%
4	有限合伙人	重庆缙融资本运营管理有限公司	10,000.00	20.00%
5	有限合伙人	重庆市北碚新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	20.00%
合计			50,000.00	100.00%

北碚西证的执行事务合伙人为重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司、西证股权投资投资有限公司，其基本情况如下：

1) 重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司

企业名称	重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	重庆市渝北区仙桃街道景融街 66 号渝富创新中心 A 座 12 楼
法定代表人	石品
经营范围	许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2023 年 12 月 14 日
营业期限	2023 年 12 月 14 日至无固定期限

重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2) 西证股权投资有限公司

企业名称	西证股权投资有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	重庆市江北区金沙门路 32 号
法定代表人	何泉成
经营范围	许可项目：股权投资，股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2010 年 3 月 29 日
营业期限	2010 年 3 月 29 日至无固定期限

西证股权投资有限公司系上市公司西南证券股份有限公司（600369.SH）（以下简称“西南证券”）全资子公司，西南证券的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

4、合顺盈二号

截至本招股说明书签署之日，合顺盈二号持有发行人 1,494,191 股股份，占总股本的 0.57%。

（1）基本情况

企业名称	共青城合顺盈稳创二号创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 5 月 9 日

出资额	2,401.00 万元
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	深圳市铸成投资有限责任公司
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

（2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，合顺盈二号的合伙人及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资比例
1	普通合伙人	深圳市铸成投资有限责任公司	1.00	0.04%
2	有限合伙人	黄伟文	600.00	24.99%
3	有限合伙人	张一帆	400.00	16.66%
4	有限合伙人	冯大明	400.00	16.66%
5	有限合伙人	黄汉元	300.00	12.49%
6	有限合伙人	吴晋文	200.00	8.33%
7	有限合伙人	钟明利	200.00	8.33%
8	有限合伙人	邢文龙	100.00	4.16%
9	有限合伙人	彭百祥	100.00	4.16%
10	有限合伙人	金晓洲	100.00	4.16%
合计			2,401.00	100.00%

合顺盈二号的执行事务合伙人为深圳市铸成投资有限责任公司，其基本情况如下：

企业名称	深圳市铸成投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司
企业住址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	陈曦
经营范围	一般经营项目：股权投资；受托管理股权投资基金；商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场调研、场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商务文化交流活动、房地产信息咨询、房地产中介、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询（不含限制项目）、经济信息咨询

	（不含限制项目）、翻译、打印及复印。许可经营项目：无。
成立日期	2013 年 10 月 18 日
营业期限	2013 年 10 月 18 日至无固定期限

深圳市铸成投资有限责任公司的实际控制人为陈曦。

5、泰科源

截至本招股说明书签署之日，泰科源持有发行人 1,344,906 股股份，占总股本的 0.51%。

（1）基本情况

公司名称	深圳泰科源电子器件科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2022 年 3 月 9 日
注册资本	300.00 万元
主要经营场所	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号艺晶公司 15 栋 101
法定代表人	罗亚飞
经营范围	一般经营项目：电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	电子元器件分销商

（2）股东出资情况

截至本招股说明书签署日，泰科源的股东及其认缴情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	刘亚东	297.00	99.00%
2	于冠兰	3.00	1.00%
合计		300.00	100.00%

泰科源的实际控制人为刘亚东。

6、王飞

截至本招股说明书签署之日，王飞持有发行人 672,453 股股份，占总股本的 0.26%，其基本情况如下：

姓名	王飞
国籍	中国
身份证号码	320222198201*****

7、刘辉

截至本招股说明书签署之日，刘辉持有发行人 6,324,912 股股份，占总股本的 2.42%，其基本情况如下：

姓名	刘辉
国籍	中国
身份证号码	362401197308*****

8、远致星火

截至本招股说明书签署之日，远致星火持有发行人 3,273,313 股股份，占总股本的 1.25%，基本情况如下：

企业名称	深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 7 月 29 日
出资额	1,440,000 万元
主要经营场所	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3301 楼
执行事务合伙人	深圳市远致创业投资有限公司
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
主营业务	股权投资

远致星火执行事务合伙人深圳市远致创业投资有限公司基本情况如下：

企业名称	深圳市远致创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业住址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 33 层
法定代表人	石澜
经营范围	一般经营项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询

	服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
成立日期	2015 年 6 月 12 日
营业期限	2015 年 6 月 12 日至无固定期限

深圳市远致创业投资有限公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

9、最近一年新增股东与发行人、本次发行的中介机构的关联关系

发行人最近一年新增股东重庆战新与发行人股东渝富益华同受重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司管理。

发行人最近一年新增股东北碚西证执行事务合伙人之一重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司与重庆战新及渝富益华执行事务合伙人重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司的控股股东均为重庆渝富控股集团有限公司。

发行人最近一年新增股东北碚西证执行事务合伙人之一西证股权投资有限公司系为本次发行联席主承销商之一西南证券股份有限公司的全资子公司。

除上述关联关系外，最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或者其他利益输送安排。

10、新增股东股份锁定情况

截至本招股说明书签署之日，前述新增股东已出具《关于所持重庆物奇微电子股份有限公司股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺》，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺”之“7、申报前 6 个月内间接受让实际控制人股份的新增股东刘辉承诺”及“8、申报前 12 个月新增股东重庆战新、洪泰嘉晟、北碚西证、合顺盈二号、泰科源、王飞、远致星火承诺”。

（六）发行人私募基金股东情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 12 名自然人股东，40 名机构股

东，其中 18 名为私募基金，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成私募基金备案及私募基金管理人登记，具体如下：

序号	私募投资基金名称	《私募投资基金备案证明》基金编号	管理人名称	《私募投资基金管理人登记证明》登记编号
1	中移股权基金	SJJ658	中移股权基金管理有限公司	P1070353
2	南方工业基金	SEV458	重庆南方工业私募股权投资基金管理有限公司	P1069383
3	重庆战新	S66645	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司	P1004104
4	惠友投资	SQQ369	深圳市惠友私募股权基金管理有限公司	P1023992
5	智城二号	SSX271	深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	P1071410
6	清研华业	SM0288	重庆清研股权投资基金管理中心（有限合伙）	P1032918
7	洪泰嘉晟	SARU31	北京洪泰同创投资管理有限公司	P1023306
8	聚源创投	SNN898	中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）	P1030872
9	君丰桐芯	SQX496	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
10	北碚西证	SAND93	西证股权投资有限公司	GC2600030932
11	大河融科	SE6998	北京大河汇智投资管理有限公司	P1029438
12	睿鲸云锦	SXW633	上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）	P1062899
13	合顺盈二号	SBCT97	深圳市铸成投资有限责任公司	P1014511
14	长沙华业	SGU878	浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司	P1070998
15	渝富益华	STJ381	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司	P1004104
16	豫富君冻	STR229	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
17	科兴科创	SLP473	重庆科兴科创股权投资基金管理有限公司	P1070703
18	远致星火	SQZ967	深圳市远致创业投资有限公司	P1071984

除上表所列示的私募基金股东外，发行人其余机构股东均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行登记或备案程序。

（七）本次发行前各股东间的关联关系及一致行动关系

截至本招股说明书签署之日，发行人各股东间的关联关系及持股如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	占比	关联关系及一致行动关系说明
1	NATIVE	4,228.5334	16.15%	1、NATIVE、物奇捌为物奇微实际控制人郑建生控制的企业； 2、郑建生、NATIVE、任泽生、林豪为一致行动人； 3、熊飞与郑建生签署了《表决权委托协议》，约定熊飞不可撤销地全权委托郑建生代表其行使熊飞作为物奇微的股东，依据现行有效适用的法律法规及目标公司届时有效的章程、股东协议等文件所享有的表决权
2	任泽生	1,931.0303	7.37%	
3	林豪	1,250.6332	4.78%	
4	物奇捌	619.5584	2.37%	
5	熊飞	416.5838	1.59%	
6	物奇壹	641.2884	2.45%	发行人员工持股平台，执行事务合伙人均为上海智享创芯企业管理咨询有限公司
7	物奇贰	769.0452	2.94%	
8	物奇叁	590.7026	2.26%	
9	物奇肆	511.0261	1.95%	
10	物奇伍	876.7551	3.35%	
11	物奇陆	137.7797	0.53%	信见成是南方工业基金的执行事务合伙人重庆南方工业私募股权投资基金管理有限公司的员工跟投平台，双方为一致行动关系
12	南方工业基金	915.2664	3.50%	
13	信见成	17.3902	0.07%	君丰桐芯与豫富君冻的执行事务合伙人均为上海君冻企业管理合伙企业（有限合伙），基金管理人均为上海君桐股权投资管理有限公司
14	君丰桐芯	228.5291	0.87%	
15	豫富君冻	71.1427	0.27%	重庆战新与渝富益华的基金管理人均为重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司；北碚西证执行事务合伙人之一重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司与重庆战新及渝富益华执行事务合伙人重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司的控股股东均为重庆渝富控股集团有限公司
16	重庆战新	830.0000	3.17%	
17	渝富益华	88.9284	0.34%	
18	北碚西证	201.7359	0.77%	

此外，公司直接股东鼎精投资、君丰桐芯穿透后间接股东郑朝晖、郑琦君的外婆系发行人实际控制人郑建生的姑姑。除上述情形外，本次发行前其他股东间不存在关联关系及一致行动关系。

（八）股东对赌条款及解除情况

自 2019 年 1 月，发行人第一次增资（A 轮融资）开始的历次股权融资中均存在股东特殊权利安排，给予投资人股东特殊权利。公司及其创始股东 NATIVE、郑建生、林豪、熊飞等与投资人签署的投资协议/增资协议、股东合同等文件中，对优先认购权、优先购买权、优先出售权、回购权、业绩承诺及补偿条款等股东特殊权利进行了约定，具体情况如下：

1、协议的签署

序号	融资轮次	事项	合同名称及签署时点	合同相对方	股东特殊权利条款（有限列举）
1	2019年1月，第一次融资（A轮）	A轮投资者入股	2018年10月 《关于重庆物奇微电子有限 公司之增资协 议》	甲方（目标公司）：物奇微有限 乙方（投资方）：大河融科、临空开发、商功投资 丙方（创始股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资 丁方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	第 8.1 条优先认购权、第 8.2 条优先购买权、第 8.3 条优先出售权、第 8.4 条共同出售权、第 8.5 条优先清算权、第 8.6 条反稀释、第 8.8 条赎回权（回购义务人限于实际控制人及其一致行动人）、第 8.10 条业绩承诺及补偿（针对 2019 年度、2020 年度、2021 年度的扣非后利润总额进行了承诺和补偿约定）等
				甲方（目标公司）：物奇微有限 乙方（投资方）：靖烨投资、光大富尊 丙方（创始股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资 丁方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	第 8.1 条优先认购权、第 8.2 条优先购买权、第 8.3 条优先出售权、第 8.4 条共同出售权、第 8.5 条优先清算权、第 8.6 条反稀释、第 8.8 条赎回权（回购义务人限于实际控制人及其一致行动人，相对本轮的其他投资方增加了（1）截至 2023 年末完成上市；（2）关于 2019 年度主营业务收入下限的触发条款）、第 8.9 条业绩承诺及补偿（针对 2019 年度、2020 年度、2021 年度的主营业务收入额进行了承诺和补偿约定）等
2	2020年5月，第二次融资（B及B+轮）	B轮投资者入股	2020年1月 《关于重庆物奇微电子有限 公司之增资协 议》	甲方（投资方）：南方工业基金、润科投资、清研华业、信见成 乙方（目标公司）：物奇微有限 丙方（原股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资及前述 A 轮投资者 丁方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	第 8.1 条优先认购权、第 8.2 条优先购买权、第 8.3 条优先出售权、第 8.4 条共同出售权、第 8.5 条优先清算权、第 8.6 条反稀释、第 8.8 条赎回权（回购义务人仅限于实际控制人及其一致行动人，含截至 2023 年末完成上市的触发条款）、第 8.10 条业绩承诺及补偿（针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）等
		鉴于 B 轮投资者存在更加优惠的条款和条件，A 轮投资者应有权享受该等优惠	2020年1月 《<关于重庆物奇微电子有限 公司之增资协 议>补充协议》	甲方（目标公司）：物奇微有限 乙方（投资方）：大河融科、靖烨投资 丙方（创始股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资 丁方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	1、序号 1 增资协议中第 8.8 条款、第 8.10 条款不执行。A 轮投资方对目标公司、目标公司创始股东及目标公司实际控制人享有等同于 B 轮增资协议第 8.8 条、第 8.10 条约定的 B 轮投资方享有的权利； 2、业绩承诺期变更为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度

序号	融资轮次	事项	合同名称及签署时点	合同相对方	股东特殊权利条款（有限列举）
				甲方（目标公司）：物奇微有限 乙方（投资方）：商功投资 丙方（创始股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资 丁方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	1、序号 1 增资协议中第 8.8 条款、第 8.10 条款不执行； 2、全面修订第 8.8 条，增加包括截至 2023 年末完成上市等触发事件； 2、全面修订第 8.10 条，业绩承诺期变更为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度
		B+轮投资者入股	2020 年 4 月 《关于重庆物奇微电子有限 公司之增资协 议》	甲方（投资方）：华润创投 乙方（目标公司）：物奇微有限 丙方（原股东）：NATIVE、任泽生、熊飞、林豪、华奇恒、鼎精投资、荣泽投资及前述 A 轮投资者 丁方：前述 B 轮投资人 戊方（实际控制人）：Jason ZHENG（郑建生）	第 8.1 条优先认购权、第 8.2 条优先购买权、第 8.3 条优先出售权、第 8.4 条共同出售权、第 8.5 条优先清算权、第 8.6 条反稀释、第 8.8 条赎回权（回购义务人仅限于实际控制人及其一致行动人，含截至 2023 年末完成上市的触发条款）、第 8.10 条业绩承诺及补偿（针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）等
3	2021 年 9 月，第三次增资（C 轮）	C 轮投资者入股	2021 年 8 月 《关于重庆物奇微电子有限 公司之股东合 同》	创始股东：NATIVE 及 Jason ZHENG（郑建生）； 关键股东：创始股东、熊飞、林豪； 天使投资人：任泽生、鼎精投资、荣泽投资； 上述 A 轮、B 轮、B+轮投资者（不含已转让退出股东）； C 轮投资人：哈勃投资； 其它因股权受让的现有股东：包括钱华等	第 4.1 条股权转让限制、第 4.3 条优先购买权、第 4.4 条整体出售及财务状况恶化情况下哈勃投资的特别优先购买权、第 4.5 条优先出售权、第 4.6 条优先认购权、第 4.7 条股权反稀释、第 4.13 条业绩承诺和补偿条款（针对 2020 年度-2023 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）、第 6.1 条回购权（回购义务人系公司和/或关键股东，触发事件包括截至 2024 年 12 月 31 日完成合格上市）等
4	2021 年 12 月，第四次增资（C+轮）	C+轮投资者入股	2021 年 12 月 《关于重庆物奇微电子有限 公司之股东合 同》	创始股东：NATIVE 及 Jason ZHENG（郑建生）； 关键股东：创始股东、熊飞、林豪； 天使投资人：任泽生、鼎精投资、荣泽投资； 上述 A 轮、B 轮、B+轮、C 轮投资者（不含已转让退出股东）； C+轮投资人：Astrend、惠友投资、智城二号、聚源创投、ANKER、佳禾电声、盈趣科技、承远壹号、长沙华业；	第 4.1 条股权转让限制、第 4.3 条优先购买权、第 4.4 条整体出售及财务状况恶化情况下哈勃投资的特别优先购买权、第 4.5 条优先出售权、第 4.6 条优先认购权、第 4.7 条股权反稀释、第 4.13 条业绩承诺和补偿条款（针对 2020 年度-2024 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）、第 6.1 条回购权（回购义务人系公司和/或关键股东，触发事件包括截至 2024 年 12 月 31 日完成合格上市）等

序号	融资轮次	事项	合同名称及签署时点	合同相对方	股东特殊权利条款（有限列举）
				其它因股权受让的现有股东：包括钱华等	
		股权受让方加入本次 C+轮签署的《股东合同》	2021 年 12 月《加入协议》	公司：物奇微有限 加入方：贾自强、重泰资本、君丰桐芯、孙凤龙、曹义勇	加入方同意和确认，通过签署本加入协议，自 2021 年 12 月 23 日开始，加入方应当被视为序号 4 之《股东合同》的一方当事人，如同其自身签署了该股东合同，加入方同意接受股东合同的全部条款和条件，并且同意受其约束
5	-	股权受让方加入本次 C+轮签署的《股东合同》	2022 年 3 月、7 月《加入协议》	公司：物奇微有限 加入方：杨心茹、科兴科创	加入方同意和确认，通过签署本加入协议，自 2021 年 12 月 23 日开始，加入方应当被视为序号 4 之《股东合同》的一方当事人，如同其自身签署了该股东合同，加入方同意接受股东合同的全部条款和条件，并且同意受其约束
6	-	股权受让方被出具《承诺函》	2023 年 2 月《承诺函》	承诺人：NATIVE 及 Jason ZHENG（郑建生）； 被承诺人：渝富益华	无论因为任何原因，当发生如下“触发情况”，由承诺人或其指定第三方进行回购：（1）转让交易发生 3 个月内，中移股权基金未能按投前 39 亿支付完毕 3 亿元投资款；（2）中移股权基金增资协议被解除或无效时，中移股权基金要求返还增资款，或增资协议中的承诺方回购中移股权基金持有的发行人股权
7	2023 年 3 月，第五次增资（D 轮）	D 轮投资者入股	2023 年 2 月《关于重庆物奇微电子股份有限公司之股东合同》	创始股东：NATIVE 及 Jason ZHENG（郑建生） 关键股东：创始股东、林豪； 承诺方：关键股东、熊飞；关键股东和任泽生、熊飞合称一致行动股东； 天使投资人：鼎精投资、荣泽投资； 上述 A 轮、B 轮、B+轮、C 轮、C+轮投资者（不含已转让退出股东）； D 轮投资人（增资股东）：中移股权基金； D 轮投资人（其他受让股东）：豫富君冻、睿鲸云锦、合泰昇通等； 其它因股权受让的现有股东：孙凤龙、贾自强、曹义勇、君丰桐芯、重泰资本、杨心茹等	第 4.1 条股权转让限制、第 4.3 条优先购买权、第 4.4 条整体出售及财务状况恶化情况下哈勃投资的特别优先购买权、第 4.5 条优先出售权、第 4.6 条优先认购权、第 4.7 条股权反稀释、第 4.13 条业绩承诺和补偿条款（针对 2020 年度-2024 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）、第 6.1 条回购权（回购义务人系前述承诺方，触发事件包括截至 2024 年 12 月 31 日完成合格上市）等

序号	融资轮次	事项	合同名称及签署时点	合同相对方	股东特殊权利条款（有限列举）
8	2025年6月，第六次增资（D+轮）	D+轮投资者入股	2025年6月 《关于重庆物奇微电子股份有限公司之股东合同》	创始股东：NATIVE 及 Jason ZHENG（郑建生） 关键股东、承诺方：创始股东、林豪； 一致行动股东：关键股东、任泽生； 天使投资人：鼎精投资、荣泽投资； 上述 A 轮、B 轮、B+轮、C 轮、C+轮、D 轮投资者（不含已转让退出股东）； D+轮投资人：重庆战新、洪泰嘉晟、泰科源、王飞、合顺盈、北碚西证； 其它因股权受让的现有股东：孙凤龙、贾自强、曹义勇、君丰桐芯、重泰资本、杨心茹等	第 4.1 条股权转让限制、第 4.3 条优先购买权、第 4.4 条整体出售及财务状况恶化情况下哈勃投资的特别优先购买权、第 4.5 条优先出售权、第 4.6 条优先认购权、第 4.7 条股权反稀释、第 4.13 条业绩承诺和补偿条款 ^注 （针对 2020 年度-2027 年度的主营业务收入累计额进行了承诺和补偿约定）、第 6.1 条回购权（回购义务人系前述承诺方，触发事件包括截至 2028 年 6 月 30 日完成合格上市）等
9	-	股权受让方加入 D+轮签署的《股东合同》	2026年6月 《加入协议》	公司：物奇微 加入方：远致星火	加入方同意和确认，通过签署本加入协议，自标的股份交割日起，加入方应当被视为序号 4 之《股东合同》的一方当事人，承继标的股份在股东合同项下的全部权利和义务（但不包括 5.2.1 董事提名权及 4.4 整体出售及财务状况恶化情况下哈勃投资的特别优先购买权），加入方同意接受股东合同的全部条款和条件，并且同意受其约束

注：针对上表序号 7 所示的 D 轮投资时签署的《关于重庆物奇微电子有限公司之股东合同》中第 4.13 条业绩承诺和补偿条款相关约定，承诺方确保公司 2020 年度-2024 年度五年累计实现业务收入不低于人民币 20 亿元。如累计实现业务收入数低于累计承诺数的 90%且不存在其他豁免情形的，承诺人（即补偿方）需按照以下计算金额进行补偿：应补偿金额=（承诺期内累计承诺业务收入数-承诺期内累计实际业务收入数）/承诺期内累计承诺业务收入数*被补偿方投资款。中移股权基金于 2025 年 6 月 25 日与补偿方、熊飞签署《关于重庆物奇微电子股份有限公司之补充约定协议》（以下简称《补充协议》），确认：因未能实现业绩承诺，按照前述《股东合同》约定，承诺方应支付中移股权基金现金补偿款 75,670,803.71 元，相关款项应于 2029 年 6 月 25 日前支付完毕。根据上表序号 8 所示的 D+轮投资时签署的《关于重庆物奇微电子有限公司之股东合同》中第 4.13.5 条约定，除中移股权基金以外的前轮投资人均确认放弃在前轮交易文件项下基于业绩承诺与补偿条款及/或前轮交易文件项下该等类似安排或约定享有的要求公司集团、补偿方、熊飞或前轮交易文件项下约定的其他义务主体承担补偿责任的权利。

根据上述协议/合同相关约定，其自签署之日起生效，协议/合同中任何约定如与先前各方或各方中的几方有关合同的所有口头及书面的协议、合同、谅解及函件等中的约定有不同之处的，以新签署的协议/合同为准。

此外，上述协议/合同的各方一致同意，投资人享有的相应特殊权利可以根据上市监管要求及上市公司惯例的信息披露和公司治理制度做相应修订，但该修订应该经过投资人的事先书面同意。如公司上市未成功（包括但不限于公司撤回申报材料、上市申请被否决以及因任何原因未能成功发行），则相应修订应立即恢复并视为自始不存在任何修订。

2、协议的解除

2022年11月5日，针对各方于2021年12月23日签署的《关于重庆物奇微电子有限公司之股东合同》（即上表中序号4所述《股东合同》，含序号4、序号5所述之《加入协议》），发行人及其创始股东NATIVE、郑建生等与全体投资者签署了《关于重庆物奇微电子有限公司之股东合同的补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。根据《补充协议一》第一条的约定：各签署方一致同意，《股东合同》中关于公司承担回购义务的全部约定（以下简称“特定条款”）于公司股东会适当批准的公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的审计及评估基准日之日（以下简称“终止日”）起自动终止且自始无效，对各签署方均不再具有法律约束力，且解除公司回购义务的约定并无恢复条款。

2026年6月15日，发行人及其子公司、实际控制人、其他股东共同签署《股东特殊权利终止协议》，各方一致同意并确认：（1）公司及其子公司自发行人首次递交上市申报材料时所使用的财务报告出具日的前一日起不可撤销地退出《D+轮股东合同》（即上表中序号8所述《股东合同》）项下第4.10.1条（投资人待遇最优惠条款）及第4.12.2条（关键股东离职情况下的股东回购要求权），且自始无效、不可恢复；《D+轮股东合同》第4.13.6条（二级市场估值保障条款）、第4.13.7（股东特殊权利效力中止及恢复条款）、第10.10条（股东特殊权利修订及恢复条款）自公司首次递交上市申报材料时所使用的财务报告出具日的前一日起终止，且自始无效、不可恢复。（2）除前述第（1）项涉及的条款及《D+轮股东合同》第4.13.5条（关键股东、熊飞以现金方式向

中移股权基金进行补偿）外，《D+轮股东合同》中约定的股权转让限制、优先购买权、优先出售权、优先认购权、优先清算权、最优惠条款、业绩承诺和补偿条款等股东特殊权利条款自公司首次递交上市申报材料受理之日起终止，但如公司上市未成功，前述条款恢复效力。

截至本招股说明书签署日，发行人不存在因对赌协议而产生的纠纷或潜在纠纷，亦不存在未披露的对赌协议或特殊安排。

（九）发行人历史沿革中的股份代持及解除情况

发行人股东历史上曾存在股权代持的情况，截至本招股说明书签署之日，该等代持已全部解除，股权代持的形成、演变及解除过程中不存在纠纷或者潜在纠纷。

1、靖烨投资的代持

2018年10月28日，靖烨投资与吴君宇签署《代持协议》，约定：（1）鉴于物奇微有限系外商投资企业，根据当时有效的《中华人民共和国中外合资经营企业法》第一条规定，中外合资企业的中方自然人直接持股存在限制，吴君宇无法直接投资物奇微有限。靖烨投资实际控制人吴靖宇为吴君宇的直系亲属，靖烨投资同意为吴君宇代持其所持有的物奇微有限股权；（2）代持股权对应的1,500万元出资款，由吴君宇支付给靖烨投资后，靖烨投资再向物奇微有限支付，且当代持股权全部转回给吴君宇时，不再收取回转价款。

2020年1月1日，《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》开始实施，原《中华人民共和国中外合资经营企业法》同时废止，针对中外合资企业中方自然人的股东身份限制不再。2020年1月29日，靖烨投资与吴君宇签订了《股权转让协议》约定将其持有的物奇微有限股权全部转回给吴君宇。本次转让实质系代持还原，故价款无需再支付。

2020年12月5日，物奇微有限召开股东会作出决议，同意前述股权转让事宜，其他股东均放弃行使优先购买权。2021年2月4日，上述股权转让事宜在重庆市渝北区市场监督管理局进行了工商变更登记。

2、华奇恒（含后续物奇壹至物奇陆）的代持

华奇恒（含后续物奇壹至物奇陆）作为发行人员工持股平台，为方便管理，自设立后存在暂以公司指定的管理人员作为工商登记名义出资人的情形。

2021年2月至4月，物奇壹至物奇陆先后设立。2021年5月，华奇恒与物奇壹至物奇陆分别签署《重庆物奇微电子股份有限公司股权转让协议》，约定华奇恒将所持有的物奇微有限19.26%股权（对应注册资本金额900.72万元）分别转让至上述六位受让人，转让完成后华奇恒不再持有物奇微有限股权。

上述设立及受让时点，物奇壹至物奇陆合伙人及其认缴情况均如下所示：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	发行人处任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	林豪	副总经理	4.5000	45.0000%
2	有限合伙人	马云峰	副总经理	2.4425	24.4249%
3	有限合伙人	熊飞 ^{注2}	副总经理	2.0575	20.5751%
4	有限合伙人	李洪兵	工程副总裁	1.0000	10.0000%
合计			-	10.0000	100.0000%

注1：物奇壹至物奇陆合伙人及其出资结构与华奇恒均保持一致；

注2：熊飞时任副总经理，已于2023年离职。

发行人完成整体变更设立股份公司及资本公积转增股本等事项后，综合考虑IPO申报进度及证券监管要求，决定员工持股显名化。

2023年5月、7月，发行人员工分别于前述物奇壹至物奇陆等持股平台办理入伙手续，原名义合伙人则办理退伙结算手续。本次退伙及入伙相关手续办理完成后，物奇壹至物奇陆不再存在任何代持关系。

3、鼎精投资合伙人份额存在的代持

（1）鼎精投资的初始设立及其股权代持形成

鼎精投资于2015年5月首次设立，系由自然人郑朝晖（郑朝晖的外婆系发行人实控人郑建生之姑姑）担任执行事务合伙人的有限合伙企业。设立之初，计划用于郑朝晖个人及其相关企业的投资持股事宜。2016年11月，郑建生创立物奇科技后，计划设立一个有限合伙企业用于其亲属、朋友投资物奇科技，因郑朝晖控制的鼎精投资当时无实际用途，故直接供郑建生转做他用。

截至2018年7月鼎精投资入股发行人时点，鼎精投资工商登记显示各合伙

人财产份额及比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称 ^注	出资额	比例
1	普通合伙人	郑朝晖	4,100.00	82.00%
2	有限合伙人	陈阳仙	800.00	16.00%
3	有限合伙人	程迎莹	100.00	2.00%
合计			5,000.00	100.00%

注：该时点鼎精投资尚未最终完成合伙人调换，郑朝晖、陈阳仙及程迎莹均仅作为鼎精投资名义合伙人体现在工商登记层面，与鼎精投资本次入股物奇微有限不存在关系。

2018年7月末，发行人创始股东股权结构形成时点，鼎精投资实际财产份额分配情况如下：

单位：万元

序号	姓名	投资入股情况	
		对应发行人注册资本	占比
1	姜忠华 ^{注1}	32.00	6.99%
2	徐罡 ^{注2}	16.00	3.50%
3	郎良 ^{注2}	24.00	5.25%
4	王珉 ^{注2}	8.00	1.75%
5	荣玺投资 ^{注3}	32.00	6.99%
6	江一波 ^{注4}	52.80	11.54%
7	郑建生	274.26	59.94%
8	王元嫒	18.50	4.04%
合计		457.56	100.00%

注 1：郑建生拟引入熟悉市场、销售工作的姜忠华，经协商，姜忠华以人民币 212.50 万元对价取得对应折算物奇微有限 32 万元注册资本的份额；

注 2：徐罡、郎良、王珉三人与郑建生彼此相对熟悉，对郑建生的个人能力有比较强的信任，非常看好郑建生本次创业历程，愿意作为天使投资人参与物奇科技。经协商，徐罡以人民币 106.25 万元对价取得对应折算物奇微有限 16 万元注册资本的份额；郎良分两次以人民币 159.375 万元对价取得对应折算物奇微有限 24 万元注册资本的份额；王珉以人民币 53.125 万元对价取得对应折算物奇微有限 8 万元注册资本的份额；

注 3：投资人李国顺控制的投资平台珠海荣玺微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣玺投资”）看好郑建生本次创业，以人民币 212.50 万元对价取得对应折算为物奇微有限 32 万元注册资本的份额；

注 4：郑建生拟引入人工智能、深度学习算法等方面的技术人员江一波，经协商，郑建生个人在鼎精投资层面以 0 元对价赠予其对应物奇微有限注册资本 52.80 万元的份额，该部分份额需在 48 个月服务期内分期授予取得。

（2）鼎精投资股权代持的演化及解除

1) 代持的演化

发行人创始股东股权结构形成后，截至 2019 年 1 月外部投资机构第一次增资发行人时点前，鼎精投资内部财产份额存在小幅变化，出资款项实际来源及股权份额分配情况如下：

单位：万元

序号	姓名	投资入股情况	
		对应发行人注册资本	占比
1	姜忠华	32.00	6.99%
2	徐罡	16.00	3.50%
3	郎良 ^{注 1}	27.20	5.94%
4	王珉	24.00	5.25%
5	荣玺投资	32.00	6.99%
6	江一波	52.80	11.54%
7	郑朝晖 ^{注 2}	16.00	3.50%
8	姜林 ^{注 3}	16.00	3.50%
9	郑建生	223.06	48.75%
10	王元嫒	18.50	4.04%
合计		457.56	100.00%

注 1：郎良、王珉希望出资增持少量物奇微有限的股权。经协商，王珉以 207.33 万元对价自郑建生处取得鼎精投资内部对应于物奇微有限 16 万元注册资本的份额；郎良以 40.00 万元对价自郑建生处取得鼎精投资内部对应于物奇微有限 3.20 万元注册资本的份额；

注 2：根据郑建生与其亲属郑朝晖前期协商，为互相支持对方创业，双方拟互换 0.5% 股权，后因物奇微有限股权结构存在小幅调整，该事项变更为郑建生以对应于物奇微有限 16.00 万元注册资本的份额（折算 0.44% 物奇微有限股权比例）交换郑朝晖持有的 0.5% 上海季丰电子股份有限公司股权，双方一致同意该事项以 2018 年 10 月为落地时点；

注 3：2018 年 8 月，郑建生拟引入熟悉市场、销售工作的姜林，经协商，郑建生个人在鼎精投资层面以 0 元对价赠予其对应物奇微有限注册资本 16 万元的份额，该部分股权份额需在 48 个月服务期内分期授予取得。

此外，2018 年 11 月，鼎精投资对工商登记层面的名义合伙人进行清退，调整后经工商登记的鼎精投资合伙人及其财产份额情况如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	比例
1	普通合伙人	王元嫒	4,825.16	96.50%
2	有限合伙人	郑朝晖	174.84	3.50%
合计			5,000.00	100.00%

本次变更登记后，前述鼎精投资内部隐名的合伙财产份额持有人全部由王元嫒代持，郑朝晖享有的 3.50% 合伙财产份额系其个人实际应持有的部分。

该次交易完成后，鼎精投资未有新的代持事项再发生。

2) 代持的解除

①部分被代持投资人离职、退出投资，将代持份额转回给郑建生，代持同步解除

单位：万元

序号	退出结算时点	退出人	份额受让人	退出份额	退出原因
1	2020 年 6 月	荣玺投资	郑建生	32.00	荣玺投资有新的投资方向，套现退出
2	2021 年 6 月	姜忠华	郑建生	32.00	姜忠华离职退股
3	2021 年 12 月	江一波	郑建生	52.80	江一波离职退股
4	2021 年 12 月	王珉	郑建生	24.00	王珉离职退股
5	2022 年 1 月	姜林	郑建生	16.00	姜林离职退股

上表中代持事项解除后，鼎精投资实际财产份额分配情况如下：

单位：万元

序号	姓名	投资入股情况	
		对应发行人注册资本	占比
1	徐罡	16.00	3.50%
2	郎良	27.20	5.94%
3	郑朝晖	16.00	3.50%
4	林磐 ^注	64.08	14.00%
5	郑建生	315.78	69.01%
6	王元嫒	18.50	4.04%
合计		457.56	100.00%

注：2020 年 6 月，投资人林磐看好物奇微有限后续发展，希望购入部分股权。经协商，林磐以人民币 1,244 万元自郑建生处取得对应物奇微有限 64.08 万元注册资本的鼎精投资份额。交易完成后，林磐签署《鼎精投资合伙协议》，并办理相关工商变更手续，在鼎精投资工商登记层面显名。

②鼎精投资分两次对外转让其持有的部分发行人股权，代持规模总体减少

2021 年 12 月，鼎精投资与君丰桐芯、贾自强、重泰资本、曹义勇、林豪分别签署《重庆物奇微电子股份有限公司股权转让协议》，约定鼎精投资将所持物

奇微有限 2.21%股权（对应注册资本金额 130.2718 万元）分别转让给君丰桐芯、贾自强、重泰资本、曹义勇、林豪。

2022 年 3 月，鼎精投资与杨心茹、科兴科创分别签订了《股权转让协议》，约定鼎精投资将所持物奇微有限 0.72%股权（对应注册资本金额 42.4651 万元）分别转让给杨心茹、科兴科创。

上述两次交易完成后，鼎精投资内部分别对王元嫒、郑建生进行分配结算并相应减少其二人持有鼎精投资的份额。结算完成后鼎精投资内部财产份额分配情况如下：

单位：万元

序号	姓名	投资入股情况	
		对应发行人注册资本	占比
1	徐罡	16.00	5.62%
2	郎良	27.20	9.55%
3	林磬	64.08	22.50%
4	郑朝晖	16.00	5.62%
5	郑建生	161.5431	56.72%
合计		284.8231	100.00%

③2026 年 3 月，完成除郑建生外其他合伙人的代持解除

2026 年 3 月 26 日，鼎精投资完成工商变更登记，对除郑建生外的隐名投资人予以显名。本次变更完成后，鼎精投资的出资结构及对应发行人股份数量如下：

单位：万元、股

序号	合伙身份	合伙人名称	鼎精投资出资情况		对应发行人股份数量
			出资额	比例	
1	普通合伙人	徐全铭	0.01	-	-
2	有限合伙人	徐罡	22.47	5.62%	626,449
3	有限合伙人	郎良	38.20	9.55%	1,064,964
4	有限合伙人	林磬	89.99	22.50%	2,508,930
5	有限合伙人	郑朝晖	22.47	5.62%	626,449
6	有限合伙人	王元嫒	226.86	56.72%	6,324,912
合计			400.00	100.00%	11,151,704

注 1：徐全铭仅担任鼎精投资的执行事务合伙人，就物奇微股权不享有任何权益；

注 2：2023 年 3 月，发行人以总股本 6,359.6518 万股为基数，按各股东持股比例，以 18,540.3482 万元资本公积转增股本 18,540.3482 万股，转增后公司总股本增加至 24,900.0000 万股，鼎精投资持有公司股份数量增加至 11,151,704 股。

④鼎精投资对外转让其持有的部分发行人股权

2026 年 4 月，鼎精投资与刘辉签订《股份转让协议》，约定将其所持有的发行人 6,324,912 股股份（郑建生在鼎精投资实际持有份额间接对应的发行人股份数量）转让至刘辉，转让完成后鼎精投资内部对郑建生（王元嫒代为持有）进行退伙处理。本次交易完成后，鼎精投资股权代持关系已全部解除。

2026 年 6 月，鼎精投资完成本次变更后，出资结构及对应发行人股份数量如下：

单位：万元、股

序号	合伙身份	合伙人名称	鼎精投资出资情况		对应发行人股份数量
			出资额	比例	
1	普通合伙人	徐全铭	0.01	0.01%	-
2	有限合伙人	徐罡	22.47	12.98%	626,449
3	有限合伙人	郎良	38.20	22.06%	1,064,964
4	有限合伙人	林磬	89.99	51.98%	2,508,930
5	有限合伙人	郑朝晖	22.47	12.98%	626,449
合计			173.13	100.00%	4,826,792

发行人历史沿革中股权代持关系的形成及解除均系当事人的真实意思表示，股权代持关系存续期间及解除后，当事人之间不存在关于发行人股权权属的争议、纠纷及其他影响股权确定性的情况。截至本招股说明书签署日，发行人股权权属清晰、明确。

（十）战略投资者情况

截至本招股说明书签署之日，发行人无战略投资者持股情况。

（十一）股东适格性

1、发行人现有股东为适格股东，不存在股权纠纷或者潜在纠纷

截至本招股说明书签署之日，发行人现有股东均具备担任公司股东的资格，不存在法律、法规及规范性文件规定的不适格或其他限制情形；股东持有

的公司股份权属清晰，不存在权属纠纷及潜在纠纷。

2、发行人现有股东与本次发行的中介机构及其项目组成员的关联关系

保荐机构控股股东中国光大集团股份有限公司所投资的主体是发行人股东穿透过程中出现的间接出资人，穿透层级较远且穿透后持股比例极低，合计间接持有发行人的股份不足 0.005%。该间接投资行为系相关投资主体所作出的独立投资决策，并非保荐机构相关主体主动针对发行人股份进行投资。

发行人股东北碚西证执行事务合伙人之一西证股权投资有限公司系为本次发行联席主承销商之一西南证券股份有限公司的全资子公司。

除上述情形外，发行人现有股东与本次发行的中介机构及其项目组成员不存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或者其他可能输送不当利益的关系。

十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在发行内部职工股的情况，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200 人的情况。

十一、公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）员工持股平台相关情况

为增强骨干员工对公司的归属感，实现骨干人员与公司未来利益的一致性，充分调动核心员工工作积极性，建立健全激励约束长效机制，推动公司中长期发展战略顺利实施，公司实施员工持股计划。截至本招股说明书签署日，发行人设立了物奇壹、物奇贰、物奇叁、物奇肆、物奇伍、物奇陆和物奇捌作为直接持股平台，七家持股平台共持有发行人 41,461,555 股股份，占发行人总股本的 15.83%。

前述员工持股平台的基本情况如下：

1、物奇壹

截至本招股说明书签署日，物奇壹持有发行人 6,412,884 股，占总股本的

2.45%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇壹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 2 月 23 日
合伙期限	2021 年 2 月 23 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼 1401 室
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇壹的合伙人共计 17 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	8.55	0.0086%
2	有限合伙人	李洪兵	工程副总裁	25,398.37	25.3984%
3	有限合伙人	古强	副总工程师	23,053.91	23.0539%
4	有限合伙人	吴限	研发工程师	9,377.86	9.3779%
5	有限合伙人	袁仕明	研发工程师	9,377.86	9.3779%
6	有限合伙人	刘志华	研发工程师	8,596.37	8.5964%
7	有限合伙人	谭作亘	研发工程师	7,814.89	7.8149%
8	有限合伙人	夏炼	研发工程师	3,907.44	3.9074%
9	有限合伙人	曾安辉	研发工程师	3,125.95	3.1260%
10	有限合伙人	黄海波	财务总监	2,344.46	2.3445%
11	有限合伙人	黄润	研发工程师	1,953.72	1.9537%
12	有限合伙人	金杰	质量总监	1,797.42	1.7974%
13	有限合伙人	张军	研发工程师	781.50	0.7815%
14	有限合伙人	罗春丽	研发工程师	781.49	0.7815%
15	有限合伙人	纵金榜	研发工程师	586.12	0.5861%
16	有限合伙人	黄雪峰	研发工程师	586.12	0.5861%
17	有限合伙人	毛志强	研发工程师	507.97	0.5080%
合计			-	100,000.00	100.0000%

普通合伙人上海智享创芯企业管理咨询有限公司的基本情况如下：

名称	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼
法定代表人	马云峰
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2021 年 2 月 19 日
营业期限	2021 年 2 月 19 日至 2041 年 02 月 18 日
注册资本	5.00 万元
股东信息	马云峰、杨红、李洪兵、陶文岩及孙凤霞各持股 20.00%

2、物奇贰

截至本招股说明书签署日，物奇贰持有发行人 7,690,452 股，占总股本的 2.94%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇贰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 2 月 23 日
合伙期限	2021 年 2 月 23 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼 1402 室
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇贰的合伙人共计 14 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	0.03	0.0000%
2	有限合伙人	马云峰	董事、副总经理	78,869.75	78.8698%
3	有限合伙人	邱东	研发工程师	4,398.74	4.3987%
4	有限合伙人	毛向荣	董事会秘书	3,258.32	3.2583%

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
5	有限合伙人	陈学辉	研发工程师	3,030.24	3.0302%
6	有限合伙人	徐志强	计算机网络管理员	2,280.83	2.2808%
7	有限合伙人	郎良	销售副总裁	1,954.99	1.9550%
8	有限合伙人	石捷锋	研发工程师	1,938.70	1.9387%
9	有限合伙人	王磊	研发工程师	1,140.41	1.1404%
10	有限合伙人	戴文松	测试工程师	814.58	0.8146%
11	有限合伙人	孙鹏程	研发工程师	749.41	0.7494%
12	有限合伙人	曹云桢	运营经理	684.25	0.6843%
13	有限合伙人	程阿梦	研发工程师	488.75	0.4888%
14	有限合伙人	韦韧	副总工程师	391.00	0.3910%
合计			-	100,000.00	100.0000%

3、物奇叁

截至本招股说明书签署之日，物奇叁持有发行人 5,907,026 股，占总股本的 2.26%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 2 月 23 日
合伙期限	2021 年 2 月 23 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼 1403 室
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇叁的合伙人共计 23 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	6.10	0.0061%
2	有限合伙人	李洪兵	工程副总裁	22,194.47	22.1945%
3	有限合伙人	左永宁	研发工程师	12,726.19	12.7262%

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
4	有限合伙人	伍海	研发工程师	10,308.20	10.3082%
5	有限合伙人	韦韧	副总工程师	10,180.96	10.1810%
6	有限合伙人	江正忠	研发工程师	6,235.83	6.2358%
7	有限合伙人	张智	研发工程师	5,726.78	5.7268%
8	有限合伙人	林桐	研发工程师	4,242.06	4.2421%
9	有限合伙人	薛林	研发工程师	3,393.65	3.3937%
10	有限合伙人	谌登	研发工程师	3,393.65	3.3937%
11	有限合伙人	陆雪松	研发工程师	3,308.81	3.3088%
12	有限合伙人	武岳	研发工程师	2,969.44	2.9694%
13	有限合伙人	刘斌	研发工程师	2,757.34	2.7573%
14	有限合伙人	伊海珂	研发工程师	2,121.03	2.1210%
15	有限合伙人	夏伟伟	研发工程师	2,121.03	2.1210%
16	有限合伙人	刘宇	研发工程师	1,696.83	1.6968%
17	有限合伙人	谢飞	研发工程师	1,696.83	1.6968%
18	有限合伙人	何艳飞	研发工程师	1,611.98	1.6120%
19	有限合伙人	余涛	研发工程师	1,018.10	1.0181%
20	有限合伙人	魏义镇	研发工程师	848.41	0.8484%
21	有限合伙人	刘彬	研发工程师	509.05	0.5091%
22	有限合伙人	郎良	销售副总裁	509.05	0.5091%
23	有限合伙人	金快快	研发工程师	424.21	0.4242%
合计			-	100,000.00	100.0000%

4、物奇肆

截至本招股说明书签署之日，物奇肆持有发行人 5,110,261 股，占总股本的 1.95%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇肆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 2 月 26 日
合伙期限	2021 年 2 月 26 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼 1404 室
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司

经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇肆的合伙人共计 35 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	116.47	0.1165%
2	有限合伙人	韦韧	副总工程师	15,445.91	15.4459%
3	有限合伙人	唐智杰	软件部总监	12,749.00	12.7490%
4	有限合伙人	陶文岩	研发工程师	7,060.99	7.0610%
5	有限合伙人	肖客	研发工程师	6,374.50	6.3745%
6	有限合伙人	邬鑫锋	研发工程师	6,374.50	6.3745%
7	有限合伙人	刘达	研发工程师	4,903.46	4.9035%
8	有限合伙人	陈武清	现场应用总监	4,903.46	4.9035%
9	有限合伙人	李波	研发工程师	3,922.77	3.9228%
10	有限合伙人	付博峰	研发工程师	3,432.42	3.4324%
11	有限合伙人	方武良	研发工程师	2,942.08	2.9421%
12	有限合伙人	丰巍巍	研发工程师	2,451.73	2.4517%
13	有限合伙人	简红华	研发工程师	2,059.45	2.0595%
14	有限合伙人	葛亦乔	研发工程师	2,059.45	2.0595%
15	有限合伙人	董伟	研发工程师	2,059.45	2.0595%
16	有限合伙人	张红枫	研发工程师	1,961.39	1.9614%
17	有限合伙人	黎晶	研发工程师	1,961.39	1.9614%
18	有限合伙人	杨永海	研发工程师	1,814.28	1.8143%
19	有限合伙人	洪永光	研发工程师	1,814.28	1.8143%
20	有限合伙人	柴玲燕	研发工程师	1,520.07	1.5201%
21	有限合伙人	徐广平	研发工程师	1,225.87	1.2259%
22	有限合伙人	梁启斌	研发工程师	1,225.87	1.2259%
23	有限合伙人	田皓	研发工程师	1,225.87	1.2259%
24	有限合伙人	胡亮	研发工程师	1,225.87	1.2259%
25	有限合伙人	陈辉	研发工程师	1,078.76	1.0788%
26	有限合伙人	田中兴	研发工程师	980.69	0.9807%

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
27	有限合伙人	陈佳闯	研发工程师	980.69	0.9807%
28	有限合伙人	骆超	研发工程师	980.69	0.9807%
29	有限合伙人	刘兆云	研发工程师	882.62	0.8826%
30	有限合伙人	周佐航	应用工程师	735.52	0.7355%
31	有限合伙人	徐凯	现场应用工程师	735.52	0.7355%
32	有限合伙人	江炳祥	现场应用工程师	735.52	0.7355%
33	有限合伙人	潘荣浩	现场应用工程师	735.52	0.7355%
34	有限合伙人	邓伟伟	软件部总监	735.52	0.7355%
35	有限合伙人	安万里	研发工程师	588.42	0.5884%
合计			-	100,000.00	100.0000%

5、物奇伍

截至本招股说明书签署之日，物奇伍持有发行人 8,767,551 股，占总股本的 3.35%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇伍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	外商投资有限合伙企业
成立日期	2021 年 3 月 1 日
合伙期限	2021 年 3 月 1 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼 1405 室
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇伍的合伙人共计 11 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	1.00	0.0010%
2	有限合伙人	Guangming Yin	模拟部副总监	51,387.49	51.3875%
3	有限合伙人	Chuen Hu ^注	-	15,672.65	15.6727%
4	有限合伙人	Alireza Kheirkhahi	海外研发工程师	5,173.04	5.1730%

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
5	有限合伙人	Wenjun Su	海外研发工程师	10,003.13	10.0031%
6	有限合伙人	林蔚然	海外研发工程师	7,730.98	7.7310%
7	有限合伙人	葛翔	研发工程师	4,287.05	4.2871%
8	有限合伙人	陈建鸿	研发工程师	3,401.06	3.4011%
9	有限合伙人	羅澤羽	研发工程师	1,286.12	1.2861%
10	有限合伙人	魏源谷	研发工程师	571.61	0.5716%
11	有限合伙人	蘇怡誠	研发工程师	485.87	0.4859%
合计			-	100,000.00	100.0000%

注：Chuen Hu 已于 2025 年 1 月退休。

6、物奇陆

截至本招股说明书签署之日，物奇陆持有发行人 1,377,797 股，占总股本的 0.53%，其基本情况如下：

公司名称	重庆物奇陆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 4 月 15 日
合伙期限	2021 年 4 月 15 日至无固定期限
出资额	10.00 万元
主要经营场所	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼
执行事务合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	员工持股平台

截至本招股说明书签署之日，物奇陆的合伙人共计 9 名，其中有限合伙人均为公司员工，其基本情况及其出资情况如下：

单位：元

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
1	普通合伙人	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	-	335.32	0.3353%
2	有限合伙人	李洪兵	工程副总裁	20,005.68	20.0057%
3	有限合伙人	陈武清	现场应用总监	20,005.68	20.0057%
4	有限合伙人	庞功会	董事、副总经理	18,186.98	18.1870%
5	有限合伙人	郎良	销售副总裁	16,913.90	16.9139%

序号	合伙身份	合伙份额持有者	任职情况	出资额	出资比例
6	有限合伙人	崔哲	高级市场总监	12,730.89	12.7309%
7	有限合伙人	李国旦	测试工程师	4,546.75	4.5468%
8	有限合伙人	孙凤霞	人事行政经理	3,637.40	3.6374%
9	有限合伙人	杨红	法务主管	3,637.40	3.6374%
合计			-	100,000.00	100.0000%

7、物奇捌

物奇捌基本情况和出资结构详见招股说明书本节“七、（一）控股股东及实际控制人基本情况”之“4、控股股东、实际控制人控制或施加重大影响其他企业情况”。

（二）员工股权激励计划主要安排

1、持股平台设立背景

（1）物奇壹至物奇陆等 6 个持股平台

为建立、健全公司长效激励机制并调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司实现跨越式发展，设立华奇恒作为员工持股平台，并经股东会决议通过实施《员工持股计划》进行股权激励。

后续发行人设立，收购了物奇科技成为全资子公司，经发行人股东会决议通过，原在物奇科技实施的《员工持股计划》平移至发行人继续实施。

2021 年 5 月，因受激励员工数量不断增加，发行人新设立物奇壹至物奇陆等六个持股平台，并将华奇恒原持有的发行人股权分别转让给前述 6 个新的员工持股平台继续实施，转让完成后华奇恒不再持有发行人股权且并无实际经营，于 2024 年注销。

上述华奇恒及物奇壹等 6 个新设员工持股平台设立后，发行人为方便管理，均暂以公司指定的管理人员作为工商登记的出资人。2023 年 6 月，发行人通过总经理办公会决议：鉴于发行人已完成整体变更为股份有限公司及资本公积转增股本等事项，综合考虑发行人 IPO 申报进度及证券监管要求，同意发行人的员工持股显名化。

（2）物奇捌

2023 年 1 月，为激励在公司日常经营管理中做出重要贡献的关键管理人员，发行人设立了新持股平台物奇捌，由创始股东熊飞以 16.93 元/股（对应发行人估值 10 亿元）的价格向物奇捌转让 2.68%公司股份。

熊飞本次转让的发行人股权（对应注册资本金额 158.24 万元），系郑建生授予熊飞的附服务条件激励。2022 年四季度，熊飞计划自发行人处离职，经协商后，于 2023 年初将其持有的该部分股权转让给物奇捌，用于发行人部分高级管理人员、关键技术人员激励。

2、合伙人的出资方式、资金来源，是否按照约定及时足额缴纳出资

（1）物奇壹至物奇陆等 6 个持股平台

发行人原持股平台华奇恒出资系由实际控制人郑建生实际出资缴纳完毕，发行人员工通过持股计划无偿获得相应股份，无需支付对价。

物奇壹至物奇陆等 6 个新设员工持股平台受让华奇恒持有的发行人股份，本质系拆分平移，亦未支付对价。

2023 年 6 月发行人员工在物奇壹至物奇陆等持股平台完成显名化后，存在部分员工离职，该部分员工原持有的合伙企业份额已重新授予在职员工。

物奇壹至物奇陆所有合伙人对合伙企业的份额持有均系个人意思的真实表示，不存在股份代持情形。

（2）物奇捌

物奇捌受让股权的资金来源系各合伙人通过自有、借贷等形式自筹资金，具体构成如下：

单位：万元

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资来源	
				自有资金	借贷资金
1	普通合伙人	郑建生	0.22	0.22	-
2	有限合伙人	庞功会	801.02	401.02	400.00
3	有限合伙人	古强	758.75	-	758.75
4	有限合伙人	韦韧	758.75	-	758.75

序号	合伙身份	合伙人名称	出资额	出资来源	
				自有资金	借贷资金
5	有限合伙人	毛向荣	361.27	37.44	323.83

注：上表中庞功会、韦韧、毛向荣所涉借贷资金全部系实控人郑建生出借；古强所涉借贷资金中 500 万元系发行人股东孙凤龙出借，剩余部分系实控人郑建生出借。

上述物奇捌各合伙人出资是个人意思的真实表示，除上述已披露的资金拆借情形以外，不存在发行人或其他第三方为员工出资合伙企业提供奖励、资助、补贴等安排，也不存在股份代持情形。

3、服务、锁定期限及对合伙人转让、退出份额的限定或特殊约定

（1）物奇壹至物奇陆等 6 个持股平台

1) 锁定安排

①全面锁定期

激励对象获授合伙份额后,至公司首次公开发行股票并上市交易之日满一年为全面锁定期（若法律法规、证券监督管理机构或证券交易所的审核要求对减持限制有更高的要求，则以该等要求为准）。除非发生《员工持股计划》规定的情形，全面锁定期内激励对象不得以任何方式转让、抵押或处置合伙份额。

②解除限售期

全面锁定期届满后四年为解除限售期。在满足解除限售的条件（详见下表）下，激励对象可以书面申请转让其持有的份额从而实现收益，但激励对象每年减持/转让份额不得超过下表中的比例（可累计），执行事务合伙人豁免的除外。

解除限售期	解除限售比例	需保留比例
全面锁定期届满后的第一年	初始出资份额的 35%	初始出资份额的 65%
全面锁定期届满后的第二年	初始出资份额的 20%	初始出资份额的 45%
全面锁定期届满后的第三年	初始出资份额的 20%	初始出资份额的 25%
全面锁定期届满后的第四年	初始出资份额的 25%	无需再保留初始出资份额

注：上表限制比例的基数为激励对象对公司直接持股（如有）与间接持股情形的总和，表格中的“年”，是按照全面锁定期届满后的次日起的 365 天进行计算。激励对象为董监高人员的，还应遵守相关法律法规、证券监督管理机构及证券交易所对其减持的相关规定。

法律法规以及证券监督管理机构、证券交易所对激励对象的股份锁定有其

他要求或激励对象自愿作出锁定承诺的，激励对象应当予以遵守。

2) 员工持股计划的退出及相应安排

鉴于激励对象的获授股权系无偿获得，因此如激励对象出现下列情形时，则激励对象获授的合伙企业份额按照下列情形分别进行安排，涉及合伙企业份额回收的价格按照如下原则确定折扣比例：

A、在授权日起的 1 年（即 365 天，下同）内触发，公司或普通合伙人及其指定的第三方有权无偿回收该等合伙企业份额，公司回收的该部分合伙企业份额须授予其他激励对象；

B、自授权日起满 1 年后触发，公司或普通合伙人及其指定的第三方有权按照所获授股权的回收价格的 25% 进行回收，此后每满半年，回收折扣在 25% 的基础上增加 12.50%，直至回收价格不再进行折扣，公司回收的该部分合伙企业份额须授予其他激励对象；

C、在公司上市后，公司不承担亦无义务回收激励对象获授的合伙企业份额。

激励对象出现的情形	上市前的安排	上市后、在全面锁定期及解除限售期内的安排
1、退休且退休后未为公司竞争对手服务的； 2、丧失劳动能力； 3、死亡（或被宣告死亡）； 4、失踪（或被宣告失踪）； 5、丧失或部分丧失民事行为能力。	激励对象可以继续持有或由其法定遗产继承人继承合伙企业份额。	
1、劳动合同到期任职单位未选择续约； 2、与任职单位协商解除劳动合同或聘任协议； 3、非因自身过错或重大过失，被任职单位解除双方之间签署的劳动合同或聘任协议的； 4、非因自身过错或重大过失而被调离核心岗位的； 5、公司股东大会另行确定的其他情形。	公司或 GP（或其指定第三方）有权按照激励对象持有的合伙企业份额对应的激励份额数量，以 5 元/激励份额乘以折扣比例的价格回收该等合伙企业份额，公司回收的该部分合伙企业份额须授予其他激励对象。	已解除限售部分可在二级市场上变现；GP（或其指定第三方）有权回收激励对象持有的未解锁部分合伙企业份额，回收该等合伙企业份额对应的价格为合伙企业份额对应的上一年度公司净资产的 2 倍与对应股权二级市场前 120 个交易日加权均价一半之低者并乘以折扣比例。
1、单方面解除劳动合同或聘任协议； 2、劳动合同或聘任协议到期而激励对象单方面拒绝续约； 3、因自身过错或重大过失被辞退； 4、因自身过错或重大过失而被调离核心岗位的； 5、作为高级管理人员的合伙人因自身过错或重大过失导致丧失《公司法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格的；		已解除限售部分可在二级市场上变现；GP（或其指定第三方）有权回收激励对象持有的未解锁部分合伙企业份额，回收该等合伙企业份额对应的价格为合伙企业份额对应的上一年度公司净资产与对应股权二级市场前 120 个交易日加权均价一半之低者并

激励对象出现的情形	上市前的安排	上市后、在全面锁定期及解除限售期内的安排
6、公司股东大会另行确定的其他情形。		乘以折扣比例。

若激励对象存在违反相关义务的情形致使严重损害公司利益（如受贿、索贿、职务侵占、泄露公司商业秘密、从事竞争业务等），则公司或普通合伙人（或其指定第三方）有权以 0 元回收激励对象所持全部合伙企业份额，追回其所有已变现收益（如有），且有权要求激励对象赔偿其对公司造成的损失。

以上收益的计算包括持股期间激励对象获得的现金分红收益，即最终支付的价款需扣除激励对象在持股期间所获得的现金分红数额。

（2）物奇捌

激励对象在公司的服务期为自获授相关激励份额之日起至公司首次公开发行股票并上市之日止，在服务期内离职的，参照前述针对物奇壹至物奇陆的锁定及退出安排，由公司安排回收相关激励对象持有的物奇捌合伙份额。

（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

上述员工持股计划有助于激发公司管理人员、核心技术人员、骨干成员的工作积极性，实现股东目标、公司目标及员工目标的统一，增强了公司凝聚力，提升了公司经营效率，有利于发行人长期发展，未对公司的控制权造成不利影响。

公司对于前述存在限制条件的股权激励事项在服务期或锁定期内平均分摊，并作为经常性损益；对于其他不存在限制条件的股份支付事项及股权激励加速行权一次性计入当期损益，并作为非经常性损益。对于员工股份支付金额按照其工作性质分别计入管理费用、研发费用、销售费用或合同履行成本。

1、物奇壹至物奇陆对应的发行人员工持股计划

报告期内，发行人针对物奇壹至物奇陆确认的股份支付费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售费用	333.56	245.91	160.67
管理费用	536.26	536.26	361.93

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	1,933.46	1,320.31	1,253.43
合同履约成本	420.46	357.76	54.88
合计	3,223.75	2,460.24	1,830.91

2、物奇捌

报告期内，发行人针对物奇捌确认的股份支付费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售费用	509.44	509.44	509.44
管理费用	258.70	258.70	160.67
研发费用	946.73	986.51	986.51
合同履约成本	39.78	-	-
合计	1,754.65	1,754.65	1,656.62

（四）本次公开发行申报前已经制定并将于上市后实施的股权激励

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在首次公开发行申报前制定上市后实施的员工股权激励计划。

十二、董事（含董事会审计委员会）、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事会成员的简要情况

公司董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	郑建生	董事长、总经理	NATIVE	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
2	林豪	董事、副总经理	NATIVE	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
3	马云峰	董事、副总经理	NATIVE	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
4	庞功会	董事、副总经理	NATIVE	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
5	姚海锋	董事	哈勃投资	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
6	彭飞	董事	中移股权基金	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
7	是大龙	董事	重庆战新	2026 年 2 月至 2029 年 2 月

序号	姓名	职务	提名人	任期
8	杨勤法	独立董事	董事会	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
9	徐鼎	独立董事	董事会	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
10	毛武兴	独立董事	董事会	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
11	吴晓辉	独立董事	董事会	2026 年 2 月至 2029 年 2 月

郑建生先生，1955 年出生，美国国籍，具有中国永久居留权，博士研究生学历。1988 年 2 月至 1995 年 6 月，任 Hewlett-Packard Inc. 主任工程师；1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任 Chromatic Research Inc. 系统工程总监；1999 年 10 月至 2008 年 1 月，于美国 Atheros Communications Inc.（创锐讯公司）历任高级系统工程总监、系统工程副总裁、亚太区总经理；2008 年 2 月至 2008 年 12 月，任晶晨半导体（上海）有限公司亚太区副总裁；2009 年 1 月至 2011 年 4 月，任高通企业管理（上海）有限公司亚太区总经理、全球高级副总裁；2011 年 5 月至 2016 年 10 月，任高通信息科技（上海）有限公司担任全球高级副总裁、中国销售副总裁；2016 年 11 月至 2018 年 6 月，任物奇科技首席执行官；2018 年 3 月至今，任 NATIVE 董事；2018 年 7 月至今，于发行人及其前身物奇微有限担任董事长，2020 年 5 月至今，于发行人及其前身物奇微有限担任总经理；2021 年 2 月至 2024 年 6 月，任深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事。

林豪先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任方舟科技（北京）有限公司芯片研发工程师；2003 年 10 月至 2006 年 5 月，任展讯通信（上海）有限公司芯片主任研发工程师；2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任创锐讯通讯技术（上海）有限公司芯片研发经理；2008 年 6 月至 2010 年 3 月，任晶晨半导体（上海）有限公司芯片研发经理；2010 年 3 月至 2016 年 10 月，任乐鑫信息科技（上海）有限公司研发部数字系统开发总监；2016 年 11 月至 2018 年 8 月，任物奇科技担任首席技术官；2016 年 11 月至 2023 年 11 月，任物奇科技执行董事；2018 年 7 月至今，于发行人及其前身物奇微有限担任董事、副总经理。

马云峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 2 月，任中国长城计算机集团上海公司工程师；1998 年

3月至1998年11月，任上海长城电子信息网络有限公司工程师；1998年12月至2004年6月，任上海长卫计算机软件与系统有限公司市场总监；2002年11月至今，任上海觉梦软件信息有限公司执行董事；2004年6月至2025年12月，于上海长卫宜斯软件系统有限公司先后担任市场总监、董事及执行董事兼总经理；2008年6月至2014年10月，任上海艾为电子技术股份有限公司运营总监；2014年5月至2023年9月，任杭州量康科技有限公司监事；2015年3月至今，任上海瑞羊电子科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任杭州量康医学检验所有限公司监事；2016年11月至2019年3月，于上海晟矽微电子股份有限公司先后担任芯片运营副总、副总经理及董事；2018年9月至2020年8月，任物奇科技芯片运营副总裁；2020年5月至今，于发行人及其前身物奇微有限担任董事、副总经理。

庞功会先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2002年5月，任创维集团有限公司市场营销主管；2002年6月，待业；2002年7月至2005年9月，任意法半导体（上海）有限公司渠道管理专员；2005年10月至2007年7月，任奥纬集成电路技术（上海）有限公司市场销售总监；2007年7月至2009年1月，任晶晨半导体（上海）有限公司区域销售总监；2009年2月至2015年6月，于美满电子科技（上海）有限公司先后担任高级销售经理、销售总监；2015年7月至2018年5月，任深圳市江波龙科技有限公司总经理；2018年6月至2018年12月，待业；2019年1月至2021年11月，于芯海科技（深圳）股份有限公司先后担任市场营销副总裁、副总经理；2021年12月至2023年2月，于发行人前身物奇微有限担任副总经理；2023年2月至今，担任公司董事、副总经理。

姚海锋先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至今，于华为技术有限公司销售与服务、企业发展部先后担任工程师、经理、专家、总监等职务；2025年12月至今，任英创新材料（绍兴）有限公司董事；2025年12月至今，任无锡市好达电子股份有限公司董事；2026年1月至今，任新港海岸（北京）科技有限公司董事；2026年2月至今，任裕太微电子股份有限公司董事；2026年2月至今，担任公司董事；2026年5月至今，任杰华特微电子股份有限公司董事。

彭飞先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 8 月至 2016 年 5 月，任中国移动通信集团政企客户分公司高级产品经理；2016 年 6 月至 2019 年 9 月，任中移资本控股有限责任公司项目经理；2019 年 9 月至今，任中移股权基金管理有限公司投资部执行董事；2023 年 3 月至今，担任公司董事。

是大龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，先后任职于平安银行股份有限公司上海分行、上海自贸试验区分行金融部；2015 年 4 月至 8 月，待业；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任职于重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司基金运营二部；2017 年 4 月至 2020 年 11 月，任宁波渝富金渝投资管理有限公司监事；2017 年 10 月至 2020 年 4 月，任职于宁波渝富金渝投资管理有限公司投资部；2020 年 5 月至今，先后于重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司担任基金运营三部副部长、部长，并兼任基金运营四部部长、副总经理；2021 年 3 月至今，任重庆京东方显示技术有限公司董事；2021 年 1 月至今，任重庆锦渝鑫企业管理有限公司经理；2021 年 11 月至今，任重庆钧和企业管理有限公司执行董事；2022 年 2 月至今，任共青城钧添厦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 3 月至 2025 年 7 月，任重药控股股份有限公司监事；2025 年 8 月至今，担任公司董事。

杨勤法先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月，任浙江时代银鹰律师事务所主任；2002 年 7 月至今，任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学房地产政策法律研究所所长、投资与建设法治研究院副院长；2003 年 6 月至 2012 年 5 月，任上海国巨律师事务所兼职律师；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，任北京大成（上海）律师事务所兼职律师；2019 年 12 月至今，任上海市浩信律师事务所兼职律师；2022 年 12 月至今，任上海东方证券资产管理有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任发行人独立董事；2023 年 4 月至今，任上海季丰电子股份有限公司独立董事；2025 年 2 月至今，任上海超导科技股份有限公司独立董事。

徐鼎先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学

历，高级工程师（教授级）。1984年8月至1989年9月，任上海贝尔股份有限公司测试工程师；1989年9月至1995年9月，任上海贝岭微电子制造有限公司市场工程师；1995年10月至2016年12月，历任上海贝岭股份有限公司产品工程部经理、通讯事业部总经理、公司副总裁；2017年1月至2022年11月，任华大半导体有限公司投资总监；2019年5月至2022年8月，任华大恒芯科技有限公司董事；2019年6月至2025年5月，任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任常州易控汽车电子股份有限公司独立董事；2022年11月至今，历任拓荆科技股份有限公司投资总监、投资副总裁；2023年3月至今，历任上海岩泉科技有限公司执行董事、经理；2023年3月至今，担任公司独立董事；2025年7月至今，任上海原子启智半导体设备有限公司董事；2025年10月至今，任上海稷拓科技有限公司董事兼经理。

毛武兴先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师（教授级）。1990年4月至1999年8月，历任普天东方通信集团有限公司程控制造部副总经理、总经理、质量管理部总经理；1999年8月至2001年11月，任中国普天信息产业集团有限公司研发中心副主任；2001年11月至2009年6月，任普天信息技术研究院副院长、党委副书记；2009年6月至2017年11月，任北京松下普天通信设备有限公司董事、副总经理；2017年11月至2023年11月，任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、党委委员；2023年12月至今，任北京易升创奇科技有限公司资深顾问；2024年3月至2024年8月，任杭州奥博瑞光通信有限公司高级顾问；2025年1月至今，任芯三代半导体科技（苏州）股份有限公司独立董事；2025年4月至今，任西河云（北京）技术有限公司董事兼经理、财务负责人；2025年8月至今，任发行人独立董事。

吴晓辉先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年4月至1999年1月，任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999年2月至12月，任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000年1月至2021年7月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2021年8月至今，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2022年3月至今，任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任江西一脉阳

光集团股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事；2026 年 2 月至今，任发行人独立董事。

（二）董事会审计委员会成员的简要情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。

截至本招股说明书签署日，审计委员会成员包括吴晓辉、杨勤法、毛武兴，由吴晓辉担任召集人。

上述审计委员会成员简历详见招股说明书本节之“十二、（一）董事会成员的简要情况”有关内容。

（三）高级管理人员的简要情况

公司现任高级管理人员如下：

序号	姓名	职务	任期
1	郑建生	董事长、总经理	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
2	林豪	董事、副总经理	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
3	马云峰	董事、副总经理	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
4	庞功会	董事、副总经理	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
5	黄海波	财务总监	2026 年 2 月至 2029 年 2 月
6	毛向荣	董事会秘书	2026 年 2 月至 2029 年 2 月

郑建生先生、林豪先生、马云峰先生、庞功会先生的基本情况详见招股说明书本节“十二、（一）董事会成员的简要情况”。

黄海波先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 5 月，于北汽福田汽车股份有限公司先后担任会计、管理会计科科长、财务部副部长；2015 年 6 月至 2017 年 7 月，于重庆小康工业集团股份有限公司担任财务副部长；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，于重庆猪八戒网络有限公司担任财务经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，于物奇科技担任

财务经理；2022 年 1 月至今，于发行人及其前身物奇微有限先后担任财务经理、财务副总监、财务总监。

毛向荣先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1997 年 3 月，任职于上海万国证券公司宁波营业部；1997 年 4 月至 1999 年 8 月，任职于宁波杉杉实业有限公司；1999 年 9 月至 2001 年 9 月，待业；2003 年 8 月至 2006 年 9 月，任职于天一证券有限责任公司投资银行总部；2006 年 10 月至 2015 年 8 月，任职于光大证券股份有限公司投资银行上海三部；2015 年 8 月至 2020 年 6 月，于光大富尊投资有限公司任投资经理；2018 年 11 月至 2020 年 5 月，于发行人前身物奇微有限担任董事；2020 年 7 月至 2024 年 6 月，于发行人及其前身物奇微有限担任董事长特别助理；2024 年 6 月至今，担任公司董事会秘书。

（四）核心技术人员的情况

公司核心技术人员的认定标准如下：在公司产品相关的技术领域有对口的专业背景和深厚的技术基础，长期从事公司产品领域的技术工作；有一定的技术创新实力、技术开发组织管理能力；加入公司时间较长，所从事技术领域的产品对公司的营业收入贡献较大。

截至本招股说明书签署之日，公司共 3 名核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	林豪	董事、副总经理
2	古强	副总工程师
3	韦韧	副总工程师

林豪先生的基本情况详见招股说明书本节“十二、（一）董事会成员的简要情况”。

古强先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，于美满电子科技（上海）有限公司担任高级数字信号处理工程师；2015 年 11 月至 2016 年 7 月，于乐鑫信息科技（上海）有限公司担任通信算法工程师；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，于深圳市大疆创新科技有限公司担任算法工程师；2017 年 3 月至今，先后于发行人及下属子公

司担任通信与算法部副总工程师。

韦韧先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2012 年 7 月，于深圳市海思半导体有限公司担任芯片设计工程师；2012 年 8 月至 2017 年 2 月，于高通企业管理（上海）有限公司担任芯片验证工程师；2017 年 3 月至今，先后于发行人及下属子公司担任硬件工程师、芯片工程师以及软件部副总工程师。

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下：

姓名	公司职务	对外任职情况（不包括发行人及其子公司）		
		公司名称	职务	兼职单位与发行人是否存在关联关系
郑建生	董事长、总经理	Native Explorer Limited	董事	是
		上海物奇捌企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	是
马云峰	董事、副总经理	上海智享创芯企业管理咨询有限公司	执行董事	是
		上海瑞羊电子科技有限公司	执行董事	是
		上海觉梦软件信息有限公司	执行董事	是
		杭州量康医学检验所有限公司	监事	是
姚海锋	董事	华为技术有限公司	企业发展部总监	是
		英创新材料（绍兴）有限公司	董事	是
		裕太微电子股份有限公司	董事	是
		新港海岸（北京）科技有限公司	董事	是
		无锡市好达电子股份有限公司	董事	是
		杰华特微电子股份有限公司	董事	是
彭飞	董事	中移股权基金管理有限公司	投资部执行董事	是
是大龙	董事	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司	副总经理	是
		重庆京东方显示技术有限公司	董事	是
		重庆锦渝鑫企业管理有限公司	总经理	是
		重庆钧和企业管理有限公司	执行董事	是
		共青城钧添厦投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	是

姓名	公司职务	对外任职情况（不包括发行人及其子公司）		
		公司名称	职务	兼职单位与发行人是否存在关联关系
杨勤法	独立董事	华东政法大学	经济法学院副教授、房地产政策法律研究所所长、投资与建设法治研究院副院长	否
		上海市浩信律师事务所	兼职律师	否
		上海季丰电子股份有限公司	独立董事	否
		上海东方证券资产管理有限公司	独立董事	否
		江苏纽泰格科技集团股份有限公司	独立董事	否
		上海超导科技股份有限公司	独立董事	否
徐鼎	独立董事	上海岩泉科技有限公司	经理	否
		常州易控汽车电子股份有限公司	独立董事	否
		拓荆科技股份有限公司	投资副总裁	否
		上海原子启智半导体设备有限公司	董事	否
		上海稷拓科技有限公司	董事兼经理	否
毛武兴	独立董事	芯三代半导体科技（苏州）股份有限公司	独立董事	否
		西河云（北京）技术有限公司	经理、董事、财务负责人	否
		北京易升创奇科技有限公司	资深顾问	否
吴晓辉	独立董事	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	否
		英科医疗科技股份有限公司	独立董事	否
		江西一脉阳光集团股份有限公司	独立董事	否
		山东新华医疗器械股份有限公司	独立董事	否

除上述已披露情况外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他单位兼职的情况。公司董事、高级管理人员与其他核心技术人员上述在外兼职情况，不影响其在发行人处履职，不存在利益冲突。

（六）董事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署之日，本公司的董事、高级管理人员及核心人员之间不存在亲属关系。

（七）董事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、高级管理人员符合《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》规定的任职资格；发行人董事、高级管理人员及其他核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

（八）公司与董事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及履行情况

截至本招股说明书签署之日，发行人已与独立董事签订了聘任合同，在公司专职并领薪的董事、高级管理人员及核心技术人员均与本公司签署了劳动合同和保密协议（含竞业限制条款）。截至本招股说明书签署日，上述合同或协议均履行正常，不存在违约情形。

除上述合同或协议以外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员与本公司之间未签订其他重大商业协议。

十三、董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

（一）直接或者间接持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况如下：

单位：万股

姓名	职务/亲属关系	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股比例
郑建生	董事长、总经理	-	2,114.42	2,114.42	8.07%
Nina Li ZHENG	郑建生之女	-	2,114.16	2,114.16	8.07%
林豪	董事、副总经理	1,250.63	-	1,250.63	4.78%
马云峰	董事、副总经理	-	606.78	606.78	2.32%
庞功会	董事、副总经理	-	210.24	210.24	0.80%
毛向荣	董事会秘书	-	108.58	108.58	0.41%
黄海波	财务总监	-	15.03	15.03	0.06%
韦韧	副总工程师	-	317.48	317.48	1.21%
古强	副总工程师	-	323.25	323.25	1.23%
是大龙	董事	-	0.08	0.08	0.0003%

截至本招股说明书签署之日，上述股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。除此以外，不存在其他直接持有发行人股份的情况。除上述情形外，报告期内不存在董事、高级管理人员及核心技术人员配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接持有公司股份的情况。

（二）近三年持股变动情况

报告期各期末，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接及间接合计持有公司股份的变动情况如下：

单位：万股

姓名	持股方式	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例
郑建生	间接	2,746.91	8.07%	2,746.91	8.49%	2,746.91	8.49%
Nina Li ZHENG	间接	2,114.16	8.07%	2,114.16	8.49%	2,114.16	8.49%
林豪	直接	1,250.63	4.78%	1,250.63	5.02%	1,250.63	5.02%
马云峰	间接	607.69	2.32%	607.69	2.44%	607.69	2.44%
庞功会	间接	210.24	0.80%	210.24	0.84%	210.24	0.84%
毛向荣	间接	108.58	0.41%	108.58	0.44%	108.58	0.44%
黄海波	间接	15.03	0.06%	15.03	0.06%	15.03	0.06%
韦韧	间接	317.48	1.21%	317.48	1.28%	254.34	1.02%
古强	间接	323.25	1.23%	323.25	1.30%	250.58	1.01%
是大龙	间接	0.08	0.0003%	-	-	-	-

注：是大龙自 2025 年 8 月起担任公司董事。

（三）所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员直接或者间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。

十四、董事、高级管理人员及核心技术人员近二年的变动情况

报告期内，公司董事、高级管理人员的变动主要系正常股东委派、公司基于业务发展需要及优化公司治理的相应选聘，并履行了必要的程序。近二年内董事、高级管理人员及核心技术人员均未发生重大变化，具体情况如下：

（一）董事变动情况

变动时间	董事	变动原因
2024/01/01	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、盛建宏、陈波、彭飞、杨勤法、王方明、徐鼎	-
2024/06/28	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、方伟、陈波、彭飞、杨勤法、王方明、徐鼎	股东哈勃投资提名董事由盛建宏变更为方伟
2025/08/13	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、方伟、是大龙、彭飞、杨勤法、王方明、徐鼎、毛武兴	股东临空远翔拟退出，其提名董事陈波辞去董事职务，重庆战新提名是大龙为新任董事，同时增加毛武兴为新任独立董事
2026/02/25	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、姚海锋、是大龙、彭飞、杨勤法、徐鼎、毛武兴、吴晓辉	股东哈勃投资提名董事由方伟变更为姚海锋，同时换届选举吴晓辉为新任独立董事

最近两年，作为发行人的核心管理人员，郑建生、林豪、马云峰及庞功会始终担任公司董事。外部董事变化主要由外部股东委派董事人员变化及增设独立董事变化导致。

报告期内，发行人董事的选任均履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的有关规定。最近两年，以郑建生、林豪为核心的发行人管理团队保持稳定，且发行人董事会成员中非独立董事构成保持了二分之一以上的稳定，公司对董事人员的部分调整及股东委派董事的变化、新设独立董事未导致重大不利变化，发行人的持续经营管理能力和本次发行上市未受到重大不利影响。

（二）高级管理人员变动情况

发行人目前的高级管理人员为郑建生、林豪、马云峰、庞功会、毛向荣、黄海波。最近两年，高级管理人员的变化情况如下：

变动时间	高级管理人员	变动原因
2024/01/01	郑建生、林豪、马云峰、庞功会	-
2024/06/06	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、毛向荣	聘任毛向荣为董事会秘书
2025/05/30	郑建生、林豪、马云峰、庞功会、毛向荣、黄海波	聘任黄海波为财务总监

最近两年，发行人高级管理人员的变动系原财务总监兼董事会秘书因个人原因离职而重新选聘所致，高级管理人员未发生重大变化。

（三）核心技术人员变动情况

最近两年，发行人核心技术人员为林豪、古强、韦韧，未发生变动。

（四）董事、高级管理人员及核心技术人员变动的原因及对公司的影响

综上所述，最近两年，公司上述人员变动系因完善法人治理结构、满足经营管理需要而进行的正常变动，已履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定，上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大影响。

十五、董事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

截至报告期末，公司董事、高级管理人员及核心技术人员除对本公司及本公司的持股平台投资以外，其他对外投资情况如下：

姓名	发行人处职务	对外投资单位	持股比例
郑建生	董事长、总经理	Native Explorer Limited	50.0025%
		上海物奇捌企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0081%
		鼎精投资 ^{注1}	56.72%
		季丰电子	3.23%
马云峰	董事、副总经理	上海智享创芯企业管理咨询有限公司 ^{注2}	99.00%
		上海瑞羊电子科技有限公司	99.00%
		上海觉梦软件信息有限公司	60.00%
		上海长卫宜斯软件系统有限公司	15.00%
		海南宇芯叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.00%
		厦门集微壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	21.28%
		宁波璟正企业管理合伙企业（有限合伙）	2.70%
		上海灵动微电子股份有限公司	1.50%
是大龙	董事	共青城钧添厦投资合伙企业（有限合伙）	15.33%
		共青城渝新创投资合伙企业（有限合伙）	6.46%
		共青城创视投资合伙企业（有限合伙）	3.31%
徐鼎	独立董事	上海岩池半导体技术合伙企业（有限合伙）	10.00%
毛武兴	独立董事	西河云（北京）技术有限公司	99.00%
吴晓辉	独立董事	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	1.38%
		中汇（海南）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	4.00%

注 1：截至报告期末，郑建生委托他人代为持有鼎精投资 56.72% 合伙份额。截至本招股说明书签署日，郑建生已不再持有鼎精投资合伙份额。具体详见招股说明书本节“九、（九）发行人历史沿革中的股份代持及解除情况”；

注 2：截至本招股说明书签署日，马云峰持有上海智享创芯企业管理咨询有限公司股权比例变更为 20%。

除上述已披露的对外投资外，截至本招股说明书签署之日，公司董事、高

级管理人员及核心技术人员均不存在其他对外投资情况。

公司董事、高级管理人员、核心技术人员的上述对外投资不存在与公司有同业竞争的情形，亦不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

十六、董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

（一）董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬构成、确定依据等情况

公司内部董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员的薪酬主要由岗位工资组成，考虑所属行业或地区的薪酬水平，并以公司经营与综合管理情况为基础，根据年度综合业绩完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。未在公司担任其他职务的外部非独立董事不予提供津贴，其参加董事会、股东会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司支付。独立董事领取固定津贴为每年 12 万元/人。核心技术人员薪酬由岗位工资及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。

公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员的履职进行考核，提交董事会或股东会审议；公司董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

报告期内，公司董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬合计	778.83	742.67	853.41
亏损总额	21,343.52	23,850.84	30,042.97
薪酬合计/亏损总额	3.65%	3.11%	2.84%

（二）董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

2025 年度，本公司董事、监事会取消前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司及关联方处领取薪酬的情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度薪酬领取		备注
		自发行人	自实际控制人控制的其他企业	
郑建生	董事长、总经理	48.00	否	
林豪	董事、副总经理、核心技术人员	60.00	否	
马云峰	董事、副总经理	60.00	否	
庞功会	董事、副总经理	84.00	否	
陈波	外部董事	-	否	未在发行人处领薪
方伟	外部董事	-	否	未在发行人处领薪
彭飞	外部董事	-	否	未在发行人处领薪
是大龙	外部董事	-	否	未在发行人处领薪
姚海锋	外部董事	-	否	未在发行人处领薪
杨勤法	独立董事	12.00	否	独董津贴
王方明	独立董事	12.00	否	独董津贴
徐鼎	独立董事	12.00	否	独董津贴
毛武兴	独立董事	5.00	否	2025 年 8 月新担任独董
吴晓辉	独立董事	-	否	2026 年 2 月新担任独董
陶文岩	监事会取消前曾任监事	58.67	否	2025 年 8 月离任
杨红	监事会取消前曾任监事	27.07	否	2025 年 8 月离任
孙凤霞	监事会取消前曾任监事	24.69	否	2025 年 8 月离任
毛向荣	董事会秘书	101.00	否	
黄海波	财务总监	50.00	否	
古强	核心技术人员	112.20	否	
韦韧	核心技术人员	112.20	否	

注 1：上述人员的薪酬包括领取的工薪、奖金、津贴等，不包括股权激励涉及股份支付金额；

注 2：陶文岩、杨红、孙凤霞领取的薪酬按其实际任期 2025 年 1-8 月统计，奖金按任期折算；

注 3：2026 年 2 月 25 日，经 2026 年第一次临时股东会审议，选举姚海锋、吴晓辉为新任董事，其二人于 2025 年度内未在发行人处领取薪酬。

在公司担任具体经营职务的董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员及核心技术人员，公司除依法为其缴纳社会保险和住房公积金以外，不存在其他特殊的福利待遇和退休金计划。

十七、发行人员工及社会保障情况

（一）员工情况

报告期各期末，发行人员工总数分别为 406 人、356 人和 329 人。

1、员工专业结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工按岗位划分结构如下：

岗位结构	人数（人）	占比
研发人员	229	69.60%
管理人员	42	12.77%
销售人员	55	16.72%
其他人员	3	0.91%
合计	329	100.00%

注：在公司认定的研发人员中，部分员工会参与受托研发项目，但公司不存在单纯从事受托研发的人员。上表中其他人员系当期同时参与自研项目及定制研发项目且定制研发项目工时超过 50% 的人员。

2、员工年龄结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工按年龄划分结构如下：

年龄	人数（人）	占比
30 岁以下	89	27.05%
31-40 岁	171	51.98%
41-50 岁	57	17.33%
50 岁以上	12	3.65%
合计	329	100.00%

3、员工受教育程度

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工按受学历划分结构如下：

教育程度	人数（人）	占比
博士	5	1.52%

教育程度	人数（人）	占比
硕士	132	40.12%
本科	177	53.80%
大专及以下	15	4.56%
合计	329	100.00%

（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况

1、公司员工缴纳社保、公积金人数

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定与员工签订劳动合同，员工根据劳动合同享受权利和承担义务。公司已按照国家、地方有关法律法规及有关政策规定为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险。同时，公司还根据《住房公积金管理条例》及地方政府的相关规定依法为员工缴纳了住房公积金。

报告期各期末，公司为员工缴纳社会保险及住房公积金情况如下：

项目		2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
员工总数（人）		329	356	406
其中：发行人及境内子公司在册员工总数		316	340	388
境外子公司在册员工总数		13	16	18
社会保险	境内已缴（人）	315	338	396
	境内未缴（人）	1	2	-8
	缴纳比例	99.68%	99.41%	102.06%
住房公积金	境内已缴（人）	315	338	396
	境内未缴（人）	1	2	-8
	缴纳比例	99.68%	99.41%	102.06%

公司及子公司已缴纳人数与境内在册员工总人数存在差异的主要原因包括：（1）退休返聘员工无需缴纳；（2）原单位未及时停缴，公司无法为其办理社会保险和住房公积金增员；（3）外籍员工无需缴纳住房公积金，自愿放弃缴纳社保。

（1）公司员工人数与缴纳社保人数的差异说明

单位：人

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
1、外籍员工自愿放弃境内社保	1	1	1
2、当月离职员工发行人仍在缴纳	2	-	10
3、原单位未及时停缴	1	-	-
4、退休人员返聘签署劳务合同	1	1	1
合计（1+3+4-2）	1	2	-8

除上述表格中所述情况之外，公司为其他所有员工缴纳了社保。

（2）公司员工人数与住房公积金缴纳人数的差异说明

单位：人

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
1、外籍员工无需缴纳住房公积金	1	1	1
2、当月离职员工发行人仍在缴纳	2	-	10
3、原单位未及时停缴	1	-	-
4、退休人员返聘签署劳务合同	1	1	1
合计	1	2	-8

除上述表格中所述情况之外，公司为其他所有员工缴纳了住房公积金。

2、公司执行社会保障制度、住房公积金政策合法合规情况

公司及其子公司已经取得当地相关管理部门出具的证明和《专项信用报告》，报告期内，公司及其子公司未有因违反劳动保障方面有关法律、法规、规章等受到相关行政处罚的情形，未有因违反公积金法规受到行政处罚的情形。

发行人境外子公司不涉及社保、公积金相关主管部门的行政处罚，与员工之间不涉及相关诉讼。

3、发行人实际控制人的承诺

发行人实际控制人郑建生已出具书面承诺，承诺如下：“在作为发行人实际控制人期间和不作为实际控制人后的任何期间内，若社会保障及住房公积金主管部门因为发行人上市前发行人及其子公司未依法足额缴纳各项社会保险金及住房公积金或存在其他违反社保、住房公积金相关法律、行政法规、政策等

规定的情况而对发行人及其控股子公司进行处罚或追缴，本人将无条件地全额承担应补缴或处罚的金额，并充分补偿因此而给发行人及其子公司造成的损失。”

（三）发行人劳务外包情况

1、劳务外包业务背景及基本情况

报告期内，公司业务持续发展，为提高研发效率及用工灵活性，将部分不涉及关键技术及关键工序的环节或辅助性工作进行外包，主要包括 Wi-Fi 芯片测试、嵌入式研发及芯片测试环节的辅助性工作等。

报告期内，公司采购劳务的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
劳务外包采购金额	224.78	93.49	62.01
研发费用+管理费用	28,174.25	29,847.25	35,032.91
劳务外包采购金额/ （研发费用+管理费用）	0.80%	0.31%	0.18%
期末在册劳务外包用工人数	16	9	15
期末公司在册员工人数	329	356	406
劳务外包人数占公司员工人数比例	4.86%	2.53%	3.69%
劳务外包人员岗位分布	测试、嵌入式研发、辅助岗位等		

注：劳务外包人数占公司员工人数比例=劳务外包用工人数/公司员工人数

报告期内，公司计入相关费用的劳务采购金额分别为 62.01 万元、93.49 万元和 224.78 万元，占相关费用的比例分别为 0.18%、0.31%和 0.80%，占比相对较小，与公司实际业务情况相匹配，对公司利润水平影响较小。

2、劳务外包服务商情况

报告期内，公司向劳务外包服务商采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占同类交易比例
2025 年度	1	深圳斐德软件技术有限公司	224.78	100.00%
		合计	224.78	100.00%
2024	1	深圳斐德软件技术有限公司	75.34	80.59%

年度	序号	供应商名称	采购金额	占同类交易比例
年度	2	滁州联孚尚世人力资源有限公司	18.15	19.41%
	合计		93.49	100.00%
2023年度	1	滁州联孚尚世人力资源有限公司	47.66	76.86%
	2	上海芯发劳务派遣有限公司	14.35	23.14%
	合计		62.01	100.00%

前述劳务外包公司基本情况如下：

（1）上海芯发劳务派遣有限公司

名称	上海芯发劳务派遣有限公司
统一社会信用代码	91310120598174311P
成立日期	2012年06月21日
注册资本	500万元
法定代表人	彭珏
注册地址	上海市奉贤区庄行镇安东南路678号7幢163
经营范围	劳务派遣，以服务外包方式：从事企业管理，从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理，商务信息咨询，投资管理，货物运输代理，人工搬运服务，机动车驾驶服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），旅客票务代理，汽车用品、汽车配件、日用百货、五金交电、家用电器、五金制品批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	华的犬、李芳各持股50%

（2）滁州联孚尚世人力资源有限公司

名称	滁州联孚尚世人力资源有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8PU9KR0U
成立日期	2022年12月19日
注册资本	200万元
法定代表人	季邦荣
注册地址	安徽省天长市天汉路南经九路与经十路之间（纬一路88号）12栋104#1032室
经营范围	一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生产线管理服务；企业形象策划；市场营销策划；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；会议及展览服务；软件开发；专业设计服务；酒店管理；工程管理服务；运输货物打包服务；市场调查（不含涉外调查）；商务代理代办服务；物业管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

	让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	上海联服企业服务集团有限公司持股 100%

（3）深圳斐德软件技术有限公司

名称	深圳斐德软件技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MACNH7B52L
成立日期	2023 年 6 月 25 日
注册资本	200 万元
法定代表人	魏秀凤
注册地址	深圳市龙华区民治街道上芬社区第五工业区一区 28 号 304-G4
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第二类增值电信业务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	上海斐德通信科技有限公司持股 100%

报告期内，发行人聘请的劳务公司均系独立经营的实体，与发行人业务交易系基于正常、合理的业务需要，为公司提供劳务服务符合其经营范围，无须特定专业资质。合作过程中，劳务外包工的管理、社保缴纳、工资发放、用工风险等由劳务外包公司承担，相应业务不存在重大风险。

（四）发行人劳务派遣情况

报告期内，公司不存在劳务派遣的情况。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）发行人主营业务概况

1、发行人主营业务概况

发行人是国内较早全系采用 RISC-V 架构，并实现商业化落地与量产的芯片设计企业。自设立以来，专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发和销售，并为客户提供 SoC 芯片定制服务。发行人致力于短距通信与端侧智能的深度融合，现已构建由高带宽低时延通信技术、端侧多模态 AI 算法及超低功耗数模混合芯片设计组成的三大核心能力，并以此为基础搭建了完善的自主研发平台，形成了“连接中枢+端侧入口”双轮驱动的业务方向。截至目前，发行人产品主要应用于网络通信与端侧智能两大领域。

在网络通信芯片领域，发行人先后推出 Wi-Fi STA 芯片与 Wi-Fi AP 芯片，全面布局从连接到中枢的核心环节。Wi-Fi AP 芯片作为高速稳定无线网络的核心器件，主要应用于路由器、网关、FTTR 等网络通信设备，其技术自主独立对保障国家网络安全、维护数据主权具有重要意义。历经多年持续攻关，发行人在 Wi-Fi AP 芯片的射频前端架构设计、基带信号处理及 SoC 系统集成等关键技术领域实现重大突破，成功研发基于 RISC-V 架构、性能比肩国际主流的 Wi-Fi 6 AP 芯片，是截至目前极少数掌握自主知识产权并具备量产能力的中国大陆企业，成为打破国际巨头在高端路由器芯片领域的长期垄断格局的重要力量。目前，该产品顺利通过国家无线电监测中心检测中心认证、中国移动芯片入库审查及相关资质审查，已向中兴微、长虹小批量供货，为我国信息基础设施建设筑牢自主独立的“连接底座”。同时，发行人正加速推进 Wi-Fi 7 AP 芯片的研发工作，努力提升高端 Wi-Fi 芯片自主独立进程。在 Wi-Fi 终端连接方面，公司 Wi-Fi STA 芯片已覆盖 Wi-Fi 4 至 Wi-Fi 6 全系列，广泛应用于电视、安防等领域，服务的终端客户包括创维集团、客户 A、客户 B 等知名企业，真正实现从终端到中枢的“智联万物”。

在端侧智能芯片领域，随着人工智能技术的快速发展，终端设备从“单一连接”向“集语音、视觉、环境感知于一体的多模态智慧交互”演进，对端侧

智能芯片在低功耗、高集成度及多模态处理能力等方面提出更高要求。发行人推出的多款端侧智能芯片，集成 RISC-V CPU、存算一体 NPU、DSP 及 ISP 等异构处理核心，构建面向多模态 AI 的完整处理能力，广泛适用于智能耳机、智能眼镜等终端设备。目前，公司正加快研发下一代基于先进制程的端侧智能芯片，持续提升产品技术竞争力，扩大市场份额。

截至报告期末，发行人已获得授权专利 141 项，其中境内专利 121 项（含发明专利 109 项）、境外专利 20 项，专利布局紧密围绕核心产品及相应核心技术，形成了完善的知识产权保护体系。此外，公司还获评国家级专精特新“小巨人”企业，连续三年获得中国 IC 设计成就奖、成功入选中国 IC 设计 Fabless100 排行榜之 Top10 无线连接芯片公司；发行人研发的 Wi-Fi 6 AP 芯片荣膺 2025 中国创新 IC-强芯领航奖；2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片凭借稳定的传输性能和国际领先的低功耗表现，获得“中国芯”优秀技术创新产品奖。

2、发行人主营业务收入构成情况

报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、芯片产品	56,369.28	99.77%	51,120.54	99.46%	28,409.42	96.19%
端侧智能芯片	45,470.45	80.48%	44,167.03	85.93%	17,486.90	59.21%
网络通信芯片	10,898.84	19.29%	6,953.52	13.53%	10,922.52	36.98%
二、定制开发及技术服务	84.20	0.15%	240.32	0.47%	1,038.02	3.51%
三、其他	43.35	0.08%	36.68	0.07%	87.25	0.30%
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

（二）发行人设立以来主营业务、主要产品或服务的演变情况

自成立以来，公司专注于通信类 SoC 芯片技术，重点深耕在以蓝牙与 Wi-Fi 为主流核心的短距通信连接技术领域，以此为核心战略支点，稳步进行业务布局与市场拓展。后续伴随着人工智能在终端侧的商业化落地需求日益明确，公司依托在短距通信领域的技术积累，以及在超低功耗、端侧多模态 AI 算法等方面建立的核心能力，致力于短距通信与端侧智能的深度融合，业务延伸至端

侧智能芯片领域。公司主要产品演变情况如下：

	网络通信芯片	端侧智能芯片
奠基阶段 2017年-2019年	推出国内首款RISC-V PLC芯片WQ3011	发布业内首款全集成3D视觉技术方案WQ5007
	构建以RISC-V为底层架构的异构多核SoC计算体系	
快速发展阶段 2020年-2024年	推出高集成的Wi-Fi 4 STA芯片WQ9001	推出首个超低功耗智能音频主控芯片WQ7033
	推出国内首款1x1 DBDC Wi-Fi 6 STA芯片	推出高端智能音频主控芯片WQ7036
	发布2x2 Wi-Fi 6+BT Combo STA芯片WQ9201	陆续推出智能音频主控芯片WQ7035、7034
	完成Wi-Fi 6 从AX300到AX1200的全速率产品布局	发布高度集成的智能音频产品开发平台
深化突破阶段 2025年至今	推出Wi-Fi 6 AP芯片WQ9301，实现批量交付	启动基于先进制程的多模态端侧AI芯片研发工作

1、2017 年至 2019 年：奠定基础，初步形成主营业务矩阵

依托创始团队在通信连接领域积淀的深厚技术实力，公司精准捕捉 2017 年前后智能电网建设提速带来的 PLC 芯片市场机遇，前瞻性采用 RISC-V 开源架构开展自主创新，推出基于该架构的高集成度 PLC 芯片，实现了从指令集架构到 CPU 内核设计的自主独立。公司产品能够有效降低下游客户系统部署成本与设备功耗，截至当前该系列芯片累计出货量已突破五千万颗。

此外，随着 2019 年以来智能物联网产业快速崛起，公司通过自主研发异构多核 SoC 架构与自研 NPU 等核心单元，推出支持主流 3D 视觉处理、具备低功耗边缘计算能力的 3D 视觉处理芯片。该芯片可应用于智能家居、智慧安防、工业互联等端侧智能场景，已在智能门锁、投影设备等终端场景实现落地，并展现出向更多应用领域拓展的潜力。

2、2020 年至 2024 年：快速升级，培育智能音频主控芯片和 Wi-Fi 芯片两大核心业务增长极

围绕智能音频终端及可穿戴设备市场对芯片低功耗、高智能化等核心需求，公司逐步构建超低功耗数模混合芯片设计、端侧多模态 AI 算法等核心能力，相继推出了多款高性能、低功耗芯片产品，逐步实现对智能耳机、智能眼

镜等多元可穿戴场景的全面覆盖。同时，依托自主研发能力与自主 IP 资源，应客户需求拓展了智能视觉处理芯片定制业务，丰富了端侧智能芯片的产品类型。

Wi-Fi 作为与蓝牙并列的核心短距通信技术，亦是短距通信芯片领域研发难度最高的方向之一。公司坚持长期主义研发理念，凭借在短距通信领域的技术优势，持续加大在 Wi-Fi 领域的研发投入、推进技术迭代升级，从早期 Wi-Fi 4 芯片切入市场，陆续推出支持双频并发、高速传输等先进技术的 Wi-Fi 6 STA 系列芯片，逐步打造起完整的 Wi-Fi STA 芯片产品矩阵。

3、2025 年至今：深化突破，打破 Wi-Fi 6 AP 芯片国际垄断，布局基于更先进制程的端侧智能芯片研发

依托研发团队的长期技术积淀、前期在 Wi-Fi 领域的深厚技术积累，以及通过 Wi-Fi STA 芯片系列产品开发所形成的工程实践能力，公司在业内公认技术壁垒最高、研发难度最大的 Wi-Fi AP 芯片领域取得关键突破。公司历时近四年技术攻关，成功推出 Wi-Fi 6 AP 芯片，是截至目前极少数具备量产能力的中国大陆企业，助力我国高端无线通信芯片技术突破。公司亦加速推进 Wi-Fi 7 AP 芯片研发进程，巩固并扩大在高端 Wi-Fi 芯片领域的技术优势与市场竞争力。

同时，伴随端侧 AI 应用场景加速落地与大模型技术的快速普及，公司把握行业发展趋势，启动基于下一代先进制程的多模态端侧智能芯片研发工作，该芯片具备更强的端侧算力输出能力与多模态数据处理能力，旨在为未来多元化人机交互场景与智能终端设备提供高性能、低功耗的核心芯片支持，抢占行业发展先机。

（三）发行人主要产品及服务

发行人专注于网络通信芯片和端侧智能芯片两大品类，主要产品如下：



1、网络通信芯片

网络通信芯片是实现设备互联与数据传输的核心硬件，负责将物理设备转化为可交互的网络节点，实现高效稳定的组网通信。发行人在网络通信芯片领域持续深耕，产品包括 Wi-Fi 芯片系列及 PLC 芯片。

(1) Wi-Fi 芯片系列

1) Wi-Fi AP 芯片

Wi-Fi AP 芯片作为搭建无线网络接入点的核心通信元器件，主要应用于无线路由器、网关、FTTR（光纤到房间）等各类网络基础设备，功能涵盖无线信号收发、数据解析与处理、网络参数配置管理及多用户接入控制等关键环节。该芯片的性能水平，直接决定无线网络的覆盖范围、数据传输速率、连接稳定性、时延控制效果及多设备并发处理能力，是保障无线网络高效、稳定、安全运行的核心器件。Wi-Fi AP 芯片作为高端无线通信芯片的核心品类，技术壁垒极高，长期以来被国际巨头垄断，是我国芯片领域亟待实现突破的关键核心器件之一。

历经多年持续研发，发行人在 Wi-Fi AP 芯片的射频前端架构设计、基带信号处理及 SoC 系统集成等关键技术领域实现重大突破，成功研发基于 RISC-V

架构、性能比肩国际主流的 Wi-Fi 6 AP 芯片，系当前 Wi-Fi AP 芯片市场的主流代际产品。

2) Wi-Fi STA 芯片

Wi-Fi STA 芯片是应用于无线终端设备的核心通信芯片，承担着终端与无线路由器、热点等网络接入点之间的稳定连接、安全认证交互及高速数据传输的关键职责，应用于电视、网络摄像机、MiFi 设备、物联网终端、电脑/平板电脑、手机等各类无线终端设备。

发行人的 Wi-Fi STA 芯片包括 Wi-Fi 4 STA 芯片、Wi-Fi 6 STA 芯片。公司从 Wi-Fi 4 芯片 WQ9001 切入市场，后续应客户需求开发 1×1 Wi-Fi 6 STA 芯片，基于前期积累的相关核心技术，推出具有市场竞争力的 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片，已实现从 AX300 到 AX1200 的全速率覆盖。

公司的 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片凭借稳定的传输性能和国际领先的低功耗表现，获得“中国芯”优秀技术创新产品奖。

（2）PLC 芯片

PLC 芯片是一种以现有电力线作为数据传输介质的专用通信芯片，通过在电力线上叠加高频通信信号，突破传统电力线仅用于电力传输的局限，实现数据在电网中的稳定、高效传输，具备部署便捷、成本可控等优势。

2017 年前后，国内智能电网、智能家居、智慧能源等场景加速落地，电力线通信因无需额外布线、适配电网存量改造需求，迎来规模化应用窗口期；同时国网推进智能电表、配网自动化升级，对 PLC 芯片的兼容性、稳定性提出明确标准，市场需求集中爆发。发行人抓住行业机遇，成为国内较早采用 RISC-V 架构自主研发 PLC 芯片并实现大规模量产的厂商之一。近年来，发行人战略聚焦于短距通信与端侧智能的深度融合，将研发及市场资源优先投入 Wi-Fi 芯片和端侧智能芯片业务领域，该芯片产品对公司的重要程度逐步降低，预计未来销售规模将进一步缩减。

2、端侧智能芯片

当前，人工智能技术正驱动智能终端从单一交互模式向语音、视觉等多模

态融合演进，并加速向端侧深度渗透，为端侧 AI 芯片产业带来广阔市场空间。公司以语音与视觉为核心方向，依托自研通信模块、音频 AI 技术及低功耗 NPU 的异构协同架构，深耕智能音频主控芯片与智能视觉处理芯片两大产品线，产品覆盖智能耳机、智能眼镜等可穿戴设备及智能家居等 AIoT 应用场景，构建差异化竞争能力。

（1）智能音频主控芯片

智能音频主控芯片是集成了通讯模块、高性能音频处理单元、人工智能计算核心及丰富外设接口的专用 SoC，该芯片承担高保真音频信号的编解码、降噪及音效增强等基础功能，通过内置 NPU 或 DSP 实现本地语音唤醒、语音识别、通话降噪等实时 AI 处理，在设备端侧提供低功耗、低延迟、高隐私保护的智能交互体验。

发行人自主研发的智能音频主控芯片 WQ703X 系列，主要面向中高端智能音频设备市场，是智能耳机、智能眼镜等智能终端设备实现无线音频交互功能的核心器件。公司智能音频主控芯片采用独创的高性能低功耗架构，具备稳定的高品质音频处理能力，可充分满足中高端品牌客户的技术门槛要求；灵活的软硬件架构支持深度定制，能够快速响应客户的个性化产品需求；良好的可扩展性支持无缝延伸至智能眼镜等穿戴设备，相较于行业内多数竞争对手需重新开发芯片的方案，显著降低客户的开发成本与周期，提升客户产品上市效率。

（2）智能视觉处理芯片

智能视觉处理芯片是一系列融合三维视觉感知、边缘人工智能计算及智能编解码能力的专用芯片，其中一款芯片专注于实时获取并处理深度、轮廓、姿态等多维空间信息，为智能门锁、金融支付、工业测量、机器人等场景提供精准的三维视觉解决方案；另一款则为定制芯片，专门赋能智能视频显示领域，通过高效视频信号的解析与优化，为终端显示设备提供高质量图像输入。二者以多元技术架构满足不同下游应用的差异化需求。

3、定制服务

芯片定制服务是指根据客户需求，为其设计专门定制的芯片。报告期内，随着公司各项核心技术体系逐步构建成型，主营业务日趋多元化。在自研核心

芯片产品实现大规模销售的同时，公司成熟、强大的大型 SoC 芯片设计能力亦获得部分行业领先客户的认可。依托长期积累的自主研发能力及丰富的自主 IP 资源（包括 RISC-V 系列 IP、Wi-Fi 通信 IP、蓝牙通信 IP、音频 IP、NPU IP、PMU IP 等），公司能够为客户提供一站式解决方案，满足其对特定芯片的定制化需求，助力客户提升产品竞争力。

报告期内，公司成功为客户定制了两款芯片：智能音频主控芯片与智能视觉处理芯片。其中，智能音频主控芯片主要应用于车规级智能语音识别领域；智能视觉处理芯片主要应用于智能视频显示领域。两款芯片均获得了市场广泛认可。

（四）发行人主要经营模式

1、盈利模式

发行人主营业务收入主要来源于芯片产品的研发、设计及销售。公司采用 Fabless 模式开展芯片设计业务，即公司负责芯片的研发、设计与销售环节，将晶圆制造、封装测试等生产制造环节全部委托外部专业厂商完成，最终通过产品交付及服务提供实现收入的确认。

此外，公司还为客户提供定制芯片服务实现服务收入，以及后续销售定制芯片实现产品收入。

发行人在自研芯片业务与芯片定制服务之间构建了良性互动，两者通过技术复用、风险分摊、需求闭环等多个方面相互促进。

（1）研发成本的分摊与复用

自研芯片在设计、IP 授权、流片、验证等环节投入较高。通过对外提供芯片定制服务，公司可将基础技术能力以服务形式输出给不同客户，实现研发成本的分摊。同时，定制业务中积累的特定应用领域需求也有助于自研产品的功能规划，提升其市场适应性。

（2）技术成熟度与风险控制的平衡

自研芯片通常追求较高的集成度与前瞻性，具有一定的技术风险；定制业务面向具体应用场景，需要成熟、可交付的模块化设计。通过定制项目先行验

证关键 IP 或子系统，可在实际客户场景中发现问题并优化设计，待技术方案稳定后再整合至自研芯片，从而降低自研产品的流片风险。

（3）市场需求与产品定义的闭环

定制业务能够直接接触不同客户的真实需求，相关信息可指导自研芯片的规格定义、接口选择及性能优先级设定，形成产品定义与市场需求的闭环。

（4）人才与技术创新的良性循环

定制业务要求快速响应与灵活变通，有助于锻炼团队的工程化能力；自研产品则鼓励深度创新与长期架构优化。两类项目的交叉进行，同时提升了团队的实战经验与前瞻视野。

（5）现金流量与财务业绩的短期取舍

自研芯片在流片、IP 授权、量产准备等阶段需集中投入大量资金，现金流出压力较大，但相应销售毛利率较高。而开展定制服务，公司可在自研产品尚未形成规模销售前，利用定制项目收取的开发服务费用等，获得相对稳定的现金流入，部分对冲自研阶段的集中支出，从而降低整体现金流波动风险，但定制芯片形成批量供货后，随着客户采购量逐步放大，可能需按照约定或商业谈判给予阶梯式价格折让，导致单位售价呈下降趋势，进而拉低毛利率表现。公司在自研芯片的同时，根据客户需求与自身研发积累的契合度，适度承接定制项目，有助于公司在自研芯片研发阶段获得经营性现金流入，改善营运资金周转效率，减少对外部融资的依赖。

2、采购及生产模式

Fabless 模式下，公司主要承担芯片规格参数定义、整体方案规划、架构设计、核心 IP 开发、封装方案设计、物理设计及全面设计验证等核心研发工作，并将集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。公司采购内容主要为晶圆制造、封测服务及 SoC 配套的存储芯片。

3、销售模式

报告期内，公司产品销售采用“经销+直销”的销售模式。

（1）经销模式

在经销模式下，公司直接面对经销商，与经销商签订购销合同或订单，明确合同标的、技术条件、交货期限、返利政策等，后续的出货、开票、付款和对账均由公司与经销商双方完成。公司与经销商的关系属于买断式销售关系，非因质量原因，经销商无权退货。

（2）直销模式

在直销模式下，公司通过自身的销售渠道直接面向终端客户，与终端客户签订产品购销合同或订单，明确合同标的、技术条件、交货期限、返利政策等，后续的出货、开票、付款和对账均由公司与终端客户双方完成。

4、研发模式

公司的芯片研发项目分为项目准备及立项、项目实施、项目验证和项目结项四个阶段。项目准备及立项阶段主要由销售部/市场部、运营部与产品线负责人根据客户需求形成新产品的构思并进行研讨立项；项目实施阶段主要由研发部和运营部完成具体的芯片系统设计和封装测试方案；项目验证阶段主要由研发部、运营部和供应商共同完成芯片量产前的加工、测试、验证、流片和试产环节；最后经由公司评审、客户反馈后完成结项。

（1）项目准备及立项阶段

销售部/市场部、运营部与产品线负责人依据客户需求，提炼形成新产品构思，随后联合研发部及其他相关部门，开展项目的市场可行性、技术可行性分析，以及成本与产出评估工作。经研讨论证后，对于具备明确市场前景的新产品，正式启动立项流程。

（2）项目实施阶段

进入项目实施阶段后，研发部结合具体项目需求，完成芯片系统设计工作；同时逐步拆解核心任务，有序推进电路设计、软件设计、可测试性设计及版图设计，最终联合运营部共同完成封装设计方案与测试方案。

（3）项目验证阶段

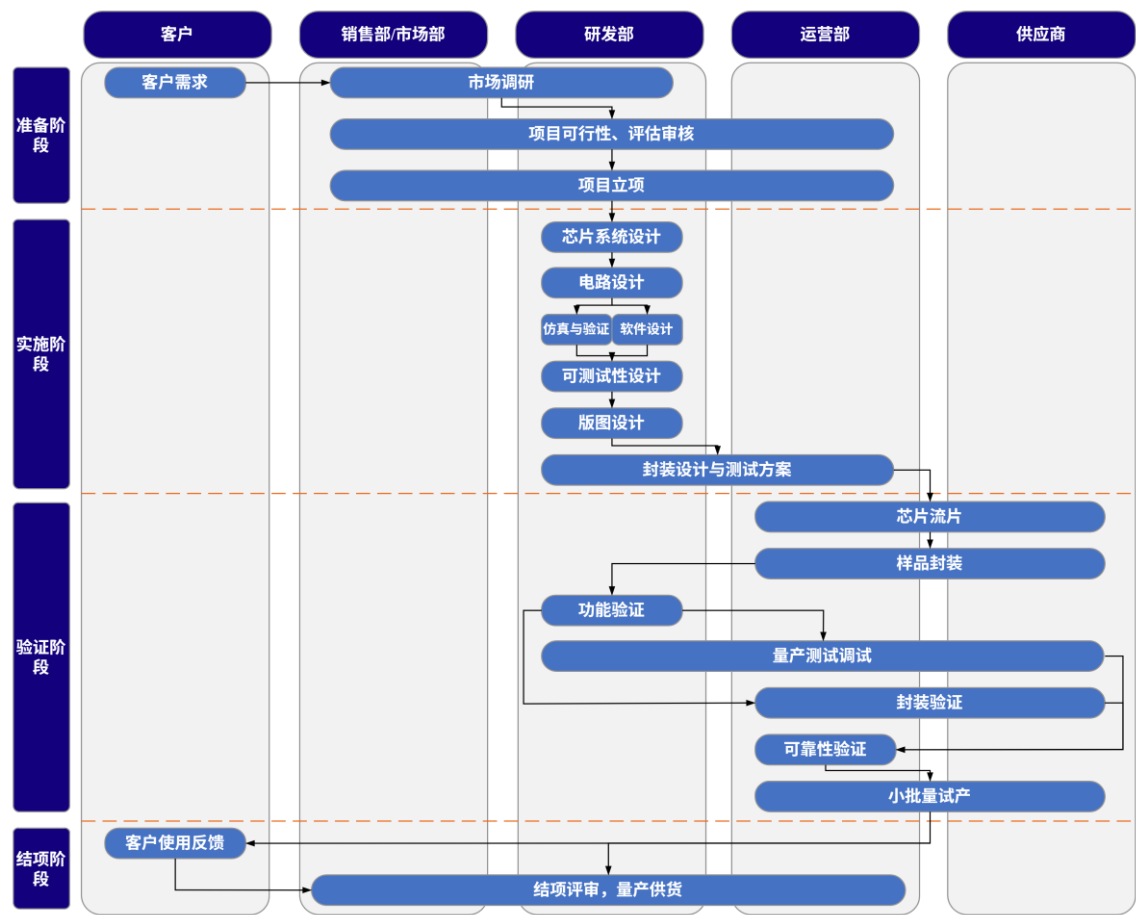
项目验证阶段核心涵盖产品加工、测试、验证评估及小批量生产全流程。

芯片设计工作收尾后，运营部与供应商协同完成芯片样品的流片与封装，后续联合研发部依次开展功能验证、封装验证、可靠性验证及量产测试调试，最终实现小批量试产落地。

（4）项目结项阶段

新产品小批量试产完成后，经由公司组织评审，并结合客户反馈情况综合研判。若发现产品存在缺陷或收到客户优化意见，将结合实际场景对芯片进行设计改版，之后再次进入加工、测试、验证循环，直至顺利通过评审，完成结项。

公司的研发模式如下：



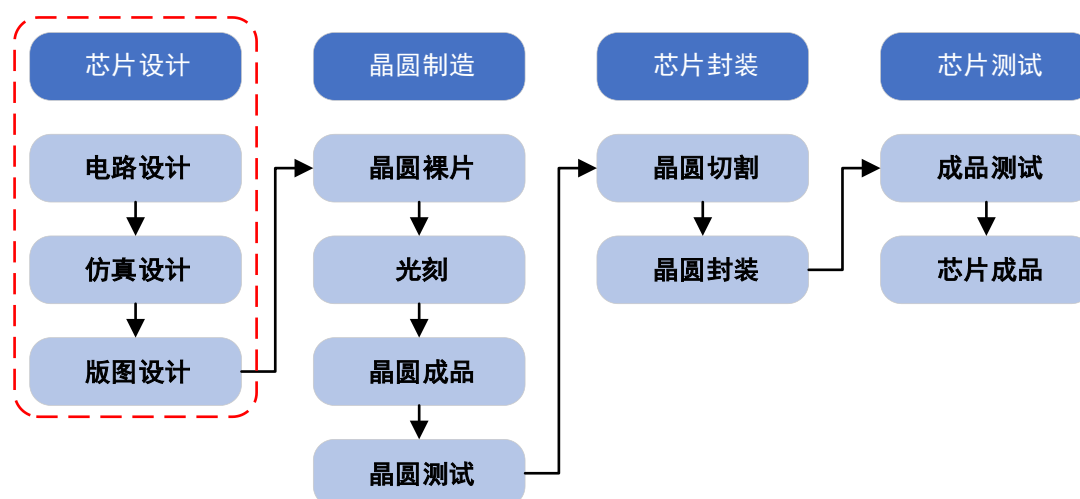
5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司的经营模式，是综合产业发展特点、产品核心特征、客户差异化需求、自身发展阶段及市场竞争格局等多重关键因素统筹确定的。报告期内，公

司经营模式运行稳定，且结合行业趋势与自身发展规划判断，可预见的未来，公司经营模式及影响该模式的核心关键因素均不会发生重大变化，为业务持续稳健发展提供坚实保障。

（五）主要产品的工艺流程图及核心技术在生产过程中的具体使用情况

报告期内，发行人负责芯片产品的设计，将晶圆制造、芯片封装和测试通过委外方式实现。主要产品的业务流程图如下所示：



注：红框内为公司主要涉及的流程环节

公司核心技术系在实际产品设计与研发过程中逐步积累、迭代形成，目前已成功实现产业化应用并转化为核心竞争力。报告期内，公司主要业务经营情况良好，核心技术广泛应用于公司主营业务中。

公司核心技术具体情况详见招股说明书本节“六、（二）核心技术在主营业务及产品中的应用和贡献情况”。

（六）报告期各期具有代表性的业务指标变动情况及原因

结合公司所处的集成电路行业和自身经营的特点，公司具有代表性的财务指标主要系营业收入、毛利率及研发投入占比，详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、（一）营业收入构成及变动分析”、“十、（三）毛利和毛利率变动分析”及“十、（四）期间费用分析之 3、研发费用”，以及本节“六、（四）研发项目情况”；具有代表性的非财务指标主要为产品销量、主要客户群体等，详见本节“三、发行人销售情况和主要客户”。

（七）公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略

报告期内，公司主要从事网络通信芯片与端侧智能芯片的研发、设计及销售，属于国家重点鼓励、支持和推动的关键产品或服务，与我国产业政策和国家经济发展战略高度契合，详见本节“二、（一）所属行业及确定所属行业的依据”。

公司相关产品的研发与推广，对提升网络入口安全防护能力、打破核心芯片技术瓶颈、保障半导体产业链安全稳定、推动核心芯片自主化进程、推进“人工智能+”进展具有重要意义，具备持续经营的核心基础与长远发展潜力。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司的主营业务为网络通信芯片和端侧智能芯片的设计研发与销售，属于集成电路设计行业，处于新一代信息技术领域。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”行业（代码：I6520）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“1.3.4 新型信息技术服务”对应的“集成电路设计”行业；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所处行业为“1.3.1 集成电路”，是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司属于“新一代信息技术领域——半导体和集成电路”的高新技术产业和战略性新兴产业。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、行业监管机制

中华人民共和国工业和信息化部是公司主要的行业主管部门，其主要职责为：拟定新型工业化发展战略、规划及政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级；拟定行业法律、法规，发布行政规章；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；监测分析工业、通信业运

行态势，进行预测预警和信息引导；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化等。

中国半导体行业协会是公司所属行业的行业自律组织，其主要职责为贯彻落实政府的相关政策和法规，协助政府制订标准、开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；汇集企业呼声，代表会员单位向政府部门提出产业发展意见和建议；开展经济、技术和学术交流活动，推动国际合作等。

中华人民共和国工业和信息化部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、主要法律法规及产业政策

2021 年以来，我国政府及各相关部门陆续出台了一系列扶持集成电路行业高质量发展的产业政策，并在对集成电路产业整体支持的框架下，聚焦发行人所处的网络通信芯片及端侧智能芯片两大细分领域，针对性出台专项支持，具体情况如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
1	2026 年	国务院、全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	提出适度超前建设新型基础设施。完善信息通信网络，深化千兆光网部署。实施电信普遍服务，提升边疆地区宽带网络覆盖水平。 提出全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关。瞄准世界科技前沿强化系统布局，实施人工智能等科技战略部署，加快突破基础理论和底层技术，促进转化应用。 全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术等产业，提升高端芯片等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。明确“人工智能+”消费提质。发展人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端，探索智能产品新形态
2	2025 年	国务院	《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	提出 2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，2030 年超 90%，2035 年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段
3	2025 年	工信部、国家发改委等 6 部门	《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》	明确推动人工智能在消费电子全领域全过程应用，提出到 2027 年形成 3 个万亿级消费领域和 10 个千亿级消费热点，其中消费电子、智能穿戴产品被列为重点方向
4	2025 年	工信部	《关于开展万兆光网试点工作的通知》	到 2025 年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
				快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用
5	2024 年	工信部	《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》	增强产业供给能力。……鼓励芯片、模组企业加快技术创新和产业化。基础电信企业要加强物联网平台建设，发挥海量数据优势，开展人工智能大模型创新应用，发展智能物联产品
6	2023 年	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	打通数字基础设施大动脉。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。…整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造
7	2023 年	发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	明确将“集成电路设计，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产）……，集成电路装备及关键零部件制造”等列为鼓励类发展的项目
8	2021 年	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。……培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天等产业创新发展
9	2021 年	工信部	《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》	支持多源、海量数据接入的智能感知技术攻关，推动低功耗、高安全、高速率的新型短距离通信技术发展，加强高可靠、广覆盖的北斗定位和高精度室内定位技术研发，突破 MEMS 传感器和物联网芯片的设计与制造，研发轻量级/分布式物联网操作系统。加快边缘计算、数字孪生、IPv6 等技术研发与应用
10	2021 年	工信部	《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》	用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和 5G 用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。千兆光网和 5G 的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链供应链现代化水平稳步提升。“双千兆”网络安全保障能力显著增强
11	2021 年	工信部	《“十四五”信息通信行业发展规划》	明确全面部署千兆光纤网络。持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器，按需开展用户侧接入设备升级

3、行业监管体制、行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响

国家高度重视以集成电路为代表的高端芯片产业的发展，将其纳入战略性

新兴产业重点支持领域，相继出台了一系列有力的政策措施，为行业提供了持续的政策保障和资金支持，营造了良好的营商环境，并指明了未来的发展方向。

（三）所处行业概况及发展态势

1、集成电路行业整体概况

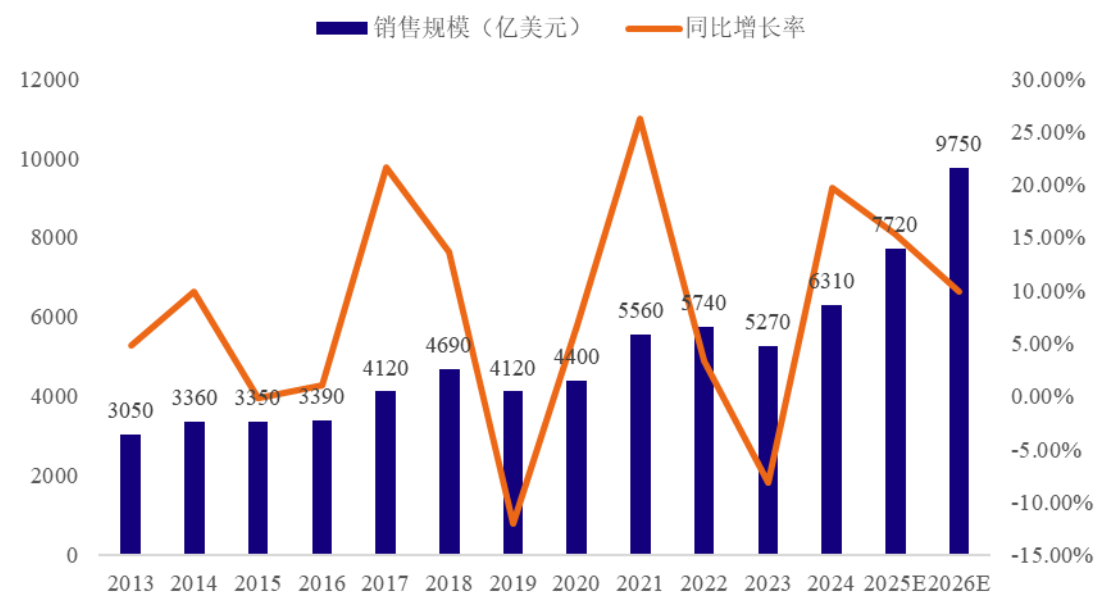
（1）全球集成电路行业发展概况

集成电路产业作为信息技术领域的核心载体，是支撑经济社会高质量发展、保障国家信息安全的战略性、基础性和先导性产业，发展水平直接关系到我国信息技术产业的自主独立能力和国家综合竞争力，受到国家产业政策的重点支持。

根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）的统计数据，2015 年至 2024 年，全球集成电路行业市场规模快速增长，由 3,350 亿美元增长至 6,310 亿美元，年均复合增长率为 7.29%。

近年来，全球宏观经济逐步复苏，伴随 5G 通讯、大数据、云计算、人工智能等方向带来的技术革新，集成电路产品应用领域不断拓宽、下游需求强劲。据 WSTS 预测，全球集成电路行业市场规模将持续增长，2024 年至 2026 年复合增长率为 24.30%。

全球集成电路行业市场规模情况



数据来源：WSTS，2025 年 8 月

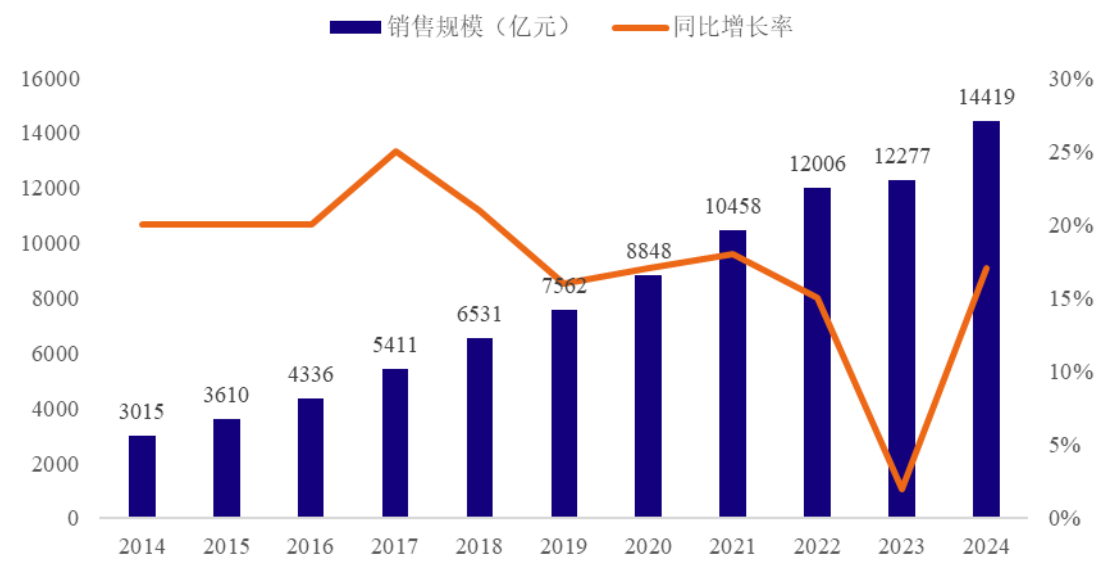
（2）中国集成电路行业发展概况

作为全球集成电路产业重要市场，中国凭借庞大的下游应用需求、完善的产业配套体系及持续的政策扶持，已成为全球集成电路产业发展的核心增长极。

近年来，国家层面持续出台产业支持政策，通过加大政策扶持力度、加强人才培养、完善产业生态等一系列举措，持续推动集成电路行业的技术进步与产业升级，我国集成电路产业呈现高速发展的趋势，市场规模显著增长，产业链自主独立能力持续提升。

据中国半导体行业协会统计，2014 年至 2024 年间，中国集成电路市场规模从 3,015 亿元迅速扩大至 14,419 亿元，年均复合增长率高达 16.94%，远高于全球集成电路市场规模增速，整体行业正处于蓬勃发展的阶段，预计将在未来继续保持快速增长的趋势。

中国集成电路行业市场规模情况（2014-2024 年）



数据来源：中国半导体行业协会，2025 年 4 月

(3) 集成电路行业产业链

集成电路产业链分为上游、中游与下游三大环节，各环节紧密关联。其中，中游芯片设计企业处于产业链核心地位，其技术研发实力、产品创新能力直接决定行业技术迭代方向与市场整体竞争力。目前，行业内芯片设计企业主要采用 IDM 模式与 Fabless 模式两种经营模式：IDM 模式覆盖芯片设计、制造、封测及销售全流程，实现全链条自主独立；Fabless 模式则专注于芯片设计与市场销售，将晶圆制造、封装测试等重资产环节委托外部专业厂商完成，聚焦核心技术研发。

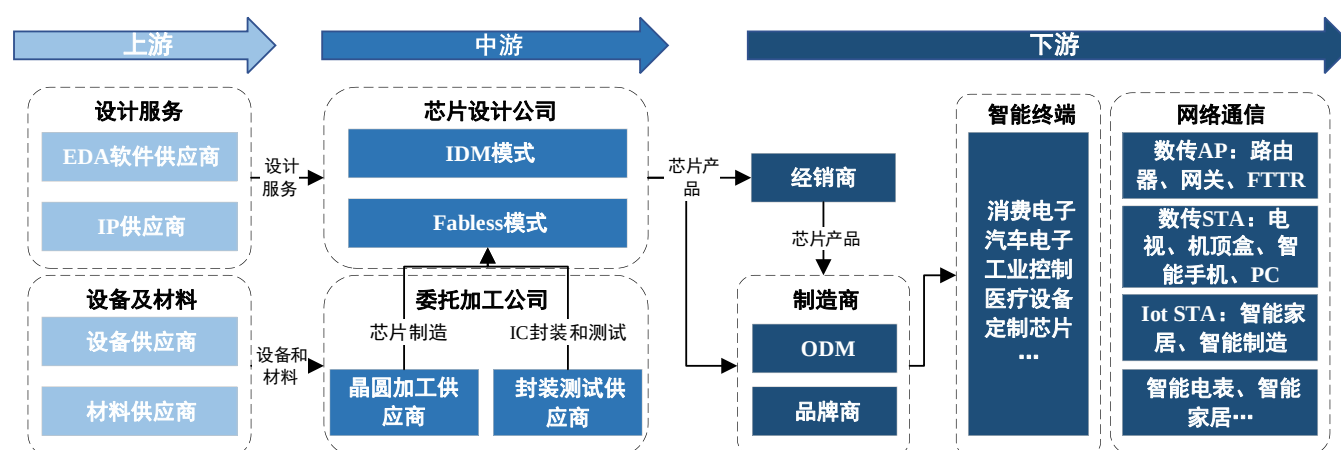
具体而言，集成电路行业产业链上游提供核心支撑资源，是产业有序运转的基础：EDA 软件与 IP 模块作为芯片设计环节的核心工具，为芯片设计的高效推进、性能优化提供关键技术支撑；生产设备与专用材料则保障晶圆制造、封装测试等环节的顺利推进，筑牢产业链稳定运行的根基。

中游除芯片设计外，还包括晶圆制造与封装测试两大关键配套环节。其中，晶圆制造多由代工厂承接，核心职责是将芯片设计方案转化为物理晶圆，其工艺水平直接影响芯片性能与良品率；封测厂商则通过 IC 封装、器件组装及性能测试，确保芯片性能符合设计标准、运行稳定可靠，为芯片进入下游应用市场提供品质保障。

下游聚焦市场化落地，是拉动产业需求增长的核心动力。经销商负责芯片

流通，实现芯片从生产端向应用端的高效传导；ODM 厂商负责将芯片集成至各类终端产品，完成产品组装、调试与优化后交付品牌商，推动芯片技术转化为终端产品竞争力；终端应用领域则根据芯片的用途来分类，公司目前专注智能终端与网络通信领域，广泛覆盖路由器、网关、FTTR、智能消费电子、汽车电子、工业控制等潜力巨大的多元需求场景，为集成电路芯片设计行业持续健康发展提供稳定的需求支撑。

集成电路芯片设计行业产业链



2、发行人主要产品及应用领域发展态势

发行人设立以来，专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发和销售，致力于短距通信与端侧智能的深度融合，形成了“连接中枢+端侧入口”双轮驱动的业务方向，产品主要应用于网络通信与端侧智能两大领域。其中网络通信芯片包括 Wi-Fi 芯片和 PLC 芯片；端侧智能芯片包括智能音频主控芯片和智能视觉处理芯片。发行人重点芯片产品及其应用领域发展态势如下：

（1）Wi-Fi 芯片发展态势

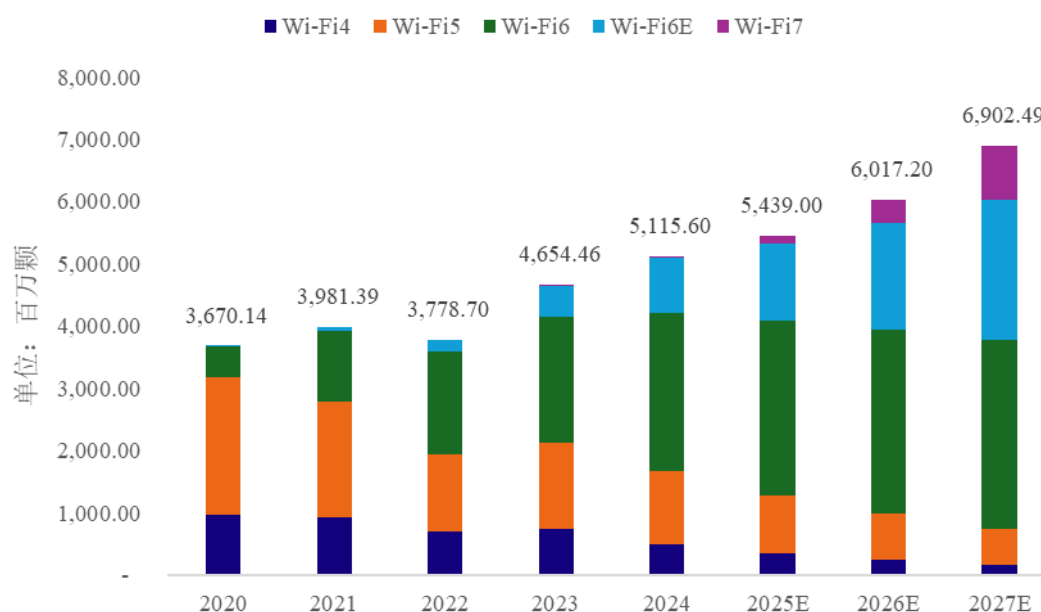
Wi-Fi 芯片是实现无线局域网通信的核心芯片，内置无线局域网通信协议和相关功能模块，通过无线信号处理、Wi-Fi 协议支持和网络连接管理，实现设备之间的无线数据传输。作为支撑万物互联的核心元器件，Wi-Fi 芯片行业的发展呈现“巨头引领”和“长尾效应”两大核心特征。

在巨头引领行业发展方面，以博通、高通为代表的头部企业，凭借数十年的技术沉淀与巨额研发投入，掌控着行业的话语权。此类企业持续加大核心技

术研发投入，不仅在芯片的基础性能上不断突破，更通过前瞻性技术布局，主导 Wi-Fi 协议的制定与升级。通过“自研技术标准”与“产品同步落地”的模式，境外巨头占据 Wi-Fi 高端市场主导地位，持续构筑技术门槛与行业壁垒。

“长尾效应”则为行业稳定发展提供重要支撑，Wi-Fi 芯片的产品生命周期普遍较长。以 2014 年商用的 Wi-Fi 5 芯片为例，尽管 Wi-Fi 6 系列已在中高端手机、企业级路由器中广泛应用，但在部分数量庞大、分布分散的长尾市场中，Wi-Fi 4 芯片、Wi-Fi 5 芯片仍占据一定地位，诸如智能家居这类的物联网设备的核心需求是低功耗、低成本和稳定性，对速率要求不高，较低价格、较低版本 Wi-Fi 协议的产品已足够满足这类应用场景的需求。同时，工业设备 5-10 年的更新周期，亦使得旧芯片无需快速迭代，这种“新协议主攻高端市场、旧协议深耕长尾领域”的错层供给模式，既避免了资源浪费，又保障行业整体营收的稳定性。

全球 Wi-Fi 芯片出货量，按不同协议区分，2020 年至 2027 年（预测）



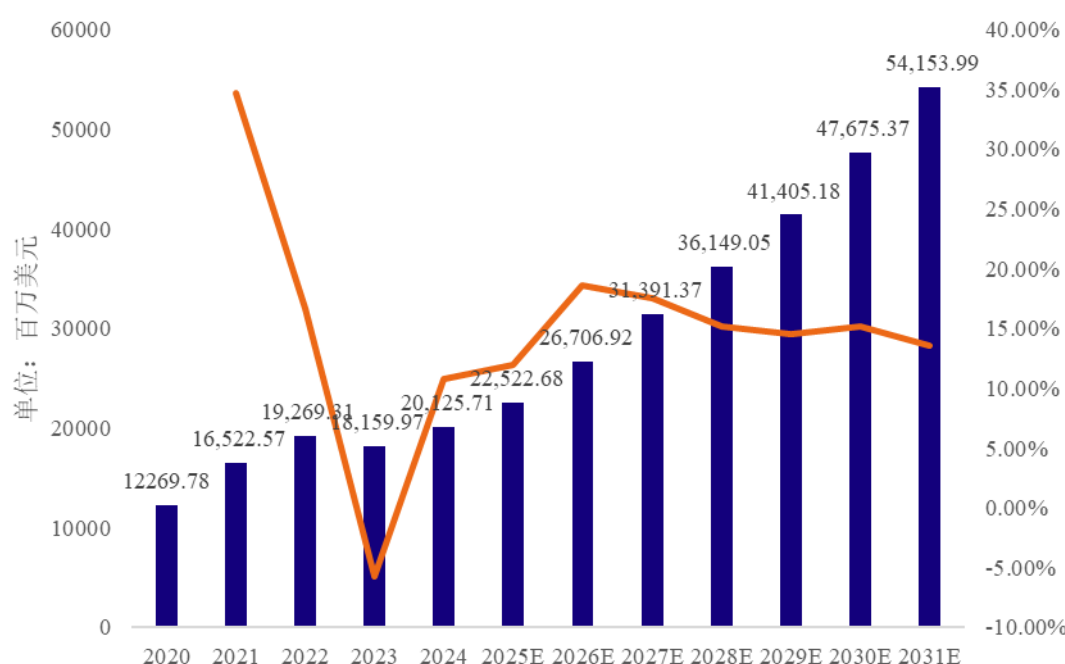
数据来源：IDC，集微咨询，2025

在人工智能技术深度渗透与全球智能终端设备持续增长的双重驱动下，全球 Wi-Fi 芯片市场需求稳步攀升，并向更高传输速率、更大网络带宽的方向加速演进。一方面，AI 技术的规模化落地，催生了大量高带宽、低时延、低功耗的网络应用场景。从路由器、智能网关、智能家居控制系统等消费级产品，到智能传感器、AIoT 网关等工业级设备，终端对数据传输能力的要求显著提升，

直接推动了 Wi-Fi 芯片性能指标的持续升级。另一方面，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等传统终端加速更新迭代，同时智能汽车、智慧医疗设备等新兴终端品类不断涌现，进一步拓宽了 Wi-Fi 芯片的应用边界，也对网络速率和带宽容量提出了更高要求。

受上述需求驱动，Wi-Fi 芯片技术正加快向更高代际演进。为满足日益增长的高速率、大带宽传输需求，Wi-Fi 协议标准持续迭代，推动芯片产品从 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 向 Wi-Fi 6/6E 及 Wi-Fi 7 等更高协议技术升级。据 QY Research 预测，2025 年全球 Wi-Fi 芯片市场规模约为 225 亿美元，至 2031 年有望增长至 541 亿美元，期间复合年增长率达 15.74%。未来，随着 AI 应用场景进一步拓展及智能终端连接密度持续提升，具备更高吞吐能力与更低时延性能的下一代 Wi-Fi 芯片将成为市场主流，驱动行业持续增长。

全球 Wi-Fi 芯片市场销售额，2020 年至 2031 年（预测）



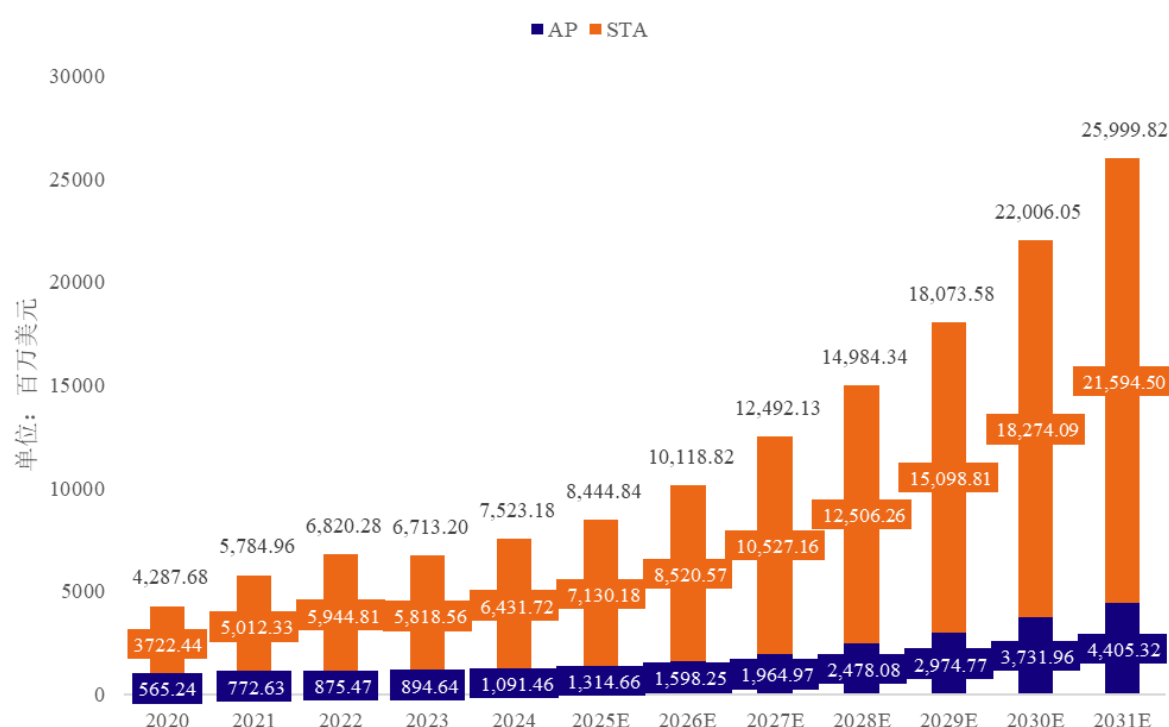
数据来源：QYResearch，2025 年

中国作为全球电子消费品生产与消费第一大国，Wi-Fi 芯片市场增长动力尤为强劲，增速领先全球平均水平，核心驱动因素体现在三方面：首先，国内 AI 技术与实体经济的融合持续深化，数字经济规模稳步壮大，进一步提升了对网络通信的品质与容量需求，尤其是 FTTR 技术的加速落地推广，极大带动家庭及企业路由器及网关设备部署需求，推动 AP 芯片需求量快速增长；其次，中

国拥有庞大的终端设备制造产业集群，智能终端设备产品出货量稳居全球前列，为 Wi-Fi 芯片提供了广阔的本土市场；最后，国家产业政策持续加码支持新一代信息技术产业发展，为行业发展提供良好的政策环境。

据 QYResearch 预测，2025 年中国 Wi-Fi 芯片市场规模达到 84.45 亿美元，2031 年将达到 260 亿美元，年均复合增长率 20.61%，其中 AP 芯片市场的增速高于平均值。

中国 Wi-Fi 芯片市场销售额，按产品类型，2020 年至 2031 年（预测）



数据来源：QYResearch，2025

（2）智能音频主控芯片发展态势

智能音频主控芯片集成了完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件，需在芯片设计阶段同步开发相应应用方案，以实现复杂硬件电路与软件系统的高效融合。该类型芯片承担无线通信、AI 音频处理、系统控制及功耗管理等关键任务，是智能可穿戴设备、各类智能物联网终端实现无线音频交互功能的核心器件。

智能可穿戴设备是指将传感、识别、通信、多媒体及音频等技术与穿戴产品深度融合，以实现个人娱乐、社交互动、健康监测等功能的智能硬件产品，

主要包括 TWS 智能无线耳机、VR/AR 智能眼镜、智能手表及智能手环等品类。据 Market.us 及 Global news wire 研究数据，2023 年全球智能可穿戴设备市场规模约为 110 亿美元，预计至 2028 年将达到 220 亿美元，2023 年至 2028 年间复合增长率 14.87%，市场规模持续保持较快增长。

1) 智能耳机

随着通信技术的发展和芯片制程工艺的提升，耳机正在从单一音频输出设备演变为集成计算、传感与 AI 算法的可穿戴智能设备，已成为智能终端设备生态中不可或缺的核心组成部分，是智能音频主控芯片重要的应用领域之一。

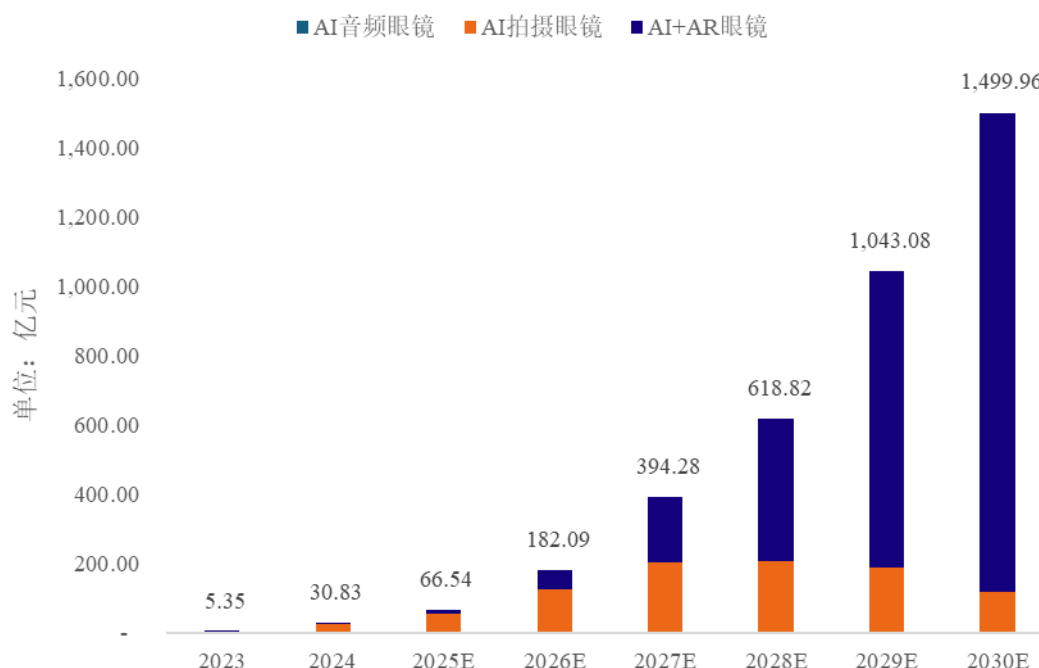
从我国来看，根据 IDC 统计，2025 年中国智能耳机市场出货量约 12,137 万台，同比增长 6.9%。其中，TWS 耳机凭借成熟的技术生态与用户习惯沉淀，仍长期占据市场主导地位，出货量 7,721 万台，同比增长 6.7%；而 OWS 耳机依托无入耳压迫感、兼顾环境音等差异化优势，正逐渐打破市场格局，有望成为下一阶段的增长核心，出货量 2,996 万台，同比增长 20.2%，开放式耳机已从快速爆发阶段逐步转向稳健增长阶段。

2) 智能眼镜

近年来，在人工智能、微型传感、AR、通信等技术快速迭代的带动下，智能眼镜作为新兴智能穿戴设备应运而生。在传统眼镜功能基础上，融合机器学习算法、传感技术、显示技术等多种先进技术，智能眼镜可实现语音识别、图像分析、健康检测、导航指引、实时翻译、游戏互动等多种人机交互功能，大幅提升了信息获取的便捷性与即时性。

据弗若斯特沙利文统计及预测，2026 年全球智能眼镜市场销量将突破 1,000 万副，市场规模将达到 182.09 亿元，2030 年全球市场规模将接近 1,500 亿元，年度复合增长可达 69.41%，展示出爆发式增长潜力。

全球智能眼镜市场规模，按产品类型区分，2023 年至 2030 年（预测）



数据来源：弗若斯特沙利文，2025 年 7 月

中国智能眼镜市场亦同步保持快速发展态势，据 IDC 的数据，2025 年中国智能眼镜出货量已达到 246 万台。从发展趋势来看，未来多模型接入能力将成为智能眼镜市场核心竞争焦点，该能力可助力智能眼镜在不同应用场景中调用最适宜的 AI 解决方案；同时，智能眼镜在 AI 大模型适配与软件协同方面将进入更深层次的探索与优化，推动产品体验持续提升。

3) 其它智能物联网终端

当前，全球新一轮科技革命与产业变革正加速演进，人工智能技术正加速向经济社会各领域深度渗透，推动生产方式、生活方式及社会治理方式实现智能化升级，并成为引领未来经济增长与产业发展的核心驱动力。AIoT（人工智能物联网）作为人工智能技术与 IoT 物联网技术融合的产物，通过感知层采集多维度海量数据，依托传输层实现终端与边缘端及云端的数据互联，再经由平台层与应用层开展大数据分析，最终构建起万物互联、万物智联的智能生态系统。

在万物智联应用场景下，各类智能终端之间依托智能语音交互实现互联互通，形成数据交互与共享的全新生态体系。随着消费者语音交互使用习惯逐步普及，终端设备智能化升级进程持续加快。目前，照明设备、智能门锁、空调、冰箱、车载支架等物联网终端产品加速实现语音化升级，市场对终端设备

具备智能语音交互能力的需求日益提升。

智能音频主控芯片作为智能终端设备实现无线音频交互功能的核心器件，在智能物联网终端快速发展、智能化程度持续提升的背景下，市场需求将随之稳步增长。

（3）其它芯片产品发展态势

1）PLC 芯片

PLC 芯片系专门针对现有电力线路数据传输场景设计，集成调制解调、信号放大等功能模块，可实现数据与电力信号共线双向传输。主流 PLC 芯片行业最显著的特点是深度依托电网系统发展，其技术迭代节奏与产品生命周期完全由电网的需求特性主导。

近年，全球电力基础设施现代化进程持续提速，叠加行业数字化转型不断深化，为 PLC 芯片市场创造了良好的发展契机，市场呈现出稳定向好的发展态势。据 Future Market Report 的数据，全球 PLC 市场在 2024 年的市场规模为 14.75 亿美元。

2）智能视觉处理芯片

目前，发行人共两款智能视觉处理芯片，其中一款主要应用于以智能门锁为代表的智能家居领域，是智能家居设备实现智能化视觉交互能力的重要硬件基础。另一款定制芯片主要应用于智能视频显示领域。

从行业发展来看，智能家居行业已从单一智能产品阶段向全屋智能互联生态持续演进。智能门锁作为全屋智能的核心物理入口级产品，承担着连接家居应用场景与用户需求的重要枢纽功能，其市场发展与端侧智能芯片的技术迭代深度绑定。从产品分类来看，智能门锁依据解锁方式可划分为指纹锁、密码锁、感应锁、遥控锁及人脸识别锁等主流类型。其中，基于智能视觉处理芯片实现的 3D 人脸识别解锁方式，凭借其精准识别、响应迅速及安全性突出等核心技术优势，已成为推动智能门锁产品智能化升级与高端化转型的关键技术路径。

据弗若斯特沙利文的预测，2025 年中国人脸识别智能门锁出货量约为

1,130 万套，预计至 2029 年将增长至 2,600 万套，期间复合增长率 23.16%。在智能门锁市场持续扩张及视觉处理技术不断迭代的背景下，具备更强视觉 AI 算力、更高能效及更优成本优势的下一代智能视觉处理芯片将成为市场主流，持续驱动行业发展。

3、进入本行业主要壁垒

芯片设计行业属于技术、资本、人才密集型产业，同时受客户合作模式、行业认证体系等特殊因素影响，共同构筑了较高的行业壁垒。

（1）技术壁垒

芯片设计是典型的技术密集型产业，其中网络通信与端侧智能芯片的研发、设计工作尤为复杂，属于高度系统的工程难题。该类芯片的开发不仅需完成核心硬件架构的系统性规划、搭建与迭代优化，还需持续积累 IP 资源、迭代各类关键算法，并实现多环节技术的协同突破，技术门槛极高。

以 Wi-Fi AP 芯片领域为例，国内相关企业整体仍处于市场开拓的起步阶段。受限于核心技术积累不足、产业链上下游协同机制尚不完善等因素，芯片研发周期普遍较长，技术突破难度较大。因此，在短期内该类芯片全链路技术的突破，仍面临较高的技术壁垒，对行业新进入者形成了显著的进入障碍。

（2）人才壁垒

网络通信芯片与端侧智能芯片研发、设计工作，对专业人员的综合素质、技术能力及行业经验等提出了极高要求。尤其在高带宽低时延通信技术研发、端侧多模态 AI 算法创新突破、超低功耗数模混合芯片设计，以及全流程软硬件协同开发等核心方向，亟需汇聚一批具备多学科知识背景深度交融、对行业发展规律具备深刻洞察，且拥有丰富实践经验的高端复合型专业人才。而这类高端人才的引进、培养与储备，往往需要企业投入高昂成本，行业人才供给与市场需求存在一定缺口，由此构筑起行业内较高的人才壁垒，成为制约行业新进入者快速发展的核心因素之一。

（3）客户资源壁垒

公司下游终端客户广泛覆盖品牌商、通信运营商及国家电网等大型知名企

业，凭借长期稳定的产品品质、高效的技术服务及深度的协同合作，构建了极具优势的客户资源壁垒。其中，通信类芯片产品需历经漫长且严苛的行业认证流程，认证标准高、周期长，而完成认证并实现批量应用后，客户基于产品稳定性、兼容性、供应链安全性及替换成本等多方面考量，将形成长期稳定的合作偏好，进而产生极强的客户锁定效应。智能终端类产品则需客户深度参与芯片研发设计全流程，客户在研发阶段即投入大量人力、物力、财力资源，与公司形成深度绑定的技术协同与业务合作关系。尽管公司优质客户导入周期较长，但合作黏性极高、稳定性极强，为公司构建了坚实的客户资源壁垒，有效抵御了市场竞争带来的客户流失风险，进一步巩固了公司的市场竞争优势。

（4）资金和规模壁垒

芯片设计具备典型的资本密集型产业特征，对企业的资金实力及业务规模有着极高要求。其中，网络通信芯片研发周期漫长、技术迭代难度大、研发投入持续性强；端侧智能芯片则对产品迭代速度、先进制程工艺有着更为严苛要求，二者均需企业前期投入巨额资金，用于核心技术攻关、高端人才储备、芯片流片测试、研发平台搭建及市场拓展等关键环节。同时，芯片研发及产业化过程中普遍存在投资回报周期长、受市场需求变化、技术迭代等因素导致的高风险特征。因此，芯片设计企业必须具备充足的资金实力和相应的业务规模，唯有依托规模效应有效摊薄研发与运营成本、提升综合盈利水平及抗风险能力，才能在激烈的市场竞争中赢得稳定的生存空间与持续发展的可能，这也对行业新进入者形成了较高的资金和规模壁垒。

4、行业面临的机遇

（1）政策大力支持集成电路行业发展

集成电路行业是现代信息化社会的基础行业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，对国家安全和国民经济健康发展有着重要的战略意义。因此，国家在政策层面大力支持集成电路行业发展，围绕产业链自主独立、安全可控的核心目标，相继出台了一系列有力的政策措施，为行业发展提供了持续的政策保障和资金支持。

国家高度重视端侧智能芯片和网络通信芯片等高端芯片产业发展，将其纳

入战略性新兴产业重点支持领域。2025 年 2 月 20 日，国务院常务会议明确提出“大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力”，标志着 AI 终端产业从“技术培育”转向“市场激活”的战略转折。2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确提出“支持突破端侧推理芯片、高速互联等关键核心技术”，直接指向端侧智能与 Wi-Fi 通信两大方向。

（2）人工智能技术发展为芯片产业带来双重机遇

人工智能技术的快速发展，正深刻重塑全球芯片产业格局。其一，人工智能与新一代通信技术的深度协同，推动 Wi-Fi 芯片从“被动传输”向“智能调度”升级，使其不再局限于数据的“搬运工”角色，而是具备实时感知射频环境、精准预测流量变化及动态调度信道资源的能力。该等“内生智能”特性显著提升了频谱利用效率与网络稳定性，推动通信芯片从单一功能载体向智能通信融合载体演进，为智慧互联、全域组网等新型应用场景提供底层技术支撑。其二，随着生成式人工智能向终端侧下沉，端侧 AI 应用呈现爆发式增长，进而催生多模态智能芯片新赛道。智能耳机、智能眼镜等终端设备需在本地完成语音、图像、传感器等多模态数据的处理，集成 NPU 加速能力与异构计算架构的端侧智能芯片，能够在极低功耗条件下实现本地推理与多模态融合分析，有效降低对云端算力的依赖，同时解决传输延迟与数据隐私保护等刚性约束。该趋势正为芯片设计企业拓展新的市场空间，推动芯片行业向高端化、智能化方向持续升级。

在此背景下，具备通信技术与人工智能计算协同设计能力的芯片企业，将有望在下一轮产业竞争中形成持续竞争优势。

（3）RISC-V 开源生态带来跨越发展的新机遇

RISC-V 作为一种开源、免费且灵活可扩展的指令集架构，打破了长期以来由 ARM 和 x86 主导的封闭授权格局，为中国半导体产业提供了一个独立、自由的技术起点。该架构为我国半导体设计行业突破传统技术壁垒、实现自主创新开辟了全新路径，也为实现从底层架构到系统应用的全链条自主化提供了可行方案。

在技术突破方面，国内企业已在 RISC-V 处理器研发领域取得显著成效，并积极参与生态建设，持续推动相关技术的商业化应用落地。在应用场景方面，RISC-V 架构已在汽车电子、电池管理、智能终端、智能穿戴等多个关键领域实现突破性应用。这不仅彰显了其技术潜力，也为国内半导体设计公司拓展了新的市场空间。RISC-V 开源生态的崛起，为我国半导体设计公司提供了难得的跨越发展新机遇。

5、行业面临的挑战

（1）与行业领先技术仍存在差距

尽管我国半导体企业在先进工艺制造、半导体设备、高端芯片设计等领域已取得阶段性突破，但与国际领先水平相比仍存在明显差距。一方面，我国集成电路企业整体资金实力相对薄弱、核心技术研发投入不足，在先进技术研发与产品创新方面与发达国家头部企业存在较大差距，在全球市场竞争中处于弱势地位；另一方面，我国集成电路产业链有待进一步完善，在芯片制造、高端封测、半导体材料、EDA 工具等关键配套领域还存在明显短板，同时高端芯片设计领域也有较大提升空间，上述因素共同制约我国半导体行业高质量发展。

（2）产业高端人才较为缺乏

伴随集成电路设计行业高速发展，行业对专业型、创新型人才的需求呈爆发式增长。作为典型的技术、人才密集型行业，集成电路设计领域的人才培养具有周期长、供给滞后于市场需求的突出特点。我国虽已通过政策倾斜、教育改革、校企合作等多项举措，加速高精尖人才培育进程，但受行业起步晚、人才培养体系尚不完善等因素制约，与欧美、日韩等先发国家相比，我国集成电路设计领域高端技术人才仍存在显著缺口。目前，随着行业内企业普遍意识到人才核心价值并加大人才布局力度，高端人才短缺现象有望逐步缓解，但短期内仍将对行业发展形成一定制约。

（3）高研发投入的压力

半导体设计行业的高研发投入压力具有多维度、全方位特征。从先进制程研发、核心技术攻关到芯片流片验证，从 EDA 工具采购、研发平台搭建到市场拓展、人才储备，每个环节均需巨额持续资金投入。同时，行业还面临 EDA 工

具对外依赖度较高、市场竞争日趋激烈、地缘政治风险不确定等多重挑战，进一步增加了研发投入的不确定性与压力。对于行业内的企业而言，如何在高研发投入与商业回报之间实现平衡，如何在技术突破与风险控制之间做出科学抉择，持续提升研发投入转化效率，是未来发展面临的一项严峻挑战。

6、行业周期性特征

公司自主研发的网络通信芯片与端侧智能芯片，系网络通信产品与智能终端设备的核心硬件支撑，其市场需求直接受半导体终端市场的波动的影响。公司产品下游应用场景广泛，具体涵盖智能耳机、智能眼镜、智能家居等多元智能终端领域，以及路由器、网关等关键网络连接设备领域，前述应用领域的发展态势与宏观经济走势、国民经济周期及产业景气度高度关联，并通过产业链传导至上游芯片市场，导致公司产品需求呈现一定的周期性特征。

除上述因素外，公司产品的研发进程、技术突破及市场拓展效果，还受到国家产业政策导向、国际地缘政治格局变化、行业技术迭代革新速度及市场竞争格局调整等多重外部因素的综合影响，前述因素的不确定性可能进一步加剧公司经营发展的周期性波动风险。

（四）行业竞争格局及行业内主要企业

1、行业内主要企业情况

公司聚焦网络通信芯片、端侧智能芯片两大核心产品线，并基于现有产品及核心技术积累，进一步拓展定制芯片服务。在市场竞争格局中，高通、博通、联发科及瑞昱等境内外知名集成电路设计企业，与发行人上述两条产品线均形成竞争关系。此外，发行人亦面临部分在各细分领域具备优势、专注于特定场景布局的芯片设计公司的竞争；在定制芯片服务这一延伸领域，亦存在一批以定制化解决方案见长的专业竞争对手。

（1）产品同时覆盖网络通信芯片与端侧智能芯片的主要企业

1）高通（Qualcomm）

高通于 1991 年在纳斯达克证券交易所上市（股票代码：QCOM），2025 财年营业收入 442.84 亿美元，归属于上市公司股东净利润 55.41 亿美元。

高通作为全球无线行业基础技术的开发和商业化的领先企业，业务布局涵盖 3G、4G 和 5G 无线连接、高性能和低功耗通用计算芯片以及人工智能设备等领域。其产品矩阵丰富，包括智能手机 SoC 芯片、车载计算平台、物联网连接模块、5G 基带芯片、AI 与边缘计算平台，广泛应用于智能手机、智能汽车、XR 设备（VR/AR）、智能家居、可穿戴设备、工业物联网及 AIPC 等智能终端领域。

2）博通（Broadcom）

博通于 1998 年在纳斯达克证券交易所上市（股票代码：AVGO），2025 财年营业收入 638.87 亿美元，归属于上市公司股东净利润 231.26 亿美元。

博通主营业务包括半导体及基础设施软件解决方案两大领域。其中，半导体业务产品组合涵盖数据中心网络（含 AI 网络与连接技术）、无线通信、服务器存储、宽带、工业产品等；基础设施软件业务聚焦于为企业提供全栈式软件产品，包括大型机、分布式及网络安全软件、服务器存储连接、宽带及无线业务等。

3）联发科（MediaTek）

联发科于 2001 年在中国台湾证券交易所上市（股票代码：2454.TW），2025 年度营业收入 5,959.66 亿台币，归属于上市公司股东净利润 1,053.19 亿台币。

联发科专注于无线通讯及数字多媒体等核心领域，产品包括移动计算设备芯片、无线通信及宽带网络芯片、数字电视芯片、定制化芯片、车用芯片及模拟芯片等。主要终端应用场景包括手机、平板电脑、数字电视、智能家电、可穿戴设备与物联网产品。

4）瑞昱（Realtek）

瑞昱半导体于 1998 年在中国台湾证券交易所上市（股票代码：2379.TW），2025 年度营业收入 1,227.06 亿台币，归属于上市公司股东净利润 147.53 亿台币。

瑞昱半导体主营业务为研究、开发、生产及销售各类型应用集成电路，并

提供各类集成电路产品的软件和硬件应用设计、测试、维护以及技术咨询服务。主要产品包括通信网络及互联媒体芯片、计算机外设及智能互联芯片、多媒体芯片，其产品覆盖通信网络、电脑周边、智能家居、消费电子、汽车、多媒体等应用领域。

（2）聚焦于网络通信芯片领域的主要企业

1）博通集成

博通集成于 2019 年 4 月在上海证券交易所主板上市（股票代码：603068.SH），2025 年度营业收入 9.18 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.22 亿元。

博通集成主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，产品应用类别主要包括 Wi-Fi、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。上述产品主要应用在智能家居、可穿戴设备、蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、汽车电子等领域。博通集成的 Wi-Fi MCU 产品属 Iot Wi-Fi 芯片，主要应用于智能门锁等场景。

2）翱捷科技

翱捷科技于 2022 年 1 月在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688220.SH），2025 年度营业收入 38.17 亿元，归属于上市公司股东净利润-3.90 亿元。

翱捷科技主营业务为芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体 IP 授权，以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。产品应用类别主要包括全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片。翱捷科技的 Wi-Fi 芯片产品属于 Iot Wi-Fi 芯片，主要应用于智能支付、智慧安防等领域。

（3）聚焦于端侧智能芯片领域的主要企业

1）恒玄科技

恒玄科技于 2020 年 12 月在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688608.SH），2025 年度营业收入 35.25 亿元，归属于上市公司股东净利润 5.94

亿元。

恒玄科技主营业务为智能音视频 SoC 芯片的研发、设计与销售，为客户提供 AIoT 场景下低功耗无线边缘智能主控平台芯片，主要产品包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片和智能家居芯片。

2) 中科蓝讯

中科蓝讯于 2022 年 7 月在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688332.SH），2025 年度营业收入 18.41 亿元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润为 2.33 亿元。

中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片、Wi-Fi 芯片、视频芯片。

（4）聚焦芯片定制服务的主要企业

1) 国芯科技

国芯科技于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688262.SH），2025 年度营业收入 5.32 亿元，归属于上市公司股东净利润-2.54 亿元。

国芯科技主营业务为 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品。公司的主要产品应用于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算三大关键领域。

2) 芯原股份

芯原股份于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688521.SH），2025 年度营业收入 31.52 亿元，归属于上市公司股东净利润-5.28 亿元。

芯原股份的主营业务为依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务。公司的芯片定制和 IP 授权服务主要面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网。

2、发行人与同行业公司比较情况

（1）经营情况对比

最新财年，发行人与可比公司财务数据对比如下：

公司	财年截止日	单位	营业收入	净利润	总资产	净资产
覆盖两类产品企业						
高通	2025/9/30	亿美元	442.84	55.41	501.43	212.06
博通	2025/10/30	亿美元	638.87	231.26	1,710.92	812.92
联发科	2025/12/31	亿台币	5,959.66	1,053.19	7,437.85	4,091.95
瑞昱	2025/12/31	亿台币	1,227.06	147.53	1,299.03	522.02
聚焦网络通信芯片企业						
博通集成	2025/12/31	亿人民币	9.18	0.22	19.61	16.96
翱捷科技	2025/12/31	亿人民币	38.17	-3.90	69.80	54.58
聚焦端侧智能芯片企业						
恒玄科技	2025/12/31	亿人民币	35.25	5.94	75.18	70.53
中科蓝讯	2025/12/31	亿人民币	18.41	14.15	57.22	52.85
聚焦芯片定制服务的企业						
国芯科技	2025/12/31	亿人民币	5.32	-2.54	32.53	19.51
芯原股份	2025/12/31	亿人民币	31.52	-5.28	77.18	34.18
发行人	2025/12/31	亿人民币	5.65	-2.13	7.66	4.77
其中：网络通信芯片	2025/12/31	亿人民币	1.09	-	-	-
端侧智能芯片	2025/12/31	亿人民币	4.55	-	-	-

注 1：数据来源为各公司招股说明书、年度报告；

注 2：净利润选用归母净利润，净资产选用归母净资产。

（2）研发能力对比

最新财年，中国大陆可比公司与国际厂商的研发投入、研发人员数量以及发明专利储备等方面存在较大差距。与中国大陆可比公司比较，发行人研发费用占营业收入的比例处于较高水平。

公司	财年截止日	单位	研发费用	研发费用占营业收入比例	研发人员数量（人）	研发人员数量占比	发明专利（项）
覆盖两类产品：							
高通	2025/9/30	亿美元	90.42	20.42%	未披露	未披露	未披露
博通	2025/10/30	亿美元	109.77	17.18%	18,810	57.00%	约 19,000

联发科	2025/12/31	亿台币	1,483.06	24.89%	未披露	未披露	未披露
瑞昱	2025/12/31	亿台币	351.25	28.63%	未披露	未披露	未披露
网络通信芯片：							
博通集成	2025/12/31	亿人民币	2.45	26.64%	239	84.45%	167
翱捷科技	2025/12/31	亿人民币	12.99	34.03%	1,157	90.18%	188
端侧智能芯片：							
恒玄科技	2025/12/31	亿人民币	6.91	19.59%	645	86.69%	287
中科蓝讯	2025/12/31	亿人民币	1.69	9.19%	281	81.69%	88
定制服务：							
国芯科技	2025/12/31	亿人民币	3.36	63.23%	293	66.59%	176
芯原股份	2025/12/31	亿人民币	13.13	41.64%	1,839	89.40%	240
发行人	2025/12/31	亿人民币	2.35	41.55%	229	69.60%	109

注：中国大陆公司列举的为在中国大陆获得的发明专利项数，不包括全球专利。

（3）技术实力与关键指标对比

发行人重要产品 Wi-Fi 6 系列芯片及智能音频主控芯片，核心指标与可比公司对比情况如下：

1）Wi-Fi 6 AP 芯片（AX3000 规格参数条件下）

项目		发行人	高通	联发科
型号		WQ9301	IPQ5018+QCN6102	MT7916A+MT7976D
2G 频段 802.11b 协议 1Mbps 速率条件下 ^{注1}	发射功率/dBm ^{注2}	25.5	26.2	23.8
	EVM/dB ^{注2}	-16.8	-17.4	-15.6
	灵敏度/dBm ^{注2}	-102	-100	-99
2G 频段 802.11ax 协议 40MHz 带宽 MCS11 调制条件下 ^{注1}	发射功率/dBm	20.4	20.3	17
	EVM/dB	-39.6	-40.7	-43.8
	灵敏度/dBm	-65	-63.5	-63
5G 频段 802.11g 协议 6Mbps 速率 ^{注1}	发射功率/dBm	25.2	25.3	20.9
	EVM/dB	-21.7	-13.6	-22.2
	灵敏度/dBm	-96	-97	-94.5
5G 频段 802.11ax 协议 160MHz 带宽 MCS11 调制条件下 ^{注1}	发射功率/dBm	21	18.9	13.7
	EVM/dB	-38	-38.8	-39
	灵敏度/dBm	-57.6	-58.5	-56

集成功率放大器	支持	支持	支持
外部 FEM ^{注3}	支持	支持	支持
芯片集成度 ^{注4}	单芯片（集成数字+模拟）	数字芯片（2.4G）+模拟芯片（5G）	数字芯片+模拟芯片（2.4G+5G）

注 1：Wi-Fi 6 有 2.4GHz 和 5GHz 两个频段，简称 2G 频段和 5G 频段；802.11b 1Mbps、802.11g 6Mbps 和 802.11ax MCS11 为不同调制下的 Wi-Fi 速率，上表选择最低的速率（2G 频段的 802.11b 1Mbps 和 5G 频段的 802.11g 6Mbps）和最高的速率（基于 1024-QAM 调制，2G 频段的 802.11ax 40MHz MCS11 和 5G 频段的 160MHz MCS11）；

注 2：发射功率即满足频谱模板和 EVM 的最大功率，其数值越大性能越好；EVM 值是衡量数字调制信号质量的一个重要指标，越低性能越好；灵敏度值越低性能越好；

注 3：可同时支持片上集成功率放大器以及外部 FEM 两种方案，具有成本及性能灵活性；

注 4：集成度越高越好，发行人单芯片方案相较于多芯片集成具有降低生产成本、更高的内部通信效率、更好的功耗优化以及更小的空间尺寸等显著优势。

2) 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片

项目		发行人	联发科	瑞昱
型号		WQ9201	MT7921LSN	RTL8852BS
2G 频段 ^{注1} 802.11b 协议 1Mbps 速率 ¹	发射功率/dBm ^{注2}	22.5	未公开	19.5
	EVM/dB ^{注2}	-22.2	未公开	-16
	灵敏度/dBm ^{注2}	-99.6	-97.5	-99.5
2G 频段 802.11ax 协议 40MHz 带宽 ¹ MCS11 调制	发射功率/dBm	18.1	13	13.1
	EVM/dB	-37.8	未公开	-39.7
	灵敏度/dBm	-63.2	-60	-64.5
5G ¹ 频段 802.11g 协议 6Mbps 速率	发射功率/dBm	22.5	未公开	19.2
	EVM/dB	-14.3	未公开	-30.9
	灵敏度/dBm	-94.2	-93.5	-95
5G 频段 802.11ax 协议 80M 带宽 MCS11 调制	发射功率/dBm	16.5	12	12.9
	EVM/dB	-37.2	未公开	-38.1
	灵敏度/dBm	-58.4	-57	-60
最高物理层速率/Mbps ^{注3}		1200	1200	1200
双频并发（DBDC） ^{注4}		支持	支持	不支持

注 1：Wi-Fi 6 有 2.4GHz 和 5GHz 两个频段，简称 2G 频段和 5G 频段；802.11b 1Mbps、802.11g 6Mbps 和 802.11ax MCS11 为不同调制下的 Wi-Fi 速率，上表选择最低的速率（2G 频段的 802.11b 1Mbps 和 5G 频段的 802.11g 6Mbps）和最高的速率（基于 1024-QAM 调制，2G 频段的 802.11ax 40MHz MCS11 和 5G 频段的 80MHz MCS11）；

注 2：发射功率即满足频谱模板和 EVM 的最大功率，其数值越大性能越好；EVM 值是衡量数字调制信号质量的一个重要指标，越低性能越好；灵敏度值越低性能越好；

注 3：最高物理层速率表示 Wi-Fi 设备在理论理想条件下传输数据的最快速度，越高越好；

注 4：双频并发是一种无线接入技术，即设备可以在 2.4GHz 和 5GHz 两个频段上同时并发通信，分别有效利用两个频段的优势，提供更高的吞吐量和更稳定的连接性能。

如上表，发行人 Wi-Fi AP 芯片在高带宽场景下发射功率表现具备明显优势，在低带宽场景下发射功率表现亦与国际知名品牌不存在显著差异。Wi-Fi STA 芯片方面，发行人产品发射功率于全频段、全带宽下均具备显著优势。

在发射信号质量方面，发行人产品集成了自研的高性能射频发射系统，通过多项自有专利技术的应用，系统性地解决了射频信号相互干扰、本振耦合、相位噪声、信号失真及杂散干扰等行业共性难题，将系统本底噪声控制在极低水平。同时，发行人成功攻克了高性能功率放大器这一通信芯片的核心设计瓶颈，结合独创的高性能记忆数字预失真技术，能够精准校正宽带信号，实现信号高度保真，显著提升芯片发射信号质量，最终使得芯片发射的信号质量达到行业领先水平。

在接收灵敏度指标方面，发行人自主设计的射频接收机，具备优异的噪声系数、相位噪声等性能指标，即能够从微弱的信号中准确接收信息。同时，结合多项先进辅助射频校正技术，如宽带 IQ 失衡估计和补偿技术，确保超宽带范围内，镜像干扰维持在极低水平，减少不同频段信号“串台”；运用模数信号转换误差检测和补偿技术，可自动修正采样误差，进一步提升模数转换精度；搭载智能自动增益控制（AGC）技术，能够根据外部环境动态、精准调节接受信号增益，既避免信号过弱导致接收不清，也防止信号过强产生噪声干扰。通过上述技术，无论通信场景多么复杂，芯片均能实现高质量的信号接收。

在功耗控制方面，发行人自研的高性能 CMOS 功率放大器，通过多项核心电路设计与优化手段，显著降低了其基础功耗。在此基础上，发行人进一步结合新一代数字预失真技术与包络追踪技术，持续提升功率放大器的运行效率。测试数据显示，在相同的 20dBm 发射功率条件下，发行人功率放大器的效率达到 22%，相较同类产品提升约 1 倍，功耗竞争优势显著。不仅有助于终端设备减少发热、延长续航时间，还可实现单芯片架构，从而降低终端设备的 BOM 成本。

3）智能音频主控芯片

项目	发行人	高通	联发科	恒玄科技
产品型号	WQ7036	QCC3072	AB1568	BES2700YP-83/Y5

项目		发行人	高通	联发科	恒玄科技
蓝牙性能	射频接收灵敏度 ^{注1}	-99dBm	-97dBm	-96dBm	-97dBm
	射频发射功率 ^{注2}	15dBm	15dBm	10dBm	15dBm
音频性能	ADC 失真噪声 ^{注3}	-93dB	-94.9dB	-90dB	-90dB
	ADC 信噪比 ^{注4}	102dB	99dB	100dB	105dB
	DAC 失真噪声 ^{注3}	-96dB	-93.3dB	-95dB	-97dB
	DAC 信噪比 ^{注4}	117dBA	104.7dBA	110dBA	120dBA
	DAC 噪底 ^{注5}	1.4uV	5.77uV	2.51uV	3uV
功耗	播放功耗	3.xmA	未公开	未公开	未公开

注 1：射频接收灵敏度，是无线射频接收能够可靠检测并正确解调的最小输入信号强度，数值越小表示通信性能越好；
注 2：射频发射功率，是保证发射线性度及信号可靠的最大功率，数值越大性能越好；
注 3：ADC/DAC 失真噪声，是衡量信号质量的重要指标，数值越小越好；
注 4：ADC/DAC 信噪比，是模拟信号和数字信号转换时准确性和可靠性，数值越高越好；
注 5：噪底，是数模转换输出信号中，除有用信号之外的最低噪声水平，越低越好。

如上表所示，发行人智能音频主控芯片在蓝牙射频接收灵敏度及射频发射功率两项关键指标上，均处于行业领先水平。

在接收性能方面，发行人产品采用了高增益、低噪声系数的射频前端结构，并配合电流复用技术，从而在不提升功耗的情况下显著增强信号增益。同时，通过优化片上无源器件与 3D 封装仿真，有效抑制了射频前端的内部噪声，进一步降低了接收机的噪声系数。此外，依托先进的基带处理算法，芯片在信号编解码与纠错方面能力更强。即便在嘈杂环境等复杂应用场景中，也能自动滤除杂音、补全丢失的信号片段，确保接收稳定可靠。在发射性能方面，发行人在蓝牙射频前端创新集成了推挽式功率放大器，并结合独创的功率匹配与杂散陷波技术。在仅 1.2V 的供电电压下，该芯片即可实现 15dBm 的饱和功率输出，同时保证了发射信号的线性度与可靠性。综合来看，发行人产品的发射性能优于行业主流水平。

在音频性能方面，发行人通过自适应降噪技术的持续创新，显著提升了智能音频主控芯片的音频表现。自主研发的 AI 上行降噪（ENC）算法与自适应主动降噪（ANC）算法均已实现大规模商用。其中，上行降噪技术如同为通话对象的耳朵装上一个“智能过滤器”，其能够自动识别并压制周边环境中突然出现的装修声、汽车鸣笛等非稳态噪声，同时确保人声清晰、自然传输；主动降

噪技术则相当于为佩戴者构建一个“静谧气泡”，有效过滤外界持续性背景噪音。搭载发行人 WQ703X 系列芯片的耳机产品，能够高效压制各类环境噪声，同时保持语音信号的完整性，为用户带来更优质的通话体验。

在功耗控制方面，发行人的 WQ703X 低功耗系列芯片表现突出。通过业内首创的 1.2V 射频 PA 架构及各模块独立上下电技术，实现音频播放功耗降至 4mA 以内。该成果基于 22nm 成熟制程实现，其功耗水平与采用先进制程的国际主流旗舰芯片持平，较行业主流同类产品（通常为 5-6mA）降低 30%以上。在同等电池容量下音频续航时间提升 40%，形成了显著的功耗竞争优势。

3、发行人市场地位

（1）Wi-Fi AP 芯片

按产品代际划分，当前 Wi-Fi AP 芯片市场主要以 Wi-Fi 6 芯片为主流。Wi-Fi 6 AP 芯片的研发具有较高技术壁垒，研发成本高昂且研发周期长（通常为 3-5 年），叠加下游客户导入周期长、认证门槛高，目前全球范围内具备量产供货能力的企业较少，市场集中度较高，竞争格局相对稳定。据 QYResearch 相关统计数据显示，博通、高通、联发科、瑞昱前四大厂商在该领域的合计市场份额 70%。相较之下，中国大陆地区目前仅海思半导体与发行人具备 Wi-Fi 6 AP 芯片的量产供货能力。

发行人的 Wi-Fi 6 AP 芯片已顺利通过国家无线电监测中心检测中心认证、中国移动芯片入库审查及相关资质审查，已向中兴微、长虹小批量供货，预计 2026 年将完成对中国移动、客户 C 等重要终端客户的导入，同时正稳步推进与中国电信和海外客户的市场拓展工作，客户群体持续拓展。同时，为抢占下一代 Wi-Fi 技术制高点、持续巩固国产自主独立能力，公司重点投入 Wi-Fi 7 AP 芯片研发项目，预计最早于 2026 年底完成 Wi-Fi 联盟认证。发行人在 Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 7 AP 芯片的研发、量产及市场导入进展均处于国内厂商前列，将为加速高端通信芯片的自产进程、保障国家通信安全与数据安全提供重要支撑。

（2）Wi-Fi STA 芯片

Wi-Fi STA 芯片应用场景广泛，主要覆盖网络摄像机、电视、MiFi 设备、物联网设备、电脑/平板电脑、手机等细分市场。与前述 Wi-Fi AP 芯片市场格局

类似，我国 Wi-Fi STA 芯片市场亦长期由博通、高通、联发科、瑞昱四大厂商主导。

发行人自研的 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片于 2024 年规模量产，已向创维集团等知名电视品牌客户供货，覆盖星网锐捷、客户 A、客户 B 等核心终端用户，市场认可度逐步提升。同时，发行人正积极推进下一代低功耗、远距传输 Wi-Fi STA 芯片的研发工作，进一步完善产品矩阵，提升市场竞争力。

（3）智能音频主控芯片

发行人智能音频主控芯片具备高品质音频处理、低功耗运行及高可拓展性等核心特征，已广泛应用于智能耳机市场，并成功拓展应用至智能眼镜领域。凭借灵活的拓展能力，该系列芯片未来可进一步延伸至更多端侧人工智能应用场景，具备广阔的市场空间。

在市场地位方面，发行人专注于中高端市场的核心赛道，与恒玄科技形成直接竞争。据统计，2025 年度全球中高端（单价区间 75-150 美元）TWS 耳机畅销机型前 20 款中，发行人芯片所供应机型的数量上仅次于恒玄科技，充分体现了市场竞争力与品牌认可度。

在终端客户方面，发行人聚焦服务荣耀、OPPO、客户 A、客户 B、哈曼 JBL 等全球知名品牌企业，持续巩固在中高端市场的客户壁垒。

此外，发行人深度布局智能眼镜芯片领域，与传音、影目、客户 A、回车等国内主流智能眼镜厂商建立紧密合作关系，在国产智能眼镜芯片市场占据一定市场份额。截至本招股说明书签署日，已有多款搭载发行人的智能眼镜产品正式发布。

综上所述，Wi-Fi 与蓝牙作为无线短距通信领域的两大核心技术，在系统架构、基带算法等底层技术层面存在显著的协同效应。发行人依托在无线短距通信领域与端侧智能领域深厚技术积淀，同步布局 Wi-Fi 芯片与端侧智能芯片，与高通、博通、联发科以及瑞昱等知名企业保持一致。

（五）发行人的竞争优势和竞争劣势

1、竞争优势

（1）产品优势

发行人具备扎实的芯片开发与快速迭代能力，网络通信芯片已形成从 Wi-Fi 4、Wi-Fi 6 STA 到技术难度最高的 Wi-Fi 6 AP 芯片的完整演进路径，并持续推进 Wi-Fi 7 AP 芯片研发；端侧智能芯片覆盖智能音频主控芯片、智能视觉处理芯片等产品，完成多次产品迭代，同时为多位客户提供定制芯片。公司具备清晰且可持续的产品迭代路径与技术储备，将持续攻关核心技术，为产品升级提供有力支撑。

Wi-Fi AP 芯片方面，公司在 Wi-Fi 6 AP 芯片批量供货与 Wi-Fi 7 AP 芯片研发进度上具备先发优势。智能音频主控芯片方面，公司产品兼具端侧 AI 功能与超低功耗特性，该芯片采用独创的高性能低功耗架构，凭借行业第一梯队的超低功耗表现与稳定的高品质音频处理能力，赢得了中高端品牌客户认可；同时，凭借超低功耗与良好可扩展性，该产品已拓展应用至智能眼镜领域，推动公司从音频芯片供应商向下一代 AI 交互入口的核心配套商升级。

（2）技术优势

针对传统技术架构在通信实时性、能耗效率及端侧智能的核心挑战，发行人构建了高带宽低时延通信技术、端侧多模态 AI 算法及超低功耗数模混合芯片设计组成的三大核心能力。公司自研通信技术可实现最高 3,000Mbps 传输速率及 128 路并发连接；超低功耗数模混合芯片设计则在保障高性能计算的前提下，使关键功耗较传统架构降低约 50%，有效缓解“性能越强、功耗越高”的产业瓶颈；端侧 AI 算法在本地完成核心交互任务的实时处理。基于上述技术，公司相关芯片及解决方案已在网络通信、智能穿戴、智能家居等领域广泛应用，相关指标达到行业先进水平。

公司高度重视对产品及技术的研发投入，报告期内累计研发投入为 7.76 亿元，占报告期内累计营业收入的比例为 56.43%，截至报告期末，公司已形成 19 项核心技术，核心知识产权自主独立。

（3）软件与算法优势

发行人在软件与算法方面已建立贯通终端与通信场景的系统性能力，能够为客户提供高集成、可定制、低复杂度的软硬件协同解决方案。依托自主研发

的芯片平台，公司形成了涵盖无线调度与音频处理的全栈技术体系，包括模块化开发框架、智能资源管理引擎、低功耗调度机制及配套工具链，助力客户提升产品性能的同时，缩短开发周期、优化综合成本。

在 Wi-Fi 芯片领域，公司构建了以软件智能调度为核心的技术体系，实现高密度场景下的高效并行传输与动态资源管理。通过自研的链路自适应算法与资源调度引擎，可在复杂网络环境中动态优化传输性能，在保障高吞吐、低时延的同时维持连接稳定性。在软件架构层面，公司在驱动层集成专用网络加速模块，通过优化数据调度机制，实现高网络吞吐与低 CPU 占用的协同。此外，对设备唤醒周期进行精细化调度，有效降低终端功耗，形成集智能调度、高效节能与低系统负载于一体的综合优势。

在端侧智能芯片方面，公司依托自研开发框架及多年技术积累，构建了从底层算法到上层工具的完整赋能体系。采用模块化、可编排的流水线架构，显著降低传统嵌入式音频开发的复杂度，支持客户灵活集成自研或第三方算法，实现高清音质、主动降噪、空间音频等功能的快速定制。

（4）质量控制优势

发行人自创立初期即确立工业级产品的品质定位，产品线始终延续品质传承：从首款面向智能电网市场的 PLC 芯片，到面向运营商市场的 Wi-Fi AP 芯片，均遵循严苛的质量流程与可靠性标准。在与荣耀、OPPO、客户 A、客户 B 等行业优质客户的长期合作中，发行人持续满足客户对芯片品质的严苛要求，以及品牌商对电商平台用户反馈的零缺陷标准。

为确保产品品质持续满足高端客户需求，发行人在产品全生命周期建立了系统化质量管控机制。产品计划阶段，将客户需求转化为设计要求与目标，并输出项目计划书；设计开发阶段，严格遵循可制造性、可测性与可靠性准则，质量团队提前介入评审；工程样件阶段，对标项目计划书，开展多维度符合性及冗余度验证；批量生产阶段，与晶圆制造厂、封测企业共建质量联合管控机制，保障各环节品质一致性；售后服务阶段，建立快速响应机制，形成从客户端到设计端的质量改进闭环。

通过全流程质量体系的持续运行，公司在量产一致性、出货稳定性和长期

可靠性方面建立起显著优势，有力支撑了公司端侧智能芯片业务的持续增长。

（5）研发与管理团队优势

发行人组建了建制完整、专业全面的芯片研发团队，业务范围覆盖数字电路设计、模拟电路设计、射频前端开发、算法设计、SoC 系统集成及软件开发平台等芯片研发全关键环节。团队核心成员主要来自国内外知名芯片企业，在短距通信芯片领域拥有深厚技术积累，并紧跟端侧 AI 领域的技术演进与市场需求，持续拓展研发能力边界，夯实技术领先基础。

在自主创新方面，发行人通过研发可复用的技术平台和 IP 库，显著提升了研发效率与产品迭代速度。截至报告期末，研发团队已形成完整的系统级芯片设计能力，能够独立完成从架构定义到量产交付的全流程开发。团队成功开发出多款在性能指标与可靠性方面表现优秀的产品，展现了卓越的技术实力，成为发行人保持技术领先优势的核心力量，为在激烈市场竞争中持续推出具有竞争力的产品提供了坚实保障。

2、竞争劣势

（1）融资渠道受限

集成电路设计行业具有技术密集、资金密集的典型特征，产品迭代速度快，需持续投入大量研发资金以维持技术领先地位。尤其是在 Wi-Fi AP 芯片、6nm 先进制程端侧智能芯片等技术难度与复杂度高的业务领域，从人才引进、技术开发到工艺更新都需要充足的资金作为支撑。

目前，发行人主要依靠一级市场融资维持运营，融资渠道较为单一，一定程度上制约了公司的研发投入规模和市场扩张步伐。在行业竞争日趋激烈的背景下，融资渠道受限、融资能力不足可能影响公司对市场机遇的把握，进而对公司长期可持续发展形成挑战。

（2）高端人才需进一步充实

集成电路设计行业作为技术密集型产业，行业竞争本质是人才竞争。尤其是在网络通信与智能终端 SoC 芯片等高端领域，公司面临着产品迭代加速、技术门槛提升的双重压力，亟需引进更多具备扎实技术功底和丰富产业经验的高

端研发人才。

尽管发行人已搭建起稳定的产品研发与市场营销体系，但研发团队规模与国内外竞争对手相比仍存在较大差距，在芯片前沿架构、先进制程与先进封装工艺等领域的高端人才储备不足。这一现状直接影响公司的技术创新速度与产品升级效率，人才瓶颈已成为制约公司实现技术突破、市场份额增长的重要因素。

（3）产品矩阵不够丰富，梯度层次不够明显

受制于融资渠道相对单一及高端人才储备不足，发行人在产品快速迭代与系列化拓展方面面临一定挑战。与行业龙头企业相比，公司当前研发投入强度尚不足以支撑多线产品的同步开发，部分产品线更新速度滞后于市场发展需求，导致产品矩阵的完整性与梯度层次有待提升。

资金与高端人才的缺口直接影响了新产品开发效率与技术突破速度，使得公司产品系列的完整度与竞争对手相比存在差距。上述制约限制了公司应对细分市场多样化需求的快速响应能力，从而对公司进一步提升市场份额形成一定阻碍。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品及服务的生产与销售情况

报告期各期，公司主要芯片产品的产量、销量和产销率情况如下表所示：

单位：万颗

类别	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
网络通信芯片	销量	3,176.48	2,203.29	3,971.60
	产量	2,867.61	2,869.59	3,293.62
	产销率	110.77%	76.78%	120.58%
端侧智能芯片	销量	8,921.49	6,792.00	2,819.44
	产量	9,213.30	7,382.87	3,040.62
	产销率	96.83%	92.00%	92.73%
合计	销量	12,097.97	8,995.29	6,791.04
	产量	12,080.91	10,252.45	6,334.24
	产销率	100.14%	87.74%	107.21%

报告期各期，公司主要芯片产品产销率总体处于较高水平，其中端侧智能芯片产销率已提升至 95%以上；网络通信芯片产销率受产品结构及备货节奏影响有所波动，2025 年已恢复至良好水平。

发行人网络通信芯片相关产品包括 Wi-Fi 芯片和 PLC 芯片，其中 Wi-Fi 芯片从早期 Wi-Fi 4 系列起步，到 Wi-Fi 6 STA 芯片量产，进而在 2025 年成功量产技术难度最高的 Wi-Fi 6 AP 芯片，可适配智慧家庭、工业控制等短距通信场景的通信需求。依托稳定的性能与较高的性价比，已逐步打开市场，成为公司营业收入增长的新动力。

发行人端侧智能芯片包括智能音频主控芯片、智能视觉处理芯片，主要应用于智能穿戴、智能家居等场景。凭借稳定的高品质、超低功耗和良好的可拓展性，公司在智能音频主控芯片上获得了中高端品牌客户的认可，具备较强的市场优势。该类芯片产品既是公司当前营业收入的主要来源，也是未来快速增长的重要驱动力。

（二）主要产品及服务的收入构成情况

报告期内，发行人主营业务收入的产品构成参见招股说明书本节之“一、（一）发行人主营业务概况”之“2、发行人主营业务收入构成情况”。

（三）主要客户销售情况

报告期内，发行人前五大客户对应收入金额及占当期销售收入比重如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	营业收入	占比
2025年度	1	深圳中电港技术股份有限公司	13,019.04	23.04%
	2	山东神驰微电子有限公司	11,393.67	20.17%
	3	深圳市天河星供应链有限公司	7,710.61	13.65%
	4	航中天启（重庆）微电子股份有限公司	5,990.80	10.60%
	5	华勤技术股份有限公司	4,307.57	7.62%
	合计		42,421.69	75.09%
2024年度	1	深圳中电港技术股份有限公司	20,910.26	40.68%
	2	深圳市天河星供应链有限公司	13,526.91	26.32%
	3	航中天启（重庆）微电子股份有限公司	5,139.87	10.00%

年度	序号	客户名称	营业收入	占比
	4	文晔科技股份有限公司	2,462.18	4.79%
	5	山东神驰微电子有限公司	1,848.00	3.60%
	合计		43,887.22	85.39%
2023 年度	1	航中天启（重庆）微电子股份有限公司	6,641.92	22.49%
	2	深圳中电港技术股份有限公司	5,073.14	17.18%
	3	深圳市天河星供应链有限公司	4,953.73	16.77%
	4	山东神驰微电子有限公司	2,726.61	9.23%
	5	亿咖通（湖北）技术有限公司	1,372.90	4.65%
	合计		20,768.30	70.32%

报告期内，对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其销售额，公司各主要客户属于同一控制下的具体情况如下：

归属	公司名称
深圳中电港技术股份有限公司	深圳中电港技术股份有限公司
	中国电子器材国际有限公司
深圳市天河星供应链有限公司	银河控股国际有限公司
	深圳市天河星供应链有限公司
航中天启（重庆）微电子股份有限公司	航中天启（重庆）微电子股份有限公司
	重庆诚投创电科技有限公司
文晔科技股份有限公司	世辉电子（香港）有限公司
	世辉电子（深圳）有限公司
	世健国际贸易（上海）有限公司
	世健系统（香港）有限公司
	文晔领科（上海）投资有限公司
	WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd.
亿咖通（湖北）技术有限公司	安徽芯智科技有限公司
	亿咖通（湖北）技术有限公司
华勤技术股份有限公司	东莞华贝电子科技有限公司

报告期内，航中天启（重庆）微电子股份有限公司系发行人关联方，关联关系详见招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、（一）公司主要关联方”。

除该情形外，发行人其它客户与公司、实际控制人及其控制的其他企业、

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在关联关系，公司主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中无持股、投资等情况。报告期内公司不存在向单一客户的销售比例超过 50%的情形。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料及服务采购情况

1、主要采购情况

公司采用 Fabless 模式开展芯片设计业务，不直接从事芯片的生产加工环节，主要对外采购晶圆、封装测试服务和存储芯片。报告期内，发行人的主要原材料及服务的采购情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
晶圆	29,796.68	64.41%	39,168.75	68.67%	9,144.66	45.24%
存储芯片	6,055.64	13.09%	6,152.84	10.79%	2,812.65	13.91%
封装测试服务	8,355.65	18.06%	9,334.38	16.36%	4,842.12	23.95%
光罩及其他	2,052.08	4.44%	2,386.98	4.18%	3,415.48	16.90%
合计	46,260.05	100.00%	57,042.95	100.00%	20,214.91	100.00%

2、主要原材料价格

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
晶圆（元/片）	已申请豁免	已申请豁免	已申请豁免
存储芯片（元/颗）	0.34	0.50	0.59
封装测试服务（元/颗）	0.21	0.27	0.37

（二）主要供应商采购情况

报告期内，公司的主要晶圆代工厂为供应商 A、供应商 B 等，主要封装测试厂商为华天科技、甬矽电子等，主要存储芯片供应商为普冉股份、北京勇旗、兆易创新、深圳淇诺等，具体如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	采购内容
----	----	-------	------	---------	------

年度	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	采购内容
2025年度	1	供应商 A	28,740.96	62.13%	晶圆、光罩
	2	甬矽电子（宁波）股份有限公司	5,935.90	12.83%	封装测试
	3	普冉半导体（上海）股份有限公司	3,014.55	6.52%	存储芯片
	4	华天科技（西安）有限公司	1,915.47	4.14%	封装测试
	5	北京勇旗科技发展有限公司	1,587.57	3.43%	存储芯片
	-	合计	41,194.45	89.05%	-
2024年度	1	供应商 A	37,177.23	65.17%	晶圆、光罩
	2	甬矽电子（宁波）股份有限公司	7,488.84	13.13%	封装测试
	3	普冉半导体（上海）股份有限公司	3,860.67	6.77%	存储芯片
	4	深圳淇诺科技有限公司	1,737.97	3.05%	存储芯片
	5	供应商 B	1,692.87	2.97%	晶圆
	-	合计	51,957.59	91.09%	-
2023年度	1	供应商 A	10,749.83	53.18%	晶圆、光罩
	2	甬矽电子（宁波）股份有限公司	3,606.85	17.84%	封装测试
	3	兆易创新科技集团股份有限公司	982.07	4.86%	存储芯片
	4	深圳淇诺科技有限公司	979.28	4.84%	存储芯片
	5	普冉半导体（上海）股份有限公司	851.29	4.21%	存储芯片
	-	合计	17,169.32	84.93%	-

注：同一控制下企业已合并披露。

报告期内，公司前五大供应商相对稳定，变动主要系公司基于市场行情、供需关系、经营需要等因素，调整对现有供应商的采购额或引入新供应商。

报告期内，公司向前五大供应商采购的产品主要为晶圆、封装测试服务、存储芯片和光罩等，合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 84.93%、91.09%和 89.05%，集中度相对较高，主要原因系：（1）晶圆代工厂和封装测试厂商均属于重资产企业，且相关行业市场集中度较高，掌握先进工艺的厂商数量较少。出于产能保障、工艺稳定性和批量采购的成本优势等因素考虑，集成电路设计企业往往仅选择少数（一般为 2-3 家）晶圆代工厂和封装测试厂商开展长期合作，发行人供应商集中度较高符合行业惯例；（2）公司需要外购存储芯片与自主研发的主控芯片合封制成 SoC 芯片，综合考虑供应商的技术实力、产品与公司技术的匹配程度、产品性能和成本、产能稳定性、市场口碑等因素，公司主要与普冉股份、兆易创新等国内知名企业展开合作。

报告期内，公司及其董监高、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占权益亦不存在关联关系。

五、发行人对主要业务有重大影响的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、主要生产经营设备

公司采用 Fabless 模式开展芯片设计业务，截至本招股说明书签署日，公司无主要生产经营设备。

2、房屋建筑物

截至招股说明书签署之日，公司无自有房屋建筑物。

3、租赁房屋建筑物

截至招股说明书签署之日，公司及其子公司主要房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁期限	用途	面积 (m ²)
1	发行人	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	重庆市渝北区仙桃数据谷中路107号（即C15栋）第15层	2025/01/01-2026/12/31	办公	1,367.21
2	物奇科技	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	重庆市渝北区仙桃数据谷中路107号（即C15栋）第14层	2025/01/01-2026/12/31	办公	1,377.93
3	物奇科技	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	重庆市渝北区仙桃数据谷中路107号（即C15栋）第负2层	2025/01/01-2026/12/31	办公	27.00
4	上海物骐微	上海临港科技创业中心有限公司	上海市浦东新区南汇新城海洋一路333号A座17层B区	2024/01/01-2026/12/31	办公及研发	580.74
5	上海物骐微	上海张江集成电路产业区开发有限公司	上海市浦东新区张东路1761号的4幢3、4层	2025/01/01-2027/12/31	办公及研发	4,393.00
6	上海物骐微	深圳乐普大厦物业管理有限公司	深圳市南山区留仙洞总部基地乐普大厦西塔写字楼24层2405、2406单元	2024/09/01-2027/08/31	办公	1,077.00
7	长沙物奇微	长沙矿冶研究院有限责任公司	长沙市岳麓区麓山南路966号，中国五矿麓山科创园F3栋302房	2026/01/01-2026/12/31	办公及研发	406.00
8	长沙物奇微	湖南三一众创孵化器有限公司	湖南省长沙市长沙经济技术开发区东六路南段77号C6栋第23层2333号	2026/03/11-2027/03/10	办公及研发	4.66

（二）主要无形资产

截至报告期末，公司所拥有的无形资产主要为商标、专利、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权和域名，具体如下：

1、土地使用权

截至报告期末，公司及其子公司不存在自有土地使用权。

2、注册商标

截至报告期末，公司及其子公司拥有的注册商标共计 14 项。该等商标的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人主要无形资产情况”。

3、专利技术

截至报告期末，公司获得已授权专利共 141 项，其中境内专利 121 项（发明专利 109 项，实用新型专利 12 项），境外专利 20 项。该等专利技术的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人主要无形资产情况”。

4、集成电路布图设计

截至报告期末，公司及其子公司拥有的集成电路布图设计共计 18 项。该等集成电路布图设计的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人主要无形资产情况”。

5、计算机软件著作权

截至报告期末，公司及其子公司拥有的计算机软件著作权共计 62 项。该等计算机软件著作权的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人主要无形资产情况”。

6、域名

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的已备案域名情况如下：

序号	域名注册人	域名	ICP 备案号	审核通过日期
1	发行人	wuqi-micro.com	渝 ICP 备 2023001936 号-2	2023/4/7
2	物奇科技	wuqi-tech.com	渝 ICP 备 17011861 号-1	2025/7/4

发行人无形资产均不存在相关诉讼或仲裁、担保或其他权利限制，不存在其他到期注销、终止等异常情况，不存在潜在的专利诉讼纠纷。

（三）与他人共享资源要素的情况

截至报告期末，除物奇科技与珠海荣奇微电子科技有限公司共同拥有 1 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权外，发行人及子公司不存在与他人共享资源要素的情况。

根据双方签署的《关于共有知识产权之协议》，物奇科技于 2018 年 4 月 28 日与珠海荣奇微电子科技有限公司共同申报了名为“一种空调内机智能检测和控制方法及方法”的实用新型专利、于 2018 年 11 月 8 日与珠海荣奇微电子科技有限公司共同开发完成了名为“基于 PLC 宽带电力载波空调通讯系统”软件著作权。

上述共有知识产权系双方合作开发原始取得，不存在利用关联方或非关联方的职务发明等可能存在纠纷的情形，双方一致同意任何一方均有权单独行使、实施前述共有知识产权，因此而获得的收益归实施方所有，另一方不得参与、干涉实施方的收益分配。

（四）发行人主要资源要素与产品和服务的内在联系

公司目前所租赁的固定资产和拥有的无形资产等主要资源要素中，租赁的房屋主要系公司生产经营场所；商标、专利、集成电路布图、软件著作权等无形资产是公司核心竞争力的体现。公司主要固定资产及无形资产与公司生产经营直接相关，上述固定资产、无形资产主要资源要素不存在重大权属纠纷或偿债风险，不存在重大诉讼、仲裁等或有事项，对公司持续经营不存在重大不利影响。

（五）主要经营资质

截至报告期末，公司取得的与生产经营相关的主要资质和认证情况如下：

1、高新技术企业证书

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	发证机关
1	物奇科技	高新技术企业证书	GR202351102811	2023/11/22	三年	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局
2	上海物骐微	高新技术企业证书	GR202531004189	2025/12/25	三年	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	发证机关
						总局上海市税务局

2、进出口资质证书

序号	持证主体	证书/备案名称	证书/备案/登记编号	发证/备案/登记时间	有效期	发证/备案/注册机关
1	发行人	报关单位注册登记证书	501223007A	2018/8/22	长期	中华人民共和国两路寸滩海关
2	发行人	对外贸易经营者备案登记表	05084343	2022/2/11	-	对外贸易经营者备案登记（重庆）
3	物奇科技	报关单位注册登记证书	501226059V/5012240079	2017/7/5	长期	中华人民共和国两路寸滩海关
4	物奇科技	对外贸易经营者备案登记表	03101513	2017/11/17	-	对外贸易经营者备案登记（重庆）
5	物奇科技	出入境检验检疫报检企业备案表	5000608391	2017/12/8	-	中华人民共和国重庆出入境检验检疫局
6	上海物骐微	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码：3122260YVQ 检验检疫备案号：3158300136	2020/6/16	长期	中华人民共和国海关洋山海关（港区）

3、管理体系认证证书

序号	持证主体	证书编号	认证内容	认证范围	有效期	认证主体
1	物奇科技	55425Q10645R0S	质量管理体系符合：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	集成电路芯片研发、销售；集成电路芯片软件开发	2025/7/25-2028/7/24	中澜认证有限公司
2	上海物骐微	03824Q04788R1M	质量管理体系符合：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	集成电路芯片研发及相关软件的设计开发和销售	2021/6/1-2027/5/31	北京世标认证中心有限公司

六、发行人核心技术和研发情况

（一）核心技术的来源与表征

1、传统技术架构面临核心挑战

随着物联网、人工智能及通信技术的快速迭代和深度融合，智能终端产业迎来结构性升级，终端设备逐步从单一功能载体，向具备环境感知、实时决策、自主交互能力的泛智能系统演进。在此产业变革进程中，传统技术架构已难以适配下游应用的多元化、高性能需求，面临三大核心技术瓶颈。

（1）大流量数据传输与实时性需求挑战

8K 超高清视频、全息通信、L4 及以上自动驾驶等高端应用正加速从概念

验证走向规模化商用，对数据传输的带宽（传输速度）与时效性（反应速度）提出了严苛要求，该核心指标直接决定了相关应用的用户体验与商业落地成效。以典型场景为例，单路 8K 超高清视频实时传输需持续占用 100-200Mbps 带宽（折合每秒传输 12.5-25MB 的文件）；而全息通信、自动驾驶等场景更为严苛，要求端到端时延稳定压缩至 5 毫秒以内，即数据从采集、传输到决策执行的全链路需在 1/200 秒内完成。一旦超出该标准，将直接导致视频卡顿、全息画面延迟、自动驾驶反应滞后等问题，甚至威胁使用安全。

当前通信网络架构存在一个底层技术权衡：带宽和低时延性能难以同时达到最优。提升带宽往往会伴随缓存队列延长、转发跳数增多，进而导致时延上升及时延抖动加剧；而若追求极致低时延，又需限制并发连接与数据批量传输，从而直接降低带宽利用率与系统容量。面对各类高端应用流量的爆发式增长，这一技术瓶颈愈发突出。若未来 2-3 年内无法在通信核心技术上取得突破性进展，将直接制约我国在高端显示、自动驾驶、元宇宙等战略性新兴产业的全球竞争力，同时阻碍相关产业的商业化进程。

（2）多模态智能技术的端侧部署瓶颈

生成式 AI 与多模态大模型的加速落地与规模化应用，使得智能终端设备对视觉、语音、传感器等多源异构数据的实时融合分析需求呈指数级攀升。以智能眼镜为例，其需在 50 毫秒内完成语音唤醒、图像识别与环境感知的联合推理，以保障人机交互的实时性。然而，传统云端集中式 AI 架构存在三大固有瓶颈，难以适配上述需求：一是隐私合规风险，端侧敏感数据上传云端不仅面临严格的法律与监管要求，也会引发用户信任危机；二是算力成本高昂，云端大模型单次推理成本在大规模商业部署时难以承受；三是传输延迟突出，尽管 5G 网络理想时延可达 1 毫秒，但实际端到端时延仍达 20-50 毫秒，无法满足工业机械臂协同、车载主动降噪等场景对毫秒级实时决策的核心需求。上述因素共同导致传统“云管端”模式在端侧实时智能分析、自主决策等场景中遭遇根本性制约，成为阻碍产业智能化升级的关键卡点，行业亟需向“端侧自主智能”架构转型。

（3）终端设备能源效率的刚性约束

全球 AIoT 设备连接数已突破 400 亿，AR 眼镜、无人机、各类可穿戴设备及工业物联网传感器等海量终端进入规模化部署阶段。此类设备普遍依赖电池供电，续航能力不仅直接决定用户接受度，更是制约相关产品商业落地规模与市场渗透速度的关键因素。以行业典型产品为例：AR 眼镜整机功耗约 1-2W，主流电池容量仅为 300-500mAh，导致重度使用场景下续航时间不足 2 小时，严重影响用户体验；TWS 耳机单耳电池容量约 30-50mAh，若核心芯片功耗无法控制在毫瓦级水平，将难以支撑全天音乐播放等核心使用需求；工业无线传感器节点则需在平均电流 10 μ A 的超低功耗状态下连续稳定工作 5-10 年，否则频繁更换电池将大幅增加运维成本，难以满足工业场景的规模化应用需求。

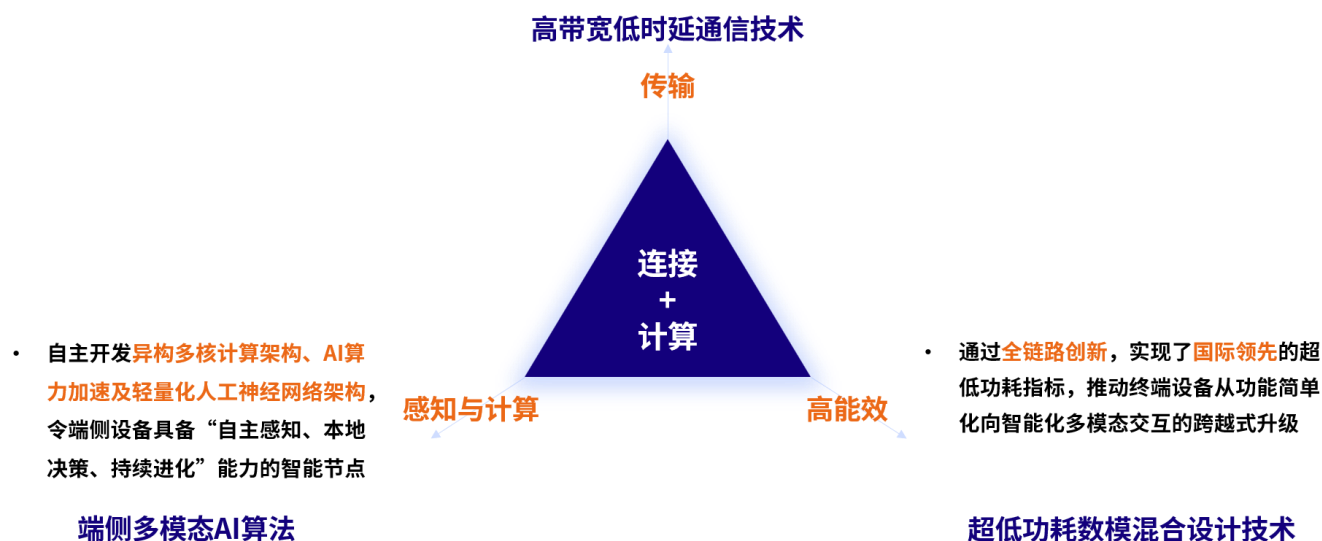
当前，泛智能终端设备普遍面临“性能越强、功耗越高”的刚性矛盾：端侧 AI 算力每提升一个数量级，设备典型功耗往往随之增加 3-5 倍；而受技术瓶颈限制，电池能量密度年增长率仅约 5%，远落后于端侧 AI 算力 50% 的年增速，供需差距持续扩大。因此，在保障设备实时计算、多模态交互等核心体验的前提下实现超低功耗设计，有效平衡续航能力与产品性能，已成为制约泛智能终端规模化应用的核心瓶颈。这也推动芯片设计行业从传统“算力竞赛”向高效“能效竞赛”转型，成为行业发展的时代驱动力。

2、发行人核心技术体系构建情况

针对上述行业传统技术架构瓶颈，发行人经过多年持续研发投入与技术积淀，聚焦高带宽低时延通信技术、端侧多模态 AI 算法、超低功耗数模混合设计技术三大核心技术方向，逐步构建自主独立、性能领先的核心技术体系。截至招股说明书签署之日，发行人上述三大核心技术方向已形成了显著的技术壁垒，能够有效破解传统技术架构的核心痛点。

公司核心能力

- 高性能低功耗Wi-Fi 6，传输速率、距离、时延与可靠性的**国际领先**
- 低功耗蓝牙，在传输延时、语音同步、功耗等指标均处于**行业领先地位**



（1）高带宽低时延通信技术

公司研发的高带宽低时延通信技术，通过物理层到应用层的全栈创新，在关键性能指标上实现对国际主流竞品的赶超。在带宽支持与最高通信速率方面，公司产品最高支持 160MHz 信道带宽，最高传输速率达 3,000Mbps，达到国际主流芯片同等水平。在时延与并发性能方面，公司已掌握基于 OFDMA 和 MU-MIMO 的物理层基带处理与多天线传输技术、MLO 多链路聚合的 MAC 层调度技术，以及 DBDC 双频并发射频技术，具备从射频前端设计、基带与协议处理到系统集成的完整产品化能力，在 Wi-Fi 芯片中单节点最多可同时支持 128 个用户并发连接，满足高密度场景下的稳定体验需求。同时公司已构建蓝牙 7.0 HDT 高速低时延传输核心技术体系，在功耗、架构优化和协议层面，深度适配端侧常态化的业务场景。

公司凭借上述技术优势，打造了稳定高速的连接底座，有效支撑智能终端多模态交互场景下海量数据的低时延交互，推动终端设备从“单一连接”向“智能互联”的技术升级。

（2）端侧多模态 AI 算法

依托异构多核计算架构及 AI 算力加速技术，赋予端侧芯片同步处理多模态数据的能力，算力分配效率较传统方案显著提升。此外，通过设计轻量化神经网络模型，发行人实现核心交互任务的本地实时处理（本地 AI 语音识别及处

理、3D 人脸识别等），同时将安全引擎深度融入神经网络加速器，从芯片底层建立金融级数据安全防护体系，确保敏感数据在端侧独立处理且不被窃取。相关技术已在智能穿戴、智能家居等场景规模化落地，推动终端设备实现端云协同的算力分配，成为具备“自主感知、本地决策、持续进化”能力的智能节点，为沉浸式交互体验筑牢技术根基。

（3）超低功耗数模混合设计技术

公司通过全链路创新，在保证高性能（如高精度信号处理、本地实时 AI 算力）的前提下，实现了国际领先的超低功耗指标，有效解决可穿戴设备、智能终端等电池焦虑场景的续航痛点。在 Wi-Fi 芯片领域，公司自研的高性能射频功率放大器（CMOS PA），结合新一代数字预失真技术与包络追踪技术，在 20dBm 典型发射功率条件下，PA 效率达到 22%，较传统架构（行业先进水平效率约 11%）提升约 1 倍，功耗降低约 50%。在智能音频主控芯片领域，公司设计的 WQ703X 系列芯片，通过业内首创的 1.2V 射频 PA 架构及各模块独立上下电技术，实现音频播放功耗降至 4mA 以内。该成果基于 22nm 成熟制程实现，其功耗水平与采用先进制程的国际主流旗舰芯片持平，较行业主流同类产品（通常为 5-6mA）降低 30%以上，同等电池容量下音频续航时间提升 40%，充分体现了公司卓越的模拟电路设计与低功耗优化能力。上述低功耗设计将电池焦虑场景从“可用”变为“易用”，推动终端设备从功能简单化向智能化多模态交互的跨越式升级。

（4）三大核心技术的协同效应

发行人三大核心技术构建了传输、计算、能效三位一体、互为前提的深度耦合格局。通信技术保障数据传得进来，为多模态交互产生的高并发数据打通高速传输通道；端侧 AI 技术保障数据和算力的合理分布，自研 NPU 与异构计算架构在终端本地完成语音、图像和传感器数据的融合分析与智能决策，有效降低端云交互频次，减少数据传输时延与隐私暴露风险；超低功耗设计保障系统撑得持久，发行人通过自研低功耗 CMOS PA、动态电压频率调节、模块独立上下电等技术，使高性能通信与端侧 AI 得以在 AI 眼镜等智能穿戴设备等功耗敏感场景中规模化部署。三大核心技术互为支撑：大带宽通信使端侧 AI 突破本地孤岛数据的限制；端侧 AI 将多模态实时数据在本地转化为有效决策；超低功

耗则确保前两者的性能优势不被电池续航所制约，共同破解了传统架构中带宽、算力、功耗难以兼得的核心矛盾。

上述三大核心技术已广泛应用于发行人的网络通信芯片和端侧智能芯片产品，并为后续产品持续迭代提供了坚实的技术基础。通信技术保障了 Wi-Fi/蓝牙系列芯片的高速稳定传输能力，端侧 AI 技术赋予了智能音频主控芯片及智能视觉处理芯片本地实时处理能力，超低功耗设计则确保上述芯片在终端设备中具备可接受的续航表现。三大技术形成系统性壁垒，竞争对手难以在通信、AI 和功耗三个维度上同时达到均衡优化水平，从而增强了客户粘性，为公司参与市场竞争构筑了深层护城河。

3、发行人核心技术先进性具体表征

经过多年的研发创新积累，发行人在架构技术、功耗管理、射频前端、基带处理等领域积累了 19 项核心技术，相关核心技术目前均已取得/在申请多项知识产权，并在其主要产品和服务中实现应用。

发行人主要核心技术的具体情况先进性表征如下：

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
1	高效率射频功率放大器（CMOS PA）与线性化技术	解决痛点：传统功率放大器普遍存在发射效率较低、功耗较高以及高功率输出下非线性失真等问题，难以兼顾高性能无线传输与终端设备低功耗需求，成为制约无线连接芯片性能提升的重要瓶颈。 技术优势：发行人自主研发的高效率射频功率放大器（CMOS PA），通过多项独创性的核心电路设计与优化手段，显著降低了其基础功耗，结合数字预失真（DPD）及包络追踪等关键技术，持续提升功率放大器的运行效率。Wi-Fi 产品测试数据显示，在相同的 20dBm 发射功率条件下，发行人射频功率放大器效率可达到 22%，相较同类产品提升约 1 倍，体现出显著的低功耗竞争优势，该技术的应用可有效减小芯片的物理尺寸并降低电源和散热结构的成本，配合自适应峰均比优化和动态幅相跟踪等技术，可以全面支持 Wi-Fi 7 4096QAM 高阶调制。	Wi-Fi 网络通信芯片	自主研发	量产	特許第 7686684 号 US12494751B2 特許第 7642693 号 ZL202111632084.7 ZL202210074424.7 ZL202210099158.3 CN202211312865.2 CN202211312882.6 CN202310310224.1 CN202510702326.7 CN202511620076.9

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
2	支持多频并发的片上高性能射频收发器（Transceiver）	解决痛点：解决新一代 Wi-Fi AP 射频系统中多通道偏差大、噪声和本振泄漏高、正交失衡、发射功率漂移、多频段同时工作相互干扰强、动态范围和线性度不足等问题。 技术优势：公司自研业界领先的射频收发器（Transceiver），具备 160MHz 带宽下 70dB 高动态范围、2.5dB 超低噪声系数和高线性度，配合自研的高精度 ADC 校准和宽带正交信号自适应误差校正算法，满足 Wi-Fi 7 4096QAM 高阶调制的严苛要求。单芯片集成方案攻克双频并发干扰隔离难题，公司的 Wi-Fi 6 AP 芯片 WQ9301 在 DBDC 模式下实现超过 3Gbps 的传输速率，达到国际先进水平；内置 FEM 减少外围器件，提升系统可靠性并降低成本。	Wi-Fi 网络通信芯片	自主研发	量产	ZL202310333246.X ZL202310310435.5 ZL202210016521.0 ZL202410999134.2 CN202510306297.2 CN202511052136.1 CN202411611457.6 CN202511052137.6 CN202511619423.6 CN202512022263.3 CN202211536820.3 CN202311239821.6
3	低复杂度多流联合检测技术	解决痛点：随着 Wi-Fi AP 芯片向高阶调制、高阶 MIMO、多用户并发及高密度组网方向演进，复杂多径与多终端信号叠加导致接收端检测复杂度大幅增加。传统最大似然检测算法复杂度过高，难以满足 Wi-Fi AP 芯片在大规模并发场景下的工程化实现需求；而现有低复杂度算法又普遍存在检测性能不足的问题，制约了复杂无线环境下系统容量与连接稳定性的进一步提升。 技术优势：公司创新性地提出低复杂度多流检测技术，引入反推机制构建双向检测候选发射集，将传统最大似然检测算法复杂度由指数级降低至线性级别，在兼顾高性能检测能力的同时显著降低实现复杂度。相较传统次优算法，该技术可有效提升检测准确率和空间覆盖能力，并降低芯片功耗与面积开销，在复杂多径、多用户并发场景下实现 20%~35% 的吞吐率提升，满足 Wi-Fi AP 芯片对高并发、高吞吐及稳定连接能力的要求。	Wi-Fi 网络通信芯片	自主研发	量产	ZL202210902053.7 CN202310075290.5 CN202311221507.5
4	高并发硬件加速流控技术	解决痛点：传统 Wi-Fi MAC 帧聚合解聚合处理、队列调度、内存管理、流控等关键操作多由软件完成。较高的处理延迟和 CPU 开销，使其无法满足 Wi-Fi 6 路由器高吞吐低延迟应用场景的性能。 技术优势：自研高并发硬件加速流控	Wi-Fi 网络通信芯片	自主研发	量产	ZL202210852556.8 ZL201910152551.2 CN202310645059.5 CN202311432904.7 CN202510680776.0 CN202310404977.9 CN202310685661.1 CN202510746604.9

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		技术融合了硬件加速器与并发多用户流量控制两大核心能力。一方面，硬件加速器将 MAC 帧聚合解聚合、TCP/IP 协议栈处理、以太网帧转换、内存管理等从软件卸载到硬件，大幅降低 CPU 负载与处理延迟。另一方面，并发多用户流量控制机制实时监测每个用户的实际缓存数据量与瞬时所需数据量，通过排序算法动态调整各用户的总线访问优先级，确保 DL-OFDMA 场景下任意配置均无用户断流。该技术在多用户复杂应用场景下使 Wi-Fi 有效吞吐提升 25% 以上；在 128 用户关联场景下，24 个用户同时并发，系统总吞吐可稳定达到 2Gbps 以上，处于业界领先的吞吐与流控效率。				CN202511684593.2 CN202511800322.9
5	基于 Wi-Fi 6 的无线 SDR 长距离传输	解决痛点： 传统 Wi-Fi 远距离图传距离短、带宽低、易掉线、抗干扰差，芯片功耗与成本偏高，多设备组网易冲突，无法满足安防、户外等场景的长距离高可靠通信需求。 技术优势： 基于 Wi-Fi 6 的 SDR（软件定义无线电）实现远距离低功耗传输：3 公里稳定高清图传，10 公里以上仍保持 2Mbps 带宽，实时图像传输时延低至 1.5ms，复杂环境下通信稳定可靠。	Wi-Fi 网络工业级远距离无线通信、低功耗图像视频传输、安防监控类芯片	自主研发	量产	ZL202011066009.4 CN202510532849.1 CN202510110503.2 CN202510492375.2 CN202211027944.9
6	基于 AI 的通感一体 Wi-Fi 6 AP 技术	解决痛点： 针对传统 Wi-Fi AP 仅具备单一通信能力、信号感知精度低，导致微动作检测误差大、环境变化后感知性能急剧下降、整体感知效果不佳的问题，弥补传统 AP 无法满足安防、人体精细活动及生命体征监测等感知需求的短板。 技术优势： 以 AI 赋能无线网关作为边缘算力中心，采集支持多类隐私感知任务的 Wi-Fi 信号，独特算法实现干扰抑制比提升 20dB，AI 模型自动提取时频空域特征，可在 2 秒内有效预测人体 5 类标准行为，准确率高达 95%，此外 AI 模型具备强化学习能力，自适应环境变化。	Wi-Fi 网络通信芯片	自主研发	研发中	ZL202210612424.8 ZL202211066357.0 ZL202310073504.5 ZL202310073460.6 ZL202310197167.0 ZL202310188495.4 ZL202310317666.9 ZL202310370018.X ZL202310369882.8 ZL202310369876.2 ZL202310189030.0
7	TWS 全链路高可靠同步通信技术	解决痛点： 传统的蓝牙 TWS 音频方案，蓝牙链路复杂，音频传输延迟大，音频稳定性差，多设备声音同步时间不精确。 技术优势： 自研 W-TWS+技术扩展了	TWS 蓝牙耳机、蓝牙耳机、可	自主研发	量产	GB2596954 US12119864B2 US11652577B2 特許第 7206565 号 US11589151B1 特許第 7220765

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		蓝牙协议新的应用场景。创新动态拓扑管理和私有通信协议突破了传统蓝牙技术对多设备连接的限制，能够支持同时一对多，多对多的可靠传输。低延迟技术保证设备端的音频延迟<20ms；多设备之间的同步机制可以使音频同步误差<10us；高可靠的通信传输技术保证了音频数据传输的稳定性，使音频不容易卡顿、失真。各项指标均处于行业领先水平。	穿戴设备等低功耗无线音频类芯片			US12432497B2 ZL201811400686.8 ZL201811400750.2 ZL201811400754.0 ZL201910511171.3 ZL201910578524.1 ZL202110282613.9 ZL202110327674.2 ZL202110287400.5 ZL202110272157.X ZL202111123131.5 ZL202111120602.7 ZL202111340912.X ZL202111172783.8 ZL202211085767.X ZL202211364389.9 ZL202310043492.1 CN202311251779.X CN202311552232.3 CN202311608633.6
8	低功耗感知与交互技术	解决痛点： 针对可穿戴设备对感知信号的高灵敏度与极致低功耗的需求。 技术优势： 公司自主研发的高性能低功耗信号处理链路，充分利用先进工艺的器件以及速度优势，并通过Sigma—Delta 调制架构的创新，结合数模混合动态噪声整形技术，实现卓越性能：音频上行链路底噪低至-105dBA，SNDR 98 dB，功耗160uA@3.8V；下行链路底噪达-117dBv，功耗300uA@3.8V；开关pop noise控制在30μV以内，在有严苛噪声需求的主动降噪（ANC）场景下，显著提升用户降噪体验。该技术应用在触摸传感器中表现优异，在1fF的检测精度下，仅需2μA超低电流消耗，有效解决了AI眼镜等智能穿戴产品极低功耗待机的技术难题，为设备的长效续航提供坚实保障。	TWS蓝牙耳机、蓝牙音箱、可穿戴设备等低功耗无线音频类芯片	自主研发	量产	CN202311577541.6
9	开放式音频软件框架	解决痛点： 传统音频软件开发处理流程复杂，算法种类繁多，移植难度大，链路数据耦合太强。 技术优势： 公司的开放式音频软件框架技术，采用音频领域特定创新架构，集成了丰富的音频算法库，同时支持统一接口的流水线模块化设计，便于直接调用现有算法和移植新算法。该框架以及内置的算法库通用于TWS/OWS/AI眼镜/录音设备等各种音频场景，根据平台能力进行了深入地底层优化，采用轻量化模型确保算	TWS蓝牙耳机、蓝牙音箱、可穿戴设备等低功耗无线音频类芯片	自主研发	量产	ZL202211153667.6 ZL202111182583.0 ZL202111597974.9 ZL202210086693.5 ZL202210539897.X CN202511339233.9 CN202210100111.4 CN202410141321.7

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		法在相应芯片上实现实时处理。大量客户已经基于该框架快速完成了软件开发和产品化定制，开发效率比使用传统软件框架提升了 30%~50%。				
10	基于 AI 深度学习的动态通话降噪技术	解决痛点：传统 ENC 算法依赖固定滤波与基础信号处理，难以有效抑制瞬态冲击、突发人声等非稳态噪声，低信噪比场景下通话语音畸变严重、可懂度下降。 技术优势： 一体化降噪体系：构建“环境感知+波束增强+智能抑噪+双模协同”架构，动态环境感知结合多麦波束成形与多模态特征融合，实现降噪力度的场景自适应调整。 混合架构 AI 模型：采用 RNN+轻量级 CNN 混合架构，经大规模真实场景噪声训练，具备非平稳信号实时跟踪与预测能力，瞬态噪声收敛<10ms。 高性能工程落地：结合 DSP 流水线优化，低资源占用下精准分离目标语音与非稳态干扰，非稳态噪声抑制>15dB。	TWS 耳机专用蓝牙音频 SoC 芯片	自主研发	量产	ZL202210480103.7 CN202410259576.3
11	全实时自适应 ANC 降噪技术	解决痛点：传统的 ANC 降噪方案使用固定、选档滤波器参数，场景适配性偏弱，易受佩戴泄漏、环境噪声变化干扰，难以适配不同耳道特征，降噪效果个体差异大。 技术优势：公司自主研发核心降噪技术采用前馈与反馈双链路融合架构，搭载高性能实时算法优化引擎。可实时感知佩戴泄漏量与环境噪声特征，动态测算适配滤波系数并平稳切换工作状态。多场景稳态降噪表现趋近人工离线优化最优水平，相较传统方案鲁棒性和降噪性能提升显著。该技术已在多款入耳、半入耳式 TWS 耳机上实现量产，有效地解决了体验一致性问题，实测最高降噪深度 55dB、有效降噪频宽上限达 5000Hz。	TWS 耳机专用蓝牙音频 SoC 芯片	自主研发	量产	ZL202110269323.0 ZL202110272158.4 ZL202110272161.6 ZL202110269322.6 ZL202210828366.2 ZL202210761520.9 ZL202210828359.2 CN202311332027.6 CN202410632649.9
12	用于开放式运动耳机及 AI 眼镜的 OWS 音频算法技术	解决痛点：传统 OWS 设备在运动耳机、AI 眼镜等场景中，面临低频泄露、麦克风回声耦合及风噪干扰等物理限制，影响通话清晰度与音频沉浸感。 技术优势： 高阶通话降噪与回声消除：引入	TWS 耳机专用蓝牙音频 SoC 芯片	自主研发	量产	ZL202210480103.7 CN202410259576.3 CN202410632649.9

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		LMS+KLM 双滤波结构，线性回声抑制达 30dB；非线性部分采用 RNN-CNN 混合神经网络进行频谱修复，确保全双工通话无回声及双讲损伤。 智能风噪抑制：基于多麦克风阵列与 DNN 风噪模型，在抑制风噪的同时保留语音谐波结构，支持 15km/h 以上风速下的清晰通话。 低频补偿与空间音频：基于心理学建模与多波段均衡算法动态补偿低频能量，在 AI 眼镜等小扬声器形态下实现接近 Hi-Fi 级低频表现。 跨模态协同增强：融合 IMU 头部姿态数据与 HRTF 空间音频渲染算法，实现动态空间环绕感知，适配不同物理腔体结构的 OWS 耳机及 AI 眼镜产品。				
13	高性能多核 RISC-V CPU 架构技术	解决痛点：针对不同应用场景，缺少可以高度定制化、可以平衡产品性能需求和成本控制的 CPU 系统架构。 技术优势： 该技术基于开源 RISC-V 指令集，自研 CPU 内核与缓存架构：采用混合多级流水实现，支持指令分支预测及可定制的分/浮点计算单元，满足不同产品需求；同时支持多核实现与 SMP 操作系统运行，在主频受限情况下仍能成倍增强处理能力；具备 L1、L2 多级缓存一致性能力，为不同应用芯片合理配置多级缓存，有效降低数据访问延时，大幅减少外部动态存储器的访问次数，全面提升 CPU 整体能效。	网络通信、端侧智能等芯片的核心和运算与控制器	自主研发	量产	ZL202210115661.3 ZL202210466018.5 CN202411750446.6
14	异构多核 SoC 架构技术	解决痛点：端侧智能应用场景复杂，包括通信、音视频、传感、AI 计算多类实时控制，需要同时满足高计算密度与低功耗指标。单一架构难以兼顾不同算力场景的性能与功耗平衡。 技术优势： 该技术通过在单一芯片内集成多种异构处理核心，成功实现复杂功能的高度集成。以智能眼镜芯片为例，RISC-V CPU 负责处理用户交互、传感器数据、蓝牙/Wi-Fi 通信数据实时处理，DSP 完成音频编解码，音效和降噪处理，ISP 负责实时 CMOS 传感器的视频/照片处理，NPU 提供强大的 AI 算力支持。通过实现“通用控制	端侧智能等 SoC 芯片	自主研发	量产	CN202511622933.9 CN202511622928.8 CN202511622937.7 CN202210112286.7

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		+专用加速”的协同计算体系，使每种应用在最合适的计算核内完成，采用创新的数据总线实现各计算核之间低功耗、高效的数据交互。 本技术凭借灵活高效的设计，特别适用于具有功能多样、应用场景复杂、兼顾性能与功耗等特点的多模态终端 AI 应用。				
15	片上先进功耗管理技术	解决痛点：电池续航短已成为制约端侧 AI 应用体验的最大痛点，亟需从芯片底层架构到系统级功耗管理进行全链路的极致优化。 技术优势：本技术方案通过创新性的可靠性设计，在先进工艺节点下实现了对 5.5V/4.6V 高压电源输入的全面支持。自研全套超低功耗电源管理单元(PMU)模块，可提供 0.45V 至 3.3V 的宽范围多电源输出；其中负载电流自适应 DCDC 转换器输出电压偏差低于 0.5%，可支持精细电压频率调节 (DVFS) 技术，静态电流仅为 2.3μA，峰值转换效率超过 90%，各项关键指标均达到国际先进水平。 方案通过融合创新电路架构、Chiplet 先进封装技术以及深度场景适配优化算法，能够在多模块协同工作的多种运行模式与多级睡眠模式下，实现系统级的极致低功耗目标，大幅提升端侧 AI 设备的续航能力。	超低功耗物联网、智能终端、便携移动设备、可穿戴设备等 SoC 芯片	自主研发	量产	ZL202110275941.6 ZL202110258164.4 ZL202120503801.5 ZL202120505493.X CN202510719395.9 CN202311630255.1
16	多模 3D 机器视觉感知技术	解决痛点：当前 3D 成像领域普遍采用通用芯片处理，存在功耗偏高、成像精度不足、环境适应性差等问题；且深度成像与本地 AI 识别并行运算，算力负载高、端侧实时处理能力有限，难以满足全域感知、多模态人机交互与长效续航的核心需求。 技术优势：该技术深度融合多模 3D 机器视觉与自研双加速引擎，全面兼容结构光、ToF、双目等主流 3D 成像方案，通过硬件加速器与专用 NPU 协同完成本地 3D 视觉感知。多模融合平衡测距与成像精度，可本地实时输出视差图、深度图、点云图；其中结构光实现毫米级高精度近距成像（精度小于 1 毫米，支持 1080p @ 30fps）；ToF 实现 3~8 米远距高速探测（最高帧率 QVGA @ 120fps）。集成的 NPU 承载了 AI 加速推理，配	3D 视觉感知、机器视觉、深度成像、边缘 AI 计算、低功耗图像处理器等芯片	自主研发	量产	ZL201711404639.6 ZL202210831852.X ZL202210903358.X CN202410162894.8 CN202410168187.X

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		合 ISP 与 3D 视觉加速模块一站式完成图像降噪、3D 成像与本地智能识别。场景功耗控制表现优异，例如在 3D 人脸门锁中冷启动识别耗时低于 600ms，平均功耗仅 150mW。该技术可广泛应用于机器人、金融支付、工业测量等领域。				
17	端侧 AI 模型轻量化与安全加速技术	解决痛点： 通用的 RISC-V 核并不适合大规模的 AI/DSP 类向量数据计算处理。此外模型参数容易被窃取或破解；推理运行效率低、安全性差。 技术优势： 公司自研的高速神经网络处理器 NPU 是为 RISC-V 核量身定制的协处理器，辅以自研的 RISC-V SIMD 扩展指令，极大的扩展了 RISC-V 在端侧智能场景下的应用。该技术支持 INT 8/INT16 神经网络，内置多维卷积与非线性层加速引擎，可支持主流 AI 算法，提供 0.2~0.5Tops 等端侧轻量化的推理算力，具有优异的算力功耗比。另外，该技术创新性的将安全引擎集成到 NPU 内部，从芯片底层保障了用户数据安全。NPU 与自研 RISC-V CPU 核及 SIMD 扩展指令库深度协同，全面支持 AI 音频处理、AI 语音识别、生物识别等终端应用，广泛应用于公司芯片产品中。	智能终端、物联网、边缘计算与工业控制等低功耗 AI 芯片	自主研发	量产	ZL202211719081.1 CN201810998614.1
18	智能自适应电力线载波通信技术	解决痛点： 电力线通信中干扰大、信号强度不稳定、带宽浪费、多设备不兼容、频段切换麻烦等问题。 技术优势： 该技术可根据传输需求动态调整时域信号采样率，提升信号功率谱密度（PSD），通信链路增益提升 15dB 以上；依托自研自动增益控制算法，可实现 110dB 以上超大动态工作范围；结合自适应数字陷波滤波器与削波技术，自动识别并滤除电力线常见的窄带干扰与脉冲干扰。该技术支持 15 级自组织 Mesh 组网，可承载超 1000 个网络节点，充分保障复杂场景下通信稳定可靠。	电力线通信（PLC/HPLC）、智能电网、智能计量、工业物联网、长距离强干扰通信等芯片	自主研发	量产	US10819547B2 ZL201710764337.3 ZL201711420494.9 ZL202211474604.0 ZL202310207439.0 CN202310057732.3 CN202310302189.9 CN202311237523.3 CN202311237496.X CN202410070314.2
19	宽带 PLC 模拟前端技术	解决痛点： 在传统宽带 PLC 系统中，线路驱动线性 PA 与 LNA 芯片长期依赖国外供应，且存在诸多短板：模拟驱动能力偏弱；PA、LNA 采用分立设计，外围器件多、成本高、集成度低；大功率输出场景下，	电力线通信（PLC/HPLC）、智能电网、	自主研发	量产	US10992345B2 ZL201820333984.9

序号	核心技术名称	核心技术内容及先进性表征	应用领域	技术来源	所处阶段	专利号/申请号 ^注
		难以同时兼顾线性度与信号质量。 技术优势：公司是业内首批实现宽带 PLC 线路驱动功率放大器 PA 国产替代的企业之一。应用该技术的芯片采用 12V 互补 BiCMOS 工艺，业内首创单芯片集成宽带 PLC PA 与 LNA；其中 PA 支持高功率、高信噪比输出，5W 峰值功率下仍可维持高线性度，有效保障宽带 PLC 通信中的 OFDM 信号质量；LNA 支持$\pm 10V$大信号输入，大大简化外部滤波及过压保护电路设计。 相较传统分立方案，外围器件可从 150 颗精简至 60 颗，有效简化硬件设计、降低系统成本，同时提升整机产品可靠性。	智能计量、工业物联网、长距离强干扰通信等芯片			

注：ZL 开头表示发行人取得的已授权境内专利，CN 开头表示发行人在审中的境内专利，US 开头表示发行人取得的已授权美国专利，特开开头表示发行人取得的已授权日本专利，GB 开头表示发行人取得的已授权英国专利。

（二）核心技术在主营业务及产品中的应用和贡献情况

报告期内，发行人主要产品为网络通信芯片、端侧智能芯片及定制芯片服务。发行人所有自研并销售的芯片产品及受托开发量产的产品均基于自主核心技术。

报告期内，发行人基于核心技术产生的销售收入占营业收入比例分别为 99.70%、99.93%及 99.92%。

（三）公司获得的重要奖项及荣誉

公司凭借领先的核心技术与持续创新能力，获得了国家级专精特新“小巨人”等多项重要奖项及业界荣誉，获得了业界广泛的认可。公司获得的奖项、荣誉情况如下：

序号	年份	奖项/荣誉/资质	颁奖单位
1	2025	上海市“专精特新”企业	上海市经济和信息化委员会
2	2025	重庆市渝北区优秀民营企业	中共重庆市渝北区委、重庆市渝北区人民
3	2025	中国 IC 设计成就奖之年度创新 IC 设计公司	ASPENCORE
4	2024	重庆市中小型硬科技企业	重庆市经济和信息化委员会

序号	年份	奖项/荣誉/资质	颁奖单位
5	2024	重庆市企业技术中心	重庆市经济和信息化委员会
6	2024	“中国芯”优秀技术创新产品奖	中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）
7	2024	中国 IC 设计成就奖之年度技术突破 IC 设计公司	ASPENCORE
8	2024	中国移动产投协同标杆奖	中国移动
9	2023	重庆市渝北区科技创新优秀企业	重庆市渝北区人民政府
10	2023	重庆市渝北区优秀民营企业	中共重庆市渝北区委、重庆市渝北区人民政府
11	2023	国家级专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
12	2023	中国最具潜力无线连接芯片企业	芯榜
13	2023	中国 IC 设计成就奖之年度技术突破 IC 设计公司	ASPENCORE
14	2023	重庆市渝北重点软件信息企业	重庆市渝北区人民政府

发行人在持续深耕技术创新的同时，积极加入行业组织，推动产业生态发展。发行人先后成为国际星闪无线短距通信联盟成员、中国移动物联网联盟首批创始会员，并加入中国电子工业标准化技术协会 RISC-V 工作委员会等各类行业组织，深度参与行业标准制定与生态建设，为行业发展贡献重要力量。

（四）研发项目情况

1、主要在研项目情况

报告期内，发行人研发投入聚焦于以下两类：（1）新产品开发及现有芯片的迭代升级。该类项目通常涉及芯片工艺调整，多数需要重新开发光罩并流片，属于重大产品创新类项目。其目标是紧跟市场发展趋势与竞争需求，持续提升芯片性能、集成度与性价比，增强公司在网络通信及端侧智能领域的市场竞争力。（2）基于已量产芯片的持续性软件与算法开发，包括 SDK 版本迭代、各类算法及软件平台的持续优化等。该类项目仅针对软件及算法进行优化升级，一般不形成新产品。其目标是通过不断打磨配套软件与算法生态，降低客户二次开发门槛，提升方案粘性与产品附加值，从而构建差异化的软硬件一体竞争力。

截至本招股说明书签署之日，发行人正在从事的新产品开发及现有芯片的迭代升级创新研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	项目介绍	项目目标	项目进度
1	Wi-Fi 7 AP 芯片	首款 Wi-Fi 7 AP 芯片项目，依托自研高功率 PA 和高性能 LNA、高性能射频收发器及成熟基带与 MAC 技术，面向办公室、商场等高密度场景提供高带宽、低时延、抗复杂干扰的无线网络接入能力	计划完成整套 Wi-Fi 7 AP 芯片产品方案研发，支持双天线、双频带通信能力，适配各类高阶信号调制与多链路协同传输规范，满足行业高端性能参数要求，实现自研技术应用落地并实现持续稳定的商业化收益	研发中
2	Wi-Fi 6 AP 芯片优化迭代	原 Wi-Fi 6 AP 芯片的优化迭代版本，聚焦芯片成本、功耗与性能优化，提升 Wi-Fi 6 AP 芯片的市场竞争力	相较原有 Wi-Fi 6 AP 芯片 WQ9301，优化芯片成本、降低功耗并提升性能，增强产品市场竞争力	研发中
3	2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片优化迭代	原 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片的优化迭代版项目，聚焦芯片成本、功耗与性能优化，提升 Wi-Fi 6 STA 芯片的市场竞争力	相较原有 Wi-Fi 6 STA 芯片 WQ9201，优化芯片成本、降低功耗并提升性能，实现芯片面积大幅缩减、数字电路功耗显著下降、功率放大器饱和功率有效提升、外围 BOM 精简，增强产品市场竞争力	研发中
4	低功耗 Wi-Fi 6 STA 芯片	基于第一代 Wi-Fi 6 STA 芯片，专为 IPC 领域研发的低功耗 Wi-Fi 6 STA 芯片项目	完成芯片设计验证、流片、封装回片、测试及 SDK 开发、应用推广全流程，集成 Wi-Fi 与低功耗蓝牙技术，具备高集成度、强计算能力、低功耗与低成本优势，实现低功耗 Wi-Fi 6 终端芯片量产交付，达成业界领先的低功耗指标与通信性能	研发中
5	定制支持 SDR 功能低功耗 Wi-Fi 6 STA 芯片	本项目系为满足客户 SDR 功能需求的定制化项目，基于低功耗 Wi-Fi 6 STA 芯片，重点开发四大定制化 SDR 软件功能：低功耗 Wi-Fi 6 增强、Wi-Fi 与蓝牙协议协同、SoC 低功耗及安全启动	完成客户所需的 SDR 功能定制开发，打造符合需求的芯片产品并快速导入其供应链；技术上重点实现低功耗 Wi-Fi 6 增强、Wi-Fi 与蓝牙协议协同、SoC 低功耗优化及安全启动功能，从而打破低功耗网络摄像机市场壁垒，提升公司定制化芯片竞争力，深化与客户合作	研发中
6	定制先进制程智能音频主控芯片开发	本项目系定制开发芯片，面向智能穿戴与端侧 AI 应用，可适配旗舰级 AI TWS 耳机、AI 眼镜、高端音箱、AI 会议系统等端侧 AI 产品	采用 6nm 先进工艺，集成 2.4G/5G 双频低功耗 Wi-Fi 6、蓝牙、上下行音频解决方案及端侧 AI 模块，搭载多核 RISC-V 架构 SoC 内核，并整合第三方 IP 与定制音频加速器，具备高集成度、强计算能力与低功耗特性，旨在打造一款在低功耗、通信性能、计算能力及音频方案上均具显著竞争力的旗舰穿戴芯片。填补公司在高端先进制程领域的布局空白，助力其在旗舰 AI TWS 耳机、AI 眼镜等智能穿戴领域建立领先地位；同时满足合作伙伴对高端端侧 AI 产品的定制需求，以高性价比方案覆盖更多终端产品，提升公司品牌价值，并依托芯片生命周期内的大规模出货实现良好商业回报	研发中

7	第三代智能音频主控芯片优化迭代	基于第三代智能音频主控芯片的优化迭代项目，聚焦制造优化与成本降低，提升产品毛利率	面向中低价位 TWS 耳机市场，在本土晶圆厂完成 22nm 成熟工艺投片，实现芯片制造来源多元化；通过架构优化、模块适配、面积压缩等方式降低芯片成本，满足中低价位品牌 TWS 耳机冲量需求，提升产品市场竞争力与毛利率	研发中
8	定制智能音频主控芯片开发	本项目系面向耳机特定形态要求而开发的定制芯片	采用高密度封装的方式完成定制化芯片的开发，匹配客户的产品应用	研发中
9	定制 AI 智能视觉处理芯片升级	基于客户定制的 AI 智能视觉处理芯片迭代升级项目，通过增加接口支持、兼容性提升等实现技术改进，打造更具市场竞争力的芯片产品	通过新增接口适配，提升兼容性；同时完成数字通路架构拓展与调试功能新增，模拟环节增强接口能力，以及软件层面对新增功能的开发和调试，最终实现产品性能优化，顺利达成量产	研发中

2、报告期内研发投入情况

发行人高度重视技术与产品研发，报告期内，发行人的研发投入均费用化，研发费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	23,472.59	25,107.80	28,972.20
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
占营业收入的比例	41.55%	48.85%	98.10%

（五）核心技术人员与研发人员情况

1、核心技术人员情况

发行人核心技术人员的认定标准为：在公司产品相关的技术领域有对口的专业背景和深厚的技术基础，长期从事公司产品领域的技术工作；有一定的技术创新实力、技术开发组织管理能力；加入公司时间较长，所从事技术领域的产品对公司的营业收入贡献较大。

综合上述认定标准，发行人将林豪、古强和韦韧认定为核心技术人员。核心技术人员情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、（四）核心技术人员的简要情况”。

2、研发人员情况

（1）研发人员认定口径

发行人研发人员为公司技术创新和产品研发的主体部门的人员，具有与公

司研发项目相关的工作经验、与公司研发方向相关的专业背景，或通过内部培养具备与研发项目相匹配的专业胜任能力。

（2）研发人员分布情况

报告期各期末，公司研发人员情况及其占员工总数的比例情况如下：

单位：人

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
研发人员	229	259	306
其中：博士	4	4	5
硕士	122	129	151
本科及以下	103	126	150
研发人员占员工总数比例	69.60%	72.75%	75.37%

3、对核心技术人员实施的约束激励措施

发行人与核心技术人员均签订了保密协议及竞业限制协议，对保密及竞业限制事项进行了约定，严格规范其在职及离职后的行为。同时，发行人为核心技术人员提供了富有竞争力的工资及奖金机制，将研发创新情况作为考核的重要一环，鼓励技术与管理创新；发行人还通过股权激励的形式对核心技术人员进行了中长期激励，使个人利益与公司利益相结合，更好地保障核心技术人员的稳定性。

4、发行人核心技术人员的变动情况

报告期内，发行人核心技术人员任职稳定，未发生变动。

（六）保持技术创新的机制、技术储备及技术创新的安排

1、发行人持续技术创新机制

（1）完善的研发创新组织体系

发行人已建立完善的研发创新组织体系和规范的研发流程，为持续开展技术创新提供坚实的组织保障。发行人下设数字平台部、通信与算法部、模拟部、软件部等核心研发部门，在各产品线项目研发过程中推行矩阵式平台化管理模式。研发流程完整涵盖立项、计划、设计、开发、验证、量产阶段，通过市场销售部、研发部、芯片运营部等多部门协同联动，确保研发工作高效、有

序推进。在有效保障产品研发的专业性，推动核心技术能力持续积淀的同时，明确了项目责任人和各成员的分工与目标，显著提升研发任务的完成质量与实施效率，为技术创新成果快速落地转化提供了有力支撑。

（2）市场需求导向的创新机制

在技术迭代速度加快、市场竞争趋于激烈的行业背景下，捕捉市场需求、提前预判需求趋势，是维持创新活力、强化核心竞争力的关键所在。发行人始终坚持市场需求导向的创新理念，高度重视市场需求的调研、分析与预判工作。通过开展全方位、多维度市场调研，深入剖析市场及客户的最新需求与核心痛点；并结合行业技术发展趋势、竞争对手动态等多方位因素，定期对市场需求趋势进行科学研判，据此制定贴合市场实际需求的产品研发与技术创新策略，力争实现提前布局、响应市场及客户的需求变化，确保公司技术创新与产品研发方向始终契合行业发展潮流与市场核心需求。

（3）系统的人才培养机制

集成电路设计行业属于典型的知识密集型、人才密集型行业，研发团队的稳定性、专业性及创新能力，直接决定公司的持续发展潜力与核心竞争优势。发行人高度重视人才队伍建设，通过社会招聘、校园招聘、内部推荐等多元渠道，广泛吸纳行业内优质人才，持续壮大研发团队整体实力。针对新入职研发员工，发行人建立带教制度，安排经验丰富的研发骨干一对一指导，助力新员工快速融入公司研发文化、熟悉研发流程及技术布局。同时，发行人定期组织研发相关部门开展内部培训、技术研讨交流活动，鼓励研发人员积极参与行业峰会、协会交流、区域技术研讨等外部活动，拓宽研发人员技术视野、开阔创新思路，助力研发人员持续提升专业技术能力与创新水平。

（4）长效激励机制

为充分调动研发人员的主观能动性与创新积极性，保障研发团队的创新性、凝聚力与稳定性，发行人建立了完善的“绩效考评+长期激励”相结合的激励体系。发行人将技术创新成果、研发项目推进进度、核心技术突破情况等，作为研发人员绩效考核的重要参考指标，并将考核结果与员工激励直接挂钩，充分激发研发人员的创新热情与工作动力。针对资深研发骨干、核心技术人

员，公司推行长期股权激励计划，将研发人员的个人利益与公司的长远发展深度绑定，有效增强研发骨干的归属感、责任感与忠诚度，激励研发人员长期投身于核心技术研发与创新工作，为公司持续技术创新提供稳定、可靠的人才支撑。

（5）重视知识产权及核心技术保护

发行人高度重视知识产权管理与核心技术保护工作，已建立完善的知识产权管理制度及专业管理团队，形成“专利保护+专有技术保密”相结合的全方位、多层次技术保护体系。发行人在研发过程中形成的创新成果，一部分通过申请发明专利、实用新型专利等方式进行知识产权确权保护，另一部分以非专利技术形式实施严格管控。发行人与全体研发人员及核心岗位员工签署的劳动合同中，均明确约定保密条款，同时定期开展保密教育培训、强化员工保密意识，规范核心技术资料的管理、使用与传递流程。发行人将核心技术视为企业核心战略资产，通过全方位保护措施，确保以自有知识产权为主导的核心技术体系不受侵害，保障公司技术创新的自主性、独立性与可持续性。

2、发行人技术储备及技术创新安排

发行人拥有的技术储备详见招股说明书本节之“六、（四）研发项目情况”。

发行人技术创新安排将围绕智能终端、网络通信及定制芯片领域的核心技术优势，结合行业发展趋势与下游客户需求，持续推进产品迭代与技术创新，进一步升级优化现有技术体系、突破关键技术瓶颈，巩固并提升行业领先地位，同时持续拓展新的产品品类与应用领域，增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

发行人系采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业，不直接从事晶圆制造、封装测试或其他生产加工工作，经营过程中不会产生工业废水、废气和噪声等污染物，主要污染物为研发办公人员日常办公所产生的生活垃圾和生活污水，其中，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，生活污水统一排入市政污水管网。

八、境外生产经营情况

发行人设立境外子公司香港物奇、新加坡物奇作为境外销售及研发基地，基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司简要情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经天健会计师事务所审计的财务报告。投资者欲了解详细情况，应认真阅读本招股说明书所附的经审计的财务报表及附注。非经特别说明，本节引用数据均为合并报表口径。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
流动资产：			
货币资金	275,071,791.62	77,611,680.83	362,441,607.10
交易性金融资产			
应收票据	1,300,000.00	4,225,392.45	16,090,052.06
应收账款	113,260,995.16	128,658,136.28	102,600,860.14
应收款项融资			
预付款项	21,094,426.76	25,340,240.03	30,403,995.04
其他应收款	550,266.69	660,000.18	1,657,035.57
存货	265,609,426.98	257,578,753.21	116,167,229.44
其他流动资产	47,039,519.50	68,386,063.14	36,881,277.99
流动资产合计	723,926,426.71	562,460,266.12	666,242,057.34
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产	8,803,313.83	10,873,119.59	16,965,416.07
在建工程			
使用权资产	11,737,646.71	18,259,477.46	6,899,031.18
无形资产	21,949,650.32	29,150,388.59	42,470,111.73
长期待摊费用	-	499,281.42	2,703,942.58
递延所得税资产			
其他非流动资产			

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
非流动资产合计	42,490,610.86	58,782,267.06	69,038,501.56
资产总计	766,417,037.57	621,242,533.18	735,280,558.90
流动负债：			
短期借款	60,143,761.26	30,033,000.00	-
应付票据	-	20,169,959.65	-
应付账款	22,875,573.41	37,860,836.49	24,359,874.92
预收款项			
合同负债	96,994,140.78	4,162,706.43	43,115.04
应付职工薪酬	49,207,409.36	37,298,730.39	51,709,319.50
应交税费	1,820,740.88	2,229,441.77	3,911,524.16
其他应付款	20,294,875.65	20,964,571.97	21,844,667.87
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	12,873,403.67	9,645,794.18	6,685,543.76
其他流动负债	6,258,488.62	2,115,207.69	5,604.96
流动负债合计	270,468,393.63	164,480,248.57	108,559,650.21
非流动负债：			
长期借款	9,900,000.00	15,840,000.00	-
租赁负债	5,830,715.43	12,780,571.18	748,890.37
长期应付款			
预计负债			
递延收益	2,826,079.48	4,543,091.59	2,213,255.34
递延所得税负债			
非流动负债合计	18,556,794.91	33,163,662.77	2,962,145.71
负债合计	289,025,188.54	197,643,911.34	111,521,795.92
所有者权益：			
股本	261,865,000.00	249,000,000.00	249,000,000.00
资本公积	1,068,387,435.43	814,748,515.83	775,803,215.62
减：库存股			
其他综合收益	1,793,054.14	1,068,562.53	1,665,649.16
盈余公积			
未分配利润	-854,653,640.54	-641,218,456.52	-402,710,101.80
归属于母公司所有者权益合计	477,391,849.03	423,598,621.84	623,758,762.98

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
少数股东权益			
所有者权益合计	477,391,849.03	423,598,621.84	623,758,762.98
负债和所有者权益总计	766,417,037.57	621,242,533.18	735,280,558.90

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	564,968,297.18	513,975,487.95	295,346,901.62
其中：营业收入	564,968,297.18	513,975,487.95	295,346,901.62
二、营业总成本	785,388,120.41	737,174,466.46	603,540,130.52
其中：营业成本	454,165,810.96	401,919,881.74	216,836,113.06
税金及附加	1,302,464.77	1,164,816.98	1,034,795.41
销售费用	44,840,227.91	39,123,790.11	41,978,989.91
管理费用	47,016,592.38	47,394,531.40	60,607,083.40
研发费用	234,725,915.14	251,077,987.77	289,722,046.85
财务费用	3,337,109.25	-3,506,541.54	-6,638,898.11
其中：利息费用	2,656,007.83	693,479.88	370,430.51
利息收入	1,482,744.19	3,587,881.47	5,970,865.72
加：其他收益	11,304,969.68	8,451,590.49	11,958,132.34
投资收益（损失以“-”号填列）	665,471.22	372,915.06	2,318,023.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,148,184.91	-2,599,990.98	95,920.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,091,236.38	-21,523,063.78	-6,626,866.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	200.47	29,817.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-213,392,433.80	-238,497,327.25	-300,418,201.61
加：营业外收入	1,165.57	0.84	14,316.74
减：营业外支出	43,915.79	11,028.31	25,790.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,435,184.02	-238,508,354.72	-300,429,675.19
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,435,184.02	-238,508,354.72	-300,429,675.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	-213,435,184.02	-238,508,354.72	-300,429,675.19

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	-213,435,184.02	-238,508,354.72	-300,429,675.19
2.少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	724,491.61	-597,086.63	-49,754.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	724,491.61	-597,086.63	-49,754.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	724,491.61	-597,086.63	-49,754.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	724,491.61	-597,086.63	-49,754.61
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-212,710,692.41	-239,105,441.35	-300,479,429.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-212,710,692.41	-239,105,441.35	-300,479,429.80
归属于少数股东的综合收益总额			

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	714,964,778.88	534,741,752.59	321,000,711.72
收到的税费返还	48,024,300.44	16,341,234.54	8,415,115.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,755,499.89	13,029,633.62	11,329,255.42
经营活动现金流入小计	771,744,579.21	564,112,620.75	340,745,082.86

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	524,629,703.16	596,164,619.33	281,129,170.24
支付给职工以及为职工支付的现金	203,509,259.88	238,453,812.82	254,170,031.83
支付的各项税费	3,333,726.63	4,929,609.31	4,430,963.12
支付其他与经营活动有关的现金	56,467,681.34	55,537,974.60	32,383,956.32
经营活动现金流出小计	787,940,371.01	895,086,016.06	572,114,121.51
经营活动产生的现金流量净额	-16,195,791.80	-330,973,395.31	-231,369,038.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,104.30	300.00	3,301.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	590,665,471.22	157,372,915.06	1,142,318,023.34
投资活动现金流入小计	590,667,575.52	157,373,215.06	1,142,321,324.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,965,197.12	2,882,689.62	48,255,527.78
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	157,000,000.00	1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计	600,965,197.12	159,882,689.62	1,188,255,527.78
投资活动产生的现金流量净额	-10,297,621.60	-2,509,474.56	-45,934,202.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	217,000,000.00	-	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	90,100,000.00	59,800,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	307,100,000.00	59,800,000.00	300,500,000.00
偿还债务支付的现金	63,960,000.00	10,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,415.43	535,000.00	304.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6,477,077.40	9,997,015.12	10,454,654.77
筹资活动现金流出小计	72,587,492.83	20,532,015.12	10,954,958.94

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生的现金流量净额	234,512,507.17	39,267,984.88	289,545,041.06
四、汇率变动对现金的影响	-1,408,982.98	234,958.72	1,246,411.22
五、现金及现金等价物净增加额	206,610,110.79	-293,979,926.27	13,488,210.77
加：期初现金及现金等价物余额	68,461,680.83	362,441,607.10	348,953,396.33
六、期末现金及现金等价物余额	275,071,791.62	68,461,680.83	362,441,607.10

二、注册会计师审计意见类型

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了“天健审〔2026〕14545 号”标准无保留意见的《审计报告》。审计意见如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物奇微电子 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、关键审计事项及重要性水平

（一）关键审计事项

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
收入确认	针对收入确认，审计程序主要包括：（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；（3）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；（4）选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、报关单、运输单、客户签收单等；（5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；（6）实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；（7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；（8）对主要客户进行实地走访，了解客户与公司之间的交易情况、合作历史、信用政策、定价及结算方式、是否存在关联关系及其他利益安排；（9）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
存货可变现净值	针对存货可变现净值，审计程序主要包括：（1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；（3）选取项目评价存

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；（4）评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；（5）测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；（6）结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；（7）检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，财务报表披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的境外经营实体	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的承诺事项	公司将重组、并购、资产抵押及质押等事项认定为重要承诺事项
重要的或有事项	单项金额超过资产总额 5%
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况等事项认定为重要的资产负债表日后事项

另外，金额虽未达到上表标准，但公司认为较为重要的相关事项，亦属于重要财务会计信息。

四、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定，并基于本节“六、主要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、合并报表范围及变化

（一）报告期内合并财务报表范围情况

报告期内，发行人纳入合并范围的主体具体如下：

序号	公司名称	是否合并		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	上海物骐微	是	是	是
2	物奇科技	是	是	是
3	香港物奇	是	是	是
4	长沙物奇微	是	是	是
5	杭州物奇微	是	是	-
6	新加坡物奇	是	是	是
7	北京物奇	是	-	-
8	上海物麒	-	-	是
9	智联讯科	-	-	-

2023 年 12 月 15 日，重庆智联讯科科技有限公司取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《核准注销登记通知书》，不再纳入合并范围。

2024 年 2 月 23 日，上海物麒科技有限公司取得上海市浦东新区自由贸易试验区市场监督管理局核发的《核准注销登记通知书》，不再纳入合并范围。

（二）分部信息

发行人主要业务为端侧智能芯片与网络通信芯片的研发、设计及销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，无需披露分部信息。

六、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则和计量方法

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带

来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、发行人收入确认的具体方法

公司经营业务包括芯片销售业务以及定制开发及技术服务，收入确认具体方法如下：

（1）芯片销售业务

公司芯片销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

（2）定制开发及技术服务

公司提供定制开发及技术服务属于在某一时点履行履约义务。公司在已经提供的定制开发及技术服务、将技术服务成果交付给客户并经客户验收后确认收入。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（三）金融工具

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（四）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收财务公司承兑汇票		

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率	
	应收账款	其他应收款
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

应收账款/其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（五）存货

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。发出存货采用月末一次加权平均法。存货的盘存制度为永续盘存制。公司低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计

售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（六）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧方法	折旧年限	净残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	3 年	3.00%-5.00%	31.67%-32.33%
专用设备	年限平均法	3 年	3.00%-5.00%	31.67%-32.33%
运输工具	年限平均法	6 年	5.00%	15.83%

（七）无形资产与研发支出

1、无形资产的确认与摊销

无形资产包括软件、IP 使用权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	按预期收益期限确定使用寿命 3-5 年	直线法
IP 使用权	按预期收益期限确定使用寿命 2-10 年	直线法

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2、研发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研发支出的具体归集范围包括如下：

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料；2）不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费

按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

（6）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

（7）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、通讯费等。

（八）股份支付

股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支

付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（九）合同履行成本

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（十一）政府补助

政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资

产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十二）重要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司不存在重要会计政策及会计估计的变更，与可比上市公司不存在较大差异。

七、税项

（一）主要税种及税率

目前，公司适用的主要税种包括：增值税、城市维护建设税、企业所得税等，其税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、6.00%、3.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、17%、16.5%、15%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7.00%、5.00%

教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2.00%

报告期内，发行人不同企业所得税税率纳税主体如下：

序号	纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	发行人	25%	25%	25%
2	物奇科技	15%	15%	15%
3	上海物骐微	15%	15%	15%
4	香港物奇	16.5%	16.5%	16.5%
5	新加坡物奇	17%	17%	17%
6	长沙物奇微	20%	20%	20%
7	杭州物奇微	20%	20%	-
8	北京物奇	20%	-	-
9	上海物麒	-	20%	20%
10	智联讯科	-	-	20%

（二）主要税收优惠

1、增值税优惠

（1）根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，发行人子公司上海物骐微、物奇科技销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。发行人子公司上海物骐微、物奇科技享受上述优惠政策。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）的规定：增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税，本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。发行人子公司杭州物奇微、上海物麒根据该规定减征增

值税，子公司长沙物奇微 2023 年 1 月至 2025 年 2 月根据该规定减征增值税，2025 年 3 月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人不再享受上述优惠政策。

（4）根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，发行人子公司上海物骐微、物奇科技报告期内从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税。

2、所得税优惠

（1）经重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局复审通过，公司子公司物奇科技公司于 2023 年取得编号为 GR202351102811 的高新技术企业认定证书，报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。

（2）经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局审核通过，公司子公司上海物骐微于 2022 年和 2025 年分别取得编号为 GR202231006341 和 GR202531004189 的高新技术企业认定证书，报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）文件的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。发行人子公司长沙物奇微、杭州物奇微、北京物奇、上海物骐、智联讯科报告期内被认定为小型微利企业，享受上述优惠政策。

3、其他税收优惠

根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。发行人子公司长沙物奇微、杭州物奇微、北京物奇、上海物麒、智联讯科报告期内被认定为小型微利企业，享受上述优惠政策。

（三）主要税种税收缴纳情况

1、增值税

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交数	-6,246.84	-3,221.88	-2,706.34
本期缴纳数	208.52	382.42	355.38
期末未交数	-3,945.52	-6,246.84	-3,221.88

2、企业所得税

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交数	-	-	-
本期缴纳数	-	-	-
期末未交数	-	-	-

八、非经常性损益情况

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，并由天健会计师出具最近三年《非经常性损益的鉴证报告》。报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益	-1.39	-0.95	0.81

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	680.92	515.75	475.15
委托他人投资或管理资产的损益	66.55	37.29	231.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.89	-0.14	1.03
非经常性损益合计	743.19	551.96	708.79
减：所得税影响金额	-	-	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	743.19	551.96	708.79
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	743.19	551.96	708.79
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-

非经常性损益主要系发行人收到计入当期损益的政府补助。

九、发行人主要财务指标

（一）基本指标

主要财务指标	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
资产负债率（合并）	37.71%	31.81%	15.17%
资产负债率（母公司）	0.09%	3.32%	0.26%
流动比率（倍）	2.68	3.42	6.14
速动比率（倍）	1.69	1.85	5.07
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.82	1.70	2.51
主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	4.43	4.21	2.57
存货周转率（次/年）	1.57	1.96	1.46
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	-22,086.71	-24,402.79	-30,751.75
息税折旧摊销前利润（万元）	-18,400.52	-20,775.31	-27,735.71
利息保障倍数（倍）	-79.36	-342.93	-810.03
研发投入占营业收入的比例	41.55%	48.85%	98.10%
每股经营活动现金流量（元）	-0.06	-1.33	-0.93
每股净现金流量（元）	0.79	-1.18	0.05

上述财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=总负债/总资产；

- （4）应收账款周转率=营业收入 / 平均应收账款余额；
- （5）存货周转率=营业成本 / 平均存货余额；
- （6）息税折旧摊销前利润=净利润+利息支出+所得税+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销+使用权资产摊销；
- （7）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）；
- （8）每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额；
- （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额；
- （10）每股净资产=期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额；
- （11）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

（二）净资产收益率和每股收益

发行人按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	-47.38%	-0.84	-0.84
	2024 年度	-45.54%	-0.96	-0.96
	2023 年度	-43.97%	-1.21	-1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	-49.03%	-0.86	-0.86
	2024 年度	-46.60%	-0.98	-0.98
	2023 年度	-45.01%	-1.24	-1.24

十、经营成果分析

报告期内，公司主要经营成果如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
毛利	11,080.25	11,205.56	7,851.08
营业利润	-21,339.24	-23,849.73	-30,041.82
利润总额	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
归属于上市公司股东的净利润	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,086.71	-24,402.79	-30,751.75

依托深厚的研发积累及持续的技术创新，发行人不断丰富产品种类、拓展应用领域、深化客户合作，并持续推进产品研发与迭代升级，报告期内，发行人营业收入呈现大幅增长趋势，复合增长率达 38.31%。

（一）营业收入构成及变动分析

1、营业收入构成及变动趋势分析

报告期内，公司的营业收入总体情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

如上表，报告期内公司营业收入全部为主营业务收入。

2、主营业务收入构成分析

报告期内，主营业务按类别分为芯片产品收入、定制开发及技术服务收入及其他。公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、芯片产品	56,369.28	99.77%	51,120.54	99.46%	28,409.42	96.19%
端侧智能芯片	45,470.45	80.48%	44,167.03	85.93%	17,486.90	59.21%
网络通信芯片	10,898.84	19.29%	6,953.52	13.53%	10,922.52	36.98%
二、定制开发及技术服务	84.20	0.15%	240.32	0.47%	1,038.02	3.51%
三、其他	43.35	0.08%	36.68	0.07%	87.25	0.30%
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 29,534.69 万元、51,397.55 万元和 56,496.83 万元，整体呈现逐年增长趋势。

公司芯片产品持续升级迭代，已形成端侧智能芯片、网络通信芯片等多品类芯片的广泛覆盖。在端侧智能芯片领域，公司产品已广泛覆盖智能终端、智能家居、汽车电子及 3D 视觉处理等 AIoT 应用场景，并深度应用于智能眼镜、智能耳机等可穿戴智能设备领域。凭借持续的技术积累与市场拓展，公司在相

关领域已形成较为突出的技术优势与市场优势，端侧智能芯片成为公司营业收入快速增长的重要驱动力。在网络通信芯片领域，发行人产品涵盖 Wi-Fi 芯片和 PLC 芯片。其中，Wi-Fi 芯片从早期 Wi-Fi 4 系列产品起步，到 Wi-Fi 6 STA 芯片量产，进而在 2025 年度成功量产技术难度最高的 Wi-Fi 6 AP 芯片，可适配智慧家庭、工业控制等不同条件下的无线传输场景的通信需求，是截至目前极少数具备量产能力的中国大陆企业，并于 2025 年四季度开始小批量交付。依托稳定的性能与较高的性价比，已逐步打开市场，将成为公司业务增长的新动力。

除芯片产品销售外，发行人紧跟行业发展趋势，依托长期积淀的自主研发实力与丰富的自主 IP 资源，积极布局 SoC 芯片定制服务领域，专注于为下游多行业客户提供定制化芯片解决方案及配套技术服务。该服务不仅能够有效助力客户在各自细分领域实现新产品开发迭代与性能升级，更将发行人底层技术能力与客户的垂直场景深度融合，形成双向锁定的长期战略合作关系，从而助力发行人与优质客户共同构筑差异化竞争壁垒，夯实可持续增长的基础。

（1）端侧智能芯片

公司端侧智能芯片相关产品包括智能音频主控芯片和智能视觉处理芯片。报告期各期，公司端侧智能芯片分产品收入情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能音频主控芯片	32,090.29	70.57%	40,067.36	90.72%	14,435.20	82.55%
智能视觉处理芯片	13,380.16	29.43%	4,099.67	9.28%	3,051.71	17.45%
合计	45,470.45	100.00%	44,167.03	100.00%	17,486.90	100.00%

报告期各期，公司端侧智能芯片销售收入分别为 17,486.90 万元、44,167.03 万元及 45,470.45 万元，2024 年较 2023 年大幅增长，2025 年同比略有增长，整体保持较高水平。其中，智能音频主控芯片销售收入分别为 14,435.20 万元、40,067.36 万元和 32,090.29 万元，呈现先大幅增长后小幅回落的阶段性特征；智能视觉处理芯片销售收入分别为 3,051.71 万元、4,099.67 万元和 13,380.16 万元，目前销售规模虽相对较小，但持续快速增长，展现出良好的市场发展潜

力。

报告期内，公司智能音频主控芯片产品总体实现较大幅度销售增长，主要得益于三大因素：一是销售渠道快速拓展，有效扩大了产品市场覆盖范围；二是产品持续迭代升级，形成差异化竞争优势；三是公司提供的服务支持获得市场及下游客户广泛认可，提升了客户粘性与产品认可度。2025 年度，受部分最终用户内部供应链体系调整影响，该等用户部分产品切换使用其自产芯片，对发行人采购量有所减少，使得该类芯片当年度销售收入出现回落。尽管短期销售规模受单一客户采购策略波动影响有所下滑，但公司智能音频主控芯片系列凭借开放的低功耗的“连接+AI+音频”的主控 SoC 平台能力，正加速向其他新兴场景拓展。随着新兴场景的持续渗透及客户结构的进一步优化，该业务有望在更广阔的端侧智能终端设备市场实现持续增长，具备较强的业务韧性与长期增长潜力。

报告期内，公司智能视觉处理芯片在 3D 机器视觉、智能编解码等领域具有较强的技术竞争力，深度应用于智能家居、智能视频显示等下游领域，形成了清晰的产品应用场景布局。自 2023 年末定制智能视觉处理芯片产品研发成功并推向市场以来，公司持续投入研发资源进行多次技术迭代升级，不断优化产品的兼容性、稳定性及核心功能。截至 2025 年度，该芯片产品性能已获得市场广泛认可，接受度显著提高，带动销售数量及销售金额实现大幅增长，成为公司智能视觉处理芯片业务增长的核心驱动力。

（2）网络通信芯片

公司深耕网络通信芯片领域，相关产品包括 Wi-Fi 芯片和 PLC 芯片两大品类。报告期各期，公司网络通信芯片分产品收入情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Wi-Fi 芯片	3,647.21	33.46%	788.35	11.34%	1,936.82	17.73%
PLC 芯片	7,251.62	66.54%	6,165.16	88.66%	8,985.70	82.27%
合计	10,898.84	100.00%	6,953.52	100.00%	10,922.52	100.00%

报告期各期，公司网络通信芯片销售收入分别为 10,922.52 万元、6,953.52

万元和 10,898.84 万元，整体呈现阶段性下行后恢复的态势。其中，Wi-Fi 芯片销售收入分别为 1,936.82 万元、788.35 万元和 3,647.21 万元，经历阶段性波动后再次大幅增长，主要得益于公司产品持续迭代升级及下游市场推广成效逐步显现；PLC 芯片销售收入分别为 8,985.70 万元、6,165.16 万元和 7,251.62 万元，报告期内总体保持相对平稳，略有回落。

Wi-Fi 芯片业务方面，随着全球数字经济加速演进，千兆宽带、智慧家庭网络、工业互联网等多元化应用场景已逐步实现规模化落地，以 Wi-Fi 6/7 为代表的新一代无线连接技术已成为支撑上述场景高效运行的核心基础设施，市场需求持续释放。公司坚持长期主义研发理念，在 Wi-Fi 芯片领域持续加大研发投入、推进技术迭代升级，逐步构建起完整的 Wi-Fi 芯片产品矩阵。在产品资质与应用层面，发行人 Wi-Fi 6 AP 芯片已通过国家无线电监测中心检测中心认证、中国移动芯片入库审查及相关资质审查，预计于 2026 年度完成中国移动网关集采测试后启动批量供货；Wi-Fi STA 芯片已构建起覆盖 Wi-Fi 4 至 Wi-Fi 6 的全系列产品矩阵，可广泛应用于电视、安防监控、网络摄像机、平板电脑、机顶盒、投影仪等各类终端设备，适配多元下游需求。在客户拓展与项目落地层面，发行人已与创维集团、客户 A、客户 B、星网锐捷等知名下游客户建立深度合作关系，合作粘性持续增强。目前，发行人 Wi-Fi 芯片收入规模整体尚处于较低水平，但随着产品逐步导入下游客户、应用场景持续拓展，未来收入有望实现持续大幅增长。

PLC 芯片业务方面，报告期内销售规模总体相对平稳，略有回落。PLC 芯片系发行人设立后首个定型量产产品，针对电力线传输环境复杂、抗干扰要求严苛、功耗控制难度较高等行业核心需求，公司采用 RISC-V 开源架构开展自主研发，通过自研 CPU 内核及异构多核设计，率先成功推出高集成度 PLC 芯片，有效降低了客户系统部署成本与设备功耗。近年来，发行人战略聚焦于短距通信与端侧智能的深度融合，将研发及市场资源优先投入 Wi-Fi 芯片和端侧智能芯片业务领域，未再针对国家电网等用户的升级需求对 PLC 芯片进行同步迭代。该芯片产品对公司的重要程度逐步降低，预计未来销售规模将进一步缩减。

（3）定制开发及技术服务

在芯片定制业务方面，公司为客户提供 SoC 芯片专业化、定制化解决方案。报告期内，发行人的定制开发及技术服务收入分别为 1,038.02 万元、240.32 万元和 84.20 万元。

3、按销售区域划分的主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类的具体情况如下：

单位：万元

区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	34,953.10	61.87%	25,464.57	49.54%	19,923.34	67.46%
境外	21,543.73	38.13%	25,932.98	50.46%	9,611.35	32.54%
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

报告期内，公司境外销售区域主要集中于中国香港，结算货币以美元为主。公司选择在中国香港开展境外销售，主要系中国香港作为全球半导体相关产品的重要贸易集散地，在外汇结算方面具备显著便利条件，且部分客户存在美元定价的偏好，该销售模式符合集成电路行业的普遍特征。报告期内，公司境外销售业务由全资子公司香港物奇负责实施完成。

4、主营业务收入按销售模式分析

公司芯片产品销售分为经销和直销两种模式，报告期内主营业务收入按销售模式分类如下：

单位：万元

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	24,922.98	44.11%	9,879.79	19.22%	14,633.66	49.55%
经销	31,573.85	55.89%	41,517.75	80.78%	14,901.03	50.45%
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

结合行业惯例、自身经营特点及终端客户核心需求，发行人采用经销与直销并存的销售模式。公司经销商核心功能主要体现在以下方面：一是为客户提供更全面的产品供给，保障客户采购需求高效落地；二是精准捕捉终端客户订货需求，为客户提供提前备货支持，提升供货响应效率；三是满足终端客户的

信用期诉求，优化公司与终端客户的整体运营效能；四是依托自身成熟的营销网络，助力公司快速拓展海外市场，拓宽业务覆盖边界。

5、按季度划分的主营业务收入构成分析

单位：万元

期间	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	9,465.60	16.75%	7,470.65	14.54%	4,385.19	14.85%
第二季度	15,364.15	27.19%	11,644.92	22.66%	7,262.05	24.59%
第三季度	16,641.40	29.46%	15,299.37	29.77%	7,998.72	27.08%
第四季度	15,025.68	26.60%	16,982.61	33.04%	9,888.73	33.48%
合计	56,496.83	100.00%	51,397.55	100.00%	29,534.69	100.00%

从分季度收入上看，公司主营业务收入主要集中在第三、四季度，主要原因如下：（1）公司正处于业务快速发展期，报告期内整体收入保持逐季度递增态势，随着全年业务的逐步推进，收入自然向下半年集中，使得第三、四季度收入占比显著高于上半年，这一趋势与公司现阶段的发展节奏高度匹配。（2）公司产品终端应用场景的下游客户，普遍存在下半年集中备货的行业惯例。一方面为应对欧美圣诞季、国内年末及春节前的终端消费旺季需求，下游厂商通常在第三、四季度加大采购力度以完成备货计划；另一方面，半导体行业下半年整体景气度相对更高，部分下游客户受行业周期及产能调配影响，也会集中在下半年推进采购与项目落地，进而带动公司主营业务收入在第三、四季度实现集中释放，导致季度收入呈现阶段性波动。综上，公司主营业务收入下半年占比较高的季节性特征，既符合自身快速发展的阶段性特点，也与集成电路行业及下游应用领域的季节性规律相一致。

6、退换货情况

报告期内，发行人退换货情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
退换货金额	86.10	8.03	632.55
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
占比	0.15%	0.02%	2.14%

报告期各期，公司退换货金额分别为 632.55 万元、8.03 万元和 86.10 万元，占当期营业收入比例分别为 2.14%、0.02%和 0.15%，占比较低，不存在大额异常退换货的情形。

7、第三方回款和现金交易

（1）第三方回款情况

报告期各期，发行人第三方回款占营业收入的比例情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
客户关联方代付	1,717.62	1,161.79	100.00
第三方回款合计	1,717.62	1,161.79	100.00
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
第三方回款占营业收入比例	3.04%	2.26%	0.34%
扣除客户关联方代付后第三方回款占营业收入比例	-	-	-

报告期各期，公司第三方回款金额分别为 100.00 万元、1,161.79 万元和 1,717.62 万元，占当年度营业收入的比例分别为 0.34%、2.26%和 3.04%，均为客户关联方代付。除该情形外，报告期内发行人不存在其他第三方回款情况。

发行人第三方回款均为真实的回款，具有合理的原因，符合发行人经营模式、行业经营特点。第三方回款主要系基于客户自身的资金周转需要安排，具有必要性、商业合理性，相关金额、比例均处于合理可控范围。

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。

（2）现金交易情况

报告期内，发行人不存在现金销售情形。

（二）营业成本构成及变动分析

1、营业成本的构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	45,416.58	100.00%	40,191.99	100.00%	21,683.61	100.00%

报告期内，公司营业成本全部由主营业务成本构成，与公司营业收入呈相同变化趋势。

2、主营业务成本按产品类别分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、芯片产品	45,322.48	99.79%	40,099.70	99.77%	20,565.10	94.84%
端侧智能芯片	37,356.20	82.25%	35,786.63	89.04%	13,977.20	64.46%
网络通信芯片	7,966.27	17.54%	4,313.07	10.73%	6,587.90	30.38%
二、定制开发及技术服务	66.99	0.15%	70.76	0.18%	1,052.03	4.85%
三、其他	27.11	0.06%	21.53	0.05%	66.48	0.31%
合计	45,416.58	100.00%	40,191.99	100.00%	21,683.61	100.00%

公司主营业务成本主要为芯片产品销售成本，芯片产品销售成本占主营业务成本的比例分别为 94.84%、99.77%和 99.79%。

3、主营业务成本按要素分析

（1）芯片产品成本要素构成情况

报告期内，公司芯片产品成本按要素构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆	28,447.69	62.77%	26,683.00	66.54%	11,676.66	56.78%
封装测试	9,083.35	20.04%	8,074.16	20.14%	5,055.64	24.58%
存储芯片	6,179.07	13.63%	4,717.63	11.76%	3,232.61	15.72%
其他成本	1,612.36	3.56%	624.91	1.56%	600.20	2.92%
合计	45,322.48	100.00%	40,099.70	100.00%	20,565.10	100.00%

发行人芯片产品主要成本包括晶圆、存储芯片等原材料成本及封装测试费用。报告期内，发行人主营业务成本构成占比总体保持稳定，各期出现的小幅波动，主要系产品销售结构变化所致。

1) 晶圆

晶圆是芯片生产的核心原材料，其采购成本也是芯片生产制造成本中占比最高的部分，报告期内，公司晶圆耗用成本占营业成本的比例维持在 60%左右。

报告期各期，公司晶圆主要供应商为供应商 A，其采购金额占公司各期晶圆采购总额的比例分别为 85.29%、89.97%和 93.62%，整体占比较高。未来，公司将坚持“自主独立”发展原则，在持续推进自身关键技术及工艺研发攻关、提升核心技术自主化水平的同时，积极培育优质国产供应商资源，稳步推进供应链多元化发展战略，建立健全供应链风险管理体系，优化供应商结构，有效降低对单一供应商的依赖程度，不断增强供应链稳定与韧性，保障公司生产经营的持续平稳。

2) 封装测试

封装测试主要指对晶圆进行封装和测试从而完成芯片成品生产的环节。报告期内，公司封装测试费占营业成本的比例在 20%左右。公司封装测试供应商主要为甬矽电子、华天科技、伟测半导体等大型封装、测试厂商。

3) 存储芯片

存储芯片系为满足 SoC 芯片功能实现及后续二次开发需求而提供可扩展存储空间的预置硬件。公司存储芯片占芯片成本的比例分别为 15.72%、11.76%和 13.63%，受产品结构影响，存储芯片的占比有所不同。公司存储芯片供应商主要为普冉半导体、深圳淇诺、兆易创新等。

4) 其他费用

其他费用主要包括 IP 授权使用费、运费以及为定制量产芯片迭代所发生技术开发成本摊销等。公司对定制智能视觉处理芯片持续进行迭代更新，产生人工成本、流片费用等技术开发成本，因该部分技术开发成本各年摊销金额有所

不同，故其他成本的占比各年有所差异。

（2）定制开发及技术服务成本要素结构

报告期内，公司芯片定制开发及技术服务成本结构如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	42.87	63.99%	61.32	86.66%	491.51	46.72%
原材料	-	-	-	-	441.12	41.93%
IP 授权使用费	17.60	26.27%	5.37	7.59%	33.01	3.14%
其他成本	6.53	9.75%	4.07	5.75%	86.39	8.21%
合计	66.99	100.00%	70.76	100.00%	1,052.03	100.00%

芯片定制开发及技术服务成本包含人工成本、光罩等原材料费用、IP 授权使用费以及其他。公司在 IP 选择过程中会综合考虑客户及项目需求、设计效率等因素，选择性地使用自研 IP 或外购 IP，因此并非所有项目均包含 IP 授权使用费。定制服务如不涉及流片环节，亦相应不会产生光罩等费用。不同项目客户需求不同，公司提供服务环节也存在差异，导致项目成本要素年度构成差异。

（三）毛利和毛利率变动分析

1、毛利构成情况分析

报告期内，公司综合毛利全部来源于主营业务收入。

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	11,080.25	100.00%	11,205.56	100.00%	7,851.08	100.00%

2、主营业务毛利额分析

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、芯片产品	11,046.81	99.70%	11,020.84	98.35%	7,844.32	99.91%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
端侧智能芯片	8,114.24	73.23%	8,380.40	74.79%	3,509.70	44.70%
网络通信芯片	2,932.56	26.47%	2,640.44	23.56%	4,334.62	55.21%
二、定制开发及技术服务	17.21	0.16%	169.56	1.51%	-14.02	-0.18%
三、其他	16.24	0.15%	15.15	0.14%	20.77	0.26%
合计	11,080.25	100.00%	11,205.56	100.00%	7,851.08	100.00%

报告期内，公司毛利额主要来源于端侧智能芯片和网络通信芯片。

3、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务各产品毛利率变动情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
一、芯片产品	19.60%	99.77%	21.56%	99.46%	27.61%	96.19%
端侧智能芯片	17.85%	80.48%	18.97%	85.93%	20.07%	59.21%
网络通信芯片	26.91%	19.29%	37.97%	13.53%	39.69%	36.98%
二、定制开发及技术服务	20.43%	0.15%	70.56%	0.47%	-1.35%	3.51%
三、其他	37.46%	0.08%	41.31%	0.07%	23.81%	0.30%
合计	19.61%	100.00%	21.80%	100.00%	26.58%	100.00%

报告期内，受产品结构波动影响，公司综合毛利率有所下滑。公司分产品毛利率波动情况如下：

（1）端侧智能芯片毛利率

报告期内，发行人端侧智能芯片毛利率变动如下表所示：

单位：万元、万颗

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	45,470.45	44,167.03	17,486.90
营业成本	37,356.20	35,786.63	13,977.20
销量	8,921.49	6,792.00	2,819.44
毛利率	17.85%	18.97%	20.07%

报告期内，发行人端侧智能芯片毛利率分别为 20.07%、18.97%和

17.85%，整体保持稳定态势，同时呈小幅下滑趋势。具体原因如下：1）智能音频主控芯片作为发行人端侧智能芯片的核心产品，在实现销售收入较快增长的同时，毛利率维持相对稳定，有效支撑了发行人端侧智能芯片整体毛利率的平稳运行，成为毛利率稳定的重要支撑；2）随着发行人为山东神驰定制的智能视觉处理芯片销售量持续增长，发行人对其销售单价逐步调低，进而导致该芯片的销售毛利率下滑，是发行人端侧智能芯片毛利率逐年小幅下滑的主要原因。上述定价策略符合定制类芯片的行业销售惯例。

（2）网络通信芯片毛利率

单位：万元、万颗

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	10,898.84	6,953.52	10,922.52
营业成本	7,966.27	4,313.07	6,587.90
销量	3,176.48	2,203.29	3,971.60
毛利率	26.91%	37.97%	39.69%

报告期内，发行人网络通信芯片的毛利率分别为 39.69%、37.97%和 26.91%。其中，2023 年度及 2024 年度毛利率保持相对稳定，2025 年度该类芯片毛利率出现比较明显下滑，具体原因包括：1）PLC 芯片系发行人自 2017 年设立后即重点研发推出的核心产品，能够充分体现公司的技术实力及产品市场竞争力，报告期内该产品保持较稳定的销售规模及毛利率水平，是支撑公司网络通信芯片产品整体毛利率表现的支柱；2）自 2024 年度发行人 2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片首次实现量产并投放市场，该产品在研发、设计阶段即定位高端市场需求，内部功能模块配置及设计指标均处于较高水平。在后续 2025 年度市场推广过程中，为获取关键客户准入资格、实现战略性市场布局，发行人采取了一定的前期让利策略，属于面向长期发展的战略性投入，从而拉低网络通信芯片毛利率表现。截至目前，该类芯片已成功导入创维集团、客户 B 等核心客户。报告期后，发行人持续推进 Wi-Fi 6 STA 芯片的技术迭代、功能合理配置及成本优化工作，该类产品毛利率将逐步回升并趋于稳定状态。

（3）定制开发及技术服务业务毛利率

报告期内，定制开发及技术服务收入分别为 1,038.02 万元、240.32 万元和

84.20 万元，其毛利率分别为-1.35%、70.56%和 20.43%，毛利率存在较大差异。芯片定制客户需求及涉及技术差异较大，不同客户合同规模也存在差异，导致毛利率水平波动较大。

4、同行业可比公司毛利率比较

报告期内，发行人与同行业 A 股上市公司毛利率水平的对比如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	38.69%	34.71%	34.20%
中科蓝讯	22.19%	22.92%	22.56%
博通集成	28.64%	34.02%	30.61%
翱捷科技	24.95%	23.19%	24.35%
国芯科技	21.83%	24.19%	21.54%
芯原股份	34.19%	39.86%	44.75%
平均	28.42%	29.82%	29.67%
发行人	19.61%	21.80%	26.58%

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

上述公司，恒玄科技、中科蓝讯主要从事端侧智能芯片；博通集成、翱捷科技主要从事网络通信芯片；国芯科技、芯原股份主要从事芯片定制服务。

报告期内，发行人主营业务综合毛利率与中科蓝讯、翱捷科技、国芯科技较为接近，总体低于其他可比公司。主要原因来自于：一方面，发行人与可比公司在具体产品及客户结构存在较明显差异。如可比公司中恒玄科技 2025 年度蓝牙音频芯片占收入比例约为 50%左右，此外产品包括智能手表/手环芯片、智能硬件等；中科蓝讯蓝牙音频芯片主要市场定位区间、客户结构与发行人存在较大差异。博通集成、翱捷科技主要从事的网络通信芯片具体细分类别、市场定位、价格区间及客户构成均有一定的差异，导致毛利率与发行人存在差异。另一方面，相对于前述可比公司经营规模，发行人正处于规模扩张的发展期，为开拓市场，结合重要战略客户导入、整体商业布局与市场开拓节奏，针对主要产品制定了相对灵活的定价策略，亦是发行人毛利率低于国内可比公司的重要原因之一。

具体来讲，发行人主要产品端侧智能芯片、Wi-Fi 芯片毛利率相对偏低原因分析如下：

（1）报告期内，发行人销售收入中端侧智能芯片占比较高，但该类芯片毛利率低于恒玄科技，与中科蓝讯持平，公司芯片毛利率低于恒玄科技核心原因主要体现在如下方面：

其一，产销规模不足导致规模效应未充分释放，进而推高采购成本。发行人作为端侧智能芯片领域的追赶者，整体产销规模与市场领先企业存在较大差距，尚未形成明显的规模效应，固定成本分摊能力较弱。在 Fabless 经营模式下，发行人核心原材料采购主要包括晶圆、存储芯片等，由于产销规模有限，在与上游晶圆厂商、存储芯片供应商等合作方的采购谈判中议价能力较弱，导致产品单位成本上升，拉低了端侧智能芯片的整体毛利率水平，该情况符合行业内追赶型企业的普遍特征。

其二，与同行业上市公司相比，发行人筹资渠道单一，产品矩阵梯度有待进一步丰富。作为行业追赶者，发行人目前的产品矩阵仍在持续扩充中，现有芯片产品定位于性能全面、配置高端，预留了充足的性能冗余量，以覆盖主流技术指标。然而，在具体客户细分应用领域，受限于研发资源及营运资金，发行人尚未能通过系统级成本优化设计，及时开发并提供更加适配目标市场需求的“优化迭代型”产品。基于整体商业布局与市场开拓节奏考量，面对部分重要战略终端客户需求时，发行人需被动将现有中高端配置芯片对应的晶圆裸片，通过适当调整辅料、优化封装工艺衍生出中低端产品，从而快速响应战略用户采购需求。在该等运营策略下，发行人相关产品实际售价低于其配置对应的合理定价，进而阶段性压低了端侧智能芯片的毛利率。

针对上述影响毛利率的因素，发行人将采取以下针对性措施，推动端侧智能芯片毛利率稳步回升：一是进一步拓展销售渠道，扩大产品产销规模，逐步释放规模效应，从而提升与上游供应商的议价能力，降低原材料采购成本。二是聚焦细分市场需求，依托研发项目中部分产品的优化迭代措施不断落地，构建更加具有梯度的产品矩阵，主动推进“产品分级”策略，精准匹配不同细分市场的需求特征，提升产品定价合理性，进而带动销售毛利率回升，增强发行人的盈利能力与市场竞争力。

（2）报告期内，发行人 Wi-Fi 芯片新品类持续投放市场，销售收入实现稳步增长，但总体仍处于市场导入期。该类芯片产品毛利率不同年度波动较大，

低于可比公司的原因主要体现如下：

Wi-Fi 芯片产品属于典型的高性能数模混合芯片，研发过程具有资金投入规模大、回报周期相对较长的显著特点。一方面，Wi-Fi 芯片涉及通信协议栈、射频前端、数字基带、嵌入式处理器及安全子系统等多个高复杂度模块，单次晶圆流片成本高昂，且需经历多次设计验证、测试迭代方能达到量产标准。另一方面，下游品牌客户对芯片的性能稳定性、兼容性及功耗表现要求严苛，导入周期通常较长，期间需持续投入工程支持与方案优化资源。因此，Wi-Fi 芯片业务在前期阶段面临较高的研发资本沉淀和较慢的利润释放节奏。

发行人深刻认识到，高端 Wi-Fi 芯片的技术壁垒必须通过系统性的难点攻关来突破。为此，在 Wi-Fi STA 芯片研发之初便坚持以顶配功能为设计目标，核心目的并非短期市场回报，而是通过挑战最严苛的技术指标，将关键模块的设计难点逐一吃透。正是在这一自上而下的高规格研发过程中，发行人逐步积累了多代可复用的核心 IP 与技术经验，形成了“设计—验证—优化”的良性技术迭代路径。这一层层递进的积累具有必然性，只有在 STA 芯片上将基础技术打磨成熟，才能为后续更复杂的产品形态铺平道路。基于此，发行人于 2025 年成功研制出 Wi-Fi 6 AP 芯片，完成了从终端到路由侧的技术跨越。同时，每一代产品迭代开发完成后，必然伴随初始的流片及晶圆采购需求，这些初期产出的芯片只有通过品牌客户的实际应用与市场验证，才能获取真实的性能反馈与可靠性数据，从而为后续产品迭代提供明确的方向积累。

在市场推广层面，尽管发行人 Wi-Fi 芯片性能优势突出，但考虑到下游客户供应链价格体系相对稳定、新供应商报价通常不能显著高于原有采购价格，发行人为获取关键客户准入资格、实现战略性市场布局，采取了一定的前期让利策略，将高端芯片以更具竞争力的价格投向更广阔的应用市场，是平衡产品开发周期与市场拓展节奏的现实选择，以短期毛利率的适度承压换取客户导入与市场份额的快速提升，具备充分的业务合理性与战略必要性。

未来，随着发行人持续推进网络通信芯片的技术迭代、功能合理配置及成本优化工作，该类芯片的毛利率水平将逐步回归至正常水平，前期战略性投入所积累的客户基础与市场地位也将为后续盈利能力释放奠定坚实基础。

综上所述，发行人毛利率暂时略低于同行业可比公司具有合理原因，符合公司现阶段业务发展实际情况。未来，随着发行人网络通信芯片中 Wi-Fi 6 AP 芯片的持续实现批量销售、其他各类产品持续迭代升级稳步推进，发行人整体毛利率水平将实现显著提升，且该提升趋势具有可持续性。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额及占营业收入的比例情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	4,484.02	7.94%	3,912.38	7.61%	4,197.90	14.21%
管理费用	4,701.66	8.32%	4,739.45	9.22%	6,060.71	20.52%
研发费用	23,472.59	41.55%	25,107.80	48.85%	28,972.20	98.10%
财务费用	333.71	0.59%	-350.65	-0.68%	-663.89	-2.25%
合计	32,991.98	58.40%	33,408.98	65.00%	38,566.92	130.58%

报告期内公司期间费用金额较大，其中以研发费用为主。

发行人所处的芯片设计行业属于技术、资本密集型产业，行业内技术、产品迭代节奏较快，需持续投入充足的研发资源，才能维持公司技术与产品的核心竞争力；同时，芯片设计业务复杂程度较高，发行人在技术研发、产品迭代、团队建设与管理、市场推广及客户服务等关键环节均需持续大量投入，由此导致期间费用保持较高水平。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资及附加费用	3,182.79	70.98%	2,608.54	66.67%	2,807.74	66.88%
股份支付	843.01	18.80%	755.35	19.31%	670.11	15.96%
差旅费	136.41	3.04%	64.03	1.64%	170.87	4.07%
业务招待费	127.73	2.85%	82.56	2.11%	121.05	2.88%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售服务费	87.93	1.96%	189.19	4.84%	116.50	2.78%
广宣费	33.94	0.76%	32.05	0.82%	93.55	2.23%
折旧摊销费	16.75	0.37%	13.91	0.36%	23.42	0.56%
租赁物业及水电费	13.86	0.31%	122.92	3.14%	128.43	3.06%
其他	41.60	0.93%	43.82	1.12%	66.22	1.58%
合计	4,484.02	100.00%	3,912.38	100.00%	4,197.90	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为 4,197.90 万元、3,912.38 万元和 4,484.02 万元，占当期营业收入的比例分别为 14.21%、7.61%及 7.94%。随着发行人销售规模的持续扩大，规模效应逐步显现，销售费用率整体呈现下降趋稳的良好态势。

公司销售费用主要为工资及附加费用、股份支付和差旅费，报告期各期，前述费用合计占销售费用比例分别为 86.91%、87.62%及 92.82%。

（1）工资及附加费用

报告期内，计入销售费用的工资及附加费用分别为 2,807.74 万元、2,608.54 万元和 3,182.79 万元，占当期销售费用的比例分别为 66.88%、66.67%及 70.98%。报告期内，工资及附加费用每年略有波动，但销售人员平均薪酬 2024 年度较 2023 年度变化不大；2025 年度，公司增强对销售团队的激励，适当提高了薪酬水平，使得当年工资及附加费用有所上升。

（2）股份支付

报告期各期，公司计入销售费用的股份支付费用分别为 670.11 万元、755.35 万元和 843.01 万元，占当期销售费用的比例分别为 15.96%、19.31%和 18.80%，该部分费用系公司向员工授予激励股票所产生。

公司根据各激励对象的股票授予价格与对应公允价值的差额确认股份支付费用，并依据激励对象所属岗位性质，将其分配至销售费用，且该等股份支付费用按相关服务期分期摊销确认。具体详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响”。

（3）差旅费

报告期各期，公司计入销售费用的差旅费支出分别为 170.87 万元、64.03 万元和 136.41 万元，占当期销售费用的比例分别为 4.07%、1.64%和 3.04%。其中，2023 年度、2025 年度差旅费支出相对较高，主要系该两个年度分别处于智能音频主控芯片、Wi-Fi 芯片产品推广导入阶段，发行人销售人员需前往客户现场对接需求，并协助客户解决产品应用过程中出现的相关问题所致。

（4）销售费用率与可比公司的对比情况

报告期内，公司销售费用率与可比公司的对比情况如下：

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	1.06%	1.02%	0.77%
中科蓝讯	0.48%	0.50%	0.43%
博通集成	3.20%	2.53%	2.32%
翱捷科技	0.63%	0.91%	1.24%
国芯科技	11.28%	10.02%	12.33%
芯原股份	4.04%	5.17%	4.91%
平均值	3.45%	3.36%	3.67%
发行人	7.94%	7.61%	14.21%

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期内，发行人营业收入年均复合增长率达 38.31%，业务尚处于快速发展阶段，营业收入规模与同行业上市公司相比总体仍相对较小。发行人销售费用中的工资及附加费用、股份支付、市场开拓等刚性支出相对较高，导致报告期内销售费用率处于较高水平，但已呈现明显改善趋势。未来，随着发行人产品研发与市场推广成效逐步显现，核心产品陆续上市，产品市场认可度持续提升，营业收入规模将稳步增长，预计销售费用率将进一步下降至合理区间。

2、管理费用

公司管理费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资及附加费用	2,177.95	46.32%	2,413.14	50.92%	2,776.74	45.82%
股份支付	794.96	16.91%	794.96	16.77%	522.60	8.62%
中介机构费	532.22	11.32%	41.65	0.88%	526.09	8.68%
差旅费	394.45	8.39%	365.62	7.71%	652.48	10.77%
折旧摊销费	331.02	7.04%	540.19	11.40%	617.54	10.19%
业务招待费	159.40	3.39%	96.46	2.04%	242.83	4.01%
办公费	133.77	2.85%	160.03	3.38%	161.58	2.67%
租赁物业及水电费	67.85	1.44%	84.81	1.79%	113.45	1.87%
招聘费	10.95	0.23%	10.00	0.21%	133.50	2.20%
残保金	6.95	0.15%	31.21	0.66%	101.35	1.67%
装修费	1.24	0.03%	84.38	1.78%	160.76	2.65%
其他	90.92	1.93%	116.98	2.47%	51.78	0.85%
合计	4,701.66	100.00%	4,739.45	100.00%	6,060.71	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为 6,060.71 万元、4,739.45 万元和 4,701.66 万元。

公司管理费用主要包括工资及附加费用、股份支付、中介机构费、差旅费、折旧摊销费等支出，前述费用合计占管理费用比例分别为 84.07%、87.68% 和 89.98%。

（1）工资及附加费用

报告期内，公司计入管理费用的工资及附加费用分别为 2,776.74 万元、2,413.14 万元和 2,177.95 万元，占当期管理费用的比例分别为 45.82%、50.92% 和 46.32%，系管理费用的重要组成部分。报告期内，公司内部整体运营效率得到提升，管理人员薪酬得到有效控制。

（2）股份支付

报告期各期，公司计入管理费用中的股份支付费用分别为 522.60 万元、794.96 万元和 794.96 万元，占当期管理费用的比例分别为 8.62%、16.77% 和 16.91%，该部分费用系公司向员工授予激励股票所产生。

公司根据各激励对象的股票授予价格与对应公允价值的差额确认股份支付

费用，并依据激励对象所属岗位性质，将其分配至管理费用，且该等股份支付费用按相关服务期分期摊销确认。具体详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响”。

（3）中介机构费

报告期各期，公司计入管理费用中的中介机构费分别为 526.09 万元、41.65 万元及 532.22 万元。其中，2023 年度、2025 年度中介机构服务费金额较高，主要系公司聘请与首次公开发行股票事项相关中介机构工作发生的费用较高，包括审计评估费、律师费及相应中介机构人员的差旅费用等。

（4）差旅费

报告期各期，公司计入管理费用中的差旅费支出分别为 652.48 万元、365.62 万元和 394.45 万元，占当期管理费用的比例分别为 10.77%、7.71%及 8.39%。其中，2023 年度，发行人管理费用中差旅费支出较高，主要系当年度公司智能音频主控芯片处于产品导入期，研发工程师需频繁前往客户现场，围绕芯片在实际应用环境中的性能表现开展系统性验证、进行技术参数调优，并针对客户集成过程中出现的各类应用问题实施现场诊断与解决方案开发，相关发生的交通、住宿等费用较高所致。发行人基于谨慎性原则，该部分研发工程师差旅费未作为研发费用核算，全部计入管理费用。

（5）折旧摊销费

报告期各期，公司计入管理费用的折旧摊销费分别为 617.54 万元、540.19 万元和 331.02 万元，占当期管理费用的比例分别为 10.19%、11.40%及 7.04%。折旧摊销费逐年下降，主要系发行人上海办公室于 2022 年装修，相应装修费逐渐摊销完毕所致。

（6）管理费用率与可比公司的对比情况

报告期内，公司管理费用率与可比公司的对比情况如下：

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	3.26%	3.47%	4.87%

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中科蓝讯	1.77%	1.86%	2.08%
博通集成	2.57%	3.34%	3.21%
翱捷科技	3.70%	4.13%	4.89%
国芯科技	11.76%	8.62%	11.13%
芯原股份	4.54%	5.27%	5.11%
平均值	4.60%	4.45%	5.22%
发行人	8.32%	9.22%	20.52%

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期内，发行人营业收入年均复合增长率达 38.31%，业务尚处于快速发展阶段，营业收入规模与同行业上市公司相比总体仍相对较小。发行人管理费用中的工资及附加费用、股份支付刚性支出相对较高，导致报告期内管理费用率处于较高水平，但已呈现明显改善趋势。未来，随着发行人产品研发与市场推广成效逐步显现，核心产品陆续上市，产品市场认可度持续提升，营业收入规模将稳步增长，预计管理费用率将进一步下降至合理区间。

3、研发费用

公司研发费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资及附加费用	14,995.85	63.89%	16,988.96	67.66%	20,214.19	69.77%
股份支付	2,880.19	12.27%	2,306.81	9.19%	2,239.94	7.73%
折旧摊销费	2,206.59	9.40%	2,376.92	9.47%	1,584.74	5.47%
直接材料	1,731.09	7.37%	1,862.83	7.42%	3,390.31	11.70%
研发服务费	1,361.27	5.80%	1,166.74	4.65%	958.92	3.31%
租赁物业及水电费	297.60	1.27%	403.29	1.61%	572.97	1.98%
其他	-	-	2.24	0.01%	11.14	0.04%
合计	23,472.59	100.00%	25,107.80	100.00%	28,972.20	100.00%

报告期各期，公司研发费用分别为 28,972.20 万元、25,107.80 万元和 23,472.59 万元。

公司研发费用主要包括工资及附加费用、股份支付、折旧与摊销、直接材

料和研发服务费等，报告期内，上述合计占当期研发费用比例分别为 97.98%、98.38%和 98.73%。

（1）公司研发项目情况

根据公司相关规定，在项目研发正式开始前，研发部门需制定相应的研发项目、研发进度、研发预算投入、主要负责及参与人员等并经审批立项通过之后才能开展相关的研发活动，后续在实际开展研发活动过程中，研发投入计入相应的研发项目。

报告期内，公司主要研发项目费用支出和实施进度等情况如下：

单位：万元

序号	项目	预算	2025 年度	2024 年度	2023 年度	项目进展
1	Wi-Fi 7 AP 芯片预研	3,673.00	522.63	-	-	研发中
2	低功耗 Wi-Fi 6 STA 芯片	5,488.00	1,952.03	-	-	研发中
3	Wi-Fi 6 AP 芯片	14,000.00	5,321.03	4,141.98	3,268.23	研发中
4	2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片优化迭代	9,451.00	3,005.27	2,325.41	148.41	研发中
5	2×2 Wi-Fi 6 STA 芯片	19,295.00	3,016.06	7,073.78	6,689.57	研发中
6	第一代 Wi-Fi 6 STA 芯片	16,650.00	60.30	641.81	4,752.53	已结项
7	Wi-Fi 4 高速通信芯片	4,050.00	-	-	162.55	已结项
8	高端旗舰 6nm 端侧智能芯片预研	400.00	362.50	-	-	已结项
9	第三代智能音频主控芯片	9,820.00	4,045.90	2,460.71	2,439.46	研发中
10	第三代智能音频主控芯片优化迭代	5,230.00	2,215.21	1,809.43	5.74	研发中
11	第二代高端智能音频主控芯片	16,960.00	1,461.79	3,840.07	5,129.60	已结项
12	第二代智能音频主控芯片	24,830.00	878.49	888.46	2,899.43	研发中
13	电力线载波通信芯片	3,350.00	-	120.52	1,703.82	已结项
14	AI 3D 视觉处理芯片	5,570.00	599.44	1,570.95	1,768.52	研发中
15	其他零星项目	-	31.92	234.68	4.35	-
-	合计	-	23,472.59	25,107.80	28,972.20	-

（2）工资及附加费用

报告期内，公司计入研发费用的工资及附加费用分别为 20,214.19 万元、16,988.96 万元和 14,995.85 万元，占研发费用支出的比例分别为 69.77%、67.66%和 63.89%，系研发费用的重要组成部分。

发行人高度重视产品及技术研发投入，坚持以技术创新为核心发展驱动力，持续加大研发资源倾斜力度，已建立完善的研究人才引进、培养及激励体系，为技术创新提供了充足的人才支撑。公司研发团队人员结构合理、技术实力雄厚，依托深厚的专业知识储备、丰富的行业技术积累及丰富的研发管理经验，为公司技术创新及业务发展做出了较为突出的贡献，构建了自身核心竞争力。

发行人为研发人员提供了富有竞争力的工资及奖金机制，报告期内，公司对部分研发领域及项目进行了调整、优化，相应对研发人员进行了结构性重组和优化，公司研发费用中员工薪酬总额有所降低。

（2）股份支付

报告期各期，公司计入研发费用中的股份支付费用分别为 2,239.94 万元、2,306.81 万元和 2,880.19 万元，占当期研发费用的比例分别为 7.73%、9.19%和 12.27%，该部分费用系公司向员工授予激励股票所产生。

公司根据各激励对象的股票授予价格与对应公允价值的差额确认股份支付费用，并依据激励对象所属岗位性质，将其分配至研发费用，且该等股份支付费用按相关服务期分期摊销确认。具体详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响”。

（3）折旧摊销费

报告期各期，发行人研发费用中的折旧摊销费主要是研发使用的技术、IP 等无形资产的摊销和研发设备等固定资产的折旧。

报告期内，发行人研发费用中折旧摊销费金额分别为 1,584.74 万元、2,376.92 万元和 2,206.59 万元，占当期研发费用总额比例分别为 5.47%、9.47%和 9.40%。其中，2024 年度，研发费用中折旧摊销费支出增幅较大，主要是公司 2023 年外购 IP 使用权金额较大，在 2024 年的摊销规模较大；2025 年折旧摊销费减少，主要系部分研发设备、软件以及外购 IP 使用权已提足折旧或摊销到期所致。

（4）直接材料

报告期内，公司研发费用支出中直接材料费用分别为 3,390.31 万元、1,862.83 万元和 1,731.09 万元，占当期研发费用支出的比例分别为 11.70%、7.42%和 7.37%。直接材料支出主要系发行人根据研发项目的计划安排，进行实验和测试的光罩掩模及其他材料的费用。其中，2023 年度发行人直接材料金额较大，主要系公司当年度推出多款芯片产品进行实验和测试。

（5）研发服务费

报告期内，公司研发费用支出中研发服务费分别为 958.92 万元、1,166.74 万元和 1,361.27 万元，占当期研发费用支出的比例分别为 3.31%、4.65%和 5.80%。研发服务费主要系公司根据项目实际需求，将部分非核心研发委托外部单位研发或者进行测试费用，以及部分知识产权和 IP 授权费用。

（6）研发费用率与可比公司的对比情况

报告期内，公司研发费用率与可比公司的对比情况如下：

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	19.59%	18.92%	25.27%
中科蓝讯	9.19%	8.92%	11.35%
博通集成	26.64%	32.99%	42.43%
翱捷科技	34.03%	36.68%	42.92%
国芯科技	63.23%	56.26%	63.06%
芯原股份	41.64%	53.72%	40.51%
平均值	32.39%	34.58%	37.59%
发行人	41.55%	48.85%	98.10%

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期内，发行人研发费用率高于同行业可比公司平均水平，主要原因系：1）发行人业务尚处于快速发展阶段，营业收入规模与同行业上市公司相比总体仍相对较小；2）发行人始终坚持自主研发，推进包括 Wi-Fi 6 STA 芯片、Wi-Fi 6 AP 芯片、端侧智能芯片等多款产品的技术迭代、产品升级，持续投入充足的研发资源，以保证公司在相关领域的核心竞争力。

未来，随着发行人产品研发与市场推广成效逐步显现，核心产品陆续上市，市场认可度持续提升，营业收入规模将稳步增长，预计研发费用率将进一步

步下降至同行业平均区间。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息费用	265.60	79.59%	69.35	-19.78%	37.04	-5.58%
减：利息收入	148.27	44.43%	358.79	-102.32%	597.09	-89.94%
汇兑损益	191.24	57.31%	-79.20	22.59%	-120.70	18.18%
银行手续费	25.14	7.53%	17.98	-5.13%	16.85	-2.54%
合计	333.71	100.00%	-350.65	100.00%	-663.89	100.00%

公司财务费用主要由利息费用、利息收入和汇兑损益等组成。报告期各期，公司财务费用分别为-663.89 万元、-350.65 万元及 333.71 万元，主要由利息费用、利息收入和汇兑损益等组成；公司财务费用占当期营业收入的比例分别为-2.25%、-0.68%及 0.59%，整体占比较小。

（五）税金及附加

报告期内，公司税金及附加具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
印花税	110.66	91.80	43.21
城市维护建设税	11.13	14.36	35.12
教育费附加	5.08	6.19	15.05
地方教育费附加	3.38	4.13	10.03
车船税	-	-	0.07
合计	130.25	116.48	103.48

报告期内，公司税金及附加金额分别为 103.48 万元、116.48 万元及 130.25 万元，占当期营业收入比例分别为 0.35%、0.23%及 0.23%，整体占比较小。

（六）其他收益

报告期内，公司其他收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	171.70	155.33	118.85
与收益相关的政府补助	836.01	652.85	922.54
代扣个税手续费返还	38.09	30.62	37.01
增值税加计抵减	84.70	6.36	117.41
合计	1,130.50	845.16	1,195.81

其中，与日常活动相关的政府补助的明细如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/ 与收益相关
1	工业和信息化专项资金	630.00	-	-	与收益相关
2	即征即退增值税返还	155.09	137.10	447.39	与收益相关
3	临港新片区高新产业和科技创新专项	94.75	113.36	-	与资产相关
4	临港管委会产业补贴-集成电路产业支持	76.95	41.97	118.85	与资产相关
5	租金补贴	21.26	21.20	5.34	与收益相关
6	升规提质扶持	19.20	-	-	与收益相关
7	稳岗补贴	2.33	24.93	2.79	与收益相关
8	高企再次认定奖励	3.00	-	-	与收益相关
9	知识产权资助	3.00	-	1.20	与收益相关
10	知识产权扶持	1.93	-	-	与收益相关
11	集成电路产业补贴	-	173.56	29.11	与收益相关
12	对上市、挂牌企业实施分阶段、分层次奖补	-	150.00	-	与收益相关
13	安商育商财政扶持	-	130.07	228.53	与收益相关
14	软件和信息服务专项资金	-	15.00	-	与收益相关
15	“专精特新”补助	-	-	70.00	与收益相关
16	中小企业专项补贴	-	-	58.00	与收益相关
17	研发补贴	-	-	46.48	与收益相关
18	科技创新产业补助	-	-	33.00	与收益相关
19	其他	0.20	1.00	0.70	与收益相关
合计		1,007.71	808.18	1,041.39	-

（七）投资收益

报告期内，公司投资收益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
理财产品收益	66.55	37.29	231.80
合计	66.55	37.29	231.80

报告期各期，公司投资收益均为银行理财收益；从投资收益的金额及占比来看，其对公司盈利情况不构成重大影响。

（八）信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	0.38	13.72	10.21
应收账款坏账损失	119.23	-181.94	58.44
其他应收款坏账损失	-4.79	-91.78	-59.06
合计	114.82	-260.00	9.59

报告期各期，公司信用减值损失金额分别为 9.59 万元、-260.00 万元及 114.82 万元，主要是按照会计政策计提的应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备等。

（九）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-609.12	-2,152.31	-662.69
合计	-609.12	-2,152.31	-662.69

报告期各期，公司资产减值损失金额分别为-662.69 万元、-2,152.31 万元及 -609.12 万元，均为按照会计政策计提的存货跌价准备。公司存货跌价准备的计提情况详见招股说明书本节之“十一、（一）流动资产分析”之“6、（3）存货跌价准备分析”。

（十）资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
使用权资产处置收益	-	-	2.98
固定资产处置收益	-	0.02	-
合计	-	0.02	2.98

报告期内，公司资产处置收益主要为使用权资产处置收益所产生，该部分收益金额较小，对公司整体财务状况及经营成果均不构成重大影响。

（十一）营业外收支

1、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废利得	-	-	0.38
其他	0.12	0.00	1.05
合计	0.12	0.00	1.43

报告期各期的营业外收入均计入当期非经常性损益，对整体财务状况及经营成果均不构成重大影响。

2、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	1.39	0.97	2.56
其他	3.01	0.14	0.02
合计	4.39	1.10	2.58

报告期各期的营业外支出均计入当期非经常性损益，对整体财务状况及经营成果均不构成重大影响。

（十二）尚未盈利或存在累计未弥补亏损的影响

报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-30,042.97 万元、-

23,850.84 万元和-21,343.52 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-30,751.75 万元、-24,402.79 万元和-22,086.71 万元。截至 2025 年末累计未分配利润为-85,465.36 万元，发行人报告期内尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损。

1、原因分析

（1）发行人仍处于战略性研发投入期

为保持技术先进性，发行人报告期内持续进行大额的研发投入，不断更新迭代现有产品并开展新产品的研发工作。

报告期内，公司研发投入分别为 28,972.20 万元、25,107.80 万元及 23,472.59 万元，分别占当期营业收入的 98.10%、48.85%及 41.55%，处于较高水平。而公司目前仍处于快速发展阶段，实现的产品销售收入暂时无法完全抵消公司各项投入及费用对净利润的影响，因此报告期内尚未盈利且在报告期末存在累计未弥补亏损。

（2）规模效应尚未显现

报告期内，公司主营业务收入分别为 29,534.69 万元、51,397.55 万元和 56,496.83 万元，年均复合增长率达 38.31%。公司业务虽处于快速发展阶段，但营收规模与同行业上市公司相比仍然偏小。未来，随着公司市场拓展和收入增长，规模效应将从以下方面逐步显现：一是提升固定成本分摊效率：公司 IP 核开发、流片、SDK 开发、验证测试等前期投入较大的固定成本，将随产品产销量增长被大幅摊薄；二是增强供应链议价能力：发行人采购规模扩大后，能够有效推动与晶圆代工厂商、封测厂商议价能力，从而获取更优惠晶圆采购价格条款及产能保障，降低原材料采购及封装测试环节的成本；三是加快研发资源复用与技术迭代：公司成熟产品的技术平台和底层架构可复用于新一代芯片设计，从而减少重复开发投入；四是客户服务与市场拓展的边际成本下降：公司标准化的技术支持与 SDK 开发方案能够覆盖更多客户，单个客户服务成本随规模显著降低。此外，行业头部客户的标杆效应亦有助于公司减少市场开拓费用，销售费用率随收入增长逐步优化。

随着产品迭代及市场化的进度加快，预计发行人销售规模有望持续扩大，

规模效应有望带动盈利能力逐步改善。

（3）为吸引与留住优秀人才，确认大额股份支付费用

集成电路设计行业属于典型的技术、人才与资本密集型行业。公司发展早期，为保持产品与技术的核心竞争优势，并快速拓展销售渠道、提升品牌知名度，组建了实力雄厚的研发与销售团队。为实现对优秀人才的持续吸引与长期留任，公司对骨干员工实施了广泛的股权激励，由此确认了大额股份支付费用。报告期内，公司确认的股份支付费用分别为 3,487.53 万元、4,214.89 万元和 4,978.39 万元，占当期营业收入的比例分别为 11.81%、8.20%和 8.81%，对当期净利润以及期末大额未弥补亏损造成了一定程度的影响。

2、影响分析

（1）对现金流的影响

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因系随着公司销售规模扩大，存货、应收账款、预付款项等经营性项目增加，以及为持续提升核心技术和产品竞争力，公司进行大额研发投入导致经营活动现金流出。

报告期内，公司通过引入外部投资机构、向银行借款等方式进行融资，筹资活动产生的现金流量净额分别为 28,954.50 万元、3,926.80 万元和 23,451.25 万元，可以覆盖经营活动现金流量净额为负造成的不利影响及扩大投资的需求。截至 2025 年末，发行人流动资产为 72,392.64 万元，其中货币资金合计为 27,507.18 万元；此外，公司与国内多家银行建立了良好的合作关系，并于 2025 年 6 月与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订总额度为 8,000.00 万元的综合授信，可随时提用，为公司提供了额外现金来源，进一步支持公司持续的营运资金需求。综上，公司现金流状况良好，资金流转不存在重大风险，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司现金流产生重大不利影响。

（2）对业务拓展的影响

发行人自设立以来，专注于通信类 SoC 芯片及软件解决方案的研发和销售，致力于短距通信与端侧智能的深度融合，产品主要应用于网络通信与端侧智能两大领域。报告期内，公司推出的以智能音频主控芯片为代表端侧智能系列芯片产品，广泛应用于智能耳机、智能眼镜等终端设备，客户深度覆盖哈曼

JBL、客户 A、客户 B、传音、影目等市场一线知名智能终端设备品牌；此外，在网络通信芯片领域，公司历经多年研发，推出基于 RISC-V 架构 Wi-Fi 6 AP 芯片，是截至目前极少数具备量产能力的中国大陆企业，并于 2025 年四季度开始小批量交付；公司 Wi-Fi STA 芯片覆盖 Wi-Fi 4 至 Wi-Fi 6 全系列，应用于电视、安防等领域，深度服务创维集团等客户；同时，公司正加速研发 Wi-Fi 7 AP 芯片，加快高端 Wi-Fi 芯片的自主独立进程。综上，报告期内公司各主要业务发展良好，产品研发及市场竞争力不断增强，公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司业务拓展产生重大不利影响。

（3）对人才吸引和团队稳定的影响

发行人高度重视研发团队建设，已建立严格科学的人才引进与培养体系，同时构建了科学高效、体系完善的研发及创新激励机制，培育形成一支全建制、专业能力扎实、研发经验深厚的研发团队。此外，发行人通过实施员工持股计划，有效激发员工工作主动性与创造性，切实增强团队稳定性及员工归属感，为公司各项业务有序推进提供坚实支撑。凭借上述完善的激励机制，尽管发行人尚未盈利且存在累计未弥补亏损，但该情形不会对其人才吸引力及研发团队稳定性产生重大不利影响。

（4）对研发投入和战略投入的影响

研发活动作为发行人业务发展的重要支柱，研发投入亦属于公司的战略性投入，发行人每年投入大量资金进行产品技术升级和迭代更新。未来，发行人将继续通过持续研发投入，不断进行产品迭代升级，保证核心技术的先进性，增强产品核心竞争力，尚未盈利及存在累计未弥补亏损不会对公司研发投入和战略性投入产生重大不利影响。

（5）对生产经营可持续性的影响

报告期内，发行人现有主要业务发展态势良好，产品研发实力及市场竞争力持续提升。发行人持续优化产品结构，随着业务持续推进，销售规模将进一步扩大，盈利能力将逐步增强，并能够通过持续经营活动产生稳定现金流入。同时，本次股票发行上市后，若募集资金投资项目顺利实施并达成预期收益，发行人未来亏损收窄乃至实现盈利的可能性较大，尚未盈利及存在累计未弥补

亏损的情形，不会对生产经营可持续性产生重大不利影响。

综上，发行人尚未盈利及存在累计未弥补亏损的情况对发行人现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略投入、生产经营可持续性等方面均不存在重大不利影响。

3、趋势分析

一方面，在国家宏观产业政策的大力扶持下，发行人 Wi-Fi 系列芯片、端侧智能系列芯片产品，契合我国经济高质量发展战略及科技创新发展规划，深度布局于国家网络安全保障自主独立、新质生产力培育的关键技术领域，对提升网络入口安全防护能力、打破核心芯片技术瓶颈、保障半导体产业链安全稳定、推动核心芯片自主化进程具有重要意义。另一方面，发行人持续优化产品结构，在巩固并提升现有 Wi-Fi 6 STA 芯片、Wi-Fi 6 AP 芯片、端侧智能芯片相关市场占有率及客户粘性的基础上，积极拓展下一代 Wi-Fi 7 AP 芯片和端侧 AI 芯片的产品布局与市场份额，进一步拓宽市场发展空间，为后续业务增长奠定坚实基础。

综合上述因素，未来随着公司收入规模的进一步扩大，公司盈利能力将得以改善，公司减少亏损甚至实现盈利的可能性较大，盈利后累计未弥补亏损将逐步获得弥补。关于公司未来实现盈利的前瞻性信息及具体趋势分析详见招股说明书本节之“十六、未来实现盈利的前瞻性信息”。

上述趋势信息为发行人管理层基于发行人的经营状况及市场发展状况做出的预测，受到上述多重因素的影响，该等预测性信息与未来的实际情况可能存在一定的偏差。发行人提醒投资者注意，相关假设的数据基础及相关预测具有较大不确定性，投资者在进行投资决策时应谨慎使用。

4、风险因素

发行人已在本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”披露了报告期内尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损的风险。

十一、资产质量分析

报告期各期末，公司资产规模及构成情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	72,392.64	94.46%	56,246.03	90.54%	66,624.21	90.61%
非流动资产	4,249.06	5.54%	5,878.23	9.46%	6,903.85	9.39%
资产总计	76,641.70	100.00%	62,124.25	100.00%	73,528.06	100.00%

报告期内，公司资产结构相对稳定，各期流动资产占总资产的比重分别为 90.61%、90.54%和 94.46%，均在 90%以上。公司为集成电路设计企业，采取 Fabless 经营模式，该模式下发行人专注于从事芯片的研发设计与销售的工作，将晶圆制造、封装、测试等生产环节分别委托给第三方晶圆制造和封装测试企业完成，上述资产结构符合发行人业务特点。

2025 年度，发行人流动资产绝对金额及占总资产比例均有所增长，主要原因系发行人当年度引入新股东增资，银行存款金额增加导致。

（一）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产规模及其构成如下所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	27,507.18	38.00%	7,761.17	13.80%	36,244.16	54.40%
应收票据	130.00	0.18%	422.54	0.75%	1,609.01	2.42%
应收账款	11,326.10	15.65%	12,865.81	22.87%	10,260.09	15.40%
预付账款	2,109.44	2.91%	2,534.02	4.51%	3,040.40	4.56%
其他应收款	55.03	0.08%	66.00	0.12%	165.70	0.25%
存货	26,560.94	36.69%	25,757.88	45.80%	11,616.72	17.44%
其他流动资产	4,703.95	6.50%	6,838.61	12.16%	3,688.13	5.54%
流动资产总计	72,392.64	100.00%	56,246.03	100.00%	66,624.21	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 66,624.21 万元、56,246.03 万元和 72,392.64 万元，由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货及其他流动资产构成。

1、货币资金

（1）货币资金构成情况

公司货币资金包括银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。报告期各期末，公司货币资金构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行存款	27,507.18	100.00%	6,846.17	88.21%	36,244.16	100.00%
其他货币资金	-	-	915.00	11.79%	-	-
资金总计	27,507.18	100.00%	7,761.17	100.00%	36,244.16	100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为 36,244.16 万元、7,761.17 万元和 27,507.18 万元，主要由银行存款构成，占同期流动资产的比例分别为 54.40%、13.80%和 38.00%。

2024 年末，发行人货币资金余额减少，主要原因系当年末为满足生产经营备货需求，存货余额相应增加所致。2025 年度，发行人完成股权融资和银行信贷融资，同时经营活动现金流显著改善，当期末货币资金余额大幅度增加。

（2）受到限制的货币资金情况

报告期内，公司使用有限制的货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
银行承兑汇票保证金	-	915.00	-
合计	-	915.00	-

2、应收票据

（1）应收票据构成情况

报告期各期末，公司应收票据的主要情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
银行承兑汇票	130.00	415.36	1,341.13
财务公司承兑汇票	-	7.56	281.97
账面余额小计	130.00	422.92	1,623.10

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
减：坏账准备	-	0.38	14.10
应收票据合计	130.00	422.54	1,609.01

报告期内，公司收到的应收票据包括银行承兑汇票和财务公司承兑汇票，公司应收票据不存在未能兑付的情形或风险。

（2）财务公司承兑汇票的坏账准备

报告期内，公司应收票据中财务公司承兑汇票的坏账准备计提情况如下：

单位：万元

时间	账面原值	计提比例	坏账准备	账面价值
2025/12/31	-	5%	-	-
2024/12/31	7.56	5%	0.38	7.18
2023/12/31	281.97	5%	14.10	267.87

公司收到的财务公司承兑汇票付款期限（含应收账款账龄连续计算）均在一年以内，参照应收账款预期信用损失的会计估计，按 5%的比例计提坏账准备。报告期内，公司收到的财务公司承兑汇票均能按期兑付，不存在已到期未兑付的情况，不存在被后手追索的情况。公司对财务公司承兑汇票计提的坏账准备能够覆盖可能存在的信用损失，坏账准备计提充分。

（3）应收票据终止确认情况

截至报告期各期末，公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	251.35	-	206.60	156.76	-	-
财务公司承兑汇票	-	-	-	7.56	-	-
合计	251.35	-	206.60	164.32	-	-
期后兑付情况	251.35	-	206.60	164.32	-	-

注：期后兑付的截至日为 2026 年 4 月 30 日。

截至本招股说明书签署日，未发生被背书人或贴现银行因票据未能到期承兑向公司追索的情形。

3、应收账款

（1）应收账款余额变动分析

报告期内，公司应收账款变动具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
应收账款余额	11,928.31	13,591.08	10,800.09
应收账款账面余额增长率	-12.23%	25.84%	-11.04%
减：坏账准备	602.22	725.26	540.00
应收账款账面价值	11,326.10	12,865.81	10,260.09
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
营业收入增长率	9.92%	74.02%	10.43%
应收账款余额占营业收入比重	21.11%	26.44%	36.57%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,260.09 万元、12,865.81 万元和 11,326.10 万元。应收账款余额占营业收入比重分别为 36.57%、26.44% 和 21.11%，占比逐年下降。

公司重视应收账款管理，结合客户资质及实力、历史合作情况等，采取合理的信用政策，对于资金实力较强、历史合作和回款情况良好的客户，核定账期和额度，及时催收货款。同时，发行人明确销售团队回款责任，及时跟进客户款项结清情况。

报告期内，公司销售回款情况逐步优化，应收账款余额与实际经营情况相匹配，应收账款波动具有合理性，不存在通过放宽信用政策以实现收入增长的情形。

（2）应收账款质量分析

1）应收账款信用风险特征分析

单位：万元

时间	类型	余额	比例	坏账准备
2025/12/31	按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	11,928.31	100.00%	602.22
	合计	11,928.31	100.00%	602.22

时间	类型	余额	比例	坏账准备
2024/12/31	按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	13,591.08	100.00%	725.26
	合计	13,591.08	100.00%	725.26
2023/12/31	按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	10,800.09	100.00%	540.00
	合计	10,800.09	100.00%	540.00

公司严格按照应收账款坏账准备计提政策计提坏账，报告期各期末，公司应收账款坏账准备期末余额分别为 540.00 万元、725.26 万元和 602.22 万元，占应收账款余额的比例分别为 5.00%、5.34%和 5.05%。报告期内，公司未出现由于以前年度计提坏账准备不充分导致近期会计报表出现大额计提坏账准备的情况。

报告期内，应收账款余额中无持发行人 5%以上表决权股份的股东欠款。截至报告期末，公司关联方应收账款余额情况详见招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“八、（四）关联方往来款余额”。

2）应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	11,812.32	99.03%	12,676.88	93.27%	10,800.09	100.00%
1-2 年	115.99	0.97%	914.19	6.73%	-	-
合计	11,928.31	100.00%	13,591.08	100.00%	10,800.09	100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄主要集中在 1 年以内，账龄结构良好，回款及时，与经营模式相符，不存在大额坏账风险。

公司按照企业会计准则规定并结合行业特点和自身经营情况，制定了具体可行的坏账计提政策，公司与同行业可比公司坏账计提比例对比情况如下：

公司	6 个月以内	7-12 个月	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
恒玄科技	1.00%	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

公司	6 个月以内	7-12 个月	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
中科蓝讯	5.00%	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
博通集成	2.00%	注 2					
翱捷科技	注 3						
国芯科技	1.00%	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	70.00%	100.00%
芯原股份	注 4						
本公司	5.00%	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：数据来源于可比公司招股说明书及定期报告；

注 2：博通集成未披露 6 个月以上账龄的预期信用损失率；

注 3：翱捷科技披露预期信用损失率为，2023 年末逾期 0.55%，逾期 1 至 365 天 1.15%；2024 年末逾期 1.58%，逾期 1 至 365 天 3.47%；2025 年末逾期 1.67%，逾期 1 至 365 天 1.76%；

注 4：芯原股份结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户（R1）、美国大客户（R2）、中国台湾大客户（R3）、欧洲大客户（R4）、东亚大客户（R5）、所有中小客户（R6）、集团内关联方（R7）及高风险客户（R8）确定各评级确认应收账款的预期损失率为，2023 年 R1 为 2.47%，R2 为 0.23%，R3 为 0.33%，R4 为 0.25%，R5 为 0.29%，R6 为 65.07%，R8 为 50.19%；2024 年 R1 为 3.16%，R2 为 0.25%，R3 为 0.90%，R4 为 0.46%，R5 为 0.74%，R6 为 59.38%，R8 为 50.29%；2025 年 R1 为 3.14%，R2 为 0.25%，R3 为 0.33%，R4 为 0.24%，R5 为 0.22%，R6 为 56.37%，R8 为 62.89%。

同行业可比公司因业务及客户构成存在差异，应收账款坏账准备计提情况有所差异。报告期内，公司应收账款的坏账准备计提比例比较谨慎，符合会计准则和制度的要求，具有恰当性和合理性，不存在明显低于同行业上市公司水平情形。

3）坏账核销情况

报告期内，公司不存在坏账核销的情况。

（3）前五大应收账款情况

报告期各期末，公司前五大应收账款情况如下：

单位：万元

时间	序号	名称	与公司关系	金额	占应收账款余额比例	账龄
2025/12/31	1	山东神驰微电子有限公司	非关联方	3,748.49	31.43%	1 年以内
	2	深圳市中电拓讯科技有限公司	非关联方	1,997.88	16.75%	1 年以内
	3	深圳易莱孚智能科技有限公司	非关联方	1,525.68	12.79%	1 年以内
	4	深圳市天河星供应链有限公司	非关联方	1,136.20	9.53%	1 年以内
	5	深圳中电港技术股份有限公司	非关联方	1,064.02	8.92%	1 年以内

时间	序号	名称	与公司关系	金额	占应收账款余额比例	账龄
	-	合计	-	9,472.27	79.41%	-
2024/12/31	1	深圳市天河星供应链有限公司	非关联方	2,821.05	20.76%	1年以内
	2	深圳易莱孚智能科技有限公司	非关联方	2,188.49	16.10%	1年以内
	3	山东神驰微电子有限公司	非关联方	1,688.24	12.42%	1年以内
	4	大川智科（深圳）技术有限公司	非关联方	1,308.15	9.63%	1年以内
	5	航中天启（重庆）微电子股份有限公司	关联方	1,202.84	8.85%	1年以内
	-	合计	-	9,208.76	67.76%	-
2023/12/31	1	航中天启（重庆）微电子股份有限公司	关联方	2,459.19	22.77%	1年以内
	2	深圳市天河星供应链有限公司	非关联方	2,132.93	19.75%	1年以内
	3	山东神驰微电子有限公司	非关联方	1,923.04	17.81%	1年以内
	4	深圳中电港技术股份有限公司	非关联方	1,541.72	14.28%	1年以内
	5	北京中电创新科技有限公司	非关联方	759.77	7.03%	1年以内
	-	合计	-	8,816.65	81.63%	-

注：上表中的应收账款余额均已按照同一控制下企业合并计算。

报告期各期末，公司前五大应收账款余额合计分别为 8,816.65 万元、9,208.76 万元和 9,472.27 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 81.63%、67.76%和 79.41%，整体比较集中，符合公司收入结构。

4、预付款项

（1）预付账款余额变动情况

报告期各期末，公司预付款项分别为 3,040.40 万元、2,534.02 万元和 2,109.44 万元，占流动资产的比例分别为 4.56%、4.51%和 2.91%，主要为预付晶圆代工厂商采购款项、部分供应商技术服务款项以及其他费用类款项。

报告期各期末，发行人预付账款账龄主要为一年以内，具体如下：

单位：万元

账龄	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	2,107.72	99.92%	2,530.78	99.87%	3,040.40	100.00%
1-2年	1.72	0.08%	3.24	0.13%	-	-
小计	2,109.44	100.00%	2,534.02	100.00%	3,040.40	100.00%

账龄	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
坏账准备	-	-	-	-	-	-
合计	2,109.44	-	2,534.02	-	3,040.40	-

（2）前五大预付账款情况

报告期各期末，公司前五大预付款项情况如下：

单位：万元

期间	序号	名称	与公司关系	金额	占比	未结算原因
2025/12/31	1	供应商 A	非关联方	1,033.01	48.97%	尚未完成
	2	深圳九天睿芯科技有限公司	非关联方	600.00	28.44%	尚未完成
	3	供应商 B	非关联方	238.50	11.31%	尚未完成
	4	深圳市网力软件有限公司	非关联方	119.00	5.64%	尚未完成
	5	杭州飞巴旅行社有限公司	非关联方	28.87	1.37%	尚未完成
	-	合计	-	2,019.38	95.73%	-
2024/12/31	1	供应商 A	非关联方	1,454.51	57.40%	尚未完成
	2	深圳市仟一科技有限公司	非关联方	754.57	29.78%	尚未完成
	3	威宏科技股份有限公司	非关联方	238.05	9.39%	尚未完成
	4	杭州飞巴旅行社有限公司	非关联方	20.00	0.79%	尚未完成
	5	Wi-Fi Alliance	非关联方	17.97	0.71%	尚未完成
	-	合计	-	2,485.10	98.07%	-
2023/12/31	1	供应商 A	非关联方	2,717.30	89.37%	尚未完成
	2	视若飞信息科技（上海）有限公司	非关联方	154.84	5.09%	尚未完成
	3	成都锐成芯微科技股份有限公司	非关联方	103.77	3.41%	尚未完成
	4	Wi-Fi Alliance	非关联方	17.94	0.59%	尚未完成
	5	上海舒宜宾馆有限公司	非关联方	9.15	0.30%	尚未完成
	-	合计	-	3,003.01	98.77%	-

注：上表中的预付账款余额已按照同一控制下企业合并计算；

报告期各期末，前五名预付对象均为发行人的供应商，预付其款项属于正常的业务往来。

5、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
押金、保证金	247.57	94.48%	267.99	99.90%	275.80	99.87%
其他	14.45	5.52%	0.26	0.10%	0.36	0.13%
余额合计	262.02	100.00%	268.26	100.00%	276.16	100.00%
坏账准备	207.00	-	202.26	-	110.46	-
账面价值	55.03	-	66.00	-	165.70	-

公司其他应收款主要由应收取的押金保证金等构成。报告期各期末，其他应收款账面余额分别为 276.16 万元、268.26 万元和 262.02 万元，波动较小。

截至 2025 年 12 月末，公司其他应收款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（1）其他应收款账龄分析

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	14.65	5.59%	36.95	13.77%	73.73	26.70%
1-2 年	27.47	10.48%	32.77	12.22%	6.70	2.43%
2-3 年	32.77	12.51%	2.81	1.05%	179.25	64.91%
3 年以上	187.13	71.42%	195.73	72.96%	16.47	5.97%
合计	262.02	100.00%	268.26	100.00%	276.16	100.00%

报告期各期末，公司其他应收款预计不存在重大回收风险。

（2）其他应收款前五名

报告期各期末，其他应收款前五名单位情况如下表所示：

单位：万元

期间	序号	名称	与公司关系	金额	占比	性质	账龄
2025/12/31	1	上海张江集成电路产业区开发有限公司	非关联方	151.53	57.83%	押金、保证金	3 年以上
	2	深圳乐普大厦物业管理有限公司	非关联方	25.42	9.70%	押金、保证金	1-2 年
	3	杭州海兴电力科技股份有限公司	非关联方	20.00	7.63%	押金、保证金	2-3 年
	4	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	非关联方	16.47	6.29%	押金、保证金	注 3

期间	序号	名称	与公司关系	金额	占比	性质	账龄
	5	上海上实物业管理有限公司创领研发中心物业管理处	非关联方	16.08	6.14%	押金、保证金	3 年以上
	-	合计	-	229.49	87.59%	-	-
2024/ 12/31	1	上海张江集成电路产业区开发有限公司	非关联方	151.53	56.49%	押金、保证金	3 年以上
	2	深圳乐普大厦物业管理有限公司	非关联方	34.36	12.81%	押金、保证金	1 年以内
	3	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	非关联方	27.22	10.15%	押金、保证金	注 2
	4	杭州海兴电力科技股份有限公司	非关联方	20.00	7.46%	押金、保证金	1-2 年
	5	上海上实物业管理有限公司创领研发中心物业管理处	非关联方	16.08	5.99%	押金、保证金	3 年以上
	-	合计	-	249.18	92.90%	-	-
2023/ 12/31	1	上海张江集成电路产业区开发有限公司	非关联方	151.53	54.87%	押金、保证金	2-3 年
	2	深圳前海国虹移动信息技术有限公司	非关联方	37.40	13.54%	押金、保证金	1 年以内
	3	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	非关联方	27.22	9.86%	押金、保证金	注 1
	4	杭州海兴电力科技股份有限公司	非关联方	20.00	7.24%	押金、保证金	1 年以内
	5	上海上实物业管理有限公司创领研发中心物业管理处	非关联方	16.08	5.82%	押金、保证金	2-3 年
	-	合计	-	252.23	91.33%	-	-

注 1：2023 年末发行人针对重庆仙桃数据谷投资管理有限公司其他应收款账龄：1 年以内 3.94 万元，2-3 年 6.82 万元，3 年以上 16.47 万元；

注 2：2024 年末发行人针对重庆仙桃数据谷投资管理有限公司其他应收款账龄：1-2 年 3.94 万元，3 年以上 23.29 万元；

注 3：2025 年末发行人针对重庆仙桃数据谷投资管理有限公司其他应收款账龄：2-3 年 3.94 万元，3 年以上 12.54 万元。

6、存货

（1）存货构成及余额分析

报告期各期末，公司存货构成明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31			2024/12/31			2023/12/31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	9,737.99	1,180.94	8,557.05	8,718.52	472.24	8,246.28	2,430.67	444.99	1,985.68
库存商品	9,240.59	950.89	8,289.70	10,060.15	704.84	9,355.31	4,656.64	498.54	4,158.10
委托加工物资	7,480.75	821.58	6,659.17	7,935.87	1,291.33	6,644.55	5,379.25	149.12	5,230.13
合同履约	2,497.80	-	2,497.80	1,258.32	-	1,258.32	150.10	-	150.10

项目	2025/12/31			2024/12/31			2023/12/31		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
成本									
发出商品	583.47	26.25	557.22	279.68	26.25	253.42	92.72	-	92.72
合计	29,540.60	2,979.66	26,560.94	28,252.53	2,494.66	25,757.88	12,709.38	1,092.65	11,616.72

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 11,616.72 万元、25,757.88 万元和 26,560.94 万元，占流动资产的比例分别为 17.44%、45.80%和 36.69%，绝对额及占比波动幅度较大，系随着公司营业收入规模持续增长，为保障订单交付能力，相应扩大备货规模所致。

公司存货主要由原材料、库存商品、委托加工物资和合同履约成本构成。其中，原材料主要为晶圆厂按照公司自主研发设计的集成电路版图代工制造的晶圆；委托加工物资为在芯片封装及测试环节的晶圆；库存商品为公司可供销售的芯片产品，合同履约成本为公司提供定制芯片服务所发生的相关成本。

（2）主要存货构成及变动分析

1）原材料

报告期各期末，公司原材料余额分别为 2,430.67 万元、8,718.52 万元和 9,737.99 万元，占当期末存货余额合计的比例分别为 19.13%、30.86%和 32.96%。公司存货中原材料的金额随着收入的规模增加而增加，与收入增长具有一致性。

2）库存商品

报告期各期末，公司库存商品余额分别为 4,656.64 万元、10,060.15 万元和 9,240.59 万元，占当期末存货余额合计的比例分别为 36.64%、35.61%和 31.28%。随着收入规模的增长，公司存货中库存商品余额增加；2025 年末库存商品余额有所下降，主要系端侧智能芯片备货规模有所减少所致。

3）委托加工物资

报告期各期末，公司委托加工物资余额分别为 5,379.25 万元、7,935.87 万元和 7,480.75 万元，占当期末存货余额合计的比例分别为 42.33%、28.09%和 25.32%。公司委托加工物资的增长与收入规模的增加具有一致性。

4) 合同履行成本

报告期内公司合同履行成本主要系为山东神驰定制的智能视觉处理芯片系列发生的服务成本和为客户 B 定制的 6nm 智能音频主控芯片发生的服务成本。报告期内，发行人合同履行成本与合同约定、按项目进行的工时分配表、折旧摊销分摊表等数据勾稽一致，各期末的合同履约成本真实、准确。

(3) 存货跌价准备分析

报告期各期末，存货跌价准备分别为 1,092.65 万元、2,494.66 万元和 2,979.66 万元，存货跌价准备计提比例分别为 8.60%、8.83%和 10.09%。

报告期各期末，发行人按产品类别计提的跌价准备金额情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例
原材料	1,180.94	12.13%	472.24	5.42%	444.99	18.31%
库存商品	950.89	10.29%	704.84	7.01%	498.54	10.71%
委托加工物资	821.58	10.98%	1,291.33	16.27%	149.12	2.77%
发出商品	26.25	4.50%	26.25	9.39%	-	-
合计	2,979.66	10.09%	2,494.66	8.83%	1,092.65	8.60%

公司已根据企业会计准则及公司实际情况，审慎制定了存货跌价准备计提政策。报告期各期末，公司对存货进行减值测试，按照存货成本与可变现净值孰低的原则，对存货可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 3,688.13 万元、6,838.61 万元和 4,703.95 万元，占流动资产的比例分别为 5.54%、12.16%和 6.50%。

公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税待抵扣进项税额	4,679.06	99.47%	6,816.40	99.68%	3,677.00	99.70%

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待摊费用	24.89	0.53%	22.21	0.32%	11.13	0.30%
合计	4,703.95	100.00%	6,838.61	100.00%	3,688.13	100.00%

公司其他流动资产主要为增值税待抵扣进项税额。

（二）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产规模及其构成如下所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	880.33	20.72%	1,087.31	18.50%	1,696.54	24.57%
使用权资产	1,173.76	27.62%	1,825.95	31.06%	689.90	9.99%
无形资产	2,194.97	51.66%	2,915.04	49.59%	4,247.01	61.52%
长期待摊费用	-	-	49.93	0.85%	270.39	3.92%
非流动资产总计	4,249.06	100.00%	5,878.23	100.00%	6,903.85	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为 6,903.85 万元、5,878.23 万元和 4,249.06 万元，由固定资产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用构成。

1、固定资产

报告期各期末，公司的固定资产账面净值分别为 1,696.54 万元、1,087.31 万元和 880.33 万元，占非流动资产的比例分别为 24.57%、18.50%和 20.72%，固定资产占非流动资产的比重较大。

报告期内，公司固定资产构成明细如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
通用设备	1,313.84	197.49	1,249.32	309.39	1,206.25	495.10
专用设备	2,924.53	681.57	2,549.62	776.66	2,410.71	1,196.50
运输工具	25.31	1.27	25.31	1.27	25.31	4.94
合计	4,263.67	880.33	3,824.25	1,087.31	3,642.27	1,696.54

作为采用 Fabless 模式运营的集成电路设计企业，公司主要固定资产为研发、测试使用通用设备及专用设备等。其中，通用设备主要为电脑、服务器等，专用设备主要包括电路板、工作台和测试设备等。

报告期内各期间，公司固定资产折旧计提政策未发生变动，如下表所示：

类别	折旧方法	折旧年限	净残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	3 年	3.00%~5.00%	31.67%~32.33%
专用设备	年限平均法	3 年	3.00%~5.00%	31.67%~32.33%
运输工具	年限平均法	6 年	5.00%	15.83%

同行业可比公司的固定资产折旧计提政策如下：

项目	类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
恒玄科技	房屋建筑物	年限平均法	20 年	0%	5%
	生产设备	年限平均法	10 年	0%-5%	9.50%-10%
	电子设备	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9.50%-33.33%
	运输设备	年限平均法	4 年	0%	25%
中科蓝讯	办公、电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
	运输工具	年限平均法	4 年	5%	23.75%
博通集成	房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
	办公、电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	0%-10%	18%-33.33%
	运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
翱捷科技	研发设备	年限平均法	2 年或 5 年	0%或 5%	19%或 50%
	计算机及其他办公设备	年限平均法	2 年、5 年或 7 年	0%或 5%	14%、19%或 50%
	房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
国芯科技	通用设备	年限平均法	5-20 年	4%	4.80%-19.20%
	运输工具	年限平均法	10-15 年	4%	6.40%-9.60%
	专用设备	年限平均法	3-10 年	4%	9.60%-32.00%
	房屋及建筑物	年限平均法	20 年	4%	4.8%
芯原股份	房屋建筑物	年限平均法	20~44 年	-	2.27%-5%
	电子设备、机器设备	年限平均法	2~10 年	-	10%~50%
	器具及家具	年限平均法	2~5 年	-	20%-50%
发行人	通用设备	年限平均法	3 年	3%-5%	31.67%-32.33%

项目	类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
	专用设备	年限平均法	3 年	3%-5%	31.67%-32.33%
	运输工具	年限平均法	6 年	5%	15.83%

与同行业可比公司相比，公司固定资产折旧政策不存在显著差异，符合实际情况和企业会计准则。

报告期各期末，发行人对固定资产的减值迹象进行了分析和识别，对相关固定资产所属的资产组进行了判断，根据企业会计准则的要求，于每个资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，发行人的减值测算的过程和计算方法谨慎、合理；发行人已综合考虑运营资产的可回收金额、账面价值、运行状况等因素计提减值准备，减值准备计提充分。

2、使用权资产

公司作为承租人租赁的资产情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31			2024/12/31			2023/12/31		
	账面原值	累计折旧	账面价值	账面原值	累计折旧	账面价值	账面原值	累计折旧	账面价值
租入房屋及建筑物	1,881.40	707.63	1,173.76	1,881.40	55.45	1,825.95	1,785.71	1,095.80	689.90
合计	1,881.40	707.63	1,173.76	1,881.40	55.45	1,825.95	1,785.71	1,095.80	689.90

报告期内，发行人适用新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，将租赁确认为使用权资产和租赁负债。

报告期各期末，公司使用权资产主要为租赁的用于办公和研发的场所。

3、无形资产

公司无形资产的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
软件	754.42	14.32	758.12	121.38	735.65	286.03
IP 使用权	5,780.11	2,180.64	5,195.35	2,793.66	5,195.35	3,960.98
合计	6,534.53	2,194.97	5,953.47	2,915.04	5,931.01	4,247.01

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 4,247.01 万元、2,915.04 万元和 2,194.97 万元，占非流动资产的比例分别为 61.52%、49.59%和 51.66%，主要系外购的软件及 IP 使用权。

报告期各期末，公司不存在内部研发形成的无形资产，各项无形资产均正常使用，无减值迹象，不存在需要计提减值准备的情形。

4、长期待摊费用

公司长期待摊费用为装修工程费用。报告期各期末，长期待摊费用分别为 270.39 万元、49.93 万元和 0.00 万元。

（三）资产周转分析

1、应收账款周转情况

报告期内，公司与可比公司应收账款周转率如下所示：

单位：次/年

应收账款周转率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	9.45	8.40	6.49
中科蓝讯	27.23	32.60	28.79
博通集成	5.73	5.32	5.33
翱捷科技	11.79	11.17	10.74
国芯科技	3.03	3.14	1.87
芯原股份	2.94	2.36	2.25
平均值	10.03	10.50	9.25
发行人	4.43	4.21	2.57

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 2.57、4.21 和 4.43，低于同行业可比公司平均值。主要原因系发行人芯片业务仍处于快速发展阶段，营业收入规模整体小于同行业头部上市公司，为加快市场拓展、培育核心客户，发行人针对不同客户资信情况及行业惯例，给予客户 1 到 3 个月的信用期，以增强市场竞争力。而同行业可比公司中，恒玄科技等企业多采用先款后货或信用期限较短的结算政策，回款速度更快。受上述客户策略及结算安排影响，发行人应收账款周转率低于同行业可比公司，但报告期内发行人回款效率逐步改善，资

产周转能力持续改善。

2、存货周转情况

报告期内，公司与可比公司存货周转率对比情况如下：

单位：次/年

存货周转率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒玄科技	2.70	3.08	1.79
中科蓝讯	2.20	1.97	1.70
博通集成	1.71	1.61	1.48
翱捷科技	1.88	1.84	1.48
国芯科技	1.12	0.99	0.98
芯原股份	4.64	4.14	3.68
平均值	2.38	2.27	1.85
发行人	1.57	1.96	1.46

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期内，发行人存货周转率分别为 1.46、1.96 和 1.57，略低于同行业可比公司平均值，整体不存在重大差异。报告期内发行人营运能力持续提升，存货周转率整体有所改善。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成分析

报告期各期末，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	6,014.38	20.81%	3,003.30	15.20%	-	-
应付票据	-	-	2,017.00	10.21%	-	-
应付账款	2,287.56	7.91%	3,786.08	19.16%	2,435.99	21.84%
合同负债	9,699.41	33.56%	416.27	2.11%	4.31	0.04%
应付职工薪酬	4,920.74	17.03%	3,729.87	18.87%	5,170.93	46.37%
应交税费	182.07	0.63%	222.94	1.13%	391.15	3.51%
其他应付款	2,029.49	7.02%	2,096.46	10.61%	2,184.47	19.59%

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动负债	1,287.34	4.45%	964.58	4.88%	668.55	5.99%
其他流动负债	625.85	2.17%	211.52	1.07%	0.56	0.01%
流动负债合计	27,046.84	93.58%	16,448.02	83.22%	10,855.97	97.34%
长期借款	990.00	3.43%	1,584.00	8.01%	-	-
租赁负债	583.07	2.02%	1,278.06	6.47%	74.89	0.67%
递延收益	282.61	0.98%	454.31	2.30%	221.33	1.98%
非流动负债合计	1,855.68	6.42%	3,316.37	16.78%	296.21	2.66%
负债合计	28,902.52	100.00%	19,764.39	100.00%	11,152.18	100.00%

从负债结构来看，公司负债以流动负债为主，各期末流动负债占比分别为 97.34%、83.22%和 93.58%，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬及其他应付款等构成。

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 0.00 万元、3,003.30 万元和 6,014.38 万元，占公司负债总额的比例分别为 0.00%、15.20%和 20.81%。短期借款的具体情况如下表：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
保证借款	5,014.31	3,003.30	-
信用借款	1,000.07	-	-
合计	6,014.38	3,003.30	-

随着公司业务规模持续增长，为满足自身经营所需现金流、拓展多元化的融资渠道，公司短期借款有所增加。截至本招股说明书签署日，发行人不存在逾期未偿还的短期借款。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据的余额分别为 0.00 万元、2,017.00 万元及 0.00 万元，为公司已开具未到期的银行承兑汇票。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
货款	2,032.51	3,316.45	2,016.86
费用款	186.04	414.09	309.68
长期资产购置款	69.00	55.54	109.45
合计	2,287.56	3,786.08	2,435.99

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 2,435.99 万元、3,786.08 万元和 2,287.56 万元，主要由应付货款和费用款组成。

报告期各期末，公司前五大应付账款情况如下：

单位：万元

期间	名称	与公司关系	金额	占应付账款余额比例
2025/12/31	甬矽电子（宁波）股份有限公司	非关联方	746.32	32.63%
	北京勇旗科技发展有限公司	非关联方	498.87	21.81%
	普冉半导体（上海）股份有限公司	非关联方	272.63	11.92%
	华天科技（西安）有限公司	非关联方	223.09	9.75%
	上海伟测半导体科技有限公司	非关联方	77.16	3.37%
	合计	-	1,818.07	79.48%
2024/12/31	甬矽电子（宁波）股份有限公司	非关联方	948.32	25.05%
	珠海市晶讯物联技术有限公司	非关联方	604.27	15.96%
	天奇创建智能科技（深圳）有限公司	非关联方	345.60	9.13%
	华天科技（西安）有限公司	非关联方	305.85	8.08%
	深圳市天河星供应链有限公司	非关联方	272.87	7.21%
	合计	-	2,476.92	65.42%
2023/12/31	天奇创建智能科技（深圳）有限公司	非关联方	577.74	23.72%
	甬矽电子（宁波）股份有限公司	非关联方	554.80	22.78%
	深圳淇诺科技有限公司	非关联方	223.62	9.18%
	深圳市天河星供应链有限公司	非关联方	220.24	9.04%
	Lorentz Solution Inc	非关联方	109.45	4.49%
	合计	-	1,685.86	69.21%

注：上表中的应付账款余额均已按照同一控制下企业合并计算；

截至 2025 年 12 月末，公司应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）

表决权股份的股东单位款项。

4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
预收货款	5,142.81	416.27	4.31
预收定制开发及技术服务费	4,556.60	-	-
合计	9,699.41	416.27	4.31

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 4.31 万元、416.27 万元和 9,699.41 万元，占负债总额比例分别为 0.04%、2.11%和 33.56%，绝对额及占比均显著增长。合同负债主要反映发行人向客户转让商品之前已收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的款项，为向客户预先收取的货款及技术服务费，系正常业务产生。

2025 年末，公司预收款项余额较大，主要系当年度预收深圳市万创宏安实业有限公司芯片采购款和客户 B 技术服务费，截至本招股说明书签署之日，发行人已向深圳市万创宏安实业有限公司交付部分芯片产品。

报告期各期末，公司合同负债中，无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项、无欠关联方款项。

5、应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬余额主要由工资、奖金等短期薪酬和离职后福利-设定提存计划组成。

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 5,170.93 万元、3,729.87 万元和 4,920.74 万元，占负债总额的比例分别为 46.37%、18.87%和 17.03%，应付职工薪酬余额波动主要受职工人数、基本薪酬及奖金计提等因素影响。

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
增值税	134.99	181.38	274.67
印花税	42.92	35.31	8.16
城市维护建设税	1.16	2.54	14.95
个人所得税	1.96	1.83	82.69
教育费附加	0.63	1.13	6.41
地方教育附加	0.42	0.75	4.27
合计	182.07	222.94	391.15

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 391.15 万元、222.94 万元和 182.07 万元，占负债总额的比例分别为 3.51%、1.13%和 0.63%。公司应交税费余额呈下降趋势，主要系随着公司销售收入规模波动，应交增值税余额变动所致。

7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 2,184.47 万元、2,096.46 万元和 2,029.49 万元，主要为项目补贴款和费用报销款。其他应付款的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
项目补贴款	2,000.00	2,000.00	2,000.00
费用报销款	28.51	49.02	70.97
残保金	-	46.57	112.68
其他	0.98	0.87	0.81
合计	2,029.49	2,096.46	2,184.47

2017 年 4 月，重庆仙桃数据谷投资管理有限公司（以下简称“数据谷公司”）与物奇科技签署《协议》，物奇科技承诺在重庆渝北区投资设立公司，开展芯片研发、设计和销售工作；数据谷公司对物奇科技办公用房和实验室装修、实验设备购买、IP 购买费用、研发人员工资等给予补贴，总额不超过 2,000.00 万元。若物奇科技在渝北区未达到约定条件，数据谷公司有权要求物奇科技将已获得的补贴款项退回，因此该笔 2,000.00 万元补贴款项作为其他应付款核算。

8、一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的非流动负债的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
一年内到期的租赁负债	691.89	568.58	668.55
一年内到期的长期借款	595.45	396.00	-
合计	1,287.34	964.58	668.55

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 668.55 万元、964.58 万元和 1,287.34 万元，占负债总额的比例为 5.99%、4.88%和 4.45%，占比较低。

9、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
待转销项税额	625.85	47.20	0.56
未终止确认的应收票据	-	164.32	-
合计	625.85	211.52	0.56

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 0.56 万元、211.52 万元和 625.85 万元，占负债总额的比例分别为 0.01%、1.07%和 2.17%，主要系因合同负债产生的待转销项税金额。

10、长期借款

报告期各期末，公司长期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
保证借款	990.00	1,584.00	-
合计	990.00	1,584.00	-

截至 2023 年底，发行人长期借款无余额。

2024 年 12 月，因生产经营需要，发行人子公司上海物骐微借入三年期流动资金借款。

11、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
租赁付款额	595.04	1,316.19	77.79
减：未确认的融资费用	11.97	38.13	2.90
租赁负债净额	583.07	1,278.06	74.89

报告期内，发行人执行新租赁准则，对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

报告期各期末，公司租赁负债余额的波动情况与租赁房产的面积变化相关，房产租赁的具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、（一）主要固定资产”之“3、租赁房屋建筑物”。

截至 2025 年末，租赁负债净额为 583.07 万元，占当期负债总额比例为 2.02%，占比及余额均较小。

12、递延收益

公司递延收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	与资产相关/与收益相关
临港管委会产业补贴	51.90	146.64	-	与资产相关
NB-IoT 终端物联网 SoC 开发与应用——专项	72.00	72.00	72.00	与资产相关
工业互联网无线专网单芯片研发与应用——专项	80.00	80.00	80.00	与资产相关
集成电路产业支持	78.71	155.67	69.33	与资产相关
合计	282.61	454.31	221.33	-

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 221.33 万元、454.31 万元和 282.61 万元，占负债总额比例分别为 1.98%、2.30%和 0.98%，占比及余额均较小。

（二）偿债能力分析

1、公司偿债能力相关指标

财务指标	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
流动比率（倍）	2.68	3.42	6.14
速动比率（倍）	1.69	1.85	5.07
资产负债率（合并）	37.71%	31.81%	15.17%
资产负债率（母公司）	0.09%	3.32%	0.26%
财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	-18,400.52	-20,775.31	-27,735.71
利息保障倍数（倍）	-79.36	-342.93	-810.03

报告期各期末，发行人流动比率分别为 6.14、3.42 及 2.68，速动比率分别为 5.07、1.85 和 1.69，资产负债率（合并）分别为 15.17%、31.81%和 37.71%。

报告期内，发行人在技术研发、产品性能优化、市场渠道拓展及客户验证等领域持续投入大量资源，推动销售规模稳步增长，营运资本投资随之大幅增加。为满足产品生产及研发投入的流动资金需求，发行人新增了银行贷款等债务融资，导致流动负债总额明显上升。与此同时，发行人报告期内亏损幅度虽持续收窄，但尚未实现扭亏为盈。在上述因素共同作用下，发行人流动比率与速动比率呈下滑趋势，资产负债率有所上升。

2、偿债能力的同行业比较

报告期各期末，公司偿债能力与同行业可比公司的对比情况如下：

财务指标	公司	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
流动比率（倍）	恒玄科技	14.92	11.84	13.42
	中科蓝讯	12.51	7.99	4.57
	博通集成	6.28	6.48	7.83
	翱捷科技	4.32	7.43	8.02
	国芯科技	1.78	2.35	4.49
	芯原股份	2.25	1.71	2.86
	平均值	7.01	6.30	6.87
	发行人	2.68	3.42	6.14
速动比率	恒玄科技	12.29	10.42	11.89

财务指标	公司	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
（倍）	中科蓝讯	9.71	6.61	3.66
	博通集成	4.77	4.68	6.26
	翱捷科技	2.64	5.15	5.95
	国芯科技	0.75	1.11	2.75
	芯原股份	1.78	1.34	2.39
	平均值	5.32	4.89	5.48
	发行人	1.69	1.85	5.07
资产负债率 （合并）	恒玄科技	6.19%	7.80%	6.93%
	中科蓝讯	7.42%	11.80%	21.41%
	博通集成	14.32%	13.46%	11.52%
	翱捷科技	21.81%	13.08%	12.92%
	国芯科技	40.01%	31.42%	18.11%
	芯原股份	55.72%	54.16%	38.72%
	平均值	24.25%	21.95%	18.27%
	发行人	37.71%	31.81%	15.17%

注：同行业可比上市公司数据来源于其年度报告。

报告期各期末，发行人偿债能力指标低于同行业可比上市公司平均值，主要原因系：1）同行业可比公司经过上市融得股权资金，极大提升了偿债能力，降低了财务风险。相较可比公司，发行人融资渠道有限，发展主要靠自身积累；2）公司业务仍处于快速发展阶段，营业收入规模整体小于同行业头部上市公司，且持续在技术研发、产品性能优化、市场渠道拓展及客户验证等领域投入大量资源，仍处于未盈利阶段，导致公司偿债能力指标低于同行业可比上市公司平均值。

3、影响偿债能力的表外因素

报告期内，公司信誉良好，未发生过到期未履行的负债义务。公司在流动性方面不存在重大不利变化或风险因素，亦不存在影响偿债能力的其他重大事项。

（三）报告期内股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量的简要情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,619.58	-33,097.34	-23,136.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,029.76	-250.95	-4,593.42
筹资活动产生的现金流量净额	23,451.25	3,926.80	28,954.50
汇率变动对现金的影响	-140.90	23.50	124.64
现金及现金等价物净增加额	20,661.01	-29,397.99	1,348.82
期末现金及现金等价物余额	27,507.18	6,846.17	36,244.16

1、经营活动现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量变动分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-23,136.90 万元、-33,097.34 万元和-1,619.58 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	71,496.48	53,474.18	32,100.07
收到的税费返还	4,802.43	1,634.12	841.51
收到其他与经营活动有关的现金	875.55	1,302.96	1,132.93
经营活动现金流入小计	77,174.46	56,411.26	34,074.51
购买商品、接受劳务支付的现金	52,462.97	59,616.46	28,112.92
支付给职工以及为职工支付的现金	20,350.93	23,845.38	25,417.00
支付的各项税费	333.37	492.96	443.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,646.77	5,553.80	3,238.40
经营活动现金流出小计	78,794.04	89,508.60	57,211.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,619.58	-33,097.34	-23,136.90

公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品收到的现金，现金支出主要用于采购原材料、支付职工薪酬、缴纳税费以及日常运营付现费用。

2024 年度，受日常经营备货需求影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，同时职工薪酬支出较大，导致经营活动产生的现金流量净额为负，且

随着业务规模扩大而进一步扩大。2025 年度，公司加强库存管理与费用管控，加之当年预收深圳市万创宏安实业有限公司芯片采购款及客户 B 技术服务费，销售商品、提供劳务收到的现金显著增长，经营活动现金流量净额明显好转。

（2）销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的关系

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的关系如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	71,496.48	53,474.18	32,100.07
营业收入	56,496.83	51,397.55	29,534.69
销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率	126.55%	104.04%	108.69%

2023 年度至 2024 年度，发行人销售商品收到的现金占当期营业收入的比例相对均衡。2025 年度，发行人销售收现比率较高，主要系当年度预收深圳市万创宏安实业有限公司芯片采购款和客户 B 技术服务费。

（3）经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,619.58	-33,097.34	-23,136.90
净利润	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
差异值	19,723.94	-9,246.50	6,906.06

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润之间存在一定差异，主要系经营性应收应付项目与存货变动等因素所致，两者之间具体调整项目如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	-21,343.52	-23,850.84	-30,042.97
加：资产减值准备	609.12	2,152.31	662.69
信用减值准备	-114.82	260.00	-9.59
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,322.99	1,432.67	1,351.53
无形资产摊销	1,304.47	1,353.04	637.02

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长期待摊费用摊销	49.93	220.47	281.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-0.02	-2.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1.39	0.97	2.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	456.85	-9.85	-83.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-66.55	-37.29	-231.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,412.19	-16,293.46	4,133.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,436.15	-5,142.00	-1,947.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,158.21	2,601.77	-1,374.55
其他	4,978.39	4,214.89	3,487.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,619.58	-33,097.34	-23,136.90

2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为 19,723.94 万元，主要原因系：1）公司重视应收账款管理，结合客户资质及实力、历史合作情况等，采取合理的信用政策，对于资金实力较强、历史合作和回款情况良好的客户，核定账期和额度，及时催收货款；同时，发行人明确销售团队回款责任，及时跟进客户款项结清情况。当年度公司销售回款情况逐步优化，应收账款、应收票据、其他流动资产等经营性应收项目的减少 5,436.15 万元；2）当年度预收深圳市万创宏安实业有限公司芯片采购款和客户 B 技术服务费等，公司经营性应付项目的增加 7,158.21 万元；3）当年度确认股份支付等事项导致其他增加 4,978.39 万元。上述因素综合作用，形成经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为-9,246.50 万元，主要原因系：1）受益于销售渠道快速拓展、产品持续快速迭代升级形成的竞争优势、以及市场及客户广泛认可的服务支持，公司芯片产品实现大规模销售增长。伴随业务增长，公司积极备货，存货增加 16,293.46 万元；2）随着业务增长，应收账款、其他流动资产等经营性应收项目合计增加 5,142.00 万元；3）当年度确认股份支付等事项导致其他增加 4,214.89 万元。上述因素综合作用，形成经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为 6,906.06 万元，主要原因系：1）公司加强库存管理，存货减少 4,133.35 万元；2）当年度确认股份支付等事项导致其他增加 3,487.53 万元。上述因素综合作用，形成经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。

2、投资活动产生的现金流量分析

投资活动现金流入和流出的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.21	0.03	0.33
收到其他与投资活动有关的现金	59,066.55	15,737.29	114,231.80
投资活动现金流入小计	59,066.76	15,737.32	114,232.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096.52	288.27	4,825.55
支付其他与投资活动有关的现金	59,000.00	15,700.00	114,000.00
投资活动现金流出小计	60,096.52	15,988.27	118,825.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,029.76	-250.95	-4,593.42

公司投资活动产生的现金流出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金和支付其他与投资活动有关的现金主要系公司购买银行理财产品及赎回。

3、筹资活动产生的现金流量分析

筹资活动现金流入和流出的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	21,700.00	-	30,000.00
取得借款收到的现金	9,010.00	5,980.00	50.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	30,710.00	5,980.00	30,050.00
偿还债务支付的现金	6,396.00	1,000.00	50.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215.04	53.50	0.03

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	647.71	999.70	1,045.47
筹资活动现金流出小计	7,258.75	2,053.20	1,095.50
筹资活动产生的现金流量净额	23,451.25	3,926.80	28,954.50

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要为股东增资、银行借款，筹资活动产生的现金流出主要为偿还借款本金及利息等。

公司支付其他与筹资活动有关的现金主要系偿还租赁负债。

（五）流动性以持续经营能力分析

1、流动性风险分析

公司重视流动性风险的管理，合理利用银行融资渠道。报告期内，资产流动性较好、偿债能力较强，债务配置期限合理，不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况，不存在对流动性产生不利影响的重大事件。

随着未来首次公开发行股票募集资金的投入，公司募集资金投入项目的资金需求将进一步得到满足。

2、持续经营能力分析

报告期内，公司业务发展良好，产品研发及市场竞争力不断增强，目前虽尚未盈利，但不存在下列对持续盈利能力构成重大不利影响的因素：

（1）公司的业务和产品定位已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）公司报告期经营策略已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）公司未来经营计划对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

（4）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

在可预见的未来，公司在持续经营方面的风险因素包括但不限于报告期内尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损的风险、研发结果未达到预期或无法产业化风险、新产品推广不及预期的风险等，公司已在本招股说明书“第三

节 风险因素”中进行了分析和披露。

综合考虑公司在技术实力、产品竞争力、市场开拓等方面的较强市场竞争实力，在国家政策的大力支持下，公司有望抓住网络通信芯片及端侧智能芯片行业快速发展的市场机遇，进一步扩大销售规模并提升盈利能力，因此，发行人具备持续经营能力。

十三、报告期内重大资产重组、重大资本性支出事项

（一）报告期内重大资产重组及影响

报告期内，发行人不存在重大资产重组事项。

（二）报告期内的重大资本支出

报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 4,825.55 万元、288.27 万元和 1,096.52 万元，主要系外购的 IP 使用权。

（三）未来重大资本性支出计划及资金需求情况

报告期末，公司未来可预见的重大资本性支出计划为本次公开发行股票募集资金投资项目。本次募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，公司不存在跨行业投资的情况。

募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划投入，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行借款先期投入，待募集资金到位后以募集资金置换已投入的自筹资金或偿还银行借款。具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。除此之外，发行人无可预见的其他重大资本性支出计划。

十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十五、发行人盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

十六、未来实现盈利的前瞻性信息

假设未来公司所处行业与市场环境不发生重大变化、无重大经营决策失误、无足以严重影响公司正常运转的重大人事变动，亦未发生对经营造成重大不利影响的突发性事件或其他不可抗力因素，则基于公司自身审慎测算，预计实现扭亏的最早时间为 2028 年。

（一）未来可实现盈利的假设条件

1、宏观环境稳定：公司经营所涉及国家和地区的政治、经济、社会环境无重大不利变化；国家战略规划、产业鼓励政策及区域发展政策无重大不利调整；相关法律法规及行业监管体系保持稳定。

2、公司经营正常：公司采购活动保持正常，晶圆供应商流片进度不存在显著变化；能够持续获取客户订单，并按时交付、确认收入；不存在对公司生产经营造成重大不利影响的突发性事件或恶性竞争。

3、核心团队稳定：公司核心团队保持稳定，无重大人事变动。

4、财务假设：公司未来一定期间内继续保持以流动资产为主的资产结构；营业收入维持较快的增长水平；毛利率不会因成本端出现难以通过价格调整予以消化的不利波动，而发生显著偏离预期的情形；销售费用率与管理费用率随销售规模扩大逐步趋于常规水平，其绝对额大致维持现有水平；财务费用不会对公司实现盈利产生重要影响；研发投入维持现有水平。

（二）未来实现盈利的前瞻性分析及其依据

1、公司未来是否盈利的前瞻性信息

尽管发行人报告期内持续亏损，但各主要业务均保持良好发展态势，产品研发实力与市场竞争力稳步提升。一方面，在国家宏观产业政策的大力扶持下，发行人 Wi-Fi 系列芯片、端侧智能系列芯片深度契合我国经济高质量发展

及科技创新战略，布局于网络安全可控、新质生产力培育等关键技术领域，对提升网络入口安全防护能力、打破核心芯片技术瓶颈、保障半导体产业链安全稳定、推动核心芯片自主化进程具有重要意义。另一方面，发行人持续优化产品结构，在巩固并提升现有 Wi-Fi 6 STA 芯片、Wi-Fi 6 AP 芯片、端侧智能芯片相关市场占有率及客户粘性的基础上，积极拓展下一代 Wi-Fi 7 AP 芯片和端侧 AI 芯片的产品布局与市场份额，进一步拓宽市场发展空间，为后续业务增长奠定坚实基础。

（1）持续深化现有产品竞争优势、优化产品矩阵并深挖潜力

1）Wi-Fi 系列芯片

网络通信芯片作为现代信息社会的基石，在构建全球互联网络中发挥着不可替代的关键作用。随着 6G、人工智能、物联网及云计算等新兴产业的加速发展，网络通信芯片已逐步成为支撑数字经济高质量发展、保障国家信息安全的重要基础设施。发行人深耕网络通信芯片领域，尤其是在 Wi-Fi 芯片研发及产业化方面取得关键性突破，有力推动了 Wi-Fi AP 芯片的相关进程。发行人于 2025 年推出的基于 RISC-V 架构的 Wi-Fi 6 AP 芯片 WQ9301，是截至目前极少数具备量产能力的中国大陆企业，进一步深化了 Wi-Fi AP 芯片领域的突破与规模化量产进程，助力我国高端无线通信芯片技术突破。与此同时，发行人持续丰富 Wi-Fi 芯片产品矩阵，覆盖不同性能等级与应用场景，未来确保产品定义与市场需求精准匹配，最大限度提升销售确定性并优化库存周转效率。

2）端侧智能芯片

当前，AI 技术浪潮席卷全球，已成为驱动科技产业迭代升级的核心动力。智能终端设备的交互形态正从传统单一模态，加速向语音、视觉等多模态融合的全新形态演进。发行人端侧智能芯片以语音、视觉两大核心交互模态为技术研发与产品布局方向：依托自主研发的音频 AI 技术与低功耗 NPU 的异构协同架构，智能耳机等语音交互场景可高效实现 AI 降噪、语音唤醒等功能；面向智能眼镜、智能家居等视觉交互场景，发行人提供高性能 3D 视觉技术方案，满足深度感知、空间识别等复杂需求。上述技术布局使产品全面覆盖智能耳机、智能眼镜等穿戴设备场景，以及智能家居等多元化 AIoT 应用场景。

目前，相关芯片产品已深度覆盖荣耀、OPPO、客户 A、客户 B、哈曼 JBL、传音、影目、回车等智能终端一线知名品牌，形成了全场景、全方位的端侧 AI 技术赋能能力，构建了自身差异化竞争优势。通过丰富的端侧芯片产品矩阵，发行人未来能够精准匹配不同客户对算力、功耗、成本的差异化需求，确保产品定义与市场实际需求紧密对接，从而提升销售确定性并优化库存周转效率。上述优势与 Wi-Fi 系列芯片形成协同发展格局，进一步夯实了发行人的行业地位。

（2）发行人积极拓展 Wi-Fi 7 AP 芯片及端侧 AI 芯片领域

1）Wi-Fi 7 AP 芯片领域

作为无线局域网的核心技术，Wi-Fi 已演进至新一代 Wi-Fi 7 标准。相较于前代技术，Wi-Fi 7 通过引入 4096-QAM 高阶调制、MLO 多链路操作及最大 320MHz 信道带宽等关键技术，在单设备峰值速率及网络并发处理能力上均实现显著改进，可有效支撑 4K/8K 视频流、云游戏、AR/VR 等高带宽、低时延应用场景，适配家庭、企业各类新兴场景的无线网络需求，发展方向已从单纯提升连接速率，转向构建更智能、更融合、更确定的无线网络体验。作为新一代正在加速推广应用的无线通信技术，Wi-Fi 7 的研发与推广直接关系到数字基础设施建设水平，符合国家在“新基建”“数字中国”等战略规划中明确提出的加快发展新型网络设备的要求，市场发展前景广阔。

与发行人现有 Wi-Fi 系列芯片产品相比，未来发行人可凭借 Wi-Fi 7 AP 芯片的技术先进性与性能优势，突破高端网络设备市场，实现收入与利润的同步提升。该产品将助力发行人把握高端芯片市场发展机遇，使其在进口产品替代及国际市场开拓中占据有利地位；随着智能家居、企业网络和工业物联网对无线通信性能要求的持续提高，Wi-Fi 7 芯片将成为发行人参与这些高增长市场的关键产品，进一步完善 Wi-Fi 芯片产品矩阵。

2）端侧 AI 芯片领域

随着生成式人工智能技术的普及和物联网设备数量的激增，设备需处理的音频流、视频流等多模态数据呈指数级增长。传统的云端处理模式已难以满足 AI 智能终端设备在即时语音交互、实时视频分析等场景下的需求，因此行业技

术演进的重心逐步转向端侧，推动计算能力下沉，旨在让终端设备自身具备强大、高效且自主的音视频信息实时处理与理解能力。这不仅是技术发展的必然路径，也是重塑人机交互体验、解锁新一轮应用场景的基础，为端侧 AI 芯片带来广阔市场需求。

未来，发行人将依托已掌握的高带宽低时延通信、超低功耗数模混合设计及端侧多模态 AI 算法等核心技术能力，通过开发端侧 AI 芯片实现技术进一步集成，推动相关能力不断深化和扩展。端侧 AI 芯片是实现“云-边-端”高效协同的硬件基础，能够为下一代 AI 智能终端提供流畅、自然且安全的智能交互所必需的硬件支撑和算力保障，从根本上克服物理距离带来的延迟，有利于催生出新的应用场景，促进 AI 智能终端设备的进一步发展与应用。同时，端侧 AI 芯片的布局将进一步丰富公司产品矩阵，与现有 Wi-Fi 系列芯片、端侧智能芯片形成协同效应，持续提升发行人市场竞争力。

2、盈亏平衡要素分析

（1）营业收入

报告期各期，公司营业收入分别为 29,534.69 万元、51,397.55 万元和 56,496.83 万元，呈现大幅增长趋势，复合增长率达 38.31%。未来，发行人一方面依托领先的核心技术、丰富的经营管理经验及坚实稳定的客户基础，进一步巩固并提升现有 Wi-Fi 6 STA 芯片、Wi-Fi 6 AP 芯片、端侧智能芯片相关市场占有率；另一方面积极拓展下一代 Wi-Fi 7 AP 芯片和端侧智能芯片的产品布局，突破高端网络设备市场，进一步拓宽市场发展空间，为公司未来业务增长提供更强有力的市场支撑，实现收入与利润的同步提升。基于上述假设和分析，预计最早将于 2028 年度，发行人营业收入达到约 11~13 亿元。

（2）毛利率

报告期内，发行人综合毛利率分别为 26.58%、21.80%及 19.61%，毛利率偏低，主要原因系：1）发行人产销规模不足导致规模效应未充分释放，进而推高采购成本。发行人作为行业追赶者，整体产销规模与市场领先企业存在较大差距，尚未形成明显的规模效应，固定成本分摊能力较弱。2）作为行业追赶者，发行人目前的产品矩阵仍在持续扩充中，现有芯片产品定位于性能全面、

配置高端，预留了充足的性能冗余量，以覆盖主流技术指标。然而，在具体客户细分应用领域，受限于研发资源及营运资金，发行人尚未能通过系统级成本优化设计，及时开发并提供更加适配目标市场需求的“优化迭代型”产品。面对部分重要战略终端客户需求时，发行人需被动将现有中高端配置芯片对应的晶圆裸片，通过适当调整辅料、优化封装工艺衍生出中低端产品销售，导致相关产品实际售价低于其配置对应的合理定价，进而阶段性压低了产品毛利率。

3) 报告期内，发行人 Wi-Fi 芯片新品类持续投放市场，该类产品在研发、设计阶段即定位高端市场需求，内部功能模块配置及设计指标均处于较高水平。在市场推广层面，发行人充分考虑到下游客户供应链价格体系相对稳定，新供应商及其产品报价通常不能显著高于原有采购价格。为获取关键客户准入资格、实现战略性市场布局，发行人采取了一定的前期让利策略，将高端芯片以更具竞争力的价格投向更广阔的应用市场，是平衡产品开发周期与市场拓展节奏的现实选择，以短期毛利率的适度承压换取客户导入与市场份额的快速提升，具备充分的业务合理性与战略必要性。

综上所述，发行人毛利率暂时偏低，符合公司现阶段业务发展实际情况。针对上述影响毛利率的因素，发行人将采取以下针对性措施，推动产品毛利率稳步回升：一是进一步拓展销售渠道，扩大产品产销规模，逐步释放规模效应。二是聚焦细分市场需求，依托研发项目中部分产品的优化迭代措施不断落地，构建更加具有梯度的产品矩阵，提升产品定价合理性。

未来，随着网络通信芯片中 Wi-Fi 6 AP 芯片的持续实现批量销售、其他各类产品的持续迭代升级稳步推进，以及成本管控能力的不断优化与完善，发行人综合毛利率预计将逐步回到 30%左右的区间水平。

（3）期间费用

公司期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用和财务费用构成。报告期内，公司期间费用率较高，主要系公司为不断增强技术优势和产品竞争力，研发费用率处于较高水平。未来随着公司经营规模的不断扩大，销售费用率、管理费用率将有所下降，绝对额大致维持现有水平；财务费用方面，随着公司完成上市融资，公司财务费用率将进一步降低；研发投入方面，公司预计将在未来一定期间内仍将保持现有较高水平的绝对额投入。因此，未来几年公

司期间费用将总体波动不大。

综上，随着公司收入规模不断增长，公司经营情况将持续改善，预计未来经营亏损将逐步收窄直至实现盈利。

前述对未来期间业绩预计情况系公司审慎根据自身经营计划及扭亏为盈的具体条件作出的初步测算数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

（三）为实现盈利公司拟采取的措施

公司拟采取的措施详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“四、（三）未来规划采取的措施”。

本公司前瞻性信息是建立在推测性假设数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者应谨慎使用。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金使用管理制度及对发行人主营业务贡献

（一）募集资金使用管理制度

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。公司董事会将根据业务发展需要，按照有关要求决定募集资金专户数量和开户商业银行，并与开户银行、保荐人签订三方监管协议，合规使用募集资金。

（二）募集资金投资项目投向科技创新领域的具体安排，对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目依托发行人自主研发的核心技术，聚焦 Wi-Fi 芯片、端侧智能芯片等与主营业务高度契合的科技创新领域布局实施。

“新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目”旨在研发新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片，在公司现有 Wi-Fi 6 STA 芯片和 Wi-Fi 6 AP 芯片的基础上，进一步扩大产品矩阵，这不仅符合全球无线连接技术向更高标准迭代的趋势，也契合我国芯片设计行业持续强化自主创新与构建完善产业生态的战略方向，为公司下一阶段的发展奠定基础。

“端侧智能芯片研发及产业化项目”旨在研发新一代的端侧智能芯片，在人工智能技术快速发展的当下，对于端侧 AI 算力的需求将显著提高，公司目前已掌握高带宽低时延通信、超低功耗数模混合设计及端侧多模态 AI 算法方面的

技术能力，开发端侧智能芯片可以对相关技术进行集成，并推动这些能力不断深化和扩展。新一代端侧智能芯片的推出，将进一步巩固公司目前的市场地位，符合公司的发展规划。

“研发中心建设项目”旨在通过研发中心的建设，聚焦行业前沿方向，开展 Wi-Fi BE10000 企业级三频万兆 AP 芯片开发、Wi-Fi 7 2×2 三频带终端芯片开发、Wi-Fi 8（802.11bn）企业级三频万兆 AP 芯片开发以及可配置、生成式多场景端侧智能设备平台研发等课题研究，通过实施本项目，将使公司紧跟行业技术发展趋势，加强核心技术的预研储备，持续提高技术创新能力。

公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排补充营运资金的使用，该等资金将投向公司的主营业务，能够有效保障公司生产经营、研发投入、市场拓展等各环节的足额资金供给，确保各项业务运转的连续性与稳定性；同时可进一步优化公司资产负债结构，合理降低财务杠杆水平，有效分散经营与财务风险。

综上分析，上述项目系对公司现有核心业务、主导产品及已攻克核心技术的延伸拓展与升级优化，核心目标为依照公司整体发展战略，持续推动产品迭代升级与技术创新突破，进一步完善业务布局与健全体系建设，全面提升公司的综合竞争实力与行业影响力，为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

（三）募集资金投资项目对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次募集资金投资项目与发行人现有主营业务密切相关，有利于巩固发行人的市场地位，强化和提升核心竞争力，提高销售规模，将对发行人日常经营、财务状况和经营成果产生积极影响。

1、增加公司净资产

本次发行募集资金到位后，发行人净资产和摊薄计算的每股净资产将大幅增加，将增强发行人持续发展能力和抗风险能力。

2、改善公司财务结构

本次股票发行募集资金到位后，发行人财务结构将有较大的改善，资产负债率将明显下降。随着发行人募集资金投资项目的投产及销售规模的增长，发

行人盈利能力将逐步发挥，偿债能力稳步提高，财务状况将进一步改善。

3、提升公司盈利能力

募集资金投资项目逐步形成生产能力并产生效益后，发行人的销售收入、净利润也将随之上升。在项目投产之前，发行人净资产收益率、每股收益等财务指标将面临一定压力，但从长远看，募集资金投资项目经济效益良好，上述财务指标也将逐渐好转，发行人盈利能力会有较大幅度的提高。

（四）募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人的独立性不产生影响

本次募投项目均围绕发行人主营业务进行，不存在利用本次募集资金发展其他业务的情形。

本次募集资金投资项目全部建成后，公司研发实力得到加强，经营规模得到提升，使得净资产增加，财务结构进一步改善，提升公司应对市场竞争的实力，增加公司的外部独立性。

本次募投项目实施后，公司将严格遵守中国证监会、交易所等相关规定和《公司章程》等的要求，履行有关同业竞争、关联交易、信息披露、募集资金使用情况等披露、报告义务，增强公司的内部独立性。

本次募投项目实施不会产生同业竞争和新增关联交易，不会对公司独立性造成重大不利影响。

二、募集资金投资项目概况

（一）本次募集资金投资项目

经第二届董事会第二次会议及 2026 年第二次临时股东会审议通过，发行人本次拟首次公开发行不超过 87,335,000 股人民币普通股（A 股）股票，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入额	项目建设期（月）
1	新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目	物奇科技	43,902.08	43,902.08	24
2	端侧智能芯片研发及产业化项目	上海物骐微	43,541.20	43,541.20	36
3	研发中心建设项目	物奇科技	44,469.18	44,469.18	36

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入额	项目建设期（月）
4	补充流动资金	发行人	30,000.00	30,000.00	-
合计		-	161,912.46	161,912.46	-

（二）募集资金投资项目可行性的分析意见

1、符合国家产业政策和国家战略规划

集成电路是信息技术产业高质量发展的核心基础与源动力，为推动集成电路产业持续升级、助力信息技术产业转型升级，国家已将集成电路产业明确列为重点鼓励、重点扶持的战略性新兴产业，出台了一系列配套法规与扶持政策，从税收优惠、人才培养与引进、投融资支持等多个维度，全方位助力集成电路企业发展壮大、突破核心技术瓶颈。

2026 年，国务院、全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出适度超前建设新型基础设施，完善信息通信网络，深化千兆光网部署。提出全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关。瞄准世界科技前沿强化系统布局，实施人工智能等科技战略部署，加快突破基础理论和底层技术，促进转化应用。2025 年，中共中央发布的《中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报》也强调，要加快建设网络强国，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。中共中央、国务院及相关部委陆续发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等政策，明确将消费电子、智能穿戴列为重点方向，提出到 2027 年形成 3 个万亿级消费领域和 10 个千亿级消费热点，并推动新一代智能终端应用普及率超过 70%。此外，财政部、税务总局联合发布的《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》、国务院下发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等多项政策，均明确提出在财税支持、投融资保障、人才激励等方面对集成电路企业给予重点扶持，为行业发展营造了良好的政策环境。

发行人本次募集资金投资项目，聚焦下一代 Wi-Fi 芯片及端侧智能芯片关键技术的突破，重点围绕 Wi-Fi 芯片、RISC-V 端侧智能芯片等数字技术创新领

域推进产品研发与产业化，契合国家集成电路产业政策导向与国家战略规划要求，具备明确的政策可行性。

2、研发与产业化具备广阔市场支撑

发行人本次募集资金主要投向 Wi-Fi 芯片及端侧智能芯片的研发与产业化，对应领域市场需求旺盛、发展前景广阔，为项目实施提供了坚实的市场基础。

据 QYResearch 的预测数据，2025 年全球 Wi-Fi 芯片市场规模将达到 225 亿美元，预计至 2031 年将增长至 541 亿美元，2025 年至 2031 年期间复合增长率达 15.74%，市场规模持续快速扩容。据弗若斯特沙利文相关数据，全球端侧智能芯片市场规模从 2020 年的 419 亿美元增长至 2024 年的 657 亿美元，年复合增长率达 11.90%；预计至 2029 年，该市场规模将进一步攀升至 1,314 亿美元，2024-2029 年复合增长率达 14.87%，行业增长动力强劲。

3、丰富的技术积累和人才优势为项目实施奠定坚实基础

经过多年持续研发投入与技术积淀，发行人已形成三大核心技术方向，构建起自主独立、层次清晰的核心技术体系，已构建起显著的技术壁垒，有效支撑本次募投项目的技术研发与产品落地。

发行人已组建建制完整、专业能力突出的芯片研发团队，研发范围覆盖数字电路设计、模拟电路设计、射频前端开发、算法设计、SoC 系统集成及软件开发平台等芯片研发等关键环节。团队核心成员均来自国内外知名芯片企业，在短距通信芯片领域拥有深厚的技术积淀与丰富的实践经验，同时紧跟端侧人工智能领域技术演进趋势与市场需求变化，持续拓展研发能力边界、提升创新水平。截至报告期末，发行人研发团队规模已达 229 人，占员工总数的 69.60%，这支具备持续创新能力与较强执行力的研发队伍，已成为公司维持技术领先优势的核心支撑，能够为本次募投项目的顺利推进、核心技术的持续突破及产品的迭代升级提供有力保障。

综上，发行人深厚的技术积累与显著的人才优势，为本次募集资金投资项目的顺利实施、高效落地奠定了坚实基础。

4、良好的客户沉淀为项目产业化提供有力支撑

自设立以来，发行人坚持市场导向与客户需求导向，在产品研发、技术创新及服务保障等方面，密切关注客户技术需求与新产品开发诉求，持续深化客户合作粘性，实现与客户的互利共赢、共同成长。凭借稳定的性能、优异的品质，发行人产品获得了下游客户的广泛认可，积累了一批优质客户资源，为本次募投项目的产业化落地提供了有力支撑。

高端通信芯片领域，发行人在高阶 Wi-Fi AP 芯片的研发与量产方面处于国内领先地位，将助力高端通信芯片发展进程，为国家通信安全与数据安全提供重要技术支撑。端侧智能芯片领域，发行人面向中高端品牌客户，终端客户已覆盖荣耀、OPPO、客户 A、客户 B、哈曼 JBL 等国内外知名品牌，客户质量优良、合作基础稳固。

未来，伴随着新产品产业化进程的不断深入，发行人将在现有优质客户资源的基础上，积极推广新产品、拓展客户合作深度，同时深挖产品应用边界，持续开拓新的优质客户资源，进一步拓宽市场空间，保障本次募投项目产能的顺利消化与效益的实现。

综上所述，发行人深耕网络通信领域芯片与端侧智能芯片业务多年，经过长期技术研发与实践积累，已形成具备自主知识产权的核心技术体系，同时储备了充足的专业人才、积累了丰富的经营管理经验，并构建了坚实稳定的客户基础。依托上述核心资源，发行人能够有效降低本次募集资金投资项目实施过程中的各类不确定性，为项目顺利推进提供有力保障。

公司董事会已对本次发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详细的核查与论证，认为本次募投项目及募集资金数额与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应；本次募投项目契合行业发展趋势，具有较好的市场前景和可持续盈利能力，能够有效防范投资风险，提升募集资金使用效益，符合公司长远发展战略，本次募投项目具备充分的可行性。

（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际情况，通过自筹资金支付上述部分项目投资，待募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。

若本次股票发行后，公司实际募集资金数额（扣除发行费用）大于上述投

资项目所需资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，严格按照国家法律、法规及监管机构的相关规定履行法定程序后做出适当使用。若本次股票发行后，公司实际募集资金数额小于上述投资项目所需资金，公司将使用自筹资金补足资金缺口。

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（四）募投项目备案及环评情况

募集资金投资项目已履行的审批程序如下：

序号	项目名称	实施主体	项目备案编号
1	新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目	物奇科技	2606-500157-04-03-529995
2	端侧智能芯片研发及产业化项目	上海物骐微	2605-310115-04-03-726447
3	研发中心建设项目	物奇科技	2606-500157-04-03-139266
4	补充流动资金	发行人	-

注：补充流动资金不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，不适用于主管部门关于固定资产投资的管理规定，无需履行相应的审批、核准或备案程序；同时不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

发行人本次发行募集资金投资项目已履行备案程序，相关募集资金投资项目不涉及环评批复和新增用地的情况，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

三、募集资金具体运用情况

（一）新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目

1、项目投资概况

本项目总投资 43,902.08 万元，包括场地装修费、场地租赁及其他费用、设备及软件购置费、研发费用、预备费与铺底流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	556.40	1.27%
1.1	场地装修费	375.00	0.85%
1.2	场地租赁及其他费用	181.40	0.41%

序号	项目	投资金额	占比
2	设备及软件购置费	9,411.50	21.44%
3	研发费用	30,880.40	70.34%
4	预备费	491.83	1.12%
5	铺底流动资金	2,561.95	5.84%
项目总投资		43,902.08	100.00%

2、项目必要性

（1）项目符合 Wi-Fi 行业技术发展趋势

Wi-Fi 7 标准商业化应用之后，其发展方向已从单纯提升连接速率，转向构建更智能、更融合、更确定的无线网络体验。这一发展升级不仅体现为物理层调制技术的升级，更在于多链路操作、多资源单元等创新技术的引入。行业技术发展已从单纯追求峰值速率，转向全面提升网络的确定性、可靠性和场景适应性，以满足日益复杂的应用需求。

本项目中公司聚焦 4096-QAM 高阶调制、多链路协同等 Wi-Fi 7 核心技术的研发，契合行业技术发展方向。通过攻克高密度星座图解调、动态调制切换等关键技术，项目将实现传输效率的显著提升。同时，对多链路操作、多资源单元等新功能的完整支持，将使芯片产品在未来的市场竞争中占据有利位置，体现了公司对行业趋势的把握和前瞻性规划。

（2）项目有利于公司抓住市场发展机遇

随着智能家居设备的普及和物联网应用的深化，家庭与办公环境正面临日益复杂的连接需求。在沉浸式应用场景方面，8K 超高清视频、云游戏、AR/VR 等新兴应用对网络吞吐量和时延提出了更高要求。设备数量的激增对传统无线网络构成严峻挑战，而 Wi-Fi 7 凭借其多用户资源单元和多链路操作等创新技术，能够显著提升网络并发处理能力和频谱利用效率，能够适配高密度连接场景。公司布局 Wi-Fi 7 AP 芯片研发，通过和技术规划中强化确定性低时延和高可靠性等特性，新的芯片将支持这些高价值应用场景，有利于抓住当前较为明确的市场机遇。

（3）项目有利于提升公司的盈利能力

与公司现有 Wi-Fi 芯片产品相比，Wi-Fi 7AP 芯片不仅具备更高的技术壁垒，更能通过支持多链路协同、高阶调制等创新功能满足高端客户对性能的严苛需求，公司能够凭借该芯片的先进性和性能优势突破高端网络设备市场，实现收入和利润的同步提升。同时，基于公司在射频前端设计和低功耗技术方面的积累，新产品可通过核心 IP 复用和设计优化有效控制研发成本，带动公司整体毛利率的提升。

另外，从业务增长和市场竞争角度考量，本项目的实施将助力公司把握高端芯片市场的发展机遇，使公司在替代进口产品和开拓国际市场方面占据有利位置。随着智能家居、企业网络和工业物联网对无线通信性能要求的不断提高，Wi-Fi 7 芯片将成为公司参与这些高增长市场的关键产品，为公司带来持续稳定的收入来源。

3、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 2 年，进度计划内容包括前期准备、装修施工、设备采购与安装调试、产品研发等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期准备	*											
2	装修施工	*											
3	设备采购与安装	*	*	*									
4	产品研发	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

4、项目选址

本项目实施主体为公司全资子公司重庆物奇科技有限公司，本项目实施地点为重庆市渝北区仙桃街道数据谷，拟新租赁场地作为项目实施地点。

（二）端侧智能芯片研发及产业化项目

1、项目投资概况

本项目总投资 43,541.20 万元，包括场地装修费、场地租赁及其他费用、设备及软件购置费、研发费用、预备费与铺底流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	871.60	2.00%
1.1	场地装修费	260.00	0.60%
1.2	场地租赁及其他费用	611.60	1.40%
2	设备及软件购置费	7,980.90	18.33%
3	研发费用	32,970.00	75.72%
4	预备费	414.55	0.95%
5	铺底流动资金	1,304.15	3.00%
项目总投资		43,541.20	100.00%

2、项目必要性

（1）创新设计端侧智能芯片，促进智能终端产业创新升级

智能终端产业的创新发展，关键在于为用户提供真正智能化的交互体验。基于音频与视频的多模态交互正成为下一代人机交互的核心方向，用户期望设备能同时理解语音语义、识别手势表情并感知环境上下文，进而做出精准响应。然而，受限于功耗、体积和散热，终端设备难以独立承载完整的大模型运算。本项目所研发的端侧智能芯片，利用多模态 AI 算法进行实时采集与轻量化特征提取，使终端设备能够在毫瓦级功耗下完成语音唤醒、环境降噪、图像增强等处理任务，再依托公司已掌握的高能效、低延迟的无线通信技术调用大模型算力，解决目前 AI 眼镜等智能终端存在的功耗较高的痛点，实现长时间的多模态交互和智能服务。由此，终端设备可以借助持续演进的大模型算法不断获得新功能，从而催生更丰富的应用场景，促进智能终端产业的创新与升级。

（2）推动实现融合音视频预处理与高效通信的端侧芯片架构

音频与视频是数据量最大、产生频率最高的两种数据形态，尤其是在 AI 眼镜、智能耳机等端侧设备的应用场景中。对于 AI 眼镜、智能耳机等设备，许多关键功能如语音唤醒、实时字幕、手势识别或环境感知，都要求在毫秒级内完成响应。传统的集中式云计算模式，因数据传输往返耗时、带宽竞争及网络抖动，难以满足此类实时性要求。因此，端侧智能芯片技术升级的核心在于将适合本地处理的任務下沉至端侧，复杂推理任务则采用大模型算力。在这一模式中，端侧芯片可在极低功耗下完成原始音视频数据的清洗、降噪、特征提取等

预处理，然后利用高带宽、低延迟、抗干扰的无线通信技术来调用大模型进行处理，从而实现较好的处理效果和响应速度。本项目将深度融合公司已掌握的高带宽低时延通信技术、端侧多模态 AI 算法、超低功耗数模混合芯片设计技术三大核心能力，研发端侧智能芯片，进而为端侧智能构建大模型入口的硬件底座。

（3）构建核心技术竞争力，促进公司可持续发展

半导体行业技术演进速度快，依靠单一技术优势或产品迭代难以维持长期竞争力。公司目前已掌握高带宽低时延通信、超低功耗数模混合设计及端侧多模态 AI 算法方面的技术能力，开发端侧智能芯片可以对相关技术进行集成，并推动这些能力不断深化和扩展。通过本项目，公司能够将已有的技术优势转化为具备市场壁垒的产品或解决方案，建立起从芯片设计、算法优化到应用的全链条知识积累。这种技术积累使公司不易被简单模仿或替代，为应对未来技术路线的波动和市场需求的变迁提供足够的竞争力。因此，本项目是公司突破发展瓶颈、实现可持续高质量发展的必然选择。

3、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 3 年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、投产运营等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期准备	*											
2	装修施工	*											
3	设备采购与安装	*	*										
4	产品研发	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

4、项目选址

本项目实施主体为公司全资子公司上海物骐微电子有限公司，本项目实施地点为上海市自由贸易试验区临港新片区海洋一路，拟新租赁场地作为项目实施地点。

（三）研发中心建设项目

1、项目投资概况

本项目总投资 44,469.18 万元，包括场地装修费、场地租赁及其他费用、设备及软件购置费、研发费用与预备费，具体如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地投入	522.80	1.18%
1.1	场地装修费	320.00	0.72%
1.2	场地租赁及其他费用	202.80	0.46%
2	设备及软件购置费	8,139.50	18.30%
3	研发费用	35,382.40	79.57%
4	预备费	424.48	0.95%
项目总投资		44,469.18	100.00%

2、项目必要性

（1）顺应行业技术发展趋势，提高技术创新能力

未来网络通信与端侧人工智能行业的技术发展方向日益清晰。其一，在无线通信领域，Wi-Fi 7 技术逐步成为主流，多频带并发架构加速普及，有助于进一步降低时延、提升连接稳定性，从而更好满足不同场景下的高速数据交互需求；其二，AI 与通信、感知能力深度结合，形成“通信+感知”一体化设备形态；其三，终端设备的智能进程持续深入，终端集成度不断提高，可依据智能穿戴、视觉成像等不同场景快速调整软硬件配置，缩短研发周期，提升场景适配能力。

本项目旨在通过研发中心的建设，聚焦行业前沿方向，重点开展 Wi-Fi BE10000 企业级三频万兆 AP 芯片开发、Wi-Fi 7 2×2 三频带终端芯片开发、Wi-Fi 8（802.11bn）企业级三频万兆 AP 芯片开发以及可配置、生成式多场景端侧智能设备平台研发等课题研究，通过上述课题推进，公司能够紧跟行业技术发展趋势，加强核心技术的预研储备，持续提高技术创新能力。

（2）完善研发设施水平，提升研发实力

作为采用 Fabless 模式的芯片设计企业，公司核心竞争力高度依赖研发端的

技术突破与效率提升，因此对研发全流程所需的计算能力、数据安全防护、专业设计工具等方面提出了极高要求。研发基础设施的先进性与完备性，直接决定了产品开发周期的效率、试错成本的控制水平，以及最终产品在性能、功耗、可靠性等核心指标上的质量可控性，是企业在高端芯片市场竞争中构筑技术壁垒的关键支撑。

未来，终端芯片的复杂度呈指数级增长，对 EDA 工具算力、射频测试环境等需求急剧攀升，对公司现有场地与设备配置提出了更高要求。通过本项目的实施，公司计划租赁研发场地，以满足未来研发人员增长的空间需求，同时补强相关硬件设备，如高速示波器、Wi-Fi 7 2×2 MIMO PHY 测试仪、Wi-Fi 7 场景化综合测试系统、IC 测试温度控制单元等，有利于提升芯片设计仿真效率、缩短验证周期、降低流片风险，进而完善公司基础设施水平，满足未来发展需要。

（3）持续优化公司产品体系，提升公司竞争力

近年来，我国人工智能、云计算、物联网、智能终端设备、5G 通信等新兴产业加速商业化落地，带动网络通信与端侧人工智能芯片的需求呈现爆发式增长。公司在网络通信与智能终端 AI 芯片领域经过长期技术积累，已成功开发出高性能数传 Wi-Fi 6 芯片、智能音频主控芯片、PLC 电力载波芯片等产品，实现了优异的产品性能。以智能音频主控芯片为例，该产品具备超低功耗、音视频多模态 AI 处理能力，以及异构多核架构的超高集成度等特点。

在市场需求持续扩大与产品技术不断升级的双重驱动下，本项目将通过建设研发中心，聚焦行业前沿方向，重点开展 Wi-Fi BE10000 企业级三频万兆 AP 芯片开发、Wi-Fi 7 2×2 三频带终端芯片开发、Wi-Fi 8（802.11bn）企业级三频万兆 AP 芯片开发以及可配置、生成式多场景端侧智能设备平台研发等课题研究。通过上述课题的推进，公司将进一步加强现有技术的升级与创新，持续推进产品迭代，不断丰富产品体系，增强市场竞争力。

3、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、场地装修、设备购置、安装及调试、人员招聘与培训和课题研究。具体进度如下表所

示：

序号	建设内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	*											
2	场地装修	*	*										
3	设备购置、安装及调试		*	*									
4	人员招聘与培训		*	*									
5	课题研究	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

4、项目选址

本项目实施主体为物奇科技，本项目实施地点为重庆市渝北区仙桃街道数据谷，拟新租赁场地作为项目实施地点。

（四）补充流动资金

1、项目投资概况

结合整体业务发展战略规划，综合考量当前营运资金的实际缺口与未来业务拓展的资金需求，发行人计划使用 30,000 万元募集资金用于补充流动资金。本次补充流动资金，能够有效保障公司生产经营、研发投入、市场拓展等各环节的足额资金供给，确保各项业务运转的连续性与稳定性；同时可进一步优化公司资产负债结构，合理降低财务杠杆水平，有效分散经营与财务风险；此外，有助于增强公司应对市场波动、把握行业发展机遇的快速反应能力，持续提升核心市场竞争力，为公司中长期战略规划有序推进筑牢坚实的资金根基。

2、项目必要性

（1）经营规模扩张亟需充足流动资金支撑

作为芯片设计企业，发行人目前正处于经营规模快速扩张的关键发展阶段，充足的流动资金储备是公司稳固现有行业地位、持续提升市场影响力的重要基础保障。随着发行人业务的持续深耕、市场份额的稳步提升，以及新产品的迭代落地与新客户的持续导入，日常营运、业务拓展等环节对流动资金的需求将随之显著增加，补充流动资金能够有效匹配上述发展需求，保障业务有序

推进。

（2）持续研发投入对流动资金存在刚性需求

芯片设计行业具有高研发投入、高技术迭代的显著特性，持续的技术突破与产品创新是发行人维持核心竞争力的关键，而这一过程离不开稳定的资金保障。补充流动资金能够确保公司各类研发项目顺利推进，为技术迭代、产品升级提供充足的资金支持，助力发行人持续巩固并扩大技术领先优势，应对行业激烈竞争。

（3）助力核心人才保留与优秀人才吸引

作为典型的知识密集型、人才密集型行业，优秀的研发及核心骨干人才是公司核心竞争力的载体。补充流动资金有助于发行人进一步优化薪酬福利体系、完善长效激励机制，切实提升人才留存率，同时增强公司对行业内优秀人才的吸引力，稳定人才队伍、强化人才支撑，为公司长远可持续发展奠定坚实的人才基础。

四、公司发展战略和业务发展目标

本业务发展目标是公司在当前经济形势和市场环境下，对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公司根据经济形势变化和经营实际状况对本发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

（一）公司发展战略和未来发展目标

自成立以来，公司秉持“诚信、开放、创新、品质”的经营理念，持续投入研发，深耕网络通信与端侧智能芯片领域，为客户提供高性能、低功耗、高集成度的芯片产品，助力客户产品升级与效能提升。

未来，公司将顺应行业发展趋势，紧密围绕国家产业政策导向、行业技术迭代方向及下游市场核心需求，以现有产品为基础，发挥产品间协同效应，持续完善产品梯度和矩阵。一方面，公司将顺应行业需求，持续投入对 Wi-Fi 芯片的研发，为数字经济的发展提供坚实的网络基础设施；另一方面，公司将积极拥抱人工智能的蓬勃发展，深度融合高性能网络连接与人工智能端侧入口能力，依托自身优势，稳步拓展公司各产品线的边界，提供更高性能、更多样

化、更具定制化的系统级解决方案，扩展产品的应用领域与客户覆盖范围，持续提升公司市场竞争力。

公司恪守“芯连万物，让智能无处不在”的技术使命，持续加大前沿技术研发投入，致力于从国内细分领域领先企业向国际知名的网络通信与端侧智能芯片企业跨越。

1、持续加大研发力度，推动技术与产品的升级

公司将坚守短距通信核心方向，在网络通信与端侧智能两大领域加大资源投入，加强关键专利布局，构建技术壁垒，筑牢核心竞争力。在网络通信领域，加速推进 Wi-Fi 系列产品研发进程，巩固现有竞争优势；拓展低功耗 Wi-Fi 技术在网络通信及端侧智能场景的应用边界，挖掘潜在市场需求。在端侧智能领域，攻克先进制程产品开发及多功能集成两大核心技术难题，匹配下游客户日益提升的个性化、多元化需求。

2、拥抱人工智能的泛在赋能，拓展下游覆盖领域

报告期内，公司产品下游应用领域主要为路由器、智能电视、智能耳机、智能眼镜、智能电网等。未来公司将不断融合网络通信与端侧智能相关核心技术，布局人工智能泛在赋能机遇，重点拓展结合多模态交互能力的智能眼镜、智能可穿戴设备、具身机器人等端侧应用场景。

3、围绕大客户战略，实现合作共赢

公司已与多家行业头部客户建立深度合作关系，在长期合作进程中，始终以客户需求为导向，构建自身核心技术体系。通过与大客户深度绑定，公司深入了解行业发展趋势与客户个性化需求，持续优化产品架构、升级技术能力。未来，公司将继续保持和大客户的紧密合作，实现合作共赢。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续研发投入及技术创新，构建了核心技术体系

报告期内，依托在短距通信领域积淀的深厚技术基础，发行人持续加大研发投入力度、推进核心技术创新。发行人已系统掌握 RISC-V 架构、蓝牙、NPU、Wi-Fi、MIPI 及软件生态等全流程核心技术，形成了一系列自主知识产

权成果，相关技术可高效复用至公司各产品线开发及定制化业务中，为产品迭代升级与业务规模拓展提供了坚实的技术支撑。

此外，发行人高度重视知识产权成果的培育与保护工作，截至报告期末，已获得授权专利 141 项、计算机软件著作权 62 项、集成电路布图设计权 18 项；另有多项发明专利及集成电路布图设计登记证书处于申请流程中，已逐步构建起完善、全方位的知识产权保护体系，为公司核心技术安全提供了有力保障。

2、积极开发新产品，拓展下游应用领域

发行人聚焦网络通信基础设施与智能终端设备领域的芯片需求，顺应行业发展趋势，持续推进产品迭代升级。发行人 Wi-Fi 6 AP 芯片已于 2025 年四季度小批量交付，后期将持续推动向中国移动、客户 C 等关键客户供货进程，稳步推进与中国电信和海外客户的市场导入工作；同时，公司高度关注智能眼镜、虚拟现实等新兴领域对端侧智能芯片的应用潜力，积极投入更先进制程的端侧智能芯片、高阶 Wi-Fi AP 芯片等新产品的研发，为拓展下游应用领域及实现营业收入增长奠定坚实基础。

在营销体系建设方面，发行人计划持续加大现有营销体系的投入力度，完善现代化营销策略，通过服务营销与品牌营销相结合的模式，稳步拓展市场并扩大品牌影响力。同时，公司将进一步提升客户服务响应速度，强化服务的针对性与解决方案的有效性，深化市场营销服务的深度与广度，持续提升客户满意度与合作粘性。

3、加强高素质人才队伍建设，打造完善的人才体系

发行人深刻认识到人才是企业持续创新的核心驱动力，高度重视人才的引进与培养，已组建一支全建制、专业化的研发团队。发行人通过举办技术研讨会、参与行业论坛、组织专业培训等多种形式，助力员工提升专业能力、实现个人成长；并通过设立专利申请专项奖励、推行员工股权激励等多元化激励政策，充分激发员工创新积极性，持续提升研发团队的整体研发能力与创新水平。

（三）未来规划采取的措施

1、加强研发创新人才队伍建设

发行人坚持以企业文化为引领，确立科学系统的人才发展战略，构建可持续吸引高端科研人才及核心骨干的人才体系与服务平台。公司将完善人才培养机制，发掘具有发展潜质的核心人才，实现员工个人成长与企业长远发展的双向赋能。同时，搭建系统化的培训、实践及职业晋升通道，助力员工提升专业能力与综合素养，充分发挥自身价值。此外，发行人将健全高效的人才激励体系，通过合理的薪酬福利与清晰的职业发展路径，有效激发各类人才的主动性、创新力与内在潜能，切实保障人才队伍的稳定性、专业性与战斗力，为持续技术创新和业务发展提供坚实的人才支撑。

2、布局前沿技术，进一步强化自主独立能力

发行人将与产业链各合作伙伴深度协同，携手共建专业化技术预研体系，主动布局前沿技术领域，提前抢占行业技术制高点；同时，进一步强化在 Wi-Fi 芯片领域“自主设计+IP 积累+生态融合”的正向循环竞争优势，持续筑牢技术自主独立的核心根基，不断提升核心技术壁垒，切实增强公司抗行业周期及市场竞争风险的能力。

3、进一步打通产业链，提升运营效率

发行人将持续强化研发体系建设，不断提升核心技术实力，紧密围绕市场发展趋势及下游客户核心需求，研发推出适配性强、具备核心竞争优势的芯片产品；稳步推进供应链多元化布局，着力提升客户需求交付达成率，增强供应链的弹性与韧性，筑牢供应链安全保障防线；深化与核心大客户的合作粘性，积极拓展海外市场布局，依托大客户需求精准锚定研发方向，精准把握新产品市场需求窗口期。同时，健全研产销全流程管控机制，提升运营精细化管理水平，严格控制运营成本、优化盈利结构，推动研产销各环节形成高效协同的正向循环，助力公司实现业务长期稳健高质量发展。

4、充分利用资本平台，有序推进募集资金项目建设

发行人将严格按照上市公司规范运作要求，建立健全有效的决策机制与内部管理机制，充分利用资本市场融资工具，增强公司融资能力与资本运作水平。本次发行上市将为公司后续发展提供充足的资金支持，发行人将严格按照

招股说明书披露要求，认真组织实施各项募集资金投资项目，推动项目顺利落地见效，提升公司经济效益，积极回馈全体投资者。同时，发行人将进一步完善法人治理结构，提升核心竞争力与产业整合能力，为企业可持续发展注入持久动力。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司在整体变更为股份公司以前，公司治理尚未完全完善。自整体变更为股份公司以来，已逐步建立健全了股东大会（股东会）、董事会、监事会（审计委员会）、独立董事、董事会秘书等制度。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

参照公司治理相关法规与规范性文件的标准，公司管理层认为：截至本招股说明书签署之日，公司治理规范，不存在重大缺陷。公司董事会、监事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和内部控制自我评价手册，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制的审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制有效性，出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕14546 号）认为：“公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

三、发行人最近三年违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，发行人及其子公司不存在重大违法违规行为，也不存在受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人资金占用和对外担保情况

发行人无控股股东。报告期内，发行人不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、面向市场独立持续经营的能力情况

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

发行人系物奇微有限整体变更设立，承继物奇微有限的全部资产、负债和权益，拥有独立、完整的与经营相关的业务体系和相关资产，具备独立完整的采购、研发、销售体系。公司资产权属清晰、完整，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，亦不存在资金或其他资产被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举或聘任，未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

发行人已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度、能够独立作出财务决策。公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职能，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司具有独立完整的研发、采购、销售系统，面向市场自主经营。发行人实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争情况，亦不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员变动情况

公司基于 RISC-V 架构，主营网络通信芯片与端侧智能芯片的研发、设计与销售，最近 2 年内未发生变化。最近 2 年内，公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。实际控制人所持公司的股份权属清晰，实际控制人最近 2 年未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）其他影响持续经营的重大事项

截至报告期末，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大资产权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生变化等对持续经营有重大影响的事项。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立持续经营能力。

六、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司无控股股东，实际控制人为郑建生。截至本招股说明书签署日，公司实际控制人控制的其他企业及主营业务情况如下：

序号	企业名称	经营范围	主营业务	控制关系
1	NATIVE	股权投资	持股平台，无实际业务	郑建生持股 50.0025%，郑建生之女 Nina Li ZHENG 持股 49.9975%，且 Nina Li ZHENG 将其所持有的 NATIVE 股权所对应的全部股东投票、提名或委派董事权等股东权利委托给郑建生行使

序号	企业名称	经营范围	主营业务	控制关系
2	物奇捌	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	持股平台，无实际业务	郑建生担任执行事务合伙人

综上，实际控制人控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争或潜在同业竞争，维护公司利益，保障公司正常经营，发行人实际控制人郑建生及其控制的企业 NATIVE、物奇捌，亲属 Nina Li ZHENG，一致行动人任泽生、林豪出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、（九）关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联关系

（一）公司主要关联方

本招股说明书从关联方的重要性和可读性原则出发，以列举方式披露了报告期内与发行人发生过关联交易的关联方或其他主要关联方，并以文字概述方式确定了其余关联方的范围。根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，截至报告期末，发行人的主要关联方及关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人

公司无控股股东，实际控制人为郑建生。公司实际控制人的具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

除发行人实际控制人郑建生，其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人如下：

序号	关联方	关联关系
1	Nina Li ZHENG	郑建生之女，通过 NATIVE 间接持有发行人 8.0735%股份
2	任泽生	发行人股东，直接持有发行人 7.3741%股份

3、发行人的董事、原监事及高级管理人员

报告期内，发行人董事、原监事或高级管理人员均为关联自然人。

4、上述 1 至 3 项所述关联自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，发行人实际控制人、董事、原监事、高级管理人员和直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母为发行人的关联方。

5、直接持有发行人 5%以上股份的机构股东

截至报告期末，直接持有发行人 5%以上股份的机构股东如下：

序号	关联方名称	持有方式及持股比例
1	NATIVE	直接持有发行人 5%以上股份，系郑建生控制的企业
2	中移股权基金	直接持有发行人 5%以上股份
3	哈勃投资	直接持有发行人 5%以上股份

6、前述 1-5 项所列关联法人或关联自然人直接或间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，以及直接持有发行人 5%以上股份股东直接或间接控制的法人或其他组织，但发行人及其控股子公司除外

（1）发行人实际控制人控制的法人或其他组织

截至报告期末，除发行人及其子公司外，发行人实际控制人控制的法人或其他组织详见招股说明书本节“六、（一）同业竞争情况”。

（2）直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法

人或其他组织

截至报告期末，直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织不存在直接或间接控制的法人或其他组织。

（3）发行人关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

发行人前述关联自然人直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织属于发行人关联方。发行人现任董事、高级管理人员对外投资及任职情况详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、（五）董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”及“十五、董事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况”。

除上述已列示的关联方外，截至报告期末，由前述关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，主要列举如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	重庆捷江药品物流有限公司	任泽生担任董事的企业
2	捷江医药供应链（重庆）有限公司	任泽生担任董事的企业
3	浙江创基有机硅材料有限公司	公司董事会秘书毛向荣父亲担任董事并持股 12.1658%的企业

7、间接持有发行人 5%以上股份的机构股东

截至报告期末，间接持有发行人 5%以上股份的机构股东如下：

序号	关联方名称	持有方式及持股比例
1	华为投资控股有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
2	华为投资控股有限公司工会委员会	间接持有发行人 5%以上股份
3	中移股权基金管理有限公司	间接控制发行人 5%以上股份

8、发行人控股及参股子公司

发行人控股及参股子公司具体情况详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司简要情况”。

9、报告期内曾经的关联方

发行人报告期内曾经的关联方详见本招股说明书“第十二节 附件”之“九、发行人曾经的关联方”。

10、其他关联方

除上述已披露的关联方之外，发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的，或者在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，视同发行人的关联方。上述关联方的具体情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	航中天启	公司曾任董事熊飞担任董事兼经理的企业

（二）报告期内关联方的变化情况

报告期内，发行人关联方主要变化情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“九、发行人曾经的关联方”。

报告期内，发行人关联方变动情况不存在关联交易非关联化情形。

八、关联交易

（一）关联交易的整体情况及重大关联交易的判断标准

1、关联交易的整体情况

报告期内，发行人存在的关联交易汇总情况如下：

单位：万元

交易性质	关联方	交易类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性关联交易	航中天启	关联销售	5,990.80	5,128.55	6,641.92
	关键管理人员	关键管理人员报酬	554.43	538.07	635.01
偶发性关联交易	航中天启	关联销售	-	11.32	-
	郑建生	关联担保	参见本节八“（三）重大偶发性关联交易”		

2、重大关联交易的判断标准及依据

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司将与关联人发生的占公司最近一期经审计总资产或市值（公司 A 股发行上市后适用）1%以上，且超过人民币 1,000 万元的交易，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项认定为重大关联交易。

（二）重大经常性关联交易

报告期内，公司重大经常性关联交易为向航中天启销售 PLC 芯片，具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
航中天启	PLC 芯片	5,990.80	5,128.55	6,641.92

公司向航中天启销售 PLC 芯片的关联交易占当期营业收入及同类型交易比例如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	占营业收入比例	占同类型交易比例	占营业收入比例	占同类型交易比例	占营业收入比例	占同类型交易比例
PLC 芯片销售	10.60%	82.61%	9.98%	83.19%	22.49%	73.92%

报告期各期，发行人对航中天启销售金额分别为 6,641.92 万元、5,128.55 万元及 5,990.80 万元，占当期营业收入比例分别为 22.49%、9.98%及 10.60%，占同类型交易比例分别为 73.92%、83.19%及 82.61%。报告期内，发行人向航中天启销售 PLC 芯片，用于其 PLC 通信模组生产，具有商业合理性。发行人基于客户选择的晶圆型号、辅料、工艺流程、产品合封方案等核算成本，并综合考虑客户合作历史、订单量等因素，协商确定交易价格，定价公允。

（三）重大偶发性关联交易

报告期内，公司重大偶发性关联交易为作为被担保方的关联担保，具体如下：

单位：万元

担保方	最高担保额	担保起始日	担保债权到期日	担保是否已经履行完毕
郑建生	8,000.00	2024/07/31	2025/7/30	是

（四）关联方往来款余额

单位：万元

项目	关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款	航中天启	-	1,202.84	2,459.19
合同负债 （含其他流动负债）	航中天启	238.77	85.44	-

（五）关联交易履行的程序及独立董事意见

公司于 2026 年 5 月召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026 年 6 月召开 2025 年年度股东会，对公司报告期内涉及的关联交易进行了审查审议，通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》。

（六）关联交易的规范措施及执行情况

1、规范关联交易的相关制度

公司自整体变更设立股份公司以来，根据《公司法》等法律法规制订了《公司章程》《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》等制度文件，对关联交易的审议、披露、回避制度等内容进行了规定，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公开，避免关联交易损害公司及股东利益。

2、规范和减少关联交易的承诺

公司实际控制人及其一致行动人以及实际控制人之女 Nina Li Zheng、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员就规范和减少关联交易事项作出了承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、（十）关于规范关联交易的承诺”。

综上，发行人建立了完善的关联交易决策机制和监督体系。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的股利分配政策和已履行的决策程序

经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，本次发行前的滚存未分配利润（累计亏损）由本次发行后的新老股东按照本次发行后的持股比例共享和承担。

二、发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红政策

（一）发行前后股利分配政策的差异

公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了本次发行上市完成后生效的《公司章程（草案）》，进一步完善和细化了利润分配原则、利润分配的形式及优先顺序、现金分红的条件和比例、利润分配的审议程序、公司利润分配的调整机制等内容，加强了对中小投资者的利益保护。

（二）现金分红政策

公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金需求，在即期盈利保证持续经营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，尊重独立董事和审计委员会的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。

公司在满足如下条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%：

1）公司该年度实现的可分配利润即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计未分配利润为正值；3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；5）法律法规及本章程规定的其他条件。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

同时，公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分公司发展阶段及未来资金支出安排，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（三）重要子公司分红政策

1、物奇科技

根据物奇科技现行有效的《公司章程》第十六条，“股东行使下列职权：……（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案”；第二十一条“执行董事对股东负责，行使下列职权……（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案”；第二十六条“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，应依法分配红利”。

2、上海物骐微

根据上海物骐微现行有效的《公司章程》第七条，“公司不设股东会，由股东行使下列职权：……（七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案”；第十条“执行董事对股东负责，行使下列职权……（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案”；第二十三条“公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行”。

3、香港物奇

根据香港物奇现行有效的《组织章程细则》第 5 部之第 6 分部，“（1）本公司可于成员大会上，宣布分派股息，但股息不得超过董事建议的款额。（2）董事可不时向成员支付中期股息，前提是董事觉得以本公司的利润而论，该中期股息属有理有据。（3）除按照《条例》第 6 部从利润中支付股息外，不得以

其他方式支付股息。（4）除非宣布分派股息的成员决议、董事的支付股息决定或股份的发行条款另有指明，否则股息的支付，须以每名成员于宣布分派或支付该股息的决议或决定的日期所持的股份，作为依据。董事在建议分派任何股息前，可从本公司的利润中拨出其认为合适的款项，作为储备。董事可按以下规定运用上述储备：（a）凡本公司的利润可恰当地运用于某目的上，董事即可将该等储备，运用于该目的上；（b）及在如上般运用该等储备前，董事可将该等储备，运用于本公司的业务上，或运用于董事认为合适的投资上，该等投资不得包括本公司的股份。（7）董事如认为不分派某笔利润，属稳健做法，即可予以结转，而不将该笔利润拨入储备内”。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排

截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情形。

四、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况及投资者保护措施

截至报告期末，发行人尚未实现盈利，存在累计未弥补亏损。发行人实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的其他企业、董事、审计委员会委员、高级管理人员、核心技术人员已根据相关法规要求就股份减持事项的特殊安排作出了相应承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的重要承诺”。

第十节 其他重要事项

一、重要合同

（一）重大销售合同

截至本招股说明书签署日，发行人签署的年度交易金额在 1,500 万元以上或不足 1,500 万元但对公司经营有重大影响的已履行或正在履行的销售合同如下：

序号	销售方	采购方	合同名称	有效期	销售产品	履行情况
1	物奇科技	航中天启（含其前身）	《芯片销售合同》	自 2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日。合同期满前七日内，如一方或双方未以书面形式通知对方终止，则本合同自动延续一年，以后各年度依此类推	PLC 芯片	已履行
	物奇科技	重庆诚投创电科技有限公司	《芯片销售合同》	自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日。合同期满前七日内，如一方或双方未以书面形式通知对方终止，则本合同自动延续一年，以后各年度依此类推	PLC 芯片	已履行
	物奇科技	航中天启（含其前身）	《芯片销售合同》	自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日。合同期满前七日内，如一方或双方未以书面形式通知对方终止，则本合同自动延续一年，以后各年度依此类推	PLC 芯片	正在履行
2	发行人、上海物骐微、香港物奇	深圳中电港技术股份有限公司、中国电子器材国际有限公司、深圳市思尼克技术有限公司	《经销商合约》	自 2022 年 5 月 16 日起 3 年，到期后若无异议自动续期	端侧智能芯片	正在履行
3	发行人、上海物骐微、香港物奇	深圳市天河星供应链有限公司、银河控股国际有限公司	《经销商合约》	自 2022 年 11 月 29 日起 3 年，到期后若无异议自动续期 1 年	端侧智能芯片	正在履行
4	上海物骐微	山东神驰微电子有 限公司	《生产采购框架协议》	自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。协议期满前三十日内，如一方或双方未以书面形式通知对方终止，则本协议自动延续一年，以后各年度依此类推	智能视觉处理芯片	正在履行
5	上海物骐微	亿咖通（湖北）技术有限公司	《生产采购框架协议》	自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 1 日止。双方未于有效期届满前 30 天通知终止的，则自动顺延一年	智能音频主控芯片	已履行
6	发行人、上海物骐微、	世辉电子（深圳）有限公司、世辉电	《经销商合约》	自 2022 年 5 月 26 日起 3 年，到期后若无异议自动续期 1 年	智能视觉	正在履行

序号	销售方	采购方	合同名称	有效期	销售产品	履行情况
	香港物奇	子（香港）有限公司、世健国际贸易（上海）有限公司、世健系统（香港）有限公司			处理芯片	
7	发行人、上海物骐微、香港物奇、物奇科技	深圳市中电拓讯科技有限公司、中电拓讯香港有限公司	《经销商合约》	自 2025 年 4 月 17 日起 3 年，到期后若无异议自动续期 1 年	智能音频主控芯片	正在履行
8	物奇科技	客户 B	《项目开发技术合同》	2025 年 8 月 15 日至项目开发完成日	定制服务	正在履行
			《项目开发技术合同》之补充协议（一）	2025 年 8 月 19 日至项目开发完成日		
			《项目开发技术合同》之补充协议（二）	2025 年 11 月 6 日至项目开发完成日		
			《项目开发技术合同》之补充协议（三）	2026 年 1 月 9 日至项目开发完成日		
9	发行人、上海物骐微、香港物奇	亿芯微电子技术有限公司	《经销商合约》	自 2022 年 9 月 22 日起 3 年，到期后若无异议自动续期 1 年	智能音频主控芯片	正在履行
			《经销商合约之补充协议》	自 2023 年 12 月 13 日起至主协议结束		
			《经销商合约之补充协议二》	自 2024 年 3 月 21 日起至主协议结束		

（二）重大采购合同

截至本招股说明书签署日，发行人签署的年交易金额在 1,500 万元以上或不足 1,500 万元但对公司经营有重大影响的已履行或正在履行的采购合同如下：

序号	主体	供应商	合同名称	生效日期	有效期	采购产品	履行情况
1	上海物骐微	供应商 A	《主服务协议》	2020/6/9	3 年，期满后自动续期 1 年，任何一方可提前 60 天书面通知终止续约，以后各年度依此类推	晶圆	正在履行
2	物奇科技	供应商 A	《技术使用协议》	2019/3/19	3 年，期满后自动续期 1 年，任何一方可提前 60 天书面通知终止续约，以后各年度依此类推	晶圆	正在履行

序号	主体	供应商	合同名称	生效日期	有效期	采购产品	履行情况
3	上海物骐微	甬矽电子（宁波）股份有限公司	《芯片封装（测试）委托加工协议》	2021/4/1	至 2024 年 3 月 31 日	封测	已履行
4	上海物骐微	甬矽电子（宁波）股份有限公司	《芯片封装（测试）委托加工协议》	2025/3/18	自生效之日起 3 年，到期前 30 天书面通知是否顺延	封测	正在履行
5	上海物骐微	甬矽半导体（宁波）有限公司	《芯片封装（测试）委托加工协议》	2023/5/15	至 2027 年 5 月 14 日	封测	正在履行
6	物奇科技	甬矽电子（宁波）股份有限公司	《芯片封装（测试）委托加工协议》	2022/1/7	至 2025 年 1 月 6 日	封测	已履行
7	物奇科技	甬矽电子（宁波）股份有限公司	《芯片封装（测试）委托加工协议》	2025/1/6	至 2028 年 1 月 5 日	封测	正在履行
8	上海物骐微	普冉半导体（上海）股份有限公司	《年度订单框架协议》	2023/6/28	至 2027 年 12 月 31 日	存储芯片	正在履行
9	物奇科技	普冉半导体（上海）股份有限公司	《年度订单框架协议》	2023/1/1	至 2027 年 12 月 31 日	存储芯片	正在履行
10	物奇科技	深圳淇诺科技有限公司	《采购框架协议》	2019/8/1	至 2024 年 7 月 31 日	存储芯片	已履行
11	物奇科技	深圳淇诺科技有限公司	《采购框架协议》	2026/1/15	至 2029 年 1 月 14 日	存储芯片	正在履行
12	上海物骐微	深圳淇诺科技有限公司	《采购框架协议》	2021/7/16	2021 年 7 月 16 日至 2027 年 7 月 15 日	存储芯片	正在履行
13	发行人、物奇科技	供应商 B	《芯片代工协议》	2024/10/25	生效日起八年	晶圆	正在履行
14	物奇科技	供应商 B	《芯片代工协议》	2019/12/19	生效日起五年	晶圆	已履行
15	物奇科技	天水华天科技股份有限公司	《IC 封装（测试）加工协议》	2021/4/8	至 2024 年 12 月 31 日	封测	已履行
16	上海物骐微	天水华天科技股份有限公司	《IC 封装（测试）加工协议》	2021/4/8	至 2024 年 12 月 31 日	封测	已履行
17	物奇科技	天水华天科技股份有限公司	《IC 封装（测试）加工协议》	2025/1/7	长期有效	封测	正在履行
18	上海物骐微	北京勇旗科技发展有限公司	《采购框架协议》	2025/11/12	有效期 1 年，届满前 30 日内，任意一方书面提出不续延协议的，协议到期终止；否则协议自动顺延壹年	存储芯片	正在履行

（三）重大授信及借款合同

截至报告期末，发行人及其子公司正在履行的重大授信及借款合同情况如

下：

单位：万元

序号	合同名称	借款人/ 被授信人	借款银行/ 授信银行	借款金额 /最高授 信额度	借款/ 授信期限	担保 方式
1	综合授信合同	发行人	中国民生银行股份有限公司重庆分行	8,000	2025/6/30- 2026/6/29	最高额 保证
2	流动资金贷款合同	上海物 骐微	上海浦东发展银行股 份有限公司上海自贸 试验区新片区分行	1,980	2024/12/24- 2027/12/23	最高额 保证
3	流动资金借款合同	上海物 骐微	中国工商银行股份有 限公司上海市卢湾支 行	5,000	合同签署日为 2025/4/15，借款 期限为自首次实 际提款日起 12 个 月	保证
4	线上流动资金贷款 总协议、借款借据	上海物 骐微	宁波银行股份有限公 司上海分行	3,000	2025/8/21- 2025/12/31	最高额 保证
5	流动资金贷款合同	物奇科 技	中信银行股份有限公 司重庆分行	1,000	2025/12/30- 2026/12/29	-

（四）IP 授权许可协议

发行人选取报告期初至招股说明书签署日累计履行金额超过 500 万元的 IP 授权许可协议作为重大合同披露。

序号	许可方	被许可方	合同名称	合同内容	有效期限
1	Riviera Waves SAS	上海 物骐微	FIRST AMENDMENT TO LICENSE AGREEMENT	授予被许可方交 付成果的使用权	2023/3/28- 2026/3/27

（五）技术开发协议

序号	技术服务提供方	采购方	合同名称	合同内容	生效日期
1	深圳九天睿芯科 技有限公司	物奇 科技	基于存算一体的 NPU 定 制开发与授权合同	存算一体神经网络 处理单元（NPU） 的定制开发设计	2025/12/10

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在为第三方提供对外担保的情况。

三、重大诉讼或仲裁事项

（一）公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

（二）公司实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员涉及的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

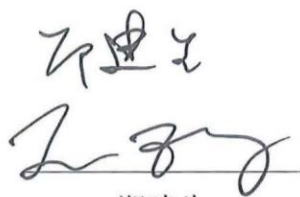
截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人及董事、高级管理人员、核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

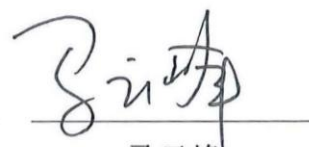
一、发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

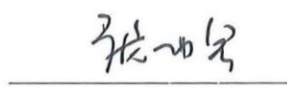
本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：


郑建生
(Jason ZHENG)


林 豪


马云峰


庞功会


姚海锋

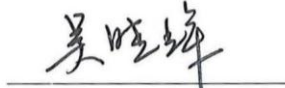

彭 飞


是大龙


杨勤法


徐 鼎


毛武兴


吴晓辉

全体审计委员
会委员：


吴晓辉


杨勤法


毛武兴

其他高级管理
人员：


毛向荣


黄海波



重庆物奇微电子股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

第十一节 声明

一、发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

郑建生
(Jason ZHENG)

林 豪

马云峰

庞功会

姚海锋

彭 飞

是大龙

杨勤法

徐 鼎

毛武兴

吴晓辉

全体审计委员
会委员：

吴晓辉

杨勤法

毛武兴

其他高级管理
人员：

毛向荣

黄海波

重庆物奇微电子股份有限公司

2026 年 6 月 26 日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：


郑建生（Jason ZHENG）



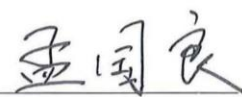
重庆物奇微电子股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


孟国良

保荐代表人：


江 嵘


王 鹏

保荐人法定代表人、总裁：


刘秋明



四、保荐人（主承销商）总裁声明

本人已认真阅读重庆物奇微电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总裁：



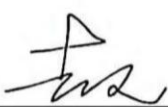
刘秋明



五、保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读重庆物奇微电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：



赵陵



联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：


朱 健



国泰海通证券股份有限公司

2026年6月26日

联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：


姜栋林



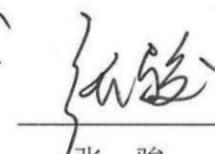
六、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


王 丽

经办律师：


谢显清 王 威 张 骏





地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕14545 号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕14546 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆物奇微电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

李伟海

李伟海

郑宇青

郑宇青

天健会计师事务所负责人：

翁伟

翁伟

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 6 月 26 日



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2023〕207号、天健验〔2023〕208号、天健验〔2023〕209号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆物奇微电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

李伟海

李伟海

郑宇青

郑宇青

天健会计师事务所负责人：

翁伟

翁伟

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 6 月 26 日



九、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：


潘华锋 方水盛

资产评估机构负责人：


潘文夫



第十二节 附件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式文件。备查文件目录如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

工作日上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：30

三、查阅地点

（一）发行人：重庆物奇微电子股份有限公司

办公地址：重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 107 号 14 楼

电话：021-50806308

联系人：毛向荣

（二）保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

电话：021-22169397

联系人：江嵘、王鹏

四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）信息披露及投资者关系安排

1、信息披露与投资者管理制度

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会的有关规定，制定了《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等相关公司治理文件。初步建立起符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，以确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，保障投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

公司将严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，公开、公正、公平地对待所有股东。

2、投资者沟通渠道的建立情况

根据《投资者关系管理制度》，发行人专设董事会办公室负责信息披露和投资者关系，董事会秘书毛向荣为公司投资者关系管理事务的负责人，公司以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。审计委员会应当对投资者关系管理工作制度实施情况进行监督。联系方式具体如下：

联系人：毛向荣

电话：021-50806308

传真：021-50806308

电子邮箱：mao.xiangrong@wuqi-tech.com

（二）发行后的股利分配政策、决策程序

1、利润分配政策

根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》及相关利润分配政策，公司本次发行后的股利分配政策和决策程序具体如下：

（1）利润分配的原则

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并应当符合法律、行政法规的相关规定。

（2）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利且满足公司持续经营和长期发展对资金需求的前提下，优先采用现金方式进行利润分配。

（3）利润分配的周期

在满足现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期利润分配的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

（4）现金分红条件、比例

1) 现金分红的条件

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- ②公司累计未分配利润为正值；
- ③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- ④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；
- ⑤法律法规及《公司章程》规定的其他条件。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

2) 现金分红的比例

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

同时，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- ①当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ②当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第③项规定处理。

3) 股票股利分配的条件

在给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模的前提下，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、年度的盈利情况、现金流状况等因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

4) 存在下列情形之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可低于当年实现的可分配利润的 10%：

①当年实现的每股收益低于 0.1 元（含亏损）；

②当年经审计净资产负债率超过 70%；

③当年经营活动所产生的现金流量净额为负数；

④公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还；

⑤公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

⑥公司存在重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

2、利润分配方案的审议程序

（1）董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定年度利润分配方案、中期利润分配方案；董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）利润分配方案由董事会审议通过后提交股东会审议。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并予以披露。

审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行

现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（3）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

利润分配方案应经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

3、公司利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章、中国证监会、上海证券交易所及本章程的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定。独立董事认为利润分配政策调整方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并予以披露。

调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会审议，该调整议案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）股东投票机制的建立情况

根据《公司章程（草案）》的规定，公司对累积投票制度选举公司董事、中小投资者单独计票机制、法定事项采取网络投票方式召开股东会进行审议表决及征集投票权等内容作出了明确规定。

1、采取累积投票制选举公司董事

股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。

2、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、征集投票权安排

董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合征集人披露征集文件。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、与投资者保护相关的重要承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺

1、发行人实际控制人、董事长、总经理郑建生承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人作为实际控制人，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减

持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；

（7）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的持股及股份变动的有关规定。在担任公司董事长、总经理期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事长、总经理的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事长、总经理的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（8）本人在前述限售期满后减持本人在本次发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；

（9）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（10）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（11）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担

相应的责任。

2、实际控制人控制的企业 NATIVE、物奇捌承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本企业直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本企业所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业作为实际控制人控制的企业，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本企业可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本企业仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的持股及股份变动的有关规定。在担任公司董事长、总经理期间，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事长、总经理的持股及股份变动的有关规

定，如实并及时申报本企业持有的公司股份及其变动情况。本企业不会因实际控制人职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份；

（8）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

3、发行人间接股东、实际控制人之女 Nina Li Zheng 承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人作为发行人的股东，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司股东的持股及股份变动的有关规定。

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（8）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

4、实际控制人的一致行动人任泽生承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人作为实际控制人的一致行动人，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的一致行动人的持股及股份变动的有关规定；

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（8）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

5、实际控制人的一致行动人、董事、副总经理、核心技术人员林豪承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若

发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人作为实际控制人的一致行动人，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）在本人担任公司董事、高级管理人员期间内，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；

（7）在本人作为公司核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，自本人所持首次公开发行上市前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行上市前股份不超过上市时本人所持公司首次公开发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

（8）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的一致

行动人的持股及股份变动的有关规定。在担任公司董事、副总经理、核心技术人员期间内，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、副总经理、核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、副总经理、核心技术人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（9）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（10）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（11）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

6、发行人直接股东熊飞承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当

年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于持股及股份变动的有关规定；

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（8）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

7、申报前 6 个月内间接受让实际控制人股份的新增股东刘辉承诺

（1）就本人在公司提交首次公开发行并上市申请前 6 个月内取得的公司股份（“新增股份”），自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理、也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行前持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）公司股票上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司股票上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份；

（6）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（7）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（8）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

8、申报前 12 个月新增股东重庆战新、洪泰嘉晟、北碚西证、合顺盈二号、泰科源、王飞、远致星火承诺

（1）就本企业/本人在公司提交首次公开发行并上市申请前 12 个月内取得的公司股份（“新增股份”），自本企业/本人取得该等新增股份之日起 36 个

月内，不转让或者委托他人管理该等新增股份，也不提议由公司回购该等新增股份；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于公司首次公开发行上市前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（3）本企业/本人在锁定期届满后减持首次公开发行上市前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务；如本企业/本人违反上述承诺减持发行人股份的，则减持该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业/本人自行承担。

9、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员马云峰、庞功会、黄海波、毛向荣承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；在前述期间

内离职的，应当继续遵守前述承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；

（6）在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（8）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

10、间接持有发行人股份的董事是大龙承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已间接持有的公司股份（对应股份 785 股，若发行人进行资本公积转增股本、送红股等权益分派，上述股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同），也不提议由公司回购该部分股份；

（2）若公司股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将

作相应调整），本人前述间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（3）作为董事/高级管理人员，若本人前述间接所持发行人股票在股份锁定期届满后 2 年内减持的，股份减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发价将作相应调整）；

（4）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持前述本次发行前间接持有的公司股份；本人在前述期间内离职的，应当继续遵守前述承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持前述本次发行前间接持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（5）前述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员职务期间内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（本人所持发行人股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受本条承诺转让比例的限制）。如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，亦不转让本人前述间接持有的公司股份；

（6）在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（7）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前，本人承诺不减持前述间接持有的公司股份；

（8）在本人间接持有发行人股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（9）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相

应的责任。

11、间接持有发行人股份的核心技术人员古强、韦韧承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）公司股票上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本次发行前持有的公司股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守前述承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持本次发行前持有的公司股份，但本人仍应遵守所作出的其他股份锁定承诺；

（3）在本人作为公司核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，自本人所持首次公开发行上市前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行上市前股份不超过上市时本人所持公司首次公开发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；

（4）在本人作为公司核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行核心技术人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺；

（5）公司存在上海证券交易所业务规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份；

（6）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（7）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

12、持股 5%以上股份的股东中移股权基金承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（3）本企业在锁定期届满后减持首次公开发行上市前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行适用的信息披露义务；如本企业违反上述承诺减持发行人股份的，则将依法承担相关法律责任。

13、公司股东 Astrend 承诺

（1）自公司首次公开发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司首次公开发行上市前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）在本企业持有发行人首次公开发行上市前股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定发生变化且明确适用于本企业持有的上述股份，则本企业愿意自动使用变更后的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定；

（3）本企业在上述锁定期届满后减持发行人首次公开发行上市前股份的，将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定；如本企业违反上述承诺减持发行人股份的，本企业承诺依法承担相应的法律责任。

14、其他股东承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若

股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；

（3）本人/本企业在锁定期届满后减持首次公开发行上市前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务；如本人/本企业违反上述承诺减持发行人股份的，则减持该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人/本企业自行承担。

（二）关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺

1、发行人实际控制人、董事长、总经理郑建生及其一致行动人林豪、任泽生承诺

（1）本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本人所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人股份的可能。在此情形下，本承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人自身经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持的发行人股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本人所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格根据当时的二级市场价格确定；同时，本人及一致行动人合计直接或间接持有公司 5%以上股份期间，若通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，本人将在首次减持的 15 个交易日前披露减持计划，通过其他方式减持的，本人将提前 3 个交易日通知公司并予以公告；

（4）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监

管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

2、实际控制人控制的企业 NATIVE、物奇捌承诺

（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本企业所持发行人股份的锁定期届满后，出于本企业自身需要，本企业存在适当减持发行人股份的可能。在此情形下，本承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本企业自身经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本企业将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持的发行人股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本企业所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格根据当时的二级市场价格确定；同时，本企业持有公司股份期间，若通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，本企业将在首次减持的 15 个交易日前披露减持计划，通过其他方式减持的，本企业将提前 3 个交易日通知公司并予以公告；

（4）若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。在本企业持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、发行人间接股东、实际控制人之女 Nina Li Zheng 承诺

（1）本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本人所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人股份的可能。在此情形下，本承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人自身经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在

发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持的发行人股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本人所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格根据当时的二级市场价格确定；同时，本人合计直接或间接持有公司 5%以上股份期间，若通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，本人将在首次减持的 15 个交易日前披露减持计划，通过其他方式减持的，本人将提前 3 个交易日通知公司并予以公告；

（4）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、申报前 6 个月间接受让实际控制人股份的新增股东刘辉承诺

（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本人所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人股份的可能。在此情形下，本承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人自身经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持的发行人股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本人所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格根据当时的二级市场价格确定；同时，本人持有公司股份期间，若通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，本人将在首次减持的 15 个交易日前披露减持

计划，通过其他方式减持的，本人将提前 3 个交易日通知公司并予以公告；

（4）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5、持股 5%以上股份的股东中移股权基金承诺

（1）在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本企业所持发行人股份的锁定期届满后，出于本企业自身需要，本企业存在减持发行人股份的可能。在此情形下，本企业计划减持的，将结合本企业自身经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本企业将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，一定期限内减持的发行人股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本企业持有公司 5%以上股份期间，本企业所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格结合当时的二级市场价格及本企业退出策略确定；若通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，本企业将在首次减持的 15 个交易日前披露减持计划，通过其他方式减持的，本企业将提前 3 个交易日通知公司并予以公告；

（4）若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。在本企业持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

6、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员马云峰、庞功会、黄海波、毛向荣承诺

（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份；

（2）在本人间接所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持间接所持的发行人股份的可能。在此情形下，本人承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持间接持有的发行人股份数量不超过相关法律法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本人间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指本次公开发行上市的发行价格，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；

（4）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

7、间接持有发行人股份的董事是大龙承诺

（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前间接持有的发行人股份（对应股份 785 股，若发行人进行资本公积转增股本、送红股等权益分派，上述股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）；

（2）在本人前述间接所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持前述间接所持的发行人股份的可能。在此情形下，本人承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持前述间接所持发行人股份，每十二个月内减持前述间接持有的发行人股份数量不超过相关法律法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所

集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）本人前述间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；

（4）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

8、间接持有发行人股份的核心技术人员古强、韦韧承诺

（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行前持有的公司股份。

（2）在本人间接所持发行人股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持间接所持的发行人股份的可能。在此情形下，本人承诺计划减持的，将结合发行人稳定股价、本人投资需要，审慎制定股份减持计划，且不违反在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺。锁定期届满后，本人将按照相关法律法规、规范性文件的规定和届时监管政策的要求减持发行人股份，每十二个月内减持间接持有的发行人股份数量不超过相关法律法规、规范性文件的限制。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式；

（3）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（三）关于稳定公司股价的预案及承诺

1、发行人上市后三年内稳定公司股价预案

（1）稳定股价措施的启动条件

公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，须进行相应调整，下同）时（以下简称“触发稳定股价条件”），则启动稳定股价措施，并提前公告具体实施方案。

（2）稳定股价措施的终止条件

在公司采取稳定股价的措施后，公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产，或继续实施股票稳定措施将导致股权分布不符合上市条件，或各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的金量的金额已达到上限。

公司稳定股价措施实施完毕或终止实施后，如再次发生启动条件，则再次启动稳定股价措施。

（3）稳定股价的具体措施

稳定股价措施的启动条件触发后，公司及相关主体将根据公司董事会或股东会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1）公司回购股票

公司将自股价稳定方案履行完毕决策程序之日起 90 个自然日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份，回购股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司股东会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人就该等回购股份的相关决议投赞成票。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

2）实际控制人增持公司股票

在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司实际控制人增持股票。

郑建生承诺将自出现实际控制人增持事项起 10 个交易日内，以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自郑建生提出的股价稳定方案公告次日起，郑建生可以开始实施增持计划。

郑建生将自股价稳定方案公告之日起 180 个自然日内通过证券交易所交易系统增持公司社会公众股份，用于稳定股价增持公司股票的资金金额不低于其在上一年度从公司获得的现金分红（税后）金额的 10%，连续 12 个月累计用于稳定股价增持公司股票的资金金额不超过其在上一年度从公司所获得现金分红（税后）累计金额的 30%，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

在发行人就稳定股价而回购股份事宜召开的董事会及股东会上，郑建生对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

3）在公司任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票

公司实际控制人增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事及高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。负有增持义务董事、高级管理人员自提出的股价稳定方案公告次日起，可以开始实施增持计划。

负有增持义务的董事及高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 180 个自然日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，各自用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的 30%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增

持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，连续 12 个月内不超过上一年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。

在负有增持义务的董事、高级管理人员稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票，如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则本公司有权将对其从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留，直至其履行完毕增持义务。

公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就稳定股价而回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

2、稳定股价的承诺

（1）发行人承诺

1) 公司将根据《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东会审议通过后实施。

公司股东会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，金额不少于公司上一年度净利润的 10%。

2) 公司股票回购预案经公司股东会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 个工作日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

4) 在《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）发行人的实际控制人郑建生承诺

1) 若发行人董事会或股东会审议通过的稳定股价措施包括本企业增持公司股票，本承诺人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2) 在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。

3) 在《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东会及信息

披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本承诺人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。

（3）在公司任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺

1）若发行人董事会或股东会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2）发行人董事确认在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。

3）在《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。

（四）关于股份回购和股份购回的承诺

1、发行人承诺

若中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行

条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《重庆物奇微电子股份有限公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东会审议。发行人将根据股东会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

2、发行人实际控制人郑建生承诺

若中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并在发行人召开股东会审议回购股份方案时投赞成票，同时本人/本企业也将购回发行人上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

（五）关于欺诈发行上市股份购回的承诺

1、发行人承诺

（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

2、发行人实际控制人郑建生承诺

（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行

上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

（六）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司董事会就本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体已出具承诺。

1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施

（1）提升公司整体实力，扩大公司业务规模

公司目前正处于稳步发展阶段，首次公开发行股票上市完成后，公司的总资产规模和净资产规模都将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力进一步增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的行业发展机遇，不断拓展公司主营业务规模，巩固和提升公司的市场竞争地位，增强公司的盈利能力。

（2）公司将不断提高运营效率，降低运营成本，提升经营业绩

公司将持续推进内部控制制度建设，不断丰富和完善公司业务发展模式，巩固和提升公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利能力。另外，公司将加强日常经营管理和预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。

（3）加快募集资金投资项目建设，确保投资尽快实现预期收益

公司本次募集资金投资项目包括新一代 Wi-Fi 7 AP 芯片研发及产业化项目、端侧智能芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金，均与公司主营业务相关。公司将加快募集资金投资项目的建设进度，尽快提升公司盈利能力，并在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目的建设顺利推进，在实现预期收益的前提下尽可能产生最大效益以回报股东。

（4）持续研发创新，提高公司竞争能力和盈利能力

经过多年专注于网络通信芯片与端侧智能芯片两大核心方向，公司进行了多项自主创新，使公司具备较强的科研技术实力。未来，发行人将始终顺应行

业发展趋势，紧密围绕国家产业政策导向、行业技术迭代方向及下游市场核心需求，依托现有产品布局与技术积累，集中核心资源持续加大 Wi-Fi、端侧 AI 等行业前沿技术的研发投入，逐步构建具有完全自主知识产权、供应链自主，且能够满足消费电子、智能家居、机器人等多领域应用需求的通信与端侧计算芯片产品及技术体系，推动公司提升核心竞争力、盈利能力及抗风险能力。

（5）完善利润分配政策，强化投资者回报

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低首次公开发行上市对公司即期回报摊薄的影响，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

2、实际控制人郑建生承诺

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

3、公司全体董事、高级管理人员承诺

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）积极行使自身职权以促使公司董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如公司未来实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（七）关于利润分配的承诺

1、发行前滚存利润的分配

根据公司股东会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润未弥补亏损在公司首次公开发行股票并在科创板上市后由新老股东按持股比例共同享有或承担。

2、发行人关于利润分配政策的承诺

为维护公众投资者的利益，发行人就上市后的利润分配政策作出承诺如下：

本次发行上市后，本公司将严格依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《重庆物奇微电子股份有限公司章程（草案）》《重庆物奇微电子股份有限公司关于利润分配政策的预案》及《重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。本公司做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

（八）关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人及其实际控制人郑建生、实际控制人的一致行动人任泽生、林豪，发行人间接股东、实际控制人之女 Nina Li Zheng 及发行人董事、高级管理人员承诺如下：

（1）本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受经济损失的，本公司将在证券监督管理部门、司法机关就该等事实作出生效认定后，以其认定的责任及金额依法承担相应的赔偿责任；

（3）在本公司收到上述认定文件后 2 个交易日内，本公司及相关方将就该项等事项进行公告/本人将促使公司及相关方就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况；

（4）若上述本公司赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告/本人将促使公司及时进行公告，并将在定期报告中披露本公司及实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员关于本公司赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；

（5）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（九）关于避免同业竞争的承诺

1、实际控制人郑建生及其一致行动人林豪、任泽生，发行人间接股东、实际控制人之女 Nina Li Zheng 承诺

（1）截至承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本人及本人控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动的情形。本人亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业

从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

（2）如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。

（3）本人及本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）本人保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。

（5）如出现因本人、本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。

（6）本人声明上述承诺系本人真实意思表示。

2、实际控制人控制的企业 NATIVE、物奇捌承诺

（1）截至承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本企业及本企业控制的其他企业（如有，下同）不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影

响的业务活动的情形。本企业亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

（2）如果未来本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本企业承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本企业控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本企业控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本企业控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。

（3）本企业及本企业控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）本企业保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。

（5）如出现因本企业、本企业控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本企业未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。

（6）本企业声明已就出具上述承诺履行了内部必要的审批程序。

（十）关于规范关联交易的承诺

1、实际控制人郑建生及其一致行动人林豪、任泽生，发行人间接股东、实际控制人之女 Nina Li Zheng 及发行人董事、高级管理人员承诺

（1）本人将尽可能的减少和规范本人或本人控制的其他企业与发行人之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律法规和规范性文件以及发行人章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；

（3）本人保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在发行人中的地位 and 影响，违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保；

（4）本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为发行人关联人期间内有效。

2、持股 5% 以上股份的股东中移股权基金承诺

（1）本企业将尽可能的减少和规范本企业或本企业控制的其他企业与发行人之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业或本企业控制的其他企业将根据有关法律法规和规范性文件以及发行人章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；

（3）本企业保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业

在发行人中的地位 and 影响，违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保；

（4）本承诺自本企业盖章之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为发行人关联人期间内有效。

（十一）关于股东信息披露的专项承诺

发行人关于股东信息披露的真实性、准确性、完整性作出如下承诺：

1、本公司不存在中华人民共和国法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

2、本公司历史沿革中曾存在股权代持的情况，该等代持已全部解除，股权代持的形成、演变及解除过程中不存在纠纷或者潜在纠纷；本公司已在招股说明书中披露了股权代持的形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等情况；截至本专项承诺出具之日，本公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

3、截至本专项承诺出具之日，保荐机构控股股东中国光大集团股份有限公司所投资的主体是本公司股东穿透过程中出现的间接出资人，穿透层级较远且穿透后持股比例极低，合计间接持有本公司的股份不足 0.005%；本公司股东重庆北碚西证私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之一西证股权投资有限公司系为本次发行联席主承销商之一西南证券股份有限公司的全资子公司。除上述情况外，本公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份，与本公司也不存在其他权益关系；

4、本公司及本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形；

5、本公司及本公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面地配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法履行了信息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

（十二）关于未能履行承诺的约束措施的承诺

公司及相关主体就公司首次公开发行作出相关承诺，为强化对公开承诺事项的约束，公司及相关主体同时提出了未能履行公开承诺事项的约束措施，具体如下：

1、发行人承诺

公司关于未履行承诺的约束措施如下：

（1）本公司将在公司股东会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定媒体上公开作出解释并道歉；

（2）若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本公司将继续履行该承诺；

（3）若有关监管机关要求期限内予以整改或对本公司进行处罚的，本公司将依法予以整改或接受处罚；

（4）如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；

（5）如因不可抗力导致，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护投资者利益；

（6）如本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准；

（7）根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

2、发行人实际控制人郑建生及其女儿 Nina Li Zheng、一致行动人林豪、任泽生承诺

发行人实际控制人郑建生及其女儿 Nina Li Zheng、一致行动人林豪、任泽生承诺将严格履行在公司本次发行上市过程中所作出的各项承诺，若未能完全且有效地履行，则将采取以下约束措施：

（1）本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定媒体上公开作出解释并道歉；

（2）若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺；

（3）若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚；

（4）如非因不可抗力导致，若给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法向公司和其他投资者承担赔偿责任；在履行完毕前述赔偿责任前，本人持有的公司股份不得转让，公司有权扣减本人所持全部股份获分配的现金红利以及本人应在公司领取的薪酬、津贴（如有）用于承担前述赔偿责任；

（5）如因不可抗力导致，本人将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益；

（6）如本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准；

（7）根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

3、公司董事、高级管理人员及核心技术人员承诺

董事、高级管理人员及核心技术人员承诺将严格履行在公司本次发行上市过程中所作出的各项承诺，若未能完全且有效地履行，则将采取以下约束措施：

（1）本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定媒体上公开作出解释并道歉；

（2）若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺；

（3）若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚；

（4）如非因不可抗力导致，若给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法向公司和其他投资者承担赔偿责任；在履行完毕前述赔偿责任前，本人持有的公司股份（如有）不得转让，公司有权扣减本人所持全部股份获分配的现金红利（如有）以及本人应在公司领取的薪酬、津贴用于承担前述赔偿责任；

（5）如因不可抗力导致，本人将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益；

（6）如本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准；

（7）根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

（十三）本次发行相关中介机构的承诺

1、保荐机构承诺

（1）本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面调查，依法出具了本次发行申请的相关文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（2）因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关作出最终认定后，本公司将依法赔偿投资者损失。

2、发行人律师承诺

（1）本所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（2）若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所依法承担赔偿责任：1）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商；2）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定本所出具的申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成重大影响，且本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判定后启动赔偿投资者损失的相关工作；3）经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。

（3）上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责

任。

3、发行人审计机构/验资机构承诺

本所及签字注册会计师承诺，因本所及签字注册会计师为重庆物奇微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、发行人资产评估机构承诺

（1）本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面调查，依法出具了本次发行申请的相关文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（2）因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关作出最终认定后，本公司将依法赔偿投资者损失。

六、股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东（大）会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司制定了《股东（大）会议事规则》，对股东（大）会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等内容作出了详细明确的规定。

截至本招股说明书签署之日，历次股东（大）会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规，以及《公司章程》《股东（大）会议事规则》的相关规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、

董事会的提案与通知、董事会的召开、董事会的表决和决议等内容作出了详细明确的规定。

截至本招股说明书签署之日，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；董事会设董事长一人。发行人的董事由股东会选举产生，董事会对发行人股东会负责。

截至本招股说明书签署之日，历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的召集、监事会的提案与通知、监事会的召开、监事会的表决和决议等内容作出了详细明确的规定。截至本招股说明书签署之日，发行人历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

2025 年 8 月 13 日，根据《公司法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，不再设置监事会或监事。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的独立性、任职条件、提名、选举和更换、职责、权利和义务等内容作出了详细明确的规定。公司现有独立董事 4 名。

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前不得无故被免职。

公司独立董事自上任以来严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，在规范公司运作、

加强风险管理、完善内部控制、保障中小股东利益及提高董事会决策水平等方面起到了积极作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格和任免程序、董事会秘书的职责等内容作出了详细明确的规定。公司设董事会秘书1名，对董事会负责。

公司董事会秘书作为高级管理人员，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，任职期间按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》等工作要求履行职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东会正常行使职权发挥了重要的作用。

公司设立以来，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步完善公司法人治理结构，制定《公司章程》，建立了由股东（大）会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东（大）会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责战略决策、公司审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作，为公司董事会科学决策提供支持。

通过以上对公司组织机构、制度的建立健全，公司逐步建立、完善了符合上市要求、保障公司稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权力的公司治理结构。

七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》等各专门委员会的工作制度，明确各委员会工作职责与工作方式等内容。

各专门委员会成员全部由董事组成，设主任委员一名并担任召集人，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的主任委员为会计专业人士。公司各专门委员会的人员构成情况如下：

委员会名称	召集人	成员
审计委员会	吴晓辉	吴晓辉、杨勤法、毛武兴
提名委员会	杨勤法	杨勤法、徐鼎、郑建生
薪酬与考核委员会	杨勤法	杨勤法、徐鼎、马云峰
战略委员会	郑建生	郑建生、林豪、徐鼎

各专门委员会自设立以来，按照各专门委员会工作的工作制度等有关规定展开工作，充分地履行了其职责。

八、发行人主要无形资产情况

（一）商标

截至 2025 年 12 月 31 日，登记在公司及其子公司名下的与生产经营相关的主要商标情况如下：

序号	申请人	图案	注册号	国际分类	有效期	取得方式
1	发行人		24590295	9	2018/6/14-2028/6/13	受让取得
2	发行人		43088348	9	2020/12/7-2030/12/6	受让取得
3	发行人		43684627	9	2021/1/28-2031/1/27	受让取得
4	发行人		62343077	45	2022/8/7-2032/8/6	原始取得
5	发行人		62339245	38	2022/8/7-2032/8/6	原始取得
6	发行人		50456097	9	2021/8/28-2031/8/27	原始取得
7	发行人		50443406	9	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
8	发行人		43695581	9	2020/11/7-2030/11/6	受让取得

序号	申请人	图案	注册号	国际分类	有效期	取得方式
9	发行人		69483584	38	2023/8/7-2033/8/6	原始取得
10	发行人		69479182	9	2023/8/7-2033/8/6	原始取得
11	发行人		69482547	42	2023/8/7-2033/8/6	原始取得
12	发行人		69475152	35	2023/8/21-2033/8/20	原始取得
13	发行人		306173857	9	2023/2/21-2033/2/20	原始取得
14	发行人		306173875	9	2023/2/21-2033/2/20	原始取得

（二）专利

截至 2025 年 12 月 31 日，公司获得已授权境内专利共 121 项，其中已授权发明专利 109 项，实用新型专利 12 项。

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
1	物奇科技	一种 PLC 网络台区识别方法及载波通信模块	ZL201710367539.4	2017/5/23	发明	原始取得	有效	无
2	物奇科技	结合无线窄带载波中继的电力线宽带载波抄表系统	ZL201720576537.1	2017/5/23	实用新型	原始取得	有效	无
3	物奇科技	电力线载波通信中对数据符号进行频域信息扩展的方法	ZL201710764337.3	2017/8/30	发明	原始取得	有效	无
4	物奇科技	深度传感器、探测系统及传感器的发射功率的控制方法	ZL201711404639.6	2017/12/22	发明	原始取得	有效	无
5	物奇科技	用于电力线载波通信系统传输中带宽自适应的方法	ZL201711420494.9	2017/12/25	发明	原始取得	有效	无
6	物奇科技	采用识别卡和设备唯一编码配对的多联机空调 PLC 组网方法	ZL201810191267.1	2018/3/8	发明	原始取得	有效	无
7	物奇科技	通过识别卡进行配对组网的多联机空调系统及其组网方法	ZL201810191148.6	2018/3/8	发明	原始取得	有效	无
8	物奇科技	通过室外机连接管配对和识别卡配对的 PLC 组网方法	ZL201810191546.8	2018/3/8	发明	原始取得	有效	无
9	物奇科技	通过设备唯一编码配对和识别卡配对的 PLC 组网方法	ZL201810191535.X	2018/3/8	发明	原始取得	有效	无
10	物奇科技	多联机空调通过设备唯一编码与物理地址实现的组网方法	ZL201810191478.5	2018/3/8	发明	原始取得	有效	无
11	物奇科技	通过识别卡进行配对组网的多联机空调系统	ZL201820319208.3	2018/3/8	实用新型	原始取得	有效	无
12	物奇科技	一种可重构滤波器	ZL201820333984.9	2018/3/12	实用新型	原始取得	有效	无
13	物奇科技	一种空调除霜除冰系统	ZL201820354349.9	2018/3/15	实用新型	原始取得	有效	无
14	物奇科技	一种语音控制器	ZL201820544855.4	2018/4/17	实用新型	原始取得	有效	无
15	珠海荣奇微电子科技有限公司、物奇科技	一种空调内机智能检测和控制系统及方法	ZL201820629722.7	2018/4/28	实用新型	原始取得	有效	无
16	上海物骐微	一种降噪设备	ZL201820685334.0	2018/5/9	实用新型	继受取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
17	物奇科技	用于模拟节点间通信的系统	ZL201810813980.5	2018/7/23	发明	原始取得	有效	无
18	物奇科技	一种模拟节点间通信的方法	ZL201810813045.9	2018/7/23	发明	原始取得	有效	无
19	物奇科技	蓝牙设备、系统及调度方法	ZL201811400686.8	2018/11/22	发明	原始取得	有效	无
20	物奇科技	蓝牙设备、蓝牙设备间信息传输的方法和蓝牙通信系统	ZL201811400750.2	2018/11/22	发明	原始取得	有效	无
21	物奇科技	蓝牙设备、蓝牙设备间的组网方法和蓝牙通信系统	ZL201811400754.0	2018/11/22	发明	原始取得	有效	无
22	物奇科技	电子价签、网关及电子价签系统	ZL201910049765.7	2019/1/18	发明	原始取得	有效	无
23	物奇科技	用于电子价签系统的组网方法	ZL201910049764.2	2019/1/18	发明	原始取得	有效	无
24	物奇科技	低能耗电子价签系统	ZL201910049767.6	2019/1/18	发明	原始取得	有效	无
25	物奇科技	用于电子价签的通信方法	ZL201910049770.8	2019/1/18	发明	原始取得	有效	无
26	物奇科技	一种集中式的最优 AP 快速关联方法	ZL201910152551.2	2019/2/28	发明	原始取得	有效	无
27	物奇科技	一种无线数据重传方法	ZL201910511171.3	2019/6/13	发明	原始取得	有效	无
28	物奇科技	一种无线数据传输方法、设备及系统	ZL201910576596.2	2019/6/28	发明	原始取得	有效	无
29	物奇科技	一种可靠传输数据的无线传输方法、设备及系统	ZL201910578524.1	2019/6/28	发明	原始取得	有效	无
30	物奇科技	一种联合电压电流检测的台区分支识别方法及系统	ZL201910893631.3	2019/9/20	发明	原始取得	有效	无
31	物奇科技	一种基于正弦电流扰动的台区分支识别方法及系统	ZL201910893602.7	2019/9/20	发明	原始取得	有效	无
32	物奇科技	一种台区分支识别装置	ZL201921761683.7	2019/10/18	实用新型	原始取得	有效	无
33	物奇科技	用于无线通信的设备主从角色切换系统及方法	ZL201911370402.X	2019/12/26	发明	原始取得	有效	无
34	物奇科技	一种增强机器类通信 e-MTC 的定位参考信号搜索方法	ZL201911379425.7	2019/12/27	发明	原始取得	有效	无
35	物奇科技	一种窄带物联网 NB-IoT 的窄带广播信道增强合并方法	ZL201911382385.1	2019/12/27	发明	原始取得	有效	无
36	物奇科技	一种窄带物联网 NB-IoT 的分层快速搜索方法	ZL201911379457.7	2019/12/27	发明	原始取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
37	物奇科技	一种 NB-IOT 终端芯片窄带上行共享信道发送功率控制方法	ZL202010085366.9	2020/2/10	发明	原始取得	有效	无
38	物奇科技	一种 NB-IoT 系统 PSM 模式控制方法及系统	ZL202010085345.7	2020/2/10	发明	原始取得	有效	无
39	物奇科技	一种 NB-IoT 混合重传方法及系统	ZL202010112360.6	2020/2/24	发明	原始取得	有效	无
40	物奇科技	一种 NB-IoT 寻呼处理方法及系统	ZL202010112362.5	2020/2/24	发明	原始取得	有效	无
41	物奇科技	一种省电的 NB-IoT 芯片及 NB-IoT 省电方法	ZL202010112365.9	2020/2/24	发明	原始取得	有效	无
42	上海物骐微	一种低辐射的省电蓝牙系统及方法	ZL202010949496.2	2020/9/10	发明	原始取得	有效	无
43	上海物骐微	一种无线设备波束调节方法	ZL202011066009.4	2020/9/30	发明	原始取得	有效	无
44	上海物骐微	一种基于灰狼算法的主动噪声控制方法及系统	ZL202110269323.0	2021/3/12	发明	原始取得	有效	无
45	上海物骐微	基于人工免疫算法的主动降噪优化方法及系统	ZL202110272158.4	2021/3/12	发明	原始取得	有效	无
46	上海物骐微	基于蚁狮优化算法的主动降噪方法	ZL202110272161.6	2021/3/12	发明	原始取得	有效	无
47	上海物骐微	一种降噪耳机前馈滤波器目标频响检测方法及系统	ZL202110269322.6	2021/3/12	发明	原始取得	有效	无
48	上海物骐微	全集成多功能充电管脚控制电路及无线耳机	ZL202110282613.9	2021/3/16	发明	原始取得	有效	无
49	上海物骐微	一种交流启动电路	ZL202120503801.5	2021/3/9	实用新型	原始取得	有效	无
50	上海物骐微	一种直流启动电路	ZL202120505493.X	2021/3/9	实用新型	原始取得	有效	无
51	上海物骐微	一种低功耗启动电路	ZL202110258164.4	2021/3/9	发明	原始取得	有效	无
52	上海物骐微	低功耗状态控制电路	ZL202110275941.6	2021/3/15	发明	原始取得	有效	无
53	上海物骐微	一种重传数据包合并纠错方法及系统	ZL202110327674.2	2021/3/26	发明	原始取得	有效	无
54	上海物骐微	一种高可靠性蓝牙数据传输系统及方法	ZL202110287400.5	2021/3/17	发明	原始取得	有效	无
55	上海物骐微	一种基于中继的多设备数据传输系统及方法	ZL202110286110.9	2021/3/17	发明	原始取得	有效	无
56	上海物骐微	蓝牙快速组网方法、系统及蓝牙耳机	ZL202110272157.X	2021/3/12	发明	原始取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
57	上海物骐微	无线通信系统及方法	ZL202111123131.5	2021/9/24	发明	原始取得	有效	无
58	上海物骐微	一种音频数据通信方法及无线音频系统	ZL202111120602.7	2021/9/24	发明	原始取得	有效	无
59	上海物骐微	无线数据传输系统及方法	ZL202111272738.X	2021/10/29	发明	原始取得	有效	无
60	上海物骐微	听力损伤预警方法、存储介质及音频设备	ZL202111182583.0	2021/10/11	发明	原始取得	有效	无
61	上海物骐微	声音信号处理方法、装置、系统、设备和存储介质	ZL202111234204.8	2021/10/22	发明	原始取得	有效	无
62	上海物骐微	一种无线音频监听方法及无线音频系统	ZL202111340912.X	2021/11/12	发明	原始取得	有效	无
63	上海物骐微	一种音频同步调节方法及音频设备	ZL202111172783.8	2021/10/8	发明	原始取得	有效	无
64	物奇科技	电力线载波通信冲突域集中式控制方法、系统及存储介质	ZL202111357235.2	2021/11/16	发明	原始取得	有效	无
65	上海物骐微	反射面的电量管理方法、系统、电子设备及存储介质	ZL202111339100.3	2021/11/12	发明	原始取得	有效	无
66	上海物骐微	身份认证方法、装置、设备和存储介质	ZL202210221145.9	2022/3/9	发明	原始取得	有效	无
67	物奇科技、上海物骐微	一种台区拓扑识别方法、装置及存储介质	ZL202111543919.1	2021/12/16	发明	原始取得	有效	无
68	物奇科技、上海物骐微	一种台区拓扑识别装置及系统	ZL202123178613.9	2021/12/16	实用新型	原始取得	有效	无
69	上海物骐微	信号传输方法、装置、系统、设备和存储介质	ZL202111571891.2	2021/12/21	发明	原始取得	有效	无
70	物奇科技、上海物骐微	基于电流信号检测的台区拓扑识别方法及系统	ZL202111570214.9	2021/12/21	发明	原始取得	有效	无
71	上海物骐微	固件发送方法、固件接收方法及固件升级系统	ZL202111597974.9	2021/12/24	发明	原始取得	有效	无
72	上海物骐微	适用多场景的 DPD 分频段校正方法及应用	ZL202111632084.7	2021/12/29	发明	原始取得	有效	无
73	上海物骐微	无线通信方法、装置、系统、设备和存储介质	ZL202111672142.9	2021/12/31	发明	原始取得	有效	无
74	上海物骐微	用于 WiFi 宽带收发通路的 IQ 失衡补偿方法及应用	ZL202210016521.0	2022/1/7	发明	原始取得	有效	无
75	上海物骐微	信号增强方法及信号增强系统	ZL202210071639.3	2022/1/21	发明	原始取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
76	上海物骐微	适用于 WiFi 无记忆功放的预失真校准方法及应用	ZL202210074424.7	2022/1/21	发明	原始取得	有效	无
77	物奇微、上海物骐微	高精度多相 CFR 系统及方法	ZL202210099158.3	2022/1/27	发明	原始取得	有效	无
78	物奇微、上海物骐微	数据交互方法、耳机设备及计算机可读取存储介质	ZL202210363729.X	2022/4/7	发明	原始取得	有效	无
79	上海物骐微	活动信息监测方法、装置、系统、设备和存储介质	ZL202210404077.X	2022/4/18	发明	原始取得	有效	无
80	物奇微、上海物骐微	耳机降噪方法、耳机设备及计算机可读取存储介质	ZL202210480103.7	2022/5/5	发明	原始取得	有效	无
81	上海物骐微	跨区域活动感知方法及系统	ZL202210523332.2	2022/5/13	发明	原始取得	有效	无
82	上海物骐微	多目标活动感知方法及系统	ZL202210612424.8	2022/5/31	发明	原始取得	有效	无
83	上海物骐微	信道均衡方法、装置、终端、及计算机可读存储介质	ZL202210902053.7	2022/7/29	发明	原始取得	有效	无
84	上海物骐微	耳机降噪方法、装置、电子设备及计算机可读取存储介质	ZL202210828366.2	2022/7/13	发明	原始取得	有效	无
85	上海物骐微	耳机降噪方法、装置、电子设备及计算机可读取存储介质	ZL202210828359.2	2022/7/13	发明	原始取得	有效	无
86	上海物骐微	Wi-Fi 信号处理方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202210852556.8	2022/7/19	发明	原始取得	有效	无
87	上海物骐微	无失真的中值滤波边界填充方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202210903358.X	2022/7/27	发明	原始取得	有效	无
88	物奇科技	一种数据传输方法及固件升级方法	ZL202210945861.1	2022/8/8	发明	原始取得	有效	无
89	上海物骐微	信号覆盖方法及系统	ZL202210962223.0	2022/8/11	发明	原始取得	有效	无
90	上海物骐微	RF 芯片线损测试方法、系统、可读储存介质及电子设备	ZL202211000593.2	2022/8/19	发明	原始取得	有效	无
91	上海物骐微	蓝牙同步方法、系统、蓝牙设备及计算机可读取存储介质	ZL202211085767.X	2022/9/6	发明	原始取得	有效	无
92	物奇科技	一种导频自适应方法、通信系统、设备及存储介质	ZL202211474604.0	2022/11/22	发明	原始取得	有效	无
93	上海物骐微	神经网络的安全保护方法、系统、加速器及芯片	ZL202211719081.1	2022/12/30	发明	原始取得	有效	无
94	上海物骐微	基于 WiFi 的手势识别方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310073504.5	2023/1/16	发明	原始取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
95	上海物骐微	基于 PDP 的手势识别方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310073460.6	2023/1/16	发明	原始取得	有效	无
96	上海物骐微	基于蓝牙 LE 音频的数据调度方法、装置及存储介质	ZL202310043492.1	2023/1/29	发明	原始取得	有效	无
97	上海物骐微	多路蓝牙链接的混合通信系统及方法	ZL202310315539.5	2023/3/29	发明	原始取得	有效	无
98	上海物骐微	基于 PDP 的行为识别方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310189030.0	2023/3/1	发明	原始取得	有效	无
99	上海物骐微	基于信道估计的行为识别方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310188495.4	2023/3/1	发明	原始取得	有效	无
100	上海物骐微	蓝牙低功耗音频网络的通信系统、方法及存储介质	ZL202310192113.5	2023/3/2	发明	原始取得	有效	无
101	物奇科技	一种基于电力线载波的数据传输方法、系统及存储介质	ZL202310207439.0	2023/3/6	发明	原始取得	有效	无
102	上海物骐微	信号幅度预补偿方法、装置及 Wi-Fi 发射机	ZL202310310435.5	2023/3/27	发明	原始取得	有效	无
103	上海物骐微	本振信号产生电路、产生方法及无线通信系统	ZL202310333246.X	2023/3/30	发明	原始取得	有效	无
104	上海物骐微	网络部署优化方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202310396225.2	2023/4/13	发明	原始取得	有效	无
105	上海物骐微	滤波器系数确定方法、装置、电子设备及计算机存储介质	ZL202310791712.9	2023/6/30	发明	原始取得	有效	无
106	物奇科技	一种多接口高速电力线载波通信监听设备	ZL202321370342.3	2023/5/31	实用新型	原始取得	有效	无
107	上海物骐微	文件压缩方法、升级方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202210086693.5	2022/1/25	发明	原始取得	有效	无
108	上海物骐微	穿戴设备的佩戴检测方法及系统	ZL202210494262.2	2022/5/7	发明	原始取得	有效	无
109	上海物骐微	一种距离测量方法及系统	ZL202210494263.7	2022/5/7	发明	原始取得	有效	无
110	上海物骐微、 物奇微	一种补丁实现方法、装置、嵌入式系统及存储介质	ZL202210539897.X	2022/5/17	发明	原始取得	有效	无
111	上海物骐微	一种深度图像生成方法及系统	ZL202210831852.X	2022/7/14	发明	原始取得	有效	无
112	上海物骐微	呼吸监测方法、系统、无线设备及计算机可读取存储介质	ZL202211066357.0	2022/9/1	发明	原始取得	有效	无
113	上海物骐微	基于 Wi-Fi 信号的感知方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310369882.8	2023/4/7	发明	原始取得	有效	无
114	上海物骐微	网络部署寻优方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202310402693.6	2023/4/13	发明	原始取得	有效	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类别	取得方式	法律状态	他项权利
115	上海物骐微	DFE 抽头系数确定方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202310828349.3	2023/7/6	发明	原始取得	有效	无
116	上海物骐微	时钟分频电路及其相位同步方法、电子设备	ZL202210115661.3	2022/2/7	发明	原始取得	有效	无
117	物奇科技	一种网络编码传输方法、存储介质及固件升级方法	ZL202211153667.6	2022/9/21	发明	原始取得	有效	无
118	上海物骐微	资源分配方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202310094630.9	2023/1/31	发明	原始取得	有效	无
119	上海物骐微	基于信道状态信息的行为识别方法、装置、电子设备、存储介质	ZL202310197167.0	2023/3/1	发明	原始取得	有效	无
120	上海物骐微	行为识别方法及装置、电子设备、存储介质	ZL202310317666.9	2023/3/28	发明	原始取得	有效	无
121	上海物骐微、 物奇微	IQ 不平衡的校准方法、装置、电子设备、存储介质、计算机程序产品	ZL202410999134.2	2024/7/24	发明	原始取得	有效	无

注：根据《中华人民共和国专利法》第三十九条和四十条的规定，发明专利权和实用新型专利权自公告之日起生效；根据第四十二条的规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

上述第 5 项和第 12 项专利系由上海物骐所有变更为物奇科技所有，第 32 项专利系由物奇科技及航中天启（发行人曾经控股子公司）共同所有变更为物奇科技单独所有；第 6-11 项、第 17-31 项专利由物奇科技和上海物骐共同所有变更为由物奇科技单独所有，前述专利权利人变更的原因系发行人内部架构调整，不涉及其他外部第三方，不存在任何瑕疵、纠纷和潜在纠纷。

上述第 16 项专利系上海物骐微自物奇科技、北联微电子有限公司继受取得，除前述专利外发行人及其控股子公司不存在其他继受取得专利的情形，上海物骐微与北联微电子之间就前述专利不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司获得已授权境外专利共 20 项。

序号	权利人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	取得方式	法律状态	他项权利
1	物奇科技	美国	Method for low-voltage broadband power line carrier communication	US10992345B2	2018/3/19	原始取得	有效	无
2	物奇科技	美国	Method for spreading data symbol frequency domain information in power line carrier	US10819547B2	2018/3/19	原始取得	有效	无

序号	权利人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	取得方式	法律状态	他项权利
			communication					
3	物奇科技	美国	System and method for defrosting/ de-icing an air-conditioner	US11009283B2	2018/4/16	原始取得	有效	无
4	物奇科技	美国	System and Method for Switching Master and Slave Roles of Devices for Use in Wireless Communications	US11751283B2	2021/2/5	受让取得	有效	无
5	物奇科技	英国	System and Method for Switching Master and Slave Roles of Devices for Use in Wireless Communications	GB2596954	2021/2/5	受让取得	有效	无
6	物奇科技、 上海物骐微	英国	Method and System for Device Communication for Use in Wireless Communication System	GB2596955	2021/2/5	受让取得	有效	无
7	上海物骐微	美国	RAPID BLUETOOTH NETWORKING METHOD AND SYSTEM AND BLUETOOTH EARPHONES	US12119864B2	2022/11/4	原始取得	有效	无
8	上海物骐微	美国	Wireless Communication System and Wireless Communication Method	US11652577B2	2021/11/3	原始取得	有效	无
9	上海物骐微	日本	無線通信システム及び方法	特許第 7206565 号	2021/11/19	原始取得	有效	无
10	上海物骐微	欧洲	Wireless Communication System and Wireless Communication Method	EP4156562	2021/11/18	原始取得	有效	无
11	上海物骐微	美国	Audio Data Communication Method and Wireless Audio System	US11589151B1	2022/6/2	原始取得	有效	无
12	上海物骐微	日本	音声データ通信方法および無線音声システム	特許第 7220765	2021/11/9	原始取得	有效	无
13	上海物骐微	欧洲	Audio Data Communication Method and Wireless Audio System	EP4156577	2021/11/1	原始取得	有效	无
14	上海物骐微	日本	無線データ伝送システム及び方法	特許第 7288734 号	2021/12/22	原始取得	有效	无
15	上海物骐微	美国	WIRELESS DATA TRANSMISSION SYSTEM AND METHOD	US12126450B2	2021/12/22	原始取得	有效	无
16	上海物骐微	日本	主増幅回路及び高周波電力増幅器	特許第 7686684 号	2023/2/17	原始取得	有效	无
17	上海物骐微	日本	バイ アス 回路及び電力増幅器	特許第 7642693 号	2023/2/17	原始取得	有效	无
18	上海物骐微	美国	一种无线音频监听方法及无线音频系统 Wireless	US12432497B2	2023/12/19	原始取得	有效	无

序号	权利人	国家/地区	专利名称	专利号	申请日	取得方式	法律状态	他项权利
			audio monitoring method and wireless audio system					
19	上海物骐微	欧洲	WIRELESS DATA TRANSMISSION SYSTEM AND METHOD	EP4175368	2021/12/17	原始取得	有效	无
20	上海物骐微	美国	偏置电路及功率放大器 BIAS CIRCUIT AND POWER AMPLIFIER	US12494751B2	2023/2/15	原始取得	有效	无

（三）集成电路布图

截至 2025 年 12 月 31 日，公司获得集成电路布图设计共计 18 项。

序号	权利人	布图设计名称	布图设计登记号	申请日期	取得方式
1	上海物骐微	BEE 蓝牙音频 PMU 模块	BS.195607228	2019/8/27	受让取得
2	上海物骐微	BEE 蓝牙音频 Bandgap 模块	BS.19560721X	2019/8/27	受让取得
3	物奇微	PA1450IEEE1901.XandHomeplugGreenPHY 模拟前端芯片	BS.205010202	2020/8/14	原始取得
4	物奇微	WQ3001 电力线载波通信（集中器）芯片	BS.205010210	2020/8/14	原始取得
5	物奇微	电力线载波专用电源管理芯片	BS.205010229	2020/8/14	原始取得
6	上海物骐微	WQ7003 蓝牙音频芯片	BS.205009093	2020/7/22	原始取得
7	上海物骐微	低功耗窄带无线通信射频前端芯片	BS.205009107	2020/7/22	原始取得
8	上海物骐微	低功耗窄带无线通信基带芯片	BS.205009115	2020/7/22	原始取得
9	物奇科技	昆仑 3 芯片	BS.225550385	2022/5/12	原始取得
10	上海物骐微	Hawk 芯片	BS.235512524	2023/3/2	原始取得
11	上海物骐微	Kiwi 芯片	BS.235512532	2023/3/2	原始取得
12	上海物骐微	Hornet 芯片	BS.235575143	2023/9/8	原始取得
13	物奇科技、上海物骐微	Bifang 芯片	BS.255512384	2025/2/28	原始取得
14	物奇科技、上海物骐微	KUKA 芯片	BS.255513070	2025/3/4	原始取得
15	上海物骐微、物奇科技	WQ7036 芯片	BS.255513100	2025/3/4	原始取得
16	上海物骐微、物奇科技	WQ9201 芯片	BS.255513119	2025/3/4	原始取得
17	上海物骐微、物奇科技	WQ9201S 芯片	BS.255519133	2025/3/27	原始取得
18	上海物骐微、物奇科技	Brolga（WQ9301）Wi-Fi 6 AP 芯片	BS.255547145	2025/6/20	原始取得

（四）计算机软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有计算机软件著作权 62 项。

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
1	物奇科技	宽带载波管理软件 1.0	2017SR437229	未发表	2017/4/3	原始取得
2	物奇科技	物奇科技低压宽带载波固件软件 1.0	2017SR379308	未发表	2017/4/1	原始取得
3	珠海荣奇微电子科技有限公司、物奇科技	基于 PLC 宽带电力载波空调通讯系统 V1.0	2019SR0076993	未发表	2018/11/8	原始取得
4	物奇科技	PLC 宽带电力载波物联网通讯系统 V1.0	2023SR0273103	未发表	2018/5/26	受让所得
5	物奇科技	HPLC 抄控宝管理软件 V1.0	2023SR0273294	未发表	2018/10/26	受让所得
6	物奇科技	HPLC 生产测试软件 V1.0	2023SR0273296	未发表	2018/11/26	受让所得
7	物奇科技	HPLC 模块烧写软件 V1.0	2023SR0273295	未发表	2018/12/5	受让所得
8	物奇科技	HPLC 抄控器软件 V1.0	2023SR0273297	未发表	2018/12/2	受让所得
9	物奇科技	PLC 宽带电力载波物联网 GE 通讯系统 V1.0	2019SR0314325	未发表	2018/12/6	原始取得
10	物奇科技	HPLC 抄控宝固件系统 V1.0	2019SR0409402	未发表	2018/12/24	原始取得
11	物奇科技	宽带电力载波物联网路灯控制系统固件软件 V1.0	2020SR0984309	未发表	2019/3/28	受让所得
12	物奇科技	宽带电力载波充电桩系统固件软件 V1.0	2020SR0984290	未发表	2019/3/31	受让所得
13	物奇科技	PLC 物联网 GE 协议通讯软件 V1.0	2020SR0984302	未发表	2019/5/31	受让所得
14	物奇科技	能耗统计管理云系统 1.0	2020SR0984315	未发表	2019/8/30	受让所得
15	上海物骐微	蓝牙 OTA 无线升级软件（Android 版）V1.0	2023SR0273293	未发表	2019/10/28	受让所得
16	物奇科技和上海物骐微	物奇科技 3D 人脸识别固件软件 V1.0	2020SR1612701	未发表	2019/9/20	受让所得
17	上海物骐微和物奇科技	物骐科技 3D 结构光成像应用软件 V1.0	2020SR1612702	未发表	2019/7/15	受让所得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
18	物奇科技	能耗智能采集管理固件软件 V1.0	2020SR0984296	未发表	2019/7/15	受让所得
19	物奇科技	MCU 配置管理系统 V1.0	2020SR0198842	未发表	2019/10/28	原始取得
20	上海物骐微	物麒科技蓝牙产品测试软件 V1.0	2023SR0273031	未发表	2019/12/5	受让所得
21	上海物骐微	TWS 自动化测试系统 V1.0	2020SR0984000	未发表	2019/12/25	受让所得
22	上海物骐微	物麒科技蓝牙音频配置管理软件 V1.0	2020SR0984005	未发表	2019/11/16	受让所得
23	上海物骐微	物麒科技蓝牙产品 RF 测试软件 V1.0	2023SR0273030	未发表	2019/11/25	受让所得
24	上海物骐微	蓝牙固件烧录工具软件 V1.0	2020SR0983992	未发表	2019/10/8	受让所得
25	上海物骐微	低功耗电子价签管理软件 V1.0	2020SR0983983	未发表	2019/9/18	受让所得
26	上海物骐微	MIPI 触发程序软件 V1.0	2023SR0272908	未发表	2019/8/15	受让所得
27	上海物骐微	Dolphin 嵌入式音频配置软件 V1.0	2020SR1604640	未发表	2019/8/6	受让所得
28	上海物骐微	物麒科技音频芯片量产测试软件 V1.0	2023SR0272909	未发表	2019/12/23	受让所得
29	上海物骐微	物麒科技 AI 芯片量产测试软件 V1.0	2023SR0272910	未发表	2019/8/30	受让所得
30	上海物骐微	物麒科技 YUV 转 RGB 的程序软件 V1.0	2023SR0273019	未发表	2019/9/20	受让所得
31	上海物骐微	图像自动曝光软件 V1.0	2020SR1604639	未发表	2019/7/22	受让所得
32	物奇科技	光伏抄控器采集软件 V1.0	2024SR2081687	未发表	2020/7/5	受让所得
33	物奇科技	基于 BPLC 光伏智能采集系统 V1.0	2020SR1614346	未发表	2020/9/3	原始取得
34	物奇科技	光伏产测软件软件 V1.3	2020SR1614345	未发表	2020/9/4	原始取得
35	物奇科技	光伏组件数据采集系统 V1.0	2020SR1736106	未发表	2020/9/20	原始取得
36	上海物骐微	POS 设备安全启动软件 V1.0	2020SR1710347	未发表	2020/8/26	原始取得
37	上海物骐微	POS 设备烧录工具软件 V1.0	2020SR1723128	未发表	2020/9/1	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
38	物奇科技	物联网 MODBUS 控制协议 APP 固件	2021SR1684038	未发表	2021/9/7	原始取得
39	物奇科技	基于 TSILA002-2021 电力线载波通信（PLC）工业照明互联规范的 PLC-IOT 通信软件	2021SR1663254	未发表	2021/9/9	原始取得
40	物奇科技	PLC 路灯控制器系统 V1.0	2021SR1777152	未发表	2020/9/1	原始取得
41	物奇科技	DLT645 和 MODBUS 自适应 PLC 透传软件 V1.0	2021SR1783336	未发表	2021/8/1	原始取得
42	物奇科技	物联网集中器多通道数据转发系统 V1.0	2021SR1783410	未发表	2021/2/9	原始取得
43	上海物骐微	蓝牙 OTA 无线升级软件（Android 版）V2.0	2022SR0092794	未发表	2020/8/26	原始取得
44	上海物骐微	蓝牙耳机固件配置应用程序 V1.0	2022SR0085570	未发表	2021/5/26	原始取得
45	物奇科技	AMP 框架核间通讯软件 V1.0	2022SR0400543	未发表	2022/2/10	原始取得
46	物奇科技	交互式固件烧录方案 V1.0	2022SR0974297	未发表	2022/3/4	原始取得
47	物奇科技	国网 12087 双模通信协议固件软件 V1.0	2023SR0036358	未发表	2022/3/1	原始取得
48	物奇科技	IEEE1901 通信协议固件软件 V1.0	2023SR0186735	未发表	2022/6/1	原始取得
49	物奇科技	电网双模物理层自动化测试软件 V1.0	2023SR1260264	未发表	2022/10/13	原始取得
50	上海物骐微	蓝牙 OTA 无线升级软件（iOS 版）V1.0	2023SR0394765	未发表	2023/1/9	原始取得
51	上海物骐微	物骐蓝牙耳机双连接音频管理软件 V1.0	2023SR1425572	未发表	2023/8/8	原始取得
52	上海物骐微	Wi-FiSDIOHost 驱动软件 V1.0	2024SR0098478	未发表	2023/1/2	原始取得
53	物奇科技、长沙物奇微	USB 通用调试工具软件 V1.0	2024SR0858185	未发表	2024/4/17	原始取得
54	上海物骐微、物奇科技	BluetoothUSBHost 驱动软件 V1.0	2024SR1471786	未发表	2022/12/16	原始取得
55	物奇科技、上海物骐微	基于 WUQILR-WiFi 技术的 IPC 方案应用软件 V1.0	2024SR1533011	未发表	2024/7/25	原始取得
56	物奇科技、上海物骐微	Wi-FiUSBHost 软件 V1.0	2024SR1531916	未发表	2024/8/15	原始取得
57	物奇科技、上海物骐微	应用于 Wi-Fi 高质量视频流传输的 USB 驱动软	2024SR1572924	未发表	2024/8/15	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
		件 V1.0				
58	物奇科技、上海物骐微	应用于 Wi-Fi 高质量视频流传输的 SDIO 驱动软件 V1.0	2024SR1568786	未发表	2024/8/5	原始取得
59	物奇科技、长沙物奇微	基于 3D 结构光和人脸识别的智能锁模组应用软件 V1.0	2024SR1595529	未发表	2024/6/6	原始取得
60	物奇科技、长沙物奇微	基于多模态的智能锁模组应用软件 V1.0	2024SR1603174	未发表	2024/7/15	原始取得
61	物奇科技、长沙物奇微	猫眼智能锁模组应用软件 V1.0	2024SR1595540	未发表	2024/8/20	原始取得
62	上海物骐微、物奇科技	基于 Wi-Fi 6 网络环境的 WUQI 云电脑应用软件 V1.0	2025SR0529532	未发表	2024/12/15	原始取得

九、发行人曾经的关联方

除前述关联方外，下列主体亦属于发行人曾经的关联方：（1）发行人报告期内曾经的董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员；（2）发行人现任董事、高级管理人员、原监事及其关系密切的家庭成员曾经直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织；（3）发行人报告期内曾任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

发行人曾经的关联方主要列举如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	NELLIEBELLY BAKERY LLC	发行人实际控制人的女儿 Nina Li ZHENG 曾持有 100% 股权且担任执行经理的企业，已于 2023 年 2 月注销
2	上海长卫宜斯软件系统有限公司	公司董事兼副总经理马云峰曾担任执行董事兼总经理的企业，已于 2025 年 12 月辞任
3	方伟	2024 年 6 月至 2026 年 2 月担任公司董事
4	锐石创芯（重庆）科技股份有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
5	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
6	武汉昱升光电股份有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
7	上海安其威微电子科技有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
8	北京中科海钠科技有限责任公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
9	济南晶正电子科技有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
10	上海本诺电子材料有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
11	宁波赛墨科技有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业
12	南京芯视界微电子科技有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业；公司曾任董事盛建宏曾任董事的企业，已于 2024 年 8 月辞任
13	辽宁中蓝电子科技有限公司	公司曾任董事方伟担任董事的企业；公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2023 年 12 月辞任
14	南通山口精工股份有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 5 月辞任；公司曾任董事盛建宏曾任董事的企业，已于 2023 年 12 月辞任
15	山东天岳先进科技股份有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 4 月辞任
16	南京中江新材料科技有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 3 月辞任
17	上扬软件（上海）有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 3 月辞任

序号	关联方名称	关联关系
18	北京清程极智科技有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 3 月辞任
19	深迪半导体（绍兴）有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 2 月辞任
20	北京面壁智能科技有限责任公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 2 月辞任
21	云南鑫耀半导体材料有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2026 年 1 月辞任
22	北京云道智造科技有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2025 年 12 月辞任
23	苏州东微半导体股份有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2025 年 7 月辞任
24	中电科技德清华莹电子有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2024 年 8 月辞任
25	湖南浩威特科技发展有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2023 年 8 月辞任
26	广东富信热电器件科技有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2023 年 7 月辞任
27	成都睿宝电子科技有限公司	公司曾任董事方伟曾担任董事的企业，已于 2023 年 7 月辞任
28	陈波	2020 年 5 月至 2025 年 8 月担任公司董事
29	重庆市渝北国有资本投资有限公司	公司曾任董事陈波担任董事的企业
30	重庆科兴科创股权投资基金管理有限公司	公司曾任董事陈波担任董事的企业
31	盛建宏	2023 年 2 月至 2024 年 6 月担任公司董事
32	阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2024 年 6 月辞任
33	东莞羽笙科技有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2024 年 3 月辞任
34	美芯晟科技（北京）股份有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2024 年 1 月辞任
35	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2024 年 1 月辞任
36	吉林求是光谱数据科技有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2024 年 1 月辞任
37	厦门云天半导体科技有限公司	公司曾任董事盛建宏曾担任董事的企业，已于 2023 年 7 月辞任
38	何刚	2021 年 9 月至 2023 年 2 月担任公司董事
39	王宇	2020 年 5 月至 2023 年 2 月担任公司董事
40	重庆南方工业私募股权投资基金管理有限公司	公司曾任董事王宇担任副总经理兼财务负责人的企业
41	航天新通科技有限公司	公司曾任董事王宇担任董事的企业
42	河南镀膜光电股份有限公司	公司曾任董事王宇担任董事的企业
43	苏州雄立科技有限公司	公司曾任董事王宇担任董事的企业
44	南方德茂（北京）资本管理有限公司	公司曾任董事王宇担任董事长的企业

序号	关联方名称	关联关系
45	成都睿沿科技有限公司	公司曾任董事王宇担任董事的企业
46	南方德茂资本管理有限公司	公司曾任董事王宇担任副总经理的企业
47	北京亮道智能汽车技术有限公司	公司曾任董事王宇曾担任董事的企业，已于 2024 年 6 月辞任
48	上海金卓科技有限公司	公司曾任董事王宇曾担任董事的企业，已于 2023 年 8 月辞任
49	神经元信息技术（成都）有限公司	公司曾任董事王宇担任董事的企业
50	ALLEN YEN	2020 年 5 月至 2023 年 2 月担任公司董事
51	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
52	重庆睿博光电股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
53	重庆蓝岸科技股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
54	艾欧创想智能科技（武汉）有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
55	深圳市思坦科技有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
56	润科投资管理（上海）有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事总经理的企业，已于 2023 年 10 月辞任
57	润高达（东莞）科技有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事长兼总经理的企业，已于 2023 年 10 月辞任，该企业已于 2025 年 2 月注销
58	无锡硅动力微电子股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
59	广东美信科技股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
60	瓴尊投资管理（广东横琴新区）合伙企业（有限合伙）	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任执行事务合伙人并持有 39.50%财产份额的企业，已于 2023 年 10 月不再担任执行事务合伙人
61	福建国光新业科技股份有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
62	深圳市开步电子有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
63	武汉理岩控制技术有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月辞任
64	矽磐微电子（重庆）有限公司	公司曾任董事 ALLEN YEN 曾担任董事的企业，已于 2022 年 7 月辞任
65	熊飞	2021 年 1 月至 2023 年 2 月担任公司董事，且为报告期内曾持有公司 5%以上股份的股东
66	蒋涛	2019 年 1 月至 2023 年 2 月担任公司监事
67	重庆临港智联电子商务有限公司	公司曾任监事蒋涛担任董事的企业
68	周雪	2018 年 7 月至 2023 年 2 月担任公司监事

序号	关联方名称	关联关系
69	陶文岩	2023 年 2 月至 2025 年 8 月担任公司监事
70	杨红	2023 年 2 月至 2025 年 8 月担任公司监事
71	孙凤霞	2023 年 2 月至 2025 年 8 月担任公司监事
72	韩雪冬	2021 年 12 月至 2023 年 10 月，担任公司财务总监；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，担任公司董事会秘书
73	安徽骁柔健康科技集团有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬担任首席财务官及财务负责人的企业
74	成都双流护佑互联网医院有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬担任董事的企业
75	合肥盛耀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬担任执行事务合伙人的企业
76	罗定市壹心德馨口腔门诊有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬曾担任董事的企业，已于 2024 年 5 月辞任
77	广州牙医植雅口腔门诊部有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬曾担任董事的企业，已于 2024 年 4 月辞任
78	广州市艺德口腔门诊有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬曾担任董事的企业，该企业已于 2022 年 8 月注销
79	河南美维口腔医疗管理有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬曾担任董事的企业，已于 2022 年 7 月辞任
80	武汉中口互连口腔医疗连锁管理有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬曾担任董事的企业，已于 2022 年 7 月辞任
81	上海方冰商务咨询有限公司	公司曾任财务总监兼董事会秘书韩雪冬的配偶持股 100%且担任执行董事的企业
82	王方明	2023 年 3 月至 2026 年 2 月担任公司独立董事
83	智联讯科	公司曾持股 100%的企业，已于 2023 年 12 月注销
84	上海物麒	物奇科技曾持股 100%的企业，已于 2024 年 2 月注销
85	鼎精投资	郑建生曾持有财产份额的企业，已于 2026 年 6 月退出
86	深圳市江波龙电子股份有限公司	郑建生曾担任独立董事的企业，已于 2024 年 6 月辞任
87	华奇恒	公司曾经的员工持股平台，已于 2024 年 1 月 26 日注销